创业板风险提示

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决策。

鸿星科技（集团）股份有限公司

HOSONIC TECHNOLOGY （GROUP） CO.,LTD.

（浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号）

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

国投证券股份有限公司
SDIC SECURITIES CO., LTD.

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

致投资者声明

一、发行人上市的目的

鸿星科技是一家专注于石英晶体谐振器、振荡器等频率控制元器件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司希望通过上市，一是优化公司治理结构，提升透明度，尊重并积极吸纳每一位投资者的声音，确保公司运作的规范与高效；二是吸引与激励行业精英，以自主创新为驱动，增强研发技术实力，持续提升国产基础电子元器件在全球的话语权，助力新质生产力发展；三是建立多元化的融资渠道，满足公司长期发展的资金需求，增强抗风险能力。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司已建立一套科学、高效的现代企业制度，确保了公司治理结构的健全与内部控制体系的完善。公司股东会、董事会及管理层各司其职，相互独立又相互监督，保障了公司治理制度均能得到有效执行。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

本次发行的募集资金将投资于“新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目”“新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目”“基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目”和“数智化制造与运营管理平台升级建设项目”。

这些投资将助力公司实现产能的高水平建设，提升生产效率，推进产品迭代升级，同时提升公司技术优势及研发成果转化能力，进而增强公司的市场竞争力。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

秉承“立足中国，面向世界”的使命和“以先进技术、优异品质、完善服务，成为晶体产业最具竞争优势的品牌”的愿景，经过三十余年发展，公司积极防范和应对各种不利风险因素，并成长为国际知名的石英晶体元器件生产商，

具备良好的持续经营能力。

未来，公司将继续深耕石英晶体元器件行业，加强自主创新，持续为客户提供质量稳定、高性能的产品，巩固和扩大在全球石英晶振行业的优势，为投资者创造更大的价值。

董事长签名：林洪河

林洪河

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型	境内上市人民币普通股（A 股）
发行股数	不超过 4,930.6188 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不超过 19,720.00 万股
保荐人、主承销商	国投证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

致投资者声明 1
一、发行人上市的目的 1
二、发行人现代企业制度的建立健全情况 1
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 1
四、发行人持续经营能力及未来发展规划 1
发行人声明 3
本次发行概况 4
目 录 5
第一节 释义 9
第二节 概览 15
一、重大事项提示 15
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 16
三、本次发行概况 16
四、公司主营业务 18
五、发行人符合创业板定位 19
六、主要财务数据和财务指标 26
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 26
八、发行人选择的具体上市标准 26
九、公司治理特殊安排等重要事项 27
十、募集资金运用与未来发展规划 27
第三节 风险因素 29
一、与发行人相关的风险 29
二、与行业相关的风险 33
三、其他风险 34
第四节 发行人基本情况 35
一、公司基本情况 35
二、公司设立情况 35
三、报告期内股本、股东变化情况 37

四、公司成立以来的重要事件.....39
五、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况.....40
六、公司股权结构.....40
七、子公司及参股公司的基本情况.....40
八、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况.....41
九、发行人股本情况.....46
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.....53
十一、发行人申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励.....65
十二、发行人员工情况.....65
第五节 业务与技术.....68
一、公司主营业务、主要产品的基本情况.....68
二、公司所处行业基本情况.....83
三、公司主营业务的具体情况.....113
四、公司主要固定资产和无形资产.....119
五、公司技术与研发情况.....130
六、环境保护与安全生产情况.....140
七、公司境外生产经营和境外资产状况.....142
第六节 财务会计信息与管理层分析.....144
一、财务报表.....144
二、财务报表审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准.....149
三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况.....151
四、主要会计政策和会计估计.....151
五、非经常性损益.....177
六、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种.....178
七、分部信息.....180
八、财务指标.....180
九、经营成果分析.....182
十、资产质量分析.....211
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....229

十二、重大资本性支出与资产业务重组情况.....243
十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项.....243
十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....244
第七节 募集资金运用与未来发展规划 245
一、本次募集资金运用概况.....245
二、募集资金运用具体情况.....249
三、发行人未来发展规划及目标.....250
第八节 公司治理与独立性 254
一、公司治理概况.....254
二、公司内部控制情况.....254
三、报告期违法违规行为情况.....255
四、报告期内资金占用和对外担保情况.....255
五、公司独立持续经营能力.....255
六、同业竞争.....257
七、关联方及关联交易.....260
第九节 投资者保护 271
一、本次发行前滚存利润的分配安排.....271
二、发行人报告期内股利分配政策和实际股利分配情况.....271
三、本次发行后的股利分配政策.....272
第十节 其他重要事项 279
一、重大合同.....279
二、对外担保情况.....282
三、诉讼或仲裁事项.....283
第十一节 董事、高级管理人员及有关中介机构声明 288
一、发行人全体董事、高级管理人员声明.....288
二、控股股东、实际控制人声明.....290
三、保荐机构（主承销商）声明.....291
四、发行人律师声明.....294
五、会计师事务所声明.....295

六、承担评估业务的资产评估机构声明.....296
七、验资机构声明.....297
八、验资复核机构声明.....298
第十二节 附件 299
一、备查文件.....299
二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....299
三、与投资者保护相关的承诺.....304
四、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.....328
五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况.....331
六、募集资金具体运用情况.....331
七、子公司及参股公司的基本情况.....338

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、普通术语

本公司、公司、发行人、股份公司、鸿星科技	指	鸿星科技（集团）股份有限公司
鸿星有限	指	杭州鸿星电子有限公司，公司前身
H-TEC	指	H-TEC HOLDING LIMITED，公司控股股东
FORTUNE	指	FORTUNE BRILLIANT HOLDINGS LIMITED，H-TEC股东
GOLD HARVEST	指	GOLD HARVEST HOLDING LIMITED，H-TEC股东
WISE	指	WISE ELEGANT HOLDING LIMITED，H-TEC股东
SHINE	指	SHINE CREATION HOLDING LIMITED，H-TEC 股东
NICE	指	NICE CREATION HOLDING LIMITED，H-TEC 股东
JOINT	指	JOINT GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED，公司股东
PERFECT	指	PERFECT TEAM TRADING LIMITED，公司股东
KSP	指	KSP ONE CO., LTD.，公司股东
DYNAMIC	指	DYNAMIC FORTUNE ENTERPRISES LIMITED，公司股东
LYH	指	LYH INVESTMENT LIMITED，公司股东
GOLDRICH	指	GOLDRICH GLOBAL INC.，公司股东
LINKRICH	指	LINKRICH GLOBAL INC.，公司股东、员工持股平台
杭州纮洋	指	杭州纮洋企业咨询合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持股平台
杭州澜洋	指	杭州澜洋企业咨询合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持股平台
杭州湛洋	指	杭州湛洋企业咨询合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持股平台
杭州湟江	指	杭州湟江企业咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
珠海博浩	指	珠海博浩企业管理咨询有限公司，公司关联方、曾经的股东
华瑞电子	指	杭州华瑞电子设备成套厂，公司曾经的股东
浙江鸿星	指	浙江鸿星电子科技有限公司，公司全资子公司
金华鸿瑞	指	金华鸿瑞电子有限公司，公司全资子公司
湖州鸿皓	指	湖州鸿皓电子新材料有限公司，公司全资子公司
东莞佳晟	指	东莞市佳晟电子有限公司，公司全资子公司
鸿星国际	指	鸿星国际电子有限公司，英文名 HOSONIC INTERNATIONAL LIMITED，公司全资子公司
鸿星企业	指	鸿星国际企业有限公司，英文名 HOSONIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED，公司全资子公司

HOSONIC GLOBAL	指	鸿星全球投资有限公司，HOSONIC GLOBAL INVESTMENT LIMITED，公司全资子公司
HOSONIC JAPAN	指	株式会社 HOSONIC JAPAN，公司全资二级子公司
HOSONIC THAI	指	Hosonic Timetec Thai Co., Ltd.，公司控股二级子公司
江阴鸿翔	指	江阴鸿翔电子有限公司，公司曾经的二级子公司
珠海鸿皓	指	珠海鸿皓科技有限公司，公司曾经的全资子公司
杭州子海	指	杭州子海企业管理有限公司，公司关联方
杭州圣瀚	指	杭州圣瀚企业管理有限公司，公司关联方
杭州凡翔	指	杭州凡翔技术咨询有限公司，公司关联方
金图控股	指	金图控股有限公司，英文名 GOLD PROJECT HOLDINGS LIMITED，公司关联方
丰诠投资	指	丰诠投资股份有限公司，公司关联方
台湾鸿星	指	鸿星电子股份有限公司，公司关联方
美国鸿星	指	HOSONIC ELECTRONIC （AMERICA） CORPORATION，公司关联方
HOLDING	指	HOSONIC HOLDING CORPORATION，公司关联方
GOODMARK	指	GOODMARK INTERNATIONAL INC，公司关联方
BEGONIA	指	BEGONIA HOLDINGS LIMITED，公司关联方
宝海星业	指	宝海星业有限公司，英文名 GOLDEN RICH OCEAN INVESTMENT LIMITED，公司关联方
宇柏投资	指	宇柏投资有限公司，英文名 UNION PRO INVESTMENT LIMITED，公司曾经的关联方
MARS	指	MARS PRINCESS INTERNATIONAL LIMITED，公司曾经的关联方
珠海鸿硕	指	鸿硕设备租赁（珠海）有限公司，曾用名鸿硕科技（珠海）有限公司，公司关联方
鸿升创建	指	鸿升创建有限公司，英文名 HUGO SUCCESS CREATION LTD.，公司关联方
深圳鸿升	指	深圳鸿升创建贸易有限公司，公司关联方
创宇股份	指	创宇股份有限公司，英文名 CREATE META LIMITED，公司关联方
创宇台湾分公司	指	香港商创宇股份有限公司台湾分公司，公司关联方
杭州典河	指	杭州典河企业管理有限公司，公司关联方
POWERCORP	指	POWERCORP LIMITED，公司关联方
爱儿堡	指	美国爱儿堡国际教育研究中心，公司关联方
洪福电子	指	洪福电子公司，英文名 HOWARD ELECTRONIC CO.，公司曾经的关联方
VEHICOMN	指	VEHICOMN CORPORATION LIMITED，公司曾经的关联方
利联科技	指	利联科技股份有限公司，公司曾经的关联方
科视电子	指	台湾科视电子股份有限公司，公司曾经的关联方

冠捷科技	指	冠捷科技有限公司，英文名 DYNATEQ LIMITED，公司曾经的关联方
HTD	指	HOSONIC TRADING LIMITED，公司曾经的关联方
珠海鸿康	指	鸿康电子（珠海）有限公司，公司曾经的关联方
杭州鸿亿	指	鸿亿电子科技（杭州）有限公司，公司曾经的关联方
客户 A	指	客户 A 及其下属公司
客户 B	指	客户 B 及其下属公司
客户 C	指	客户 C 及其下属公司
客户 D	指	客户 D 及其下属公司
富士康	指	鸿海精密工业股份有限公司，中国台湾地区上市公司，证券代码 2317，系全球最大电子制造服务商之一，本招股说明书泛指鸿海及其下属公司。该公司为发行人客户
客户 H	指	客户 H 及其下属公司
商络电子	指	南京商络电子股份有限公司，深交所上市公司，证券代码：300975，是国内领先的电子元器件分销商之一，主要面向网络通信、汽车电子、工业控制、消费电子等应用领域的电子产品制造商，为其提供电子元器件产品。该公司为发行人客户
伟创力	指	Flex Ltd.，伟创力国际有限公司，系美国纳斯达克上市公司，证券代码 FLEX，全球著名 OEM 厂商，伟创力的业务涉足多个行业,为航空航天、汽车、计算机、工业、消费品、基础设施、医疗等多个领域提供完整的设计、工程和制造服务。本招股说明书泛指伟创力及其下属公司。该公司为发行人客户
长虹	指	四川长虹电子控股集团有限公司，旗下四川长虹电器股份有限公司系上交所上市公司，证券代码 600839，为集智慧家居、核心器件研发与制造、ICT 综合服务等业务为一体的全球化、综合型科技企业集团，2025 年，位列四川省数字经济企业第 1 位、中国电子信息百强第 13 位、世界品牌 500 强第 279 位。本招股说明书泛指长虹及其下属公司。该公司为发行人客户
客户 I	指	客户 I 及其下属公司
客户 J	指	客户 J 及其下属公司
三环集团	指	潮州三环（集团）股份有限公司，系深交所上市公司，证券代码 300408，主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要包括通信部件、半导体部件、电子元件及材料、压缩机部件、新材料等的生产和研发，产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。本招股说明书泛指三环公司及其下属公司。该公司为发行人的供应商
时尚科技	指	时尚科技（香港）股份有限公司，主营业务为代理销售电子零件，是日本特殊陶业（NGK）指定经销商。该公司为发行人的供应商
京瓷集团	指	KYOCERA CORPORATION，即京瓷株式会社，日本东京证券交易所上市公司，证券代码 6971。该集团在全球的业务领域涉及原料、零件、设备、机器，以及服务、网络等各个领域。该公司为发行人的供应商
日本特殊陶业（NGK）	指	Niterra Co., Ltd.，日本东京证券交易所上市公司，证券代码为 5334，成立于 1936 年，业务包括汽车传感器、汽车火花塞、先进陶瓷、半导体封装外壳、陶瓷基座、上盖、切削工具等。该公司为发行人主要原

		材料的生产厂商
西铁城	指	CITIZEN FINEDEVICE CO.,LTD.，中文全称西铁城精密器件株式会社，系日本上市公司西铁城时计株式会社（Citizen Watch Co., Ltd.，东京证券交易所，证券代码：7762）的全资子公司，主要从事汽车零部件、晶体振荡器、晶体谐振器以及晶片、映像用电子设备、薄膜底座、陶瓷产品、工业用机械设备、精密测量仪器、小型精密金属加工零部件等。该公司为发行人的供应商
国网电力	指	国网浙江省电力有限公司及其下属公司，以建设和运营电网为核心业务。该公司为发行人的供应商
BVI	指	THE BRITISH VIRGIN ISLANDS，英属维尔京群岛
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商	指	国投证券股份有限公司
会计师、立信、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
银信评估、资产评估机构	指	银信资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、报告期各期	指	2023 年、2024 年和 2025 年
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日
二、专业术语		
晶振、石英晶振	指	石英晶振（Quartz Crystal Oscillator）是一种谐振器件，通过石英晶体的压电效应将电信号转化为机械振动，再将机械振动转化为稳定的电信号，从而提供精确的频率输出，确保电子电路正常运行
谐振器、晶体谐振器、无源晶振	指	晶体谐振器是通过在石英晶片两面镀上电极而构成的频率元件。交变信号加载至电极两端时，谐振器依靠压电效应稳定起振于特定频率；谐振频率与晶片厚度、切割工艺密切相关，经由精密加工，可实现指定频率输出
TSX、热敏晶振	指	Temperature Sensing Crystal，译为“热敏晶振”。一种内置 NTC 热敏电阻的无源晶体谐振器，可同时提供基准频率与温度传感信号，用于温度补偿和测温的无源元件
音叉型石英晶体谐振器、音叉型谐振器	指	Tuning Fork Crystal Resonator 的缩写，译为“音叉型石英晶体谐振器”。因其材料晶片经精密加工后外观形似音叉的晶体谐振器而得名。其晶片通常采用 Z 切割方式制成，通过弯曲振动模式工作，频率范围主要为 32.768kHz 为主
振荡器、晶体振荡器、有源晶振	指	晶体振荡器是晶体谐振器和振荡电路（IC）集成在一个封装中，由于晶体单元和振荡电路之间的匹配调整已经完成，因此可输出高稳定度的频率信号。可广泛应用于通信设备、系统时钟、传感检测、工业控制等对频率源要求严苛的领域
SPXO、普通晶体振荡器	指	Simple Packaged Crystal Oscillator 的缩写，译为“普通晶体振荡器”。SPXO 是一种不进行温度补偿和温度控制的晶体振荡器，其温度特性

		完全由晶体谐振器和振荡电路（IC）的温度特性决定，此应用最为广泛
VCXO、压控晶体振荡器	指	Voltage Controlled Crystal Oscillator 的缩写，译为“压控晶体振荡器”，VCXO 是具有通过外加电压控制振荡频率的功能
差分振荡器	指	Differential Crystal Oscillator 的缩写，输出差分的两个信号幅度相同、相位差 180°，使用此特点来消除共模噪声。差分振荡器输出类型分为 LV-PECL、LVDS、HCSL 等种类
LV-PECL	指	Low Voltage Positive Emitter Coupled Logic 缩写，译为“低电压正发射极耦合逻辑”，一种高速差分逻辑接口，由 ECL 技术发展而来，采用低电压的正电源供电，输出摆幅较小，适用于时钟分配及高频信号传输
LVDS	指	Low Voltage Differential Signaling 缩写，译为“低电压差分信号”，采用一对差分信号线传输数据，使用极低的电压摆幅（通常为±350mV 左右），在保持高速传输的同时，显著降低功耗和电磁干扰。是一种用于高速数据传输的电信号传输技术
HCSL	指	High-Speed Current Steering Logic 缩写，译为“高速电流转向逻辑“，为差分电流驱动高速接口架构，广泛应用于时钟缓冲器、PCIe 参考时钟分发场景，具备边沿控制精准、低抖动、抗干扰强的特性
TCXO、温补晶体振荡器	指	Temperature Compensate Crystal Oscillator 的缩写，译为“温度补偿晶体振荡器"。TCXO 是一种通过内置温度补偿电路来补偿环境温度变化对振荡频率影响的石英晶体振荡器
OCXO、恒温晶体振荡器	指	Oven Controlled Crystal Oscillator 的缩写，译为“恒温晶体振荡器”，为了提供更高的稳定性，内部配备一个小型恒温槽来放置晶体器件，来防止因外界温度变化引起的频率漂移。OCXO 主要用于测量系统和基站通信设备等设备
PLL	指	锁相环（Phase Locked Loop）的缩写。是基于特定频率的时钟信号，在具备 PLL 电路的晶体振荡器中，可通过编程设定任意输出频率电路或 IC
相位噪声	指	相位噪声（Phase Noise）是晶体振荡器受电路内部扰动与外部环境噪声影响，在工作振荡频率邻近频段所产生的热噪声、非线性效应或其他随机扰动，产生短期、快速、随机的相位波动
相位抖动	指	相位抖动（Phase Jitter）是时钟信号在理想边沿与实际边沿在时间上的随机偏移。在每一个上升/下降沿前后，随着时间信号边沿位置偏离理想位置的微小移动，这微小移动大小就是相位抖动
DIP	指	Dual In-Line Package 的缩写，译为“双列直插式元件”，此封装形式适合穿孔式 PCB，布线较为方便等特点，主要产品为 49U、49S
SMD	指	Surface-Mount Device 的缩写，译为“表面贴装元件”，属于一种压电石英晶体元器件生产封装技术。表面贴装元件相较于传统插装元件，具有组装密度高、产品体积小、重量轻、可靠性高、抗振能力强和高频特性好等优点
MCU	指	Microcontroller Unit，微控制单元（或称单片机），将处理器、存储器、I/O 接口等集成于一体的芯片，广泛用于嵌入式控制场景
GPU	指	Graphics Processing Unit，是最初专为图形渲染流水线并行处理所设计的众核处理器，具备海量算术逻辑单元与高显存带宽；通过 GPGPU 架构实现通用并行计算，广泛应用于科学计算、AI 训练推理等算力场景
NPU	指	Neural Processing Unit，神经网络处理器。针对卷积、矩阵乘、激活函数等深度学习算子进行数据流与计算架构优化的专用处理器，常采用脉动阵列与稀疏计算技术，在低功耗下提供高能效的 AI 推理能力

DSP	指	Digital Signal Processor，数字信号处理器，专门用于高速数字信号处理（如滤波、FFT）的微处理器
频率（MHz、kHz）	指	频率是描述周期性过程中每单位时间内重复事件次数的物理量，国际单位为 Hz。1000Hz 等于 1kHz，1000000Hz 等于 1MHz
ppm、ppb	指	描述极高精度频率稳定度或频率误差的参数。在基准温度时，工作频率相对于标称频率的最大允许偏离，单位用 ppm（百万分之一）、ppb（十亿分之一）来表示。此值越小表示精度越高
fs（飞秒）	指	用于描述输出信号的相位噪声，所对应的时域抖动的参数。此值越小表示时间精度高或信号纯净度越好
AIoT	指	人工智能物联网（Artificial Intelligence of Things），指人工智能技术与物联网基础设施的融合，通过在终端、边缘或云端部署机器学习模型，实现设备的智能感知、自主决策与协同控制
5G-A	指	5G-Advanced，即增强型第五代移动通信技术，是 5G 向 6G 演进过程中的中间标准版本（3GPP Release 18 及以上），在带宽、时延、连接密度及通感一体化等方面较 5G 有显著提升
6G	指	第六代移动通信技术（Sixth Generation Mobile Networks），预计在 5G 基础上实现太比特级峰值速率、亚毫秒级时延、空天地海一体化覆盖及通信感知计算融合等能力
LPWAN	指	低功耗广域网（Low-Power Wide-Area Network），一类为远距离、低数据速率、低功耗物联网场景设计的无线通信技术，典型制式包括 LoRa、NB-IoT、Sigfox，适用于智能表计、资产追踪及环境监测
QAM	指	正交幅度调制（Quadrature Amplitude Modulation），一种通过同时改变载波的同相分量（I 路）与正交分量（Q 路）的幅度来传递数字信息的调制方式
Wi-Fi 7	指	第七代无线传输技术，相比上一代技术具有更快传输速度，以及高吞吐、低延时、抗干扰、广覆盖等众多升级
Wi-Fi 8	指	第八代无线传输技术，目前技术标准尚在制定中，根据公开资料和标准草案，相比上一代技术将强化多链路并发、更精细的时延控制与调度、面向海量终端的连接管理
PMIC	指	电源管理集成电路（Power Management Integrated Circuit），负责电能的变换、分配、检测与时序控制，为各类电子系统提供精细化电源管理
UWB	指	超宽带（Ultra-Wideband），一种无载波短距无线通信技术，兼具高精度定位与数据通信能力，具备低功耗、强抗干扰特性
IMU	指	惯性测量单元（Inertial Measurement Unit），集成陀螺仪与加速度计等惯性传感器，用于测量角速度与线性加速度，解算物体的姿态与运动状态
VMI	指	Vendor Managed Inventory，供应商管理库存，即供应商将物料送至客户指定的仓库存放，由客户代为保管，但所有权归供应商所有，客户根据需要从仓库中领用物料，转移所有权

注：1、本招股说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致；

2、本招股说明书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息，由于引用不同来源的统计信息可能其统计口径有一定的差异，故统计信息并非完全具有可比性。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）重大风险因素

发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容。

1、毛利率下降和经营业绩波动风险

石英晶振下游应用领域受宏观经济环境、居民收入水平、消费者消费偏好等因素影响，呈现出一定的周期性，与宏观经济形势息息相关。

近年来，受到宏观经济波动、地缘冲突等因素影响，市场竞争加剧，公司主要产品售价呈下降态势。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 45.06%、42.01%和 37.54%，毛利率亦有所下降。未来，若市场竞争持续加剧，或公司未能跟紧行业技术发展趋势、保持研发技术优势或者持续优化产品结构，致使主要产品销售价格下降，但产品成本不能保持同步下降，可能会使得公司毛利率下降，从而影响公司的经营业绩。

2、供应商集中且芯片依赖进口风险

报告期内，公司向前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 65.61%、61.05%和 60.59%，采购集中度较高。公司主要原材料的主要生产厂商为三环集团、京瓷集团和日本特殊陶业（NGK）。同时，公司振荡器产品主要原材料芯片存在进口依赖。若未来公司主要原材料供应商的经营情况、销售政策、上游原材料供应格局和国际贸易环境等发生重大不利变化，公司的主要原材料采购情况将面临承压，进而对生产经营活动产生一定影响。

（二）相关重要承诺事项

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、高级管理人员及中介机构作出的重要承诺，相关承诺事项详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、

与投资者保护相关的承诺”的相关内容。

（三）利润分配政策的安排

本公司提示投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“三、本次发行后的股利分配政策”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	鸿星科技（集团）股份有限公司	**成立日期**	1993 年 12 月 31 日
注册资本	14,789.3812 万元	**法定代表人**	林洪河
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号	**主要生产经营地址**	浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号
控股股东	H-TEC HOLDING LIMITED	**实际控制人**	林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	**在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况**	无
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	国投证券股份有限公司	**主承销商**	国投证券股份有限公司
发行人律师	上海市锦天城律师事务所	**其他承销机构**	无
审计机构、验资机构、验资复核机构	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	**资产评估机构**	银信资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		无	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**	**收款银行**	
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况	
股票种类	境内上市人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元

发行股数	不超过 4,930.6188 万股	**占发行后总股本比例**	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 4,930.6188 万股	**占发行后总股本比例**	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	**占发行后总股本比例**	-
发行后总股本	不超过 19,720.00 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（发行价格除以发行后每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元/股（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）	**发行前每股收益**	【】元/股（以【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元/股（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	**发行后每股收益**	【】元/股（以发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立股票交易账户的自然人、法人、机构等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目		
	新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目		
	基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目		
	数智化制造与运营管理平台升级建设项目		
发行费用概算	承销、保荐费用	【】万元	
	审计、验资及评估费用	【】万元	
	律师费用	【】万元	
	信息披露费、发行手续费及其他	【】万元	
	总计	【】万元	
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		

开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、公司主营业务

（一）主营业务、主要产品及用途

公司专业从事石英晶体谐振器、石英晶体振荡器等频率控制元器件的研发、生产和销售，是全球前十大石英晶体频率元器件品牌制造商，致力于为通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制、汽车电子、AI 算力、机器人等领域提供微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化的频率控制与时序解决方案，并依托深厚的技术底蕴，持续驱动频率控制元器件的自主创新与国产化替代。

公司晶振产品覆盖从 kHz 级到 MHz 级晶体的全频段需求。该产品是利用石英晶体（二氧化硅）的压电效应制成的频率控制元器件，可以产生稳定的脉冲，为电路提供基准频率信号，属于计时、频率控制等各类电子设备的关键基础元器件。

（二）主要原材料及重要供应商

公司主要原材料为基座、上盖、石英晶片和芯片，主要供应商为三环集团、京瓷集团和时尚科技（日本特殊陶业（NGK）的代理商）等国内外知名公司及其代理商。公司产品生产所需的主要原材料均具有成熟的供应市场，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，能够保证公司生产所需材料的稳定供应。

（三）主要生产模式和销售模式

在生产模式方面，公司采取“以销定产、适度备货”的经营方针。依托已获得的全球知名品牌商及电子制造服务商的合格供应商认证，公司构建了高效的订单响应机制，落实精准排产与及时交付。

在销售模式方面，公司坚持“直销为主、经销为辅”的策略，以自主品牌“Hosonic”深耕全球市场。凭借长期积累的品牌名誉度与稳定的客户关系，公司持续强化国际竞争力，保障主营业务的稳健发展。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

全球石英晶振产业领军企业高度集中于日本、中国台湾及中国大陆地区。日本精工爱普生（Epson）、日本电波（NDK）、京瓷（Kyocera）及大真空（KDS）等日本厂商凭借深厚的技术积累，在高端产品及汽车电子领域保持竞争优势。近年来，以台湾晶技（TXC）为代表的中国台湾地区企业通过持续的工艺优化，逐步实现对日本厂商高端市场份额的渗透，2024 年台湾晶技全球市场占有率位居首位。美国厂商则主要深耕军工等特定细分市场。

受益于下游需求驱动及产业转移，中国大陆地区石英晶振产业发展迅速。在稳固中低端产品进口替代的基础上，以发行人为代表的中国大陆地区厂商在高端领域竞争力持续增强，市场空间进一步拓展。

2、发行人行业地位

公司系全球石英晶体元器件领域的主要制造商。根据 QYResearch 数据，2024 年全球前十大厂商合计市场份额达 67.92%，产业集中度较高；其中，鸿星科技凭借 3.19%的全球市场占有率位居全球第九位，具备显著的规模优势与市场影响力。

五、发行人符合创业板定位

（一）发行人所属行业符合创业板定位

公司隶属于电子元器件的细分行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司主营业务属于“C 制造业”门类中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C3989 其他电子元件制造”。根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司主要产品属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

公司所属行业为电子元件制造，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，同时也不属于产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，或从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。因此，发行人所处行业领域符合创业板定位。

（二）发行人符合创业板定位相关指标要求及其依据

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条第（二）项的规定，公司符合创业板定位相关指标的规定，具体如下：

创业板定位相关指标二	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	是	2023 年度、2024 年度和 2025 年度，发行人研发投入分别为 3,540.71 万元、3,597.44 万元和 3,799.99 万元，合计为 10,938.14 万元，最近三年累计研发投入超过 5,000 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	不适用	公司最近一年营业收入为 63,212.05 万元，超过 3 亿元，不适用营业收入符合增长率的要求
最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求	是	

（三）发行人创新、创造、创意性特征

公司凭借持续的研发投入和技术积累，在石英晶体元器件领域形成了显著的技术优势与市场地位，公司的创新、创造、创意性特征具体体现如下：

1、创新投入及创新成果

（1）研发战略与投入

公司坚持研发驱动发展战略，紧密围绕核心客户需求、前沿技术演进及行业趋势进行深度布局。通过持续的技术迭代与研发创新，公司不断丰富产品矩阵，实现多维应用场景的深度覆盖与精准适配。报告期内，公司研发投入分别为 3,540.71 万元、3,597.44 万元及 3,799.99 万元，占营业收入比例分别为 6.54%、6.34%及 6.01%，研发强度始终保持在稳定水平，为核心技术的持续突破提供了坚实保障。

（2）研发成果与行业荣誉

依托卓越的研发创新与精益生产实力，公司创新成果丰硕且具有行业影响力。公司荣获高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省加工贸易创新发展示范企业、浙江省分领域分行

业亩均效益领跑者、浙江出口名牌等多项殊荣。

在产品维度，公司“小型化高频基本波低抖动压控晶体振荡器”等 13 项产品获评省级工业新产品，“车载高频石英晶体振荡器”等 24 项产品通过省级科学技术成果鉴定。多项研发成果彰显了公司在高端石英晶体元器件领域深厚的技术储备与产品竞争力。

2、公司多项核心技术及产品技术指标处于行业前列

公司深耕晶片设计、精密制造及测试全链路，构筑了高度产业化的技术体系。在高精度高频设计与测量领域，公司具备显著的技术优势；同时，公司积极布局光刻腐蚀、MEMS 等前沿工艺，持续开展前瞻性技术储备，以驱动未来业务增长。

依托技术转化能力，公司核心产品的微型化、频率精度、运行温度范围等关键性能指标处于行业第一梯队，持续推动晶振产品顺应微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等行业发展趋势精进升级：SMD 谐振器目前已实现 1008 超小尺寸量产，将同步开展更小尺寸产品如 0806 的迭代研发；振荡器频率突破 312.5MHz，并持续推进更高频率规格如 625MHz 的研制与技术储备；温补晶振（TCXO）已于 2024 年实现量产。公司通过稳步推进核心技术迭代，不断强化产品性能并巩固在石英晶体元器件领域的市场地位。

3、公司是中国大陆少数已全面进入国际电子产业巨头供应链的晶振厂家

公司凭借技术实力通过了全球知名客户严格的供应商准入认证，与终端品牌商建立了长期稳定的战略协同关系。报告期内，逾 60%的收入源于世界 500 强及行业领军企业。作为中国大陆地区少数全面切入国际知名电子企业供应链的晶振厂商，公司具备显著的客户资源壁垒与先发优势。

4、标准制定情况

公司深度参与石英晶体元器件行业标准体系建设，在一定程度上体现了公司在行业内的影响力。公司作为主要起草单位已完成 1 项国家标准和 3 项团体标准的制定，目前正在参与 1 项国家标准、1 项行业标准和 3 项团体标准的制定。

（四）发行人能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展

电子元器件作为电子信息产业的基石，是支撑工业创新发展的关键，已成为全球高科技竞争的核心领域。其中，石英晶体频率元器件作为电子系统的核心频率控制部件，核心功能是为电子系统提供精准的时钟同步信号与频率基准，其性能直接决定电子设备信号处理、数据运算及传输链路的稳定性与可靠性，广泛应用于各类电子终端及设备。公司顺应行业趋势，以技术工艺与产品创新双轮驱动，在研发、认证及生产工艺等关键环节形成了深厚的技术沉淀，具备显著的创新创造能力。

1、公司依托完善的核心技术体系，持续推动研发升级与技术创新

公司构建了贯穿产品研发设计与生产工艺全链条的核心技术体系。在高精度高频设计、精密制造及测量技术等领域，形成了一系列成熟的研发与工艺成果，涵盖从晶片加工、微型化设计到溅射镀膜、精密点胶、封焊等关键环节。公司关键技术均实现自主研发并产业化，多项核心指标代表行业前列水平，支撑了现有产品生产及新产品的持续开发。

2、公司凭借丰富的产品矩阵，不断提升产品竞争力与覆盖面

公司已形成核心突出、系列完整的晶振产品矩阵，涵盖 SMD 高频、微小尺寸、热敏、SPXO/TCXO/VCXO、车规级、差分型、音叉型等全系列线路，基本覆盖石英晶振各细分类型。为顺应石英晶体元器件行业发展趋势，公司产品在通用化标准品的基础上逐步拓展至面向具体应用场景的解决方案，针对不同领域的差异化需求持续推动晶振产品性能升级：

（1）针对消费电子与 AIoT 的微型智能终端领域，公司晶振产品封装尺寸最小可达 1008 并实现规模化量产，kHz 音叉晶体、MHz 晶体等产品均可满足智能终端电子设备的轻薄化与低功耗唤醒需求。

（2）针对通讯电子、AI 服务器、光模块等超高速应用领域，公司振荡器频率突破 312.5MHz，差分振荡器相位抖动可低至 30fs，满足相关领域等对频率控制元器件的要求。

（3）针对汽车电子领域，公司车规级产品已通过 AEC-Q200 认证，具备宽工作温度范围及全生命周期可靠性测试能力，满足车载严苛环境要求。

3、公司通过取得主流芯片平台认证，稳固市场先发优势

公司技术实力获全球头部客户广泛认可。目前，公司已取得高通（Qualcomm）、联发科（MTK）、客户 N、瑞昱（Realtek）等数十家全球主流芯片平台的认证，应用涵盖智能手机、汽车电子及算力基础设施等领域。公司亦是中国大陆少数切入客户 O Wi-Fi 芯片及芯科科技（Silicon Labs）物联网模块认证清单的厂商，为精准把握下游需求奠定了坚实基础，显著增强了市场先发优势。

4、公司紧跟前沿技术发展趋势，拓展新兴应用领域并深化产业融合

公司坚持微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化的研发导向，业务版图逐步从通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制等核心领域向汽车电子、AI 算力、机器人等新兴领域拓展，实现了产品与前沿产业趋势的深度融合。

（1）在汽车电子领域，公司车规级产品工作温度范围已拓展至-40℃~+125℃，全面覆盖主流车载 Grade 1 等级，并具备 150℃更高温等级延伸能力，产品已应用于国内新能源终端汽车品牌的主流车型。

（2）在 AI 算力领域，公司推出的高频振荡器及差分振荡器系列产品已通过主要算力基础设施及服务提供商的验证，覆盖处理器配套、算力存储及高速光模块等场景，成为 AI 算力产业链关键频率控制元器件供应商。

（3）在机器人领域，公司开发的抗振动、微型化谐振器及振荡器已导入部分机器人产业链客户，应用于电机驱动、3D 视觉模组、关节驱动、编码器等核心模块，率先抢占新兴应用赛道。

综上所述，公司核心技术与产品指标均位居行业前列，凭借多元化的产品矩阵、权威的平台认证及前瞻性的市场布局，构筑了强大的竞争壁垒，满足全球市场对高性能产品的需求。

（五）发行人成长性特征

公司产品市场空间广阔，近年来凭借研发技术、自主品牌、国际化等优势实现报告期内收入规模稳步增长。公司依托在石英晶振领域的技术研发实力和市场开拓能力可以支撑未来发展，发行人的成长性特征具体体现如下：

1、技术迭代、国产替代与应用拓展多重驱动，晶振市场空间广阔

第一，受益于技术迭代与下游应用领域深化带来的市场规模增长，公司所处石英晶振行业持续扩容。作为电子信息产业的关键电子元器件之一，石英晶体元器件产业具备稳固的刚需基石地位。不仅在通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制等核心市场需求稳健，同时在汽车电子、AI 算力、高速光模块、机器人等新兴市场的涌现下，持续延伸行业应用场景，驱动全球晶振市场保持较快增长。根据 QYResearch 数据，2024 年全球市场规模为 33.40 亿美元，预计 2031 年将达 63.37 亿美元，复合增长率为 9.58%，较强的增长韧性与行业扩容潜力为公司持续成长提供了坚实的市场基础。

第二，受益于我国主要制造基地地位与国产替代进程的叠加推动，公司将充分把握国内市场发展机遇。我国凭借完善的产业链配套和成熟的制造工艺已成为全球石英晶振主要制造基地之一。随着产业链自主可控需求的增强及本土头部厂商竞争力的提升，国产替代从中低端向中高端加速渗透。公司凭借在微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等领域的技术突破，已切入 AI 算力、高速光模块、车规级等高端供应链，并在部分关键产品上实现了对进口元器件的替代，将深度受益于产业转移与供应链自主可控的市场机遇。

第三，受益于终端应用拓展推动的产品性能升级与竞争逻辑重塑，公司作为行业头部企业竞争优势逐步显现。随着人工智能、5G-A/6G 通讯及智能辅助驾驶等前沿技术的深度融合，石英晶振的应用范畴已拓展至新兴战略领域。终端应用对晶振产品的尺寸、频率范围、频率精度、温度、功耗、可靠性等性能要求持续提升，有利于具备自主研发能力和全系列产品布局的行业头部厂商构筑竞争壁垒并逐步释放增长空间。特别是 AI 大模型训练与推理需求的快速增长，推动更高基频、更低相位抖动、高稳定度温补晶振（TCXO）、差分型振荡器等高端产品需求增加，为公司高附加值产品带来增长动能。

2、技术创新、自主品牌与全球化布局协同赋能，收入规模持续增长

报告期内，公司主营业务收入实现稳步提升，分别为 54,091.17 万元、56,738.44 万元和 63,211.96 万元。持续的研发投入和前瞻性的自主品牌战略与全球化布局协同支撑了公司收入规模持续增长。

第一，技术创新支撑产品领先。公司基于对频率控制行业的深刻洞察，持

续突破微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等技术瓶颈，凭借先发优势较早实现了高端产品的市场导入与规模化量产。公司高频差分振荡器已逐步在800G/1.6T 光模块、AI 服务器 GPU 与 CPU 集群等超高速场景完成送样、适配及量产，技术转化能力能够较快响应下游应用对晶振产品的升级需求。

第二，品牌溢价强化竞争优势。公司自主品牌“Hosonic”已累积一定的品牌知名度与客户认可度，有助于提升客户合作的稳定性与产品导入机会。在行业竞争从同质化的成本与规模竞争逐步转向差异化需求竞争的趋势下，品牌影响力成为公司获取高附加值、增强客户黏性的重要支撑。

第三，全球化布局夯实市场基础。公司持续推进境内外市场拓展与供应链协同布局，已逐步形成覆盖多区域的销售网络与生产协同能力。同时，公司积累了以知名电子品牌商、通信设备制造商及电子制造服务商为代表的优质客户资源，为公司持续拓展市场提供了坚实的业务基础。

3、经营战略稳步落地，综合盈利与抗风险能力持续提升

第一，优化产品结构，布局新兴产业，增厚公司发展潜力。公司积极把握国产替代带来的市场契机，紧扣产业升级趋势，前瞻性地聚焦汽车电子、AI 算力、高速光模块、机器人等增量市场需求，围绕前沿应用场景提供有竞争力的频率控制与时序解决方案，拓展晶振产品在新兴产业的应用范围。同时，通过增加微型化、高频化、高精度等高附加值产品的销售占比以提升盈利水平，为公司未来发展注入新的动力。

第二，深化市场拓展能力，扩大市场覆盖广度与合作深度。面对下游行业及多样化应用场景的差异化需求，公司始终坚持以客户需求为导向，致力于为客户提供适配的频率控制元器件。一方面，公司依托与现有核心客户的长期合作基础，充分发挥全系列晶振产品优势，持续跟进客户产品迭代、规格升级及新增需求，不断提升在单一客户中的配套范围与合作深度；另一方面，通过参加境内外专业展会、市场推广及客户开发活动，持续拓展新客户、新项目及新应用机会，推动客户覆盖范围和业务来源进一步扩展，为公司业务持续增长提供支撑。

第三，丰富产品矩阵，打造全栈式频率控制解决方案。公司持续丰富产品线，通过技术创新促进新质生产力发展，构建综合频率控制解决方案能力。公

司已开发并持续迭代高精度 TCXO、车规级晶振、高基频差分型振荡器等高性能产品，形成覆盖多元化场景的频控矩阵，为下游应用提供稳定可靠的核心频率控制元器件支撑，进一步强化公司的综合竞争优势与市场地位。

六、主要财务数据和财务指标

项目	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
资产总额（万元）	147,809.48	139,148.17	121,802.91
归属于母公司所有者权益（万元）	115,722.61	113,997.10	100,435.57
资产负债率（母公司）（%）	25.11	20.77	14.73
营业收入（万元）	63,212.05	56,739.10	54,153.81
净利润（万元）	10,832.13	13,303.66	13,290.75
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,831.89	13,303.66	13,290.75
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,586.44	12,635.44	12,413.25
基本每股收益（元）	0.73	0.90	0.90
稀释每股收益（元）	0.73	0.90	0.90
加权平均净资产收益率（%）	9.08	12.41	14.18
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,525.64	17,289.62	20,889.50
现金分红（万元）	8,873.63	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	6.01	6.34	6.54

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

本招股说明书已披露的财务报告的审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司经营情况良好。公司所处行业未发生重大变化，公司的主要业务模式、主要客户及供应商、税收政策等均未发生重大变化，公司的董事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，公司未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

八、发行人选择的具体上市标准

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，发行人选择创业板第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

根据立信会计师出具的信会师报字[2026]第 ZF 10204 号标准无保留意见审

计报告，公司 2024 年度和 2025 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 12,635.44 万元和 10,586.44 万元，合计为 23,221.88 万元，且最近一年净利润（2025 年度）不低于 6,000 万元，满足上述上市标准中“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元”的要求。因此，公司满足所选择的上市标准。

九、公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在特殊治理结构安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用概况

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目	鸿星科技	32,240.00	32,240.00
2	新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目	浙江鸿星	15,960.00	14,860.00
3	基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目	鸿星科技	10,000.00	10,000.00
4	数智化制造与运营管理平台升级建设项目	鸿星科技	7,900.00	7,900.00
合计			**66,100.00**	**65,000.00**

若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，发行人将通过银行借款等方式自筹解决。

在本次公开发行募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。

（二）未来发展规划

公司将秉承“立足中国，面向世界”的企业使命和“以先进技术、优异品质、完善服务，成为晶体产业最具竞争优势的品牌”的企业愿景，坚持以客户需求为导向，持续为客户提供质量稳定、性能优异的石英晶体元器件产品。公司未来将继续坚持市场导向，加强品牌建设以扩大市场份额；根据下游需求情

况推进产能建设，提升生产效率与供应能力；同时聚焦研发创新与工艺优化，增强核心竞争力。

本次募集资金运用与未来发展规划的具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”相关内容。

第三节 风险因素

投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）财务风险

1、毛利率下降和经营业绩波动风险

毛利率下降和经营业绩波动风险具体详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险因素”之“1、毛利率下降和经营业绩波动风险”。

2、单一产品占比较高的风险

公司主要产品为石英晶体谐振器，其中以 SMD 石英晶体谐振器为主。报告期内，该类产品销售收入占主营业务收入的比例分别为 79.73%、80.46%和 78.18%。若未来行业内新增竞争者进入该领域，或现有厂商扩大产能，可能导致该类产品盈利水平下滑，进而对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。

3、汇率波动风险

公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料采购两个方面，主要以美元和日元进行结算。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入均超过 50%。报告期各期，公司汇兑损失分别为-18.55 万元、-503.31 万元和 1,036.92 万元。随着公司业务的发展，外汇结算量将进一步增加，同时人民币汇率可能受到国内外政治、经济环境等因素的影响，存在波动风险，从而对公司整体经营业绩产生影响。

4、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面净值分别为 15,179.84 万元、15,631.16 万元和 16,370.69 万元，占流动资产的比例分别为 17.37%、15.83%和 15.50%。公司应收账款账龄均在一年以内，账龄结构良好，但如果宏观经济、客户经营

状况发生重大不利变化，或未来公司不能加强应收账款回收，公司面临着应收账款不能按期或无法收回的风险，影响公司资金周转，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

5、存货减值风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 9,644.53 万元、11,996.51 万元和 14,211.01 万元，各期末存货跌价准备金额分别为 669.00 万元、637.20 万元和 958.82 万元。

未来，若公司因未能及时把握下游行业变化、未能及时优化存货管理或其他难以预计的原因导致存货无法及时实现销售，可能导致公司存在存货跌价的风险，从而对公司盈利能力造成不利影响。

6、固定资产成新率较低的风险

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 28,808.41 万元、29,291.02 万元和 34,426.25 万元，占资产总额的比例分别为 23.65%、21.05%和 23.29%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产中机器设备的原值为 69,614.37 万元，成新率为 19.75%，固定资产规模较大、成新率较低。较低的成新率将有可能使公司在对上述设备进行日常维护时投入较多的资金，未来如果出现非常规维修，或因陈旧过时无法使用或使用效率降低，可能会对公司生产经营带来不利影响。

7、税收优惠政策变化的风险

报告期内公司享受高新技术企业税收优惠政策，子公司金华鸿瑞、东莞佳晟和湖州鸿皓 2023 年度、2024 年度和 2025 年度享受小微企业普惠性税收减免政策。若未来上述税收优惠政策发生不利变化或公司未能通过高新技术企业资格复审，将对公司经营业绩造成不利影响。

8、增值税出口退税政策变化风险

根据财政部、国家税务总局（财税〔2012〕39 号）《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》的规定，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。报告期内，发行人实际退税额分别为 619.74 万元、1,852.26 万元和 3,153.75 万元，占当期利润总额的比例分别为 4.15%、12.30%和 26.20%。报告

期内公司产品的出口退税率一直保持在 13%，如果国家对公司主营产品出口的退税率进行调整，将对公司的经营产生一定影响。

（二）经营风险

1、供应商集中且芯片依赖进口风险

供应商集中风险具体详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险因素”之“2、供应商集中且芯片依赖进口风险”。

2、产品质量风险

发行人设立品保中心全面统筹质量控制工作，建立了从供应商甄选、到产品售后服务的全方位质量管理体系。公司日常销售过程中产品经检测合格后发货给客户。如果公司产品出现性能不稳定、精度不达标等故障，已实现销售的产品出现返修、退货或召回情况，导致客户向公司提出索赔，公司可能面临一定的产品质量风险。

（三）技术风险

1、技术研发风险

近年来，基于自身发展战略布局、顺应行业技术变革和发展趋势，结合生产管理能力和技术研发能力，公司实现微型化、高频率、高精度产品持续量产和销售；同时，公司实现了产品的全场景布局，产品应用于通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制、汽车电子、AI 算力、机器人等领域。

为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量，必须进行持续的研发投入。若公司技术研发方向未能紧跟行业技术发展趋势和市场需求变化，甚至出现研发方向滞后或偏离情形，将使公司在市场竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。

2、核心技术泄密风险

公司在压电石英晶体元器件研发、生产环节方面掌握了一系列核心技术，从而使得公司能够在产品研发、性能提升、工艺制程改进、设备改造和生产线管理等各环节对产品质量进行严格管控，进一步实现产品高精度、高速率的生产和高良率水平。

随着市场竞争格局的变化和人才竞争的日趋激烈，公司不能完全排除在经营过程中相关技术或保密信息泄露、相关技术人员不慎泄密或竞争对手采用非法手段获取本公司的核心技术等风险，进而可能导致公司核心技术泄密。未来，若核心技术泄密并被竞争对手获知和模仿，将可能给公司市场竞争力带来不利影响。

3、技术人才流失风险

公司的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，公司已经建立了完善的管理制度和良好的激励机制，具有稳定的技术团队，但随着市场竞争的日趋激烈，公司可能存在着技术人才流失的风险。未来，若公司技术人才大量流失或因规模扩张引起技术人才不足，使得公司丧失技术研发优势，从而对公司的生产经营和市场竞争力造成不利影响。

（四）内控风险

1、经营规模扩大带来的管理风险

报告期内公司资产和业务规模整体呈增长态势，未来随着募集资金的到位和募投项目的顺利实施，公司总体经营规模将进一步扩大，员工人数也会随之增加。经营规模的扩大及人员扩充将使得公司组织结构、管理体系趋于复杂，对经营管理、财务规范、内部控制等提出更高要求。未来，若公司不能及时提高管理水平并充实、培养相应高素质管理人才队伍以适应公司及市场环境变化，将影响公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险，从而对公司未来的业务发展造成一定的不利影响。

2、实际控制人控制不当的风险

截至本招股说明书签署日，林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士为公司共同实际控制人。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营和其他中小股东的利益产生不利影响。

（五）募集资金投资项目的风险

1、募投项目实施和收益不确定的风险

公司本次募集资金将用于“新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目”“新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目”“基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目”和“数智化制造与运营管理平台升级建设项目”。项目建成将全面提高公司在石英晶体元器件行业的核心竞争优势，有利于业务规模的扩大和市场地位的提升。

本次募集资金投资项目的可行性分析基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势做出，公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，并进行了充分的可行性论证。

本次募集资金投资项目建设完成后，公司的固定资产较本次发行前将有较大规模的增加，折旧、摊销费用和员工薪酬将有所增加，短期内可能会对公司的经营业绩产生一定不利影响。同时，由于募投项目存在新增产能爬坡、市场逐步开拓的周期，如果行业或市场环境发生重大不利变化，或公司在设计研发、市场开拓等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，则有可能出现公司新增产能无法完全消化或者销售产品不及预期，从而出现募投项目无法实现预期收益的风险。

2、净资产收益率被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司的净资产规模较本次发行前预计将出现大规模的增长。由于投资项目的建设需要一定的时间才能达到预计的收益水平，因此在本次发行后的一段时间内，公司的净资产收益率可能出现一定程度的下降。在短期内，公司将面临净资产增长较快而导致净资产收益率被摊薄的风险。

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争加剧风险

石英晶振作为电子产品的基础元器件，受下游应用领域产品销售价格及需求变动、宏观经济政策等因素影响。未来，若下游市场需求减少或者市场竞争加剧，或公司对行业发展趋势判断失误，不能根据客户的需求持续提升技术水平和核心竞争力以扩大市场份额，可能造成现有客户或订单流失，对公司的行

业地位、市场份额等产生不利影响。

（二）新客户及料号开发风险

石英晶体元器件的大额订单一般集中于大型跨国企业和国内大型制造公司，进入合格供应商名单，并取得认证料号是获取客户量产订单的前提，进入合格供应商名单并认证料号一般都要经过严格的认证过程。在认证过程中，除对公司产品的质量、价格、交货期有较高要求外，还对公司的设备、环境、内控体系、财务状况甚至社会责任都设有较高的标准。因此要获得下游优质大客户的供应商及料号认证需要一定的时间过程。

未来，若下游需求减少或市场竞争加剧，导致新客户开发及认证料号难度变大，公司新客户开发、认证料号数量减少，持续获客能力降低，公司将面临一定的新客户及料号开发风险。

三、其他风险

（一）国际贸易争端风险

公司石英晶体元器件产品出口国包含美国，报告期内公司石英晶体元器件产品直接向美国出口金额合计 3,547.82 万元，占营业收入的比例为 2.04%，占比较小。

根据美国公布的对中国加征关税清单，石英晶体元器件等在此征税清单之列，因此直接销往美国的石英晶体元器件产品将受到国际贸易争端的影响，从而对公司生产经营产生一定的不利影响。

第四节 发行人基本情况

一、公司基本情况

中文名称	鸿星科技（集团）股份有限公司
英文名称	HOSONIC TECHNOLOGY （GROUP） CO.,LTD.
注册资本	14,789.3812 万元
法定代表人	林洪河
成立日期	1993 年 12 月 31 日（2022 年 6 月 6 日整体变更设立股份有限公司）
住所	浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号
邮政编码	311113
电话	0571-88778111
传真	0571-88778216
互联网网址	www.hosonic.com
电子信箱	board@hosonic.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
部门负责人	陈意青
联系电话	0571-88778111

二、公司设立情况

（一）有限公司设立情况

1993 年 12 月，台湾鸿星与华瑞电子共同出资成立浙台合资企业杭州鸿星电子有限公司，注册资本 125 万美元，其中：台湾鸿星认缴 100 万美元注册资本，分别以设备出资 71.2 万美元、以货币出资 28.8 万美元；华瑞电子认缴 25 万美元注册资本，全部以场地、厂房出资。

1993 年 12 月 23 日，杭州市下城区对外经济贸易局出具下外经资（1993）137 号《关于同意合资经营杭州鸿星电子有限公司合同、章程的批复》，批准鸿星有限成立。

1993 年 12 月 27 日，浙江省人民政府核发了外经贸资浙府字[1993]6022 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

1993 年 12 月 31 日，杭州市工商行政管理局核发了（93）杭工商外企字第 1639 号《核准登记通知书》。

鸿星有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	台湾鸿星	100.00	80.00
2	华瑞电子	25.00	20.00
合计		**125.00**	**100.00**

（二）股份公司设立情况

2022 年 2 月 26 日，鸿星有限召开股东会，同意以 2022 年 2 月 28 日为审计、评估基准日整体变更为股份有限公司，公司名称拟为“鸿星科技（集团）股份有限公司”。

2022 年 5 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第 ZF10747 号《专项审计报告》，确认截至 2022 年 2 月 28 日，鸿星有限的净资产为 67,493.0909 万元（扣除专项储备后的净资产为 67,231.7146 万元）；2022 年 5 月 9 日，银信资产评估有限公司出具银信评报字（2022）沪第 1074 号《资产评估报告》，确认截至 2022 年 2 月 28 日，鸿星有限的净资产为 82,755.76 万元。

2022 年 6 月 6 日，公司召开创立大会，全体股东一致同意鸿星有限以截至 2022 年 2 月 28 日经审计的净资产（扣除专项储备）67,231.7146 万元，按照 4.54594507:1 的比例折合股本 14,789.3812 万股整体变更为股份有限公司，剩余净资产计入资本公积。

2022 年 6 月 6 日，公司取得杭州市余杭区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100609123211C 的《营业执照》。

股份公司成立后，鸿星科技的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	H-TEC	11,672.3860	78.9241
2	JOINT	437.5142	2.9583
3	LINKRICH	352.9190	2.3863
4	PERFECT	333.6336	2.2559
5	杭州纮洋	311.3165	2.1050
6	KSP	302.6203	2.0462
7	DYNAMIC	298.9230	2.0212

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
8	LYH	259.9529	1.7577
9	杭州澜洋	212.5826	1.4374
10	贡进忠	121.4208	0.8210
11	杭州湟江	107.0455	0.7238
12	刘强	90.7772	0.6138
13	冯信和	89.6532	0.6062
14	江燕	79.4337	0.5371
15	GOLDRICH	66.1973	0.4476
16	辜达元	7.5722	0.0512
17	桂志义	7.5722	0.0512
18	陶霞芳	7.5722	0.0512
19	闫翠华	7.5722	0.0512
20	杨耀中	7.5722	0.0512
21	何东升	7.5722	0.0512
22	代祖明	7.5722	0.0512
合计		**14,789.3812**	**100.0000**

三、报告期内股本、股东变化情况

报告期期初，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	H-TEC	11,672.3860	78.9241
2	JOINT	437.5142	2.9583
3	LINKRICH	352.9190	2.3863
4	PERFECT	333.6336	2.2559
5	杭州纮洋	311.3165	2.1050
6	KSP	302.6203	2.0462
7	DYNAMIC	298.9230	2.0212
8	LYH	259.9529	1.7577
9	杭州澜洋	212.5826	1.4374
10	贡进忠	121.4208	0.8210
11	杭州湟江	107.0455	0.7238
12	刘强	90.7772	0.6138

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
13	冯信和	89.6532	0.6062
14	江燕	79.4337	0.5371
15	GOLDRICH	66.1973	0.4476
16	辜达元	7.5722	0.0512
17	桂志义	7.5722	0.0512
18	陶霞芳	7.5722	0.0512
19	闫翠华	7.5722	0.0512
20	杨耀中	7.5722	0.0512
21	何东升	7.5722	0.0512
22	代祖明	7.5722	0.0512
合计		**14,789.3812**	**100.0000**

报告期初至今，公司股本、股东变化情况如下：

2026 年 1 月 20 日，冯信和分别与代祖明、桂志义、何东升、江燕、闫翠华、杨耀中、杭州湛洋签订《股权转让协议》，刘强与杭州湛洋签订《股权转让协议》，对股权转让事项进行约定，具体情况如下：

转让方	受让方	转让股数（万元注册资本）	转让比例（%）	转让价格（元/股）
冯信和	代祖明	5.0000	0.0338	10.50
	桂志义	8.2000	0.0554	
	何东升	5.0000	0.0338	
	江燕	9.2304	0.0624	
	闫翠华	5.0000	0.0338	
	杨耀中	5.0000	0.0338	
	杭州湛洋	37.2228	0.2517	
刘强	杭州湛洋	90.7772	0.6138	

上述变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	H-TEC	11,672.3860	78.9241
2	JOINT	437.5142	2.9583
3	LINKRICH	352.9190	2.3863
4	PERFECT	333.6336	2.2559

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
5	杭州纮洋	311.3165	2.1050
6	KSP	302.6203	2.0462
7	DYNAMIC	298.9230	2.0212
8	LYH	259.9529	1.7577
9	杭州澜洋	212.5826	1.4374
10	杭州湛洋	128.0000	0.8655
11	贡进忠	121.4208	0.8210
12	杭州湟江	107.0455	0.7238
13	江燕	88.6641	0.5995
14	GOLDRICH	66.1973	0.4476
15	桂志义	15.7722	0.1067
16	冯信和	15.0000	0.1014
17	闫翠华	12.5722	0.0850
18	杨耀中	12.5722	0.0850
19	何东升	12.5722	0.0850
20	代祖明	12.5722	0.0850
21	辜达元	7.5722	0.0512
22	陶霞芳	7.5722	0.0512
合计		**14,789.3812**	**100.0000**

上述变更完成后，截至本招股说明书签署日，鸿星科技不存在其他股本、股东变更的情况。

四、公司成立以来的重要事件

发行人控股股东于 2001 年 7 月由洪福电子变更为 H-TEC，具体情况如下：

2001 年 7 月，台湾鸿星将其持有的鸿星有限 95.86%股权无偿转让给 H-TEC 和华瑞电子。本次转让完成后，H-TEC 持有鸿星有限 94.04%股权，成为鸿星有限控股股东。

本次股权转让的具体背景详见本节“九、发行人股本情况”之“（十一）股权代持的形成及解除情况”之“1、直接层面：发行人设立早期由台湾鸿星代洪福电子持股”。

本次控股股东变更，变更前控股股东洪福电子与变更后控股股东 H-TEC 的

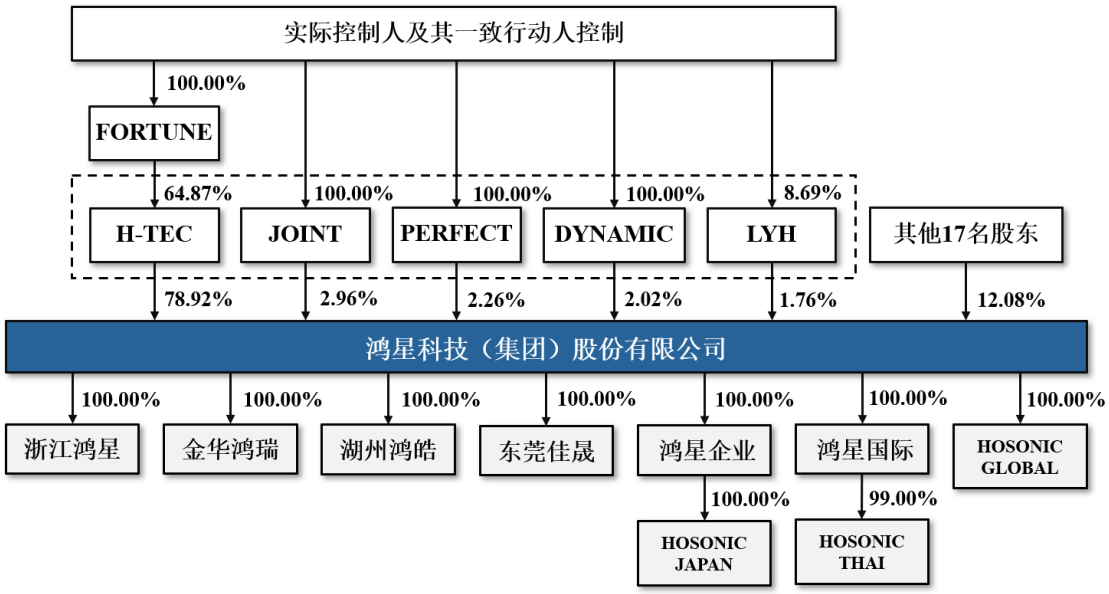
实际股权结构完全相同，因此未导致鸿星有限的实际控制人发生变更，对鸿星有限的业务发展不存在不利影响。

五、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况

截至本招股说明书签署日，公司未在其他证券市场上市或挂牌。

六、公司股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



七、子公司及参股公司的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 9 家全资或控股子公司，其中 4 家境内子公司、5 家境外子公司，无参股公司。此外，报告期内公司注销 1 家子公司。上述子公司具体情况如下：

序号	子公司名称	经营地	股权结构	业务定位
1	浙江鸿星	浙江湖州	发行人持股 100%	石英晶振等产品的生产基地之一
2	金华鸿瑞	浙江金华	发行人持股 100%	原材料晶片的生产基地之一
3	湖州鸿皓	浙江湖州	发行人持股 100%	原材料晶片的生产基地之一
4	东莞佳晟	广东东莞	发行人持股 100%	华南地区的销售平台
5	鸿星企业	中国香港	发行人持股 100%	境外采购平台
6	鸿星国际	中国香港	发行人持股 100%	境外销售平台
7	HOSONIC GLOBAL	中国香港	发行人持股 100%	拟作为境外投资、采购平台

序号	子公司名称	经营地	股权结构	业务定位
8	HOSONIC JAPAN	日本	鸿星企业持股 100%	拟作为境外投资平台
9	HOSONIC THAI	泰国	鸿星国际持股 99.00%，林毓馨持股 0.50%，林毓湘持股 0.50%	拟开展石英晶振等产品的制造、研发与销售
10	江阴鸿翔（已注销）	江苏江阴	湖州鸿皓持股 100%	原为原材料晶片的生产基地之一，注销清算过程中主要设备迁至湖州鸿皓

发行人子公司的具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“七、子公司及参股公司的基本情况”。

除上述子公司外，截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他控股子公司、参股公司和报告期内注销子公司的情况。

八、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况

（一）控股股东及实际控制人

1、公司控股股东

截至本招股说明书签署日，H-TEC 持有公司 78.9241%股份，系公司控股股东。H-TEC 基本情况如下：

公司名称	H-TEC HOLDING LIMITED				
成立时间	2000 年 7 月 11 日				
已发行股数	2,443.407 万股				
实收资本	2,443.407 万美元				
注册地和主要生产经营地	Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands				
股权结构	FORTUNE 持股 64.87%，NICE 持股 11.48%，WISE 持股 9.62%，GOLD HARVEST 持股 7.94%，SHINE 持股 6.09%				
主营业务	持股平台，无实际经营				
与发行人主营业务的关系	仅为持股平台，不存在与发行人从事相同或相似业务的情况				
最近一年主要财务数据（单位：万美元）	**日期**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	5,535.02	5,092.68	-	928.27

注：2025 年 12 月 31 日/2025 年度数据经上海鼎业会计师事务所（普通合伙）审计。

2、公司实际控制人及一致行动人

林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士为公司实际控制人，林张玉珍女士为实际控制人的一致行动人。其中，实际控制人林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士合计控制公司表决权比例为 87.9172%；一致行动人林张玉珍仅间接持股且在各持股平台的持股比例较低，未控制持股平台对发行人的表决权，穿透后持股比例为 8.1312%。具体情况如下：

（1）实际控制人基本情况

截至本招股说明书签署日，实际控制人林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士合计控制公司表决权比例为 87.9172%，具体情况如下：

①林洪河先生与林毓馨女士、林毓湘女士为父女关系，与林瑞堂先生为父子关系。

②截至本招股说明书签署日，林洪河先生担任公司董事长，林毓湘女士担任公司及子公司 HOSONIC THAI 董事，林毓馨女士担任子公司鸿星国际、鸿星企业、HOSONIC GLOBAL 董事。

③截至本招股说明书签署日，公司实际控制人能够控制的表决权数量为 13,002.4097 万股，对应股份比例为 87.9172%，具体情况如下：

序号	控制的股东名称	实际控制人控制情况	控制的表决权数量（万股）	控制的表决权比例（%）
1	H-TEC	FORTUNE 持有 H-TEC 64.8725%股权，为 H-TEC 的控股股东，能够控制 H-TEC 所持有的发行人的表决权。 林洪河、林毓湘、林毓馨、林瑞堂合计持有 FORTUNE 85%股权，能够控制 FORTUNE，进而控制 H-TEC 对发行人 78.9241%的表决权	11,672.3860	78.9241
2	JOINT	林毓湘持有 JOINT 100%股权	437.5142	2.9583
3	PERFECT	林洪河、林毓馨、林瑞堂持有 PERFECT 80%股权，能够控制 PERFECT 对发行人 2.2559%的表决权	333.6336	2.2559
4	DYNAMIC	林瑞堂及其配偶林佳燕持有 DYNAMIC 100%股权[注A]	298.9230	2.0212
5	LYH	林毓馨实际控制[注B]	259.9529	1.7577

序号	控制的股东名称	实际控制人控制情况	控制的表决权数量（万股）	控制的表决权比例（%）
实际控制人合计控制表决权数量及比例			**13,002.4097**	**87.9172**

注：A. 林瑞堂与林佳燕已于 2021 年 11 月签署《表决权委托协议》，将林佳燕持有的 DYNAMIC 50%股权对应的表决权委托给林瑞堂行使。因此，林瑞堂能够控制 DYNAMIC 100%股权的表决权。

B. LYH 部分股东（合计表决权比例超过三分之二）授权唯一董事林毓馨对平台进行统一管理，并在决策事务上以林毓馨意见作为一致意见，因此认定林毓馨为 LYH 的实际控制人。

公司实际控制人简介如下：

林洪河先生，1946 年 10 月出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，台胞证号码 0026****，住所浙江省杭州市拱墅区，大专学历。1969 年 6 月至 1970 年 11 月，担任台湾通用器材股份有限公司工程师；1971 年 12 月至 1973 年 7 月，担任日本株式会社 TTK 工程师；1973 年 8 月至 1979 年 2 月，担任亚波罗电子股份有限公司厂长；1979 年 3 月，林洪河先生在中国台湾地区创立台湾鸿星，自创立起至 2020 年 6 月担任台湾鸿星董事长；1993 年 12 月起，林洪河先生逐步将业务重心转移至中国大陆，并于 1993 年 12 月创立鸿星有限，自创立至今担任公司董事长；1993 年 12 月至 2018 月 10 月，担任鸿星有限总经理；2000 年 7 月至 2021 年 6 月，担任 H-TEC 董事；2020 年 7 月至今，担任浙江鸿星执行董事。除上述任职情况外，目前林洪河先生还担任杭州圣瀚及杭州凡翔执行董事兼总经理、台湾鸿星董事、HOLDING 董事、GOODMARK 董事、PERFECT 董事、POWERCORP 董事、FORTUNE 董事等职务。

林瑞堂先生，1972 年 2 月出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，台胞证号码 0222****，住所中国台湾地区新北市板桥区，本科学历。1996 年 6 月至 2020 年 12 月，担任珠海鸿康董事，2020 年 12 月至 2022 年 5 月，担任珠海鸿康监事；2000 年 5 月至 2022 年 5 月，担任台湾鸿星董事；2003 年 9 月至 2022 年 6 月，担任鸿星有限董事；2006 年 6 月至 2021 年 12 月，担任江阴鸿翔董事长；2022 年 5 月至今，担任台湾鸿星董事长。除上述任职情况外，目前林瑞堂先生还担任美国鸿星董事、PERFECT 董事等职务。

林毓馨女士，1973 年 8 月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，香港永久性居民身份证号码 P249****，住所中国香港特别行政区沙田区，高中学历。2000 年 6 月至今，担任鸿星国际董事；2008 年 6 月至 2018 年 11 月，担任东莞佳晟董事；2017 年 1 月至今，担任鸿星企业董事；2018 年 9 月至 2020 年

9 月，担任金图控股董事；2024 年 9 月至今，担任 HOSONIC GLOBAL 董事。除上述任职情况外，目前林毓馨女士还担任 LYH 董事、鸿升创建董事、深圳鸿升执行董事兼总经理、创宇股份及创宇台湾分公司董事、宝海星业董事、PERFECT 董事等职务。

林毓湘女士，1975 年 12 月生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，台胞证号码 0114****，住所浙江省杭州市，本科学历。1997 年 10 月至 2003 年 12 月，担任台湾鸿星董事长助理；2004 年 1 月至 2022 年 6 月，历任鸿星有限董事长助理、营销负责人；2006 年 6 月至 2023 年 1 月，担任江阴鸿翔监事；2014 年 2 月至今，担任鸿星科技董事；2020 年 6 月至 2022 年 5 月，担任台湾鸿星董事长；2020 年 12 月至 2022 年 5 月，担任珠海鸿康董事；2021 年 6 月至今，担任 H-TEC 董事；2022 年 9 月至今，担任鸿星科技副总经理；2025 年 8 月至今，担任 HOSONIC THAI 董事。除上述任职情况外，目前林毓湘女士还担任 DYNAMIC 董事、JOINT 董事、金图控股董事、台湾鸿星董事、丰诠投资董事长、BEGONIA 董事、珠海鸿硕执行董事、杭州典河执行董事、杭州子海监事、PERFECT 董事、NICE 董事、WISE 董事、SHINE 董事等职务。

（2）一致行动人基本情况

截至本招股说明书签署日，林张玉珍为公司实际控制人之一致行动人，具体情况如下：

①林张玉珍女士与林洪河先生为夫妻关系，与林瑞堂先生为母子关系，与林毓馨女士、林毓湘女士为母女关系。

②自公司设立至今，林张玉珍女士未在公司担任任何职务，亦未参与公司经营管理；且其对公司重大战略规划的了解较少，对公司经营的参与度较低，表决权的行使以林洪河先生的意见为准。

③林张玉珍女士未直接持股，仅在 H-TEC 上层平台 FORTUNE 及 PERFECT 分别持有 15%和 20%的股权，持股比例较低，无法单独控制前述持股平台。因此，林张玉珍女士未通过直接持有或间接控制等方式控制发行人的表决权。

④截至本招股说明书签署日，林张玉珍女士穿透后持股数量为 1,202.5526 万股，持股比例为 8.1312%，具体情况如下：

序号	穿透持股的股东名称	股东持股比例（%）	股东间接股权结构	穿透持股数量（万股）	穿透持股比例（%）
1	H-TEC	78.9241	FORTUNE 持有 H-TEC 64.8725%股权，林张玉珍持有 FORTUNE 15%股权（林洪河、林瑞堂、林毓湘、林毓馨合计持有 FORTUNE 85%股权）	1,135.8259	7.6800
2	PERFECT	2.2559	林张玉珍持有 PERFECT 20%股权（林洪河、林瑞堂、林毓馨合计持有 PERFECT 80%股权）	66.7267	0.4512
林张玉珍穿透合计持股数量及比例				**1,202.5526**	**8.1312**

林张玉珍女士简介如下：

林张玉珍女士，1951 年 9 月出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，中国台湾身份证号码 Q20059****，住所中国台湾地区新北市树林区，高中学历。1981 年 1 月至 2017 年 1 月，担任台湾鸿星经理。除上述任职情况外，目前林张玉珍女士还担任 PERFECT 董事等职务。

（3）实际控制人及其一致行动人签署的一致行动协议执行情况

2022 年 6 月 6 日，林张玉珍女士与林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士签订《一致行动协议》，约定在公司股东会、董事会和在其他决策性事务上行使表决权前，林洪河先生应当将其表决意见告知其他方，在听取其他方合理的意见和建议后，由林洪河先生决定最终表决意见，各方（或各方控制的持股平台）应当根据该等最终表决意见行使表决权，以在公司上述决策性事务上与林洪河先生保持一致意见。

《一致行动协议》签署前后，发行人实际控制人及其一致行动人在发行人历次股东会会议和发行人的其他决策性事务上均积极协商，在历次行使表决权和作出相关决策时均保持一致意见，不存在意见不一致的情形。

3、控股股东和实际控制人股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，因发行人间接层面的股权纠纷导致的诉讼情况详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、诉讼或仲裁事项”之“（二）控股股东或实际控制人、子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼

或仲裁事项”。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

4、控股股东和实际控制人报告期内重大违法违规行为情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法违规行为。

（二）其他持股 5%以上股东

截至本招股说明书签署日，除 H-TEC 以外，公司不存在其他直接持股 5%以上的股东。

（三）特别表决权股份或类似安排的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情形。

（四）协议控制架构的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构的情形。

九、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

公司本次发行前股本总额 14,789.3812 万股，本次拟公开发行新股 4,930.6188 万股，无股东公开发售股份，发行后股本总额 19,720.0000 万股。本次发行前后公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	H-TEC	11,672.3860	78.9241	11,672.3860	59.1906
2	JOINT	437.5142	2.9583	437.5142	2.2186
3	LINKRICH	352.9190	2.3863	352.9190	1.7897
4	PERFECT	333.6336	2.2559	333.6336	1.6919
5	杭州纮洋	311.3165	2.1050	311.3165	1.5787

序号	股东姓名/名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
6	KSP	302.6203	2.0462	302.6203	1.5346
7	DYNAMIC	298.9230	2.0212	298.9230	1.5158
8	LYH	259.9529	1.7577	259.9529	1.3182
9	杭州澜洋	212.5826	1.4374	212.5826	1.0780
10	杭州湛洋	128.0000	0.8655	128.0000	0.6491
11	贡进忠	121.4208	0.8210	121.4208	0.6157
12	杭州湟江	107.0455	0.7238	107.0455	0.5428
13	江燕	88.6641	0.5995	88.6641	0.4496
14	GOLDRICH	66.1973	0.4476	66.1973	0.3357
15	桂志义	15.7722	0.1067	15.7722	0.0800
16	冯信和	15.0000	0.1014	15.0000	0.0761
17	闫翠华	12.5722	0.0850	12.5722	0.0638
18	杨耀中	12.5722	0.0850	12.5722	0.0638
19	何东升	12.5722	0.0850	12.5722	0.0638
20	代祖明	12.5722	0.0850	12.5722	0.0638
21	辜达元	7.5722	0.0512	7.5722	0.0383
22	陶霞芳	7.5722	0.0512	7.5722	0.0383
23	社会公众股	-	-	4,930.6188	25.0031
合计		**14,789.3812**	**100.0000**	**19,720.0000**	**100.0000**

（二）本次发行前的前十名股东情况

截至本招股说明书签署日，公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	H-TEC	11,672.3860	78.9241
2	JOINT	437.5142	2.9583
3	LINKRICH	352.9190	2.3863
4	PERFECT	333.6336	2.2559
5	杭州纮洋	311.3165	2.1050
6	KSP	302.6203	2.0462
7	DYNAMIC	298.9230	2.0212
8	LYH	259.9529	1.7577

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
9	杭州澜洋	212.5826	1.4374
10	杭州湛洋	128.0000	0.8655
合计		**14,309.8481**	**96.7576**

（三）前十名自然人股东及其在公司任职情况

截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	是否在公司任职	担任职务
1	贡进忠	121.4208	0.8210	否	曾任湖州鸿皓副总经理，2023 年 12 月离职
2	江燕	88.6641	0.5995	是	业务经理
3	桂志义	15.7722	0.1067	是	生产经理
4	冯信和	15.0000	0.1014	否	曾任经营主管，2024 年 3 月退休
5	闫翠华	12.5722	0.0850	是	营业管理经理
6	杨耀中	12.5722	0.0850	是	职工董事、质保经理
7	何东升	12.5722	0.0850	是	车间经理
8	代祖明	12.5722	0.0850	是	车间经理
9	辜达元	7.5722	0.0512	是	董事、总经理
10	陶霞芳	7.5722	0.0512	是	业务经理

（四）发行人国有股份及外资股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司股权中不存在国有股份。

截至本招股说明书签署日，公司共有 9 名外资股东，合计持股比例 92.8485%，具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	注册地/籍贯
1	H-TEC	11,672.3860	78.9241	BVI
2	JOINT	437.5142	2.9583	BVI
3	LINKRICH	352.9190	2.3863	萨摩亚
4	PERFECT	333.6336	2.2559	BVI
5	KSP	302.6203	2.0462	萨摩亚
6	DYNAMIC	298.9230	2.0212	BVI

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	注册地/籍贯
7	LYH	259.9529	1.7577	中国香港
8	GOLDRICH	66.1973	0.4476	萨摩亚
9	辜达元	7.5722	0.0512	中国台湾籍
合计		**13,731.7185**	**92.8485**	-

（五）申报前十二个月新增股东情况

1、新增股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据

公司申报前十二个月内新增股东为杭州湛洋，具体情况如下：

（1）基本情况

2026 年 1 月，公司发生股权转让，冯信和将其所持部分股份转让至代祖明、桂志义、何东升、江燕、闫翠华、杨耀中、杭州湛洋，刘强将其所持股份转让至杭州湛洋，具体情况详见本节“三、报告期内股本、股东变化情况”。其中，杭州湛洋为本次新增股东，其他受让方均为老股东。

（2）入股原因

因公司部分老股东具有个人资金需求，因此拟进行老股转让；同时，公司部分员工看好行业及公司未来发展，因此愿意承接老股东转让的股份。因本次提出投资入股意愿的员工较多，因此成立杭州湛洋，作为本次新入股员工的持股平台。

（3）定价依据

本次股权转让价格为 10.50 元/股，系参考评估价值协商定价，定价具有合理性、公允性。

2、新股东与公司其他股东、董事、高级管理人员是否存在关联关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形

新股东为公司员工持股平台，其执行事务合伙人杭州子海为公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人陈意青控制的企业，其他合伙人均为公司员工。除上述情况外，新股东与公司其他股东、董事、高级管理人员不存在其他

关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员亦不存在关联关系。截至本招股说明书签署日，新增股东所持公司股份均系真实持有，不存在股份代持的情况。

（六）战略投资者的情况

截至本招股说明书签署日，公司股东中不存在战略投资者。

（七）各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东之间的关联关系以及关联股东的各自持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	关联关系
1	H-TEC	11,672.3860	78.9241	公司实际控制人及一致行动人控制的企业
	JOINT	437.5142	2.9583	
	PERFECT	333.6336	2.2559	
	DYNAMIC	298.9230	2.0212	
	LYH	259.9529	1.7577	
2	杭州纮洋	311.3165	2.1050	公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人陈意青100%持股的杭州子海担任执行事务合伙人的企业
	杭州澜洋	212.5826	1.4374	
	杭州湛洋	128.0000	0.8655	
	杭州湟江	107.0455	0.7238	
3	LINKRICH	352.9190	2.3863	公司董事吴哲婉担任董事的企业
	GOLDRICH	66.1973	0.4476	

截至本招股说明书签署日，除上表各股东间关联关系外，本次发行前公司股东之间无其他关联关系。

（八）发行人股东公开发售股份情况

本次公开发行股票不涉及股东公开发售股份事项。

（九）对赌协议或类似安排的解除情况

截至本招股说明书签署日，发行人股东不存在对赌协议或其他特殊权益或权利安排。

（十）私募投资基金股东备案情况

截至本招股说明书签署日，发行人股东不存在私募投资基金。

（十一）股权代持的形成及解除情况

自设立以来，公司及其前身存在的股权代持情况如下：

1、直接层面：发行人设立早期由台湾鸿星代洪福电子持股

自 1993 年 12 月至 2001 年 7 月期间，鸿星有限登记为台湾鸿星的股权实际为洪福电子持有，具体情况如下：

（1）历史背景

林洪河先生于 1993 年 12 月通过洪福电子在杭州投资成立鸿星有限。洪福电子具体情况如下：

企业名称（中文）	洪福电子公司
企业名称（英文）	HOWARD ELECTRONIC CO.
成立时间	1992 年 4 月 1 日
注销日期	2001 年 5 月 17 日
住所	中国香港特别行政区九龙湾启兴道二号太平洋贸易中心 12 楼 11 室
股权结构	林洪河持股 100%
经营范围	电子零件买卖及转口业务

鸿星有限成立之初，由于当时台湾鸿星已从事电子行业十余年，为方便终端客户对鸿星有限进行合格供应商的认证，因此将鸿星有限的境外股东登记为台湾鸿星。

自鸿星有限成立至 2001 年 7 月期间，台湾鸿星所持鸿星有限股权的实际出资主体均为洪福电子，其用于购买设备及出资的款项均为洪福电子自有资金；台湾鸿星仅为工商登记的名义股东，并未实际出资。

（2）解决情况

①具体还原方案

2001 年，台湾鸿星拟筹备于中国台湾地区上市（后未实施），因此对包括对外投资在内的事项进行全面规范。由于台湾鸿星仅为鸿星有限名义股东，为清理该登记错误事项，因此将登记在台湾鸿星名下的鸿星有限股权还原实际股东。同时，由于台湾鸿星自始未对鸿星有限实际出资，因此本次股权转让的对价为 0 元。

在进行股权还原的过程中，考虑到洪福电子成立时间较久，为简化对洪福电子的梳理程序，林洪河先生新设 H-TEC 并以新主体受让台湾鸿星所持鸿星有限股权。具体股权转让情况如下：

还原前			还原后		
股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
台湾鸿星	671.00	95.86	H-TEC	658.30	94.04
华瑞电子	29.00	4.14	华瑞电子	41.70	5.96
合计	**700.00**	**100.00**	**合计**	**700.00**	**100.00**

注：本次还原前后两名股东的出资金额及出资比例有所调整的原因为修正登记错误，具体如下：2000 年 4 月鸿星有限增资至 700 万元，新增注册资本由原股东台湾鸿星、华瑞电子认缴。本次增资以未分配利润转增资本 86.94 万美元、以货币出资 13.06 万美元。货币出资部分实际全部由华瑞电子认缴，其中 12.68 万美元货币出资由华瑞电子向林洪河先生借款出资，并委托林洪河先生打款至鸿星有限以完成实缴。由于登记错误，该笔 12.68 万美元出资错误登记在台湾鸿星名下，导致本次增资完成后登记股权结构与实际股权结构存在差异。因此，在本次还原时，将上述登记错误予以修正。

②内部审议及外部登记程序

2001 年 2 月 16 日，鸿星有限召开董事会，同意台湾鸿星将其持有的 671 万美元注册资本无偿转让给 H-TEC 和华瑞电子，其中：向 H-TEC 转让 658.30 万美元注册资本，向华瑞电子转让 12.70 万美元注册资本。

2001 年 2 月 28 日，台湾鸿星与 H-TEC、华瑞电子就上述股权转让事项签署《股份转让及接受协议书》。

2001 年 3 月 19 日，杭州市下城区对外经济贸易合作局出具下外经资（2001）28 号《关于同意杭州鸿星电子有限公司股权转让的批复》，同意本次股权转让。

2001 年 6 月，浙江省人民政府向鸿星有限换发了外经贸资浙府字[1993]04507 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2001 年 7 月 2 日，鸿星有限就本次变更事项在杭州市工商行政管理局办理了变更登记。

上述股权转让完成后，台湾鸿星代持事项清理完成，H-TEC 为鸿星有限境外实际股东。

2、间接层面：发行人早期间接投资及名义登记安排

（1）历史背景

1993 年起，林洪河先生基于产业发展规划，拟将相关业务及经营活动逐步拓展至中国大陆。综合考虑当时两岸投资政策、审批程序、业务发展需要及相关出资人的个人意愿等因素，林洪河先生与其亲属、朋友等通过洪福电子、H-TEC、GOODMARK 平台在中国大陆进行投资。相关投资款主要来源于各出资人的自有资金（对台湾鸿星等主体的投资收益等）。

由于相关投资事项发生时间较早，且当时中国台湾地区赴中国大陆投资审批、登记及两岸投资实务具有一定历史特殊性，上述平台在早期办理相关投资报备、登记及工商登记手续时，曾存在部分登记名义人与实际出资及权益安排不完全一致的情形。内部根据实际出资情况、历史合作关系及约定安排确认相应权益，相关利润分配亦主要按照实际权益安排执行。

（2）解决情况

发行人已结合历次出资、利润分配、内部确认文件、相关人员说明及其他可取得资料，对上述历史股权沿革进行了梳理。上述历史登记差异主要系特定历史时期两岸投资政策、监管环境及登记实务限制下形成，并非发行人现行股权权属不清或存在重大争议。

发行人已就相关程序性瑕疵完成整改，截至本招股说明书签署日，发行人现有股权结构清晰、控制权稳定。

综上，公司历史上存在的股权代持事项均已完成清理。截至本招股说明书签署日，公司不存在股权代持的情况。

十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况

1、董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	本届任职期限
1	林洪河	董事长	H-TEC	2025-06-19 至 2028-06-18
2	辜达元	董事、总经理	DYNAMIC、JOINT	
3	林毓湘	董事、副总经理	H-TEC	
4	陈意青	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	杭州澜洋、杭州纮洋	
5	刘华	独立董事	H-TEC	
6	郭耀成	独立董事	DYNAMIC、JOINT	
7	李强	独立董事	杭州澜洋、杭州纮洋	
8	吴哲婉	董事	杭州澜洋、杭州纮洋	2025-12-04 至 2028-06-18
9	杨耀中	职工董事	职工代表大会	

公司现任董事的基本情况如下：

（1）林洪河先生，担任公司董事长，其基本情况详见本节“八、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“2、公司实际控制人及一致行动人”。

（2）辜达元先生，1958 年 7 月出生，中国台湾籍，大专学历，无其他境外永久居留权。1987 年 2 月至 1990 年 6 月，担任台湾鸿星生产主管；1990 年 7 月至 1994 年 3 月，担任台湾鸿星技研主管；1994 年 4 月至 2006 年 6 月，担任鸿星有限副总经理；2006 年 7 月至 2018 年 9 月，担任鸿星有限执行副总经理；2013 年 4 月至今，担任金华鸿瑞执行董事；2013 年 12 月至今，担任发行人董事；2018 年 10 月至今，担任发行人总经理；2020 年 7 月至今，担任浙江鸿星总经理。

（3）林毓湘女士，担任公司董事、副总经理，其基本情况详见本节“八、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“2、公司实际控制人及一致行动人”。

（4）陈意青女士，1975 年 1 月生，中国台湾籍，本科学历，无其他境外永久居留权。1998 年 1 月至 1999 年 8 月，担任立本台湾联合会计师事务所审计员；1999 年 9 月至 2004 年 7 月，担任勤业众信联合会计师事务所审计经理；2004 年 8 月至 2006 年 1 月，担任上海喜士多便利连锁有限公司财务经理；2007 年 3 月至今，担任公司管理中心协理；2020 年 1 月至今，担任珠海博浩执行董事；2021 年 12 月至今，担任杭州子海执行董事兼总经理、杭州典河监事；

2022 年 6 月至今，担任鸿星科技财务负责人、董事会秘书；2022 年 9 月至今，担任鸿星科技董事、副总经理。

（5）刘华先生，1974 年 8 月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2001 年 8 月至今，担任上海财经大学会计学院副教授；2016 年 7 月至 2019 年 3 月，担任上海基美文化传媒股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2022 年 6 月，担任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 6 月，担任上海比路电子股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，担任熊猫乳品（300898）独立董事；2018 年 9 月至 2024 年 7 月，担任城地香江（603887）独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 9 月，担任河北智同生物制药股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，担任上海芯圣电子股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，担任联翔股份（603272）独立董事；2023 年 11 月至今，担任开创国际（600097）独立董事；2022 年 6 月至今，担任鸿星科技独立董事。

（6）郭耀成先生，1966 年 12 月生，中国台湾籍，硕士研究生学历，无其他境外永久居留权。1995 年 8 月至 1998 年 12 月，任台湾大华证券股份有限公司副理；1998 年 12 月至 2001 年 1 月，任台湾元大证券股份有限公司协理；2001 年 1 月至今，任台湾元大证券股份有限公司国际营运部副总经理；2013 年 2 月至今，任台湾元大证券股份有限公司上海代表处首席代表；2022 年 6 月至今，担任鸿星科技独立董事。

（7）李强先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，中国执业律师。1997 年 7 月至 1999 年 7 月，担任中国工艺集团有限公司职员；1999 年 8 月至 2000 年 8 月，担任联想（上海）有限公司市场经理；2003 年 3 月至 2005 年 4 月，担任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；2005 年 4 月起，历任国浩律师（上海）事务所律师、管理合伙人等职务；现任国浩律师（上海）事务所管理合伙人，同时担任安诺其（300067）、英派斯（002899）、威高股份（01066.HK）等公司独立董事等职务；2022 年 6 月至今，担任鸿星科技独立董事。

（8）吴哲婉女士，1973 年 11 月出生，中国台湾籍，本科学历，无其他境外永久居留权。1997 年 7 月至 1999 年 8 月，担任立本台湾联合会计师事务所审计员；1999 年 9 月 2000 年 8 月，担任勤业众信联合会计师事务所审计员；

2000 年 9 月至 2001 年 2 月，担任马可威运通股份有限公司财务；2001 年 3 月至 2015 年 12 月，担任台湾鸿星财务协理；2015 年 12 月至 2022 年 6 月，担任鸿星有限监事；2018 年 11 月至今，担任东莞佳晟监事；2020 年 12 月至今，担任杭州圣瀚、杭州凡翔监事；2021 年 6 月至 2021 年 12 月，担任珠海鸿皓监事；2021 年 10 月至今，担任 LINKRICH 董事；2021 年 11 月至今，担任 GOLDRICH 董事；2020 年 7 月至今，担任浙江鸿星监事；2021 年 12 月至今，担任湖州鸿皓监事；2022 年 6 月至 2025 年 12 月，担任鸿星科技监事会主席；2025 年 12 月至今，担任鸿星科技董事。

（9）杨耀中先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1992 年 9 月至 1998 年 10 月，担任湖北省应城市热电厂职工；1998 年 10 月至 1999 年 1 月，担任国巨电子（东莞）有限公司工务课组长；1999 年 1 月至 2000 年 9 月，担任东莞世昕电子有限公司品保主任；2000 年 10 月至 2001 年 10 月，担任珠海鸿康技术课长；2001 年 11 月至 2003 年 2 月，担任鸿毅电子（东莞）有限公司品保部副理；2003 年 2 月至今，担任公司质保经理、工会主席；2022 年 6 月至 2025 年 12 月，担任鸿星科技职工监事；2025 年 12 月至今，担任鸿星科技职工董事。

2、监事会/审计委员会

截至本招股说明书签署日，公司未设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司审计委员会由 3 名董事组成，分别为林洪河先生、刘华先生、李强先生，其中刘华为审计委员会召集人。前述审计委员会委员的基本情况详见本节“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事会”。

3、高级管理人员

公司共有 3 名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	辜达元	董事、总经理	2025-06-19 至 2028-06-18
2	林毓湘	董事、副总经理	
3	陈意青	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	

公司现任高级管理人员的基本情况如下：

（1）辜达元先生，担任公司董事、总经理，其基本情况详见本节“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事会”。

（2）林毓湘女士，担任公司董事、副总经理，其基本情况详见本节“八、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“2、公司实际控制人及一致行动人”。

（3）陈意青女士，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，其基本情况详见本节“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事会”。

4、其他核心人员

公司其他核心人员主要为核心技术人员。综合考虑行业及技术经验、对公司的贡献、专业资质等因素，公司对核心技术人员进行了审慎认定，包括林洪河先生、辜达元先生、安田克史先生。公司核心技术人员基本情况如下：

（1）林洪河先生，基本情况详见本节“八、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“2、公司实际控制人及一致行动人”。

（2）辜达元先生，基本情况详见本节“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“1、董事会”。

（3）安田克史先生，1971 年 10 月 26 日生，日本国籍，本科学历，无其他境外永久居留权。1994 年 4 月至 2002 年 2 月，担任日本东京电波株式会社开发工程师；2002 年 7 月至 2014 年 5 月，担任三星电机有限公司（韩国）晶体器件开发总经理；2014 年 6 月至 2016 年 3 月，担任三星电机有限公司（菲律宾）水晶事业部总经理；2016 年 8 月至 2019 年 7 月，担任广东惠伦晶体科技股份有限公司技术总监；2019 年 9 月至 2020 年 3 月，担任泰晶科技股份有限公司技术顾问；2020 年 9 月至今，担任公司技术研发经理；2024 年 5 月至今，担任 HOSONIC JAPAN 董事长。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司未设监事，除在发行人及其子公司任职之

外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员的主要兼职情况如下：

序号	姓名	职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系
1	林洪河	董事长	杭州圣瀚	执行董事、总经理	同控公司
			杭州凡翔	执行董事、总经理	同控公司
			台湾鸿星	董事	同控公司
			HOLDING	董事	同控公司
			GOODMARK	董事	同控公司
			PERFECT	董事	同控公司
			POWERCORP	董事	同控公司
			FORTUNE	董事	股东、同控公司
2	林毓湘	董事、副总经理	H-TEC	董事	控股股东、同控公司
			DYNAMIC	董事	股东、同控公司
			JOINT	董事	股东、同控公司
			金图控股	董事	同控公司
			台湾鸿星	董事	同控公司
			丰诠投资	董事长	同控公司
			BEGONIA	董事	同控公司
			珠海鸿硕	执行董事	同控公司
			杭州典河	执行董事	同控公司
			杭州子海	监事	董事、高管控制的公司
			PERFECT	董事	同控公司
			NICE	董事	股东
			WISE	董事	股东
			SHINE	董事	股东
3	陈意青	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	珠海博浩	执行董事	同控公司
			杭州典河	监事	同控公司
			杭州子海	执行董事、总经理	董事、高管控制的公司
4	吴哲婉	董事	杭州圣瀚	监事	同控公司
			杭州凡翔	监事	同控公司
			珠海博浩	监事	同控公司
			LINKRICH	董事	董事控制的公司
			GOLDRICH	董事	董事控制的公司

序号	姓名	职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系
5	刘华	独立董事	上海财经大学	副教授	-
			开创国际（600097）	独立董事	-
			上海芯圣电子股份有限公司	独立董事	-
			联翔股份（603272）	独立董事	-
6	郭耀成	独立董事	台湾元大证券股份有限公司上海代表处	首席代表	-
7	李强	独立董事	国浩律师（上海）事务所	管理合伙人	-
			安诺其（300067）	独立董事	-
			英派斯（002899）	独立董事	-
			威高股份（01066.HK）	独立董事	-

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员亲属关系

公司董事长林洪河先生与董事、副总经理林毓湘女士系父女关系。

除此之外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在其他亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年违法违规情况

最近三年，公司董事、原监事、高级管理人员及其他核心人员均不存在受到重大行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施，或被中国大陆司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议及履行情况

在公司任职并专职领薪的董事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签署了《劳动合同》或《聘用协议》，对勤勉尽责、保守商业机密、重大知识产权等方面作了规定。独立董事与公司签订了《聘用协议》。

截至本招股说明书签署日，上述《劳动合同》《聘用协议》均得到了有效的执行。

（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况

1、直接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司未设监事，董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如下：

序号	姓名	担任职务或亲属关系	持股数量（万股）	持股比例（%）	质押或冻结情况
1	辜达元	董事、总经理	7.5722	0.0512	否
2	杨耀中	职工董事	12.5722	0.0850	否

除上述情况外，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接持有发行人股份的情况。

2、间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司未设监事，董事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	担任职务或亲属关系	间接持股平台	穿透持股数量（万股）	穿透持股比例（%）
1	林洪河	董事长	FORTUNE	2,271.6517	15.3600
			PERFECT	150.1351	1.0151
2	林毓湘	董事、副总经理、董事长女儿	FORTUNE	1,514.4345	10.2400
			JOINT	437.5142	2.9583
			LINKRICH	22.6957	0.1535
			杭州纮洋	0.7565	0.0051
			杭州澜洋	0.7566	0.0051
3	林瑞堂	董事长儿子	FORTUNE	1,665.8779	11.2640
			PERFECT	66.7267	0.4512
			DYNAMIC	149.4615	1.0106
4	林毓馨	董事长女儿	FORTUNE	984.3824	6.6560
			PERFECT	50.0451	0.3384
			LYH	22.5834	0.1527
5	林张玉珍	董事长配偶	FORTUNE	1,135.8259	7.6800
			PERFECT	66.7267	0.4512

序号	姓名	担任职务或亲属关系	间接持股平台	穿透持股数量（万股）	穿透持股比例（%）
6	黄林秀华	董事长姐姐	NICE	168.4881	1.1392
7	辜达元	董事、 总经理	LINKRICH	75.6525	0.5115
			GOLDRICH	10.0000	0.0676
8	陈意青	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	LINKRICH	62.0177	0.4193
			杭州纮洋	2.8612	0.0194
			杭州澜洋	0.7566	0.0051
			杭州湛洋	0.8000	0.0055
			杭州湟江	10.2128	0.0690
			GOLDRICH	9.3400	0.0631
9	吴哲婉	董事	LINKRICH	31.7741	0.2148
			GOLDRICH	1.5130	0.0102
10	杨耀中	职工董事	杭州澜洋	15.1304	0.1023
11	安田克史	核心技术人员	LINKRICH	15.1305	0.1023

除上述情形外，发行人的董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他间接持有发行人股份的情况。

3、所持股份质押、冻结或诉讼纠纷情况

截至本招股说明书签署日，因发行人间接层面的股权纠纷导致的诉讼情况详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、诉讼或仲裁事项”之“（二）控股股东或实际控制人、子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项”。

除上述情况外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员所持股份不存在其他被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内变动情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内的变动情况如下：

变动日期	变动原因	具体变更情况			
		董事	监事	高级管理人员	其他核心人员
报告期期初	-	林洪河、辜达元、林毓湘、陈意青、刘华、郭耀成、李强共 7 名董事	吴哲婉、桂志义、杨耀中共 3 名监事	辜达元（总经理）、林毓湘（副总经理）、陈意青（副总经理、财务负责人、董事会秘书）共 3 名高级管理人员	林洪河、辜达元、安田克史
2025 年 12 月	根据《公司法》、证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排等规定，取消监事会，增选董事、新增职工董事	增选吴哲婉、杨耀中为董事，其中杨耀中为职工董事。增选后，董事会人数变更为 9 名	取消监事会，不设监事	-	-

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的上述变动符合相关规定，履行了必要的法律程序。公司核心管理层始终保持稳定，上述人员变动未对公司日常管理、持续经营产生不利影响。

（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况如下：

序号	姓名	担任职务	投资企业	持股情况	与发行人及其业务关系
1	林洪河	董事长	H-TEC	通过持股平台 FORTUNE 间接投资：林洪河持有 FORTUNE 的 30.00%股权，FORTUNE 持有 H-TEC 的 64.87%股权	发行人控股股东，持股平台，无实际经营
			PERFECT	直接持股 45.00%	发行人股东，持股平台，无实际经营
			台湾鸿星	通过持股平台金图控股、丰诠投资间接投资：林洪河持有金图控股 16%股权，金图控股持有丰诠投资 100%股权，丰诠投资持有台湾鸿星 56.78%股权	同控企业，从事晶振产品的经销
2	林毓湘	董事、副总经理	H-TEC	通过持股平台 FORTUNE 间接投资：林毓湘持有 FORTUNE 的 20.00%股权，FORTUNE 持有 H-TEC 的 64.87%股权	发行人控股股东，持股平台，无实际经营

序号	姓名	担任职务	投资企业	持股情况	与发行人及其业务关系
			JOINT	直接持股 100.00%	发行人股东，持股平台，无实际经营
			LINKRICH	直接持股 6.43%	发行人股东，持股平台，无实际经营
			杭州纮洋	通过持股平台杭州典河间接持股：林毓湘持有杭州典河100.00%股权，杭州典河持有杭州纮洋 0.24%份额	发行人股东，持股平台，无实际经营
			杭州澜洋	通过持股平台杭州典河间接持股：林毓湘持有杭州典河100.00%股权，杭州典河持有杭州纮洋 0.36%份额	发行人股东，持股平台，无实际经营
			台湾鸿星	通过持股平台金图控股、丰诠投资间接投资：林毓湘持有金图控股 28%股权，金图控股持有丰诠投资 100%股权，丰诠投资持有台湾鸿星56.78%股权	同控企业，从事晶振产品的经销
			HOSONIC THAI	直接持股 0.5%	发行人子公司
3	辜达元	董事、总经理	LINKRICH	直接持股 21.44%	发行人股东，持股平台，无实际经营
			GOLDRICH	直接持股 15.11%	发行人股东，持股平台，无实际经营
4	陈意青	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	LINKRICH	直接持股 17.57%	发行人股东，持股平台，无实际经营
			杭州纮洋	通过持股平台杭州子海间接持股：陈意青持有杭州子海100.00%股权，杭州子海持有杭州纮洋 0.92%份额	发行人股东，持股平台，无实际经营
			杭州澜洋	通过持股平台杭州子海间接持股：陈意青持有杭州子海100.00%股权，杭州子海持有杭州澜洋 0.36%份额	发行人股东，持股平台，无实际经营
			杭州湛洋	通过持股平台杭州子海间接持股：陈意青持有杭州子海100.00%股权，杭州子海持有杭州湛洋 0.63%份额	发行人股东，持股平台，无实际经营
			杭州湟江	通过持股平台杭州子海间接持股：陈意青持有杭州子海100.00%股权，杭州子海持有杭州湟江 9.54%份额	发行人股东，持股平台，无实际经营
			GOLDRICH	直接持股 14.11%	发行人股东，持股平台，无实际经营
5	吴哲婉	董事	LINKRICH	直接持股 9.00%	发行人股东，持股平台，无实际经营
			GOLDRICH	直接持股 2.29%	发行人股东，持股平台，无实际经营

序号	姓名	担任职务	投资企业	持股情况	与发行人及其业务关系
6	杨耀中	职工董事	杭州澜洋	直接持股 7.12%	发行人股东，持股平台，无实际经营
7	安田克史	核心技术人员	LINKRICH	直接持股 4.29%	发行人股东，持股平台，无实际经营

公司董事、高级管理人员及其他核心人员的上述对外投资中，除台湾鸿星及发行人子公司 HOSONIC THAI 以外，其余均为发行人股东持股平台，不涉及利益冲突之情形。

台湾鸿星为发行人在中国台湾地区的下游经销商，与发行人业务不构成竞争关系，具体详见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”。

（九）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

1、薪酬组成和确定依据

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要包括：基本工资、津贴奖金、年终奖、公司缴纳的社保和住房公积金、股份支付费用；公司独立董事每年在公司领取独立董事津贴。

公司董事薪酬由公司股东会决议，高级管理人员薪酬由公司董事会决议，其他核心人员薪酬由公司人力资源部门按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及相关岗位的薪酬水平制定。

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签订了劳动合同或聘任协议，对薪酬事项作出明确约定。

2、薪酬确定所履行的程序

公司董事、高级管理人员的薪酬确定需要履行严格的程序：公司董事的年度薪酬须报经董事会同意后提交股东会审议；高级管理人员的年度薪酬，须提交董事会审议；其他核心人员的薪酬由公司遵照内部决策程序与员工签署劳动合同确定。

3、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额及占当期利润总额的比重

报告期各期，公司董事、原监事、高级管理人员及其他核心人员任职期间每年的薪酬总额分别为 1,007.77 万元、1,003.32 万元和 951.35 万元，占发行人

同期利润总额的比重分别为 6.76%、6.66%和 7.90%。

4、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2025 年度从发行人及关联企业领取收入的情况

公司现任董事、原监事、高级管理人员及其他核心人员 2025 年度在公司及其关联方领取薪酬的情况如下：

序号	姓名	职务	2025 年度薪酬（万元）	是否在关联方领薪
1	林洪河	董事长	197.04	否
2	辜达元	董事、总经理	157.35	否
3	林毓湘	董事、副总经理	108.65	否
4	陈意青	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	122.93	否
5	吴哲婉	董事	93.72	否
6	杨耀中	职工董事	62.46	否
7	刘华	独立董事	15.00	否
8	郭耀成	独立董事	15.00	否
9	李强	独立董事	15.00	否
10	安田克史	核心技术人员	101.29	否
11	桂志义	原监事（2025 年 12 月离任）	62.91	否

除上述情况外，公司董事、原监事、高级管理人员及其他核心人员在公司及其关联方处不存在领取其他收入及享受其他待遇或退休金计划的情况。

十一、发行人申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励

报告期内，公司不存在实施股权激励或期权激励的情况，亦不存在本次发行前制定、上市后实施的股权激励或期权激励。

十二、发行人员工情况

（一）员工情况

报告期各期末，公司员工总数（包括正式员工、退休返聘人员、临时工）分别为 860 名、887 名、1,004 名。此外，公司报告期各期末的劳务派遣人数分别为 27 名、23 名、27 名。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工的专业结构分布如下：

专业分工	人数（名）	占员工总数比例
管理人员	126	12.55%
研发人员	118	11.75%
生产人员	685	68.23%
销售人员	56	5.58%
财务人员	19	1.89%
合计	**1,004**	**100.00%**

（二）劳务派遣情况

报告期内，公司存在劳务派遣的情况，报告期各期末劳务派遣用工人数及占比如下：

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
劳务派遣人数（名）	27	23	27
员工总数（名）	1,004	887	860
劳务派遣人数占比	**2.62%**	**2.53%**	**3.04%**

注：劳务派遣人数占比=劳务派遣人数/（员工总数+劳务派遣人数）

报告期内，公司使用的劳务派遣人员主要从事辅助性工作岗位，劳务派遣人数较少，用工比例均低于 10%，符合《劳务派遣暂行规定》等相关法律法规的要求。

（三）社会保险和住房公积金缴纳情况

1、发行人及境内子公司社会保障情况

（1）社保及公积金缴纳情况

公司依照国家法律法规及地方政府社会保障政策，为符合条件的员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。报告期各期末，发行人及其子公司为员工缴纳社会保险、住房公积金情况如下：

单位：人

项目		2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
员工总人数		1,004	887	860
社会保险缴纳情况	已缴纳人数	965	851	820
	已缴纳比例	**96.12%**	**95.94%**	**95.35%**

项目		2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
住房公积金缴纳情况	已缴纳人数	965	851	820
	已缴纳比例	**96.12%**	**95.94%**	**95.35%**

上述员工未缴纳社会保险和住房公积金的原因主要包括：①公司为部分中国台湾籍员工、中国香港籍员工按照相关规定参保了当地的社会保障政策；②少量外籍员工未缴纳等情况；③退休返聘人员、临时工未缴纳。

（2）主管机关证明情况

①社会保险缴纳证明

发行人及各境内子公司均已取得当地人力资源和社会保障部门出具的证明文件，证明上述公司报告期内均不存在欠缴社会保险，或不存在因违反劳动保障法律法规受到行政处罚的情况。

②住房公积金缴纳证明

发行人及各境内子公司均已取得当地住房公积金管理部门出具的证明文件，证明上述公司报告期内均不存在欠缴住房公积金，或不存在因违反住房公积金法律法规受到行政处罚的情况。

2、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东 H-TEC，实际控制人林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士及其一致行动人林张玉珍女士已出具《关于公司社会保险费与住房公积金缴纳事宜的承诺函》：

“若发行人及其子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本企业/本人将在发行人或其子公司收到有权政府部门出具的生效文件后，全额承担需由发行人或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本企业/本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向发行人或其子公司追偿，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。”

第五节 业务与技术

一、公司主营业务、主要产品的基本情况

（一）公司主营业务、主要产品的基本情况

1、公司主营业务

（1）主营业务概述

公司专业从事石英晶体谐振器、石英晶体振荡器等频率控制元器件的研发、生产和销售，是全球前十大石英晶体频率元器件品牌制造商。公司深耕行业三十余年，致力于为通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制、汽车电子、AI 算力、机器人等领域提供微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化的频率控制与时序解决方案，并依托深厚的技术底蕴，持续驱动频率控制元器件的自主创新与国产化替代。

石英晶体频率元器件作为现代电子系统不可或缺的核心频率控制部件，核心功能是为电子系统提供精准的时钟同步信号与频率基准，其性能直接决定各类电子终端及设备信号处理、数据运算及传输链路的稳定性与可靠性。

公司始终坚持自主研发与技术创新，在长期技术积累与市场实践中实现跨越式发展，已全面掌握晶片及产品设计、制程工艺、溅射镀膜、高精密点胶、封装测试等核心技术，构建了完善的研发、生产与质量管控体系。公司核心产品的微型化、频率精度、运行温度范围等关键性能指标处于行业第一梯队，能够充分满足下游高端应用场景的严苛需求。

公司紧密把握关键电子元器件国产化替代及数字经济基础设施建设的行业发展趋势，持续深耕晶振行业前沿技术研发。在产品端，公司重点布局并持续迭代车规级晶振、高精度 TCXO、高基频差分型振荡器等高性能产品，不断丰富产品规格与品类，形成了覆盖多元化应用场景的频控产品矩阵。在市场端，公司在稳固通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制等核心市场份额的基础上，积极向汽车电子、AI 算力、高速光模块、机器人等高增长新兴市场拓展，目前已实现批量供货。公司通过为下游各应用领域提供稳定可靠的核心元器件支撑，助力提升产业链供应链的韧性与安全水平，进一步巩固并提升公司在全球频率控制元器件领域的市场竞争力与行业影响力。

（2）市场地位及行业影响力

公司是石英晶体元器件的全球主要制造商之一，具有较高的市场知名度和品牌认可度。根据 QYResearch 数据，2024 年全球前十大石英晶体频率元器件厂商合计市场份额 67.92%，其中鸿星科技全球市场占有率为 3.19%，排名全球第九位。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业，近年来被评为高新技术企业、浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省加工贸易创新发展示范企业、浙江省分领域分行业亩均效益领跑者、浙江出口名牌等。公司“小型化高频基本波低抖动压控晶体振荡器”等 13 项新产品获评省级工业新产品，“车载高频石英晶体振荡器”等 24 项新产品获得省级科学技术成果鉴定证书。同时，公司深度参与石英晶体元器件行业标准体系建设，作为主要起草单位完成了 1 项国家标准和 3 项团体标准的制定，目前正在参与 1 项国家标准、1 项行业标准和 3 项团体标准的制定。

（3）技术及产品创新

随着终端设备性能提升、数据传输速率加快及系统对同步性、稳定性和可靠性要求的增强，频率控制元器件正向高性能、高附加值方向升级。在智能汽车、高速通信（5G-A/6G、Wi-Fi7/8、硅光互联）、北斗高精度定位、算力基础设施及新型智能终端等下游应用驱动下，行业呈现出微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等发展趋势。

在关键元器件国产化替代持续深化的背景下，公司积极把握频率控制元器件行业技术升级与下游应用领域拓展的市场机遇。历经多年的技术创新与沉淀，公司在高精度高频设计、精密制造及测量技术等领域形成了一系列成熟的研发与工艺成果。公司在技术与产品创新方面的具体情况如下：

① 微型化、高频化、高精度协同技术突破

针对下游电子终端对晶振尺寸、频率、精度同步提升的需求，公司顺应行业发展趋势实现微型化、高频化、高精度三大方向的协同突破：

A、微型化制程能力：为顺应通讯电子、消费电子及物联网模组向轻薄化、小型化发展的趋势，发行人微型化晶振产品中，1210、1008 规格均已实现规模化量产及市场化应用，精准适配通讯电子、智能穿戴设备等场景的微型化装配

需求。

B、高频化技术突破：公司通过优化高频制备工艺及核心材料研发，实现谐振器频率 76.8MHz、80MHz、96MHz 批量供应，差分高频振荡器频率突破 312.5MHz，精准匹配 Wi-Fi 7/8、5G-A/6G 通信、高速光模块等场景的高频需求。

C、高精度性能升级：公司通过精密频率调整及高性能封装等技术，有效降低温度、湿度等环境因素对频率稳定性的影响，实现更高精度的频率控制，持续提升产品附加价值与市场竞争力。

② 低抖动、低功耗差分振荡器全场景布局

针对 AI 算力、高速通讯、汽车电子等应用场景对低抖动差分振荡器的刚性需求，公司聚焦高频差分振荡器的研发与优化，重点突破极低相位抖动的技术瓶颈。目前，公司 LV-PECL、LVDS、HCSL 三种类型晶振的相位抖动可低至 30fs，能够有效降低高速信号传输中的误码率，避免信号“微波动”导致的数据同步偏差，已逐步在 800G/1.6T 光模块、AI 服务器 GPU 与 CPU 集群等超高速场景完成送样、适配及量产。

③ 宽温化、高可靠性车规级产品场景应用

针对车规级场景对宽温、高可靠、抗振动、长寿命的核心要求，公司已构建完整适配汽车电子场景的车规级技术与质量体系，能够深度切入智能辅助驾驶、车载通信等新能源汽车相关的高增长细分应用领域并形成规模化供应：

A、资质准入：公司已通过 ISO 9001:2015 及 IATF 16949:2016 汽车行业质量管理体系认证，满足汽车供应链强制准入要求，具备进入整车厂及一级供应商体系的核心资质。

B、宽温能力：公司车规级晶振产品的工作温度范围已从工业级的-40℃至+85℃拓展至-40℃至+125℃，可稳定支撑智能辅助驾驶域控制器、车身控制模块等高温、高振动、高干扰的严苛车载场景。

C、全生命周期可靠性：公司已在关键制造环节形成成熟且稳定的工艺，实现车规级晶振产品从“出厂达标”向“长期使用仍保持稳定性能”的升级。同时，公司建立了覆盖晶体设计、样品试制、批量生产全环节的车规级测试验证体系，可独立完成 AEC-Q200 车用被动元器件的温度循环、高温高湿、机械振动、耐冲击等全项严苛测试，全面满足车用场景的可靠性要求，具备提供符

合车规级要求的产品能力。此外，公司具备车规级产品所需的供货能力与供应链稳定管控能力以确保下游客户供应链的稳定性。

（4）主要客户情况

报告期内，公司以石英晶体谐振器、石英晶体振荡器为核心，主要客户覆盖通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制等核心应用领域，并持续向汽车电子、AI 算力、高速光模块、机器人等新兴应用领域拓展，形成了“核心领域稳健增长、新兴领域前瞻布局”的客户结构与应用场景矩阵。

公司主要客户包括客户 A、客户 B、客户 C、客户 D、长虹等国内外知名电子品牌商和通信设备制造商以及富士康、伟创力、客户 H 等知名电子制造服务商，产品最终应用于惠普、戴尔、思科、索尼、金士顿、希捷等众多品牌的终端电子产品。

2、公司主要产品

（1）主要产品概述

石英晶振是利用石英晶体（二氧化硅）的压电效应制成的频率控制元器件，可以产生稳定的脉冲，为电路提供基准频率信号，属于计时、频率控制等各类电子设备的关键基础元器件，其核心功能在于为电子系统提供精准的频率基准与时钟同步。例如，在蓝牙、Wi-Fi、5G 及卫星导航等无线通信射频前端，晶振能够提供高稳定的载波基准频率，确保射频通信的稳定性与接收灵敏度，直接决定通信链路的传输质量；在 MCU、CPU、DSP 及各类传感器等有源芯片中，晶振为其提供工作时钟，驱动指令周期同步、数据采样与处理逻辑的协调运行，从而保证信号处理与数据运算的可靠性。

公司依托于在石英晶体元器件领域多年积累的晶片及产品设计、制程工艺及封装测试等核心技术，具备微型片式、高频晶体谐振器、晶体振荡器规模化生产的技术基础，覆盖从 kHz 级到 MHz 级晶体的全频段需求。同时，公司持续扩大高基频产品、差分型振荡器、车规级晶振等高附加值产品的产能布局，产品不断向着微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等方向发展延伸。

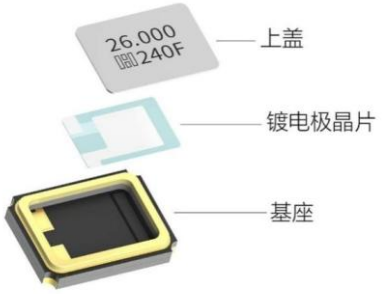
（2）主要产品型号及用途

报告期内，公司主要产品分为石英晶体谐振器和石英晶体振荡器两大类，

具体情况如下：

①石英晶体谐振器

公司石英晶体谐振器的特点及产品结构图示如下：

产品类型	产品特点	产品结构图示
石英晶体谐振器	晶体谐振器是通过在石英晶片两面镀上电极而构成的频率元件。交变信号加载至电极两端时，谐振器依靠压电效应稳定起振于特定频率；谐振频率与晶片厚度、切割工艺密切相关，经由精密加工，可实现指定频率输出。	

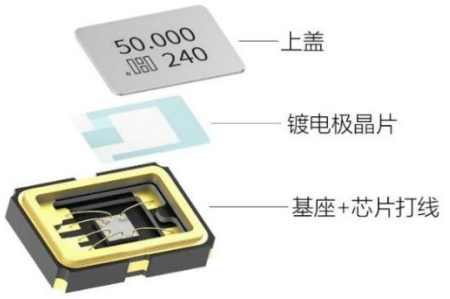
公司石英晶体谐振器的主要产品型号及用途如下：

产品类别		频率范围	型号	应用领域	产品示例图片
谐振器	石英晶体谐振器（SMD）	8~100MHz	1008 ~ 5032	物联网应用、移动终端、智能家居、智能穿戴、网络通讯设备、汽车电子、工控产品、智能医疗等	
	音叉型石英晶体谐振器	32.768kHz	1610 ~ 3215	智能手机、智能穿戴、工控产品、智能医疗等	
	热敏石英晶体谐振器（TSX）	19.2~76.8MHz	1612 ~ 2520	智能手机、智能手表/手环、汽车电子、AI 眼镜、AI 穿戴式产品等	

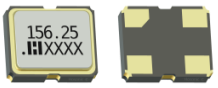
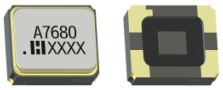
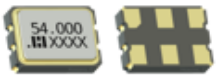
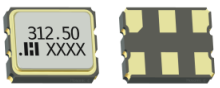
注：型号区分标准主要为产品尺寸，行业内通常用四位整数表示产品尺寸，前两位为长度，后两位为宽度，数字越小则产品尺寸越小。例如：1210 表示该型号石英晶体元件长宽为 1.2mm×1.0mm。

②石英晶体振荡器

公司石英晶体振荡器的特点及产品结构图示如下：

产品类型	产品特点	产品结构图示
石英晶体振荡器	石英晶体振荡器（有源晶振）则含振荡、放大等完整电路，加入电流电压后直接输出稳定时钟信号。包含普通晶体振荡器（SPXO）、温补晶体振荡器（TCXO）、压控晶体振荡器（VCXO）、差分振荡器等子品类。	

公司石英晶体振荡器的主要产品型号及用途如下：

产品类别		频率范围	型号	应用领域	产品图片
振荡器	普通晶体振荡器（SPXO）	1~156.250MHz、32.768kHz	1612～5032	智能穿戴、智能终端、汽车电子、云端与边缘运算、网络通讯设备、激光雷达、机器人、工控产品等	
	温补晶体振荡器（TCXO）	9.6~76.8MHz	1612～2520	智能手机、汽车电子、无人机、卫星定位、工控产品等	
	压控晶体振荡器（VCXO）	1.75~122.88MHz	3225～5032	通讯基站、网络设备等	
	差分振荡器	25~312.5MHz	2016～5032	AI 服务器、AI 算力卡、智能驾驶、光模块、机器人、网络通讯设备等	

注：型号区分标准主要为产品尺寸，行业内通常用四位整数表示产品尺寸，前两位为长度，后两位为宽度，数字越小则产品尺寸越小。例如：1210 表示该型号石英晶体元件长宽为 1.2mm×1.0mm。

（3）主要产品应用领域

公司主要产品广泛应用于通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制等核心市场，为电子设备提供精准的时钟频率基准。同时，产品已逐步延伸至汽车电子（智能座舱、车载通信、域控制器）、AI 算力（服务器、高速光模块）、机器

人等新兴市场，满足其对高频化、高精度、宽温化等性能要求。公司产品在不同场景的应用情况如下：



①核心应用领域

A、通讯电子领域

晶振产品为 5G 基站、Wi-Fi、蓝牙等提供高稳定度频率控制与时钟同步，是保障通信链路可靠性的关键元件，5G-A/6G 及 Wi-Fi 7/8 等通信技术的发展驱动通讯电子领域对高频化、高精度晶振的需求持续增强。在通信基础设施领域，公司产品已进入客户 K、客户 A、锐捷等主流通信设备商供应链，覆盖基站、路由器、交换机等场景。

在卫星导航定位细分领域，随着北斗规模化应用加速，智能手机、车载导航、无人机等终端对定位精度的要求持续提升，高精度 TCXO 市场需求稳步增长。AI 辅助定位、融合感知等新技术对时钟源的长期稳定性和抗干扰能力提出更高挑战。公司高精度 TCXO 产品为 GNSS 模组提供高稳定性频率基准。目前，公司正持续与产业主流定位服务供应商及导航定位模组厂商开展合作，共同推动高可靠性温补晶振在定位领域的业务拓展。

B、消费电子领域

不同频率的石英晶体频率元器件在终端电子产品中分别用于处理器指令周期同步、射频通信稳定性保障及摄像头帧率控制等关键功能。

随着终端设备向轻薄化、长续航及高集成度方向发展，公司持续为智能手

机、TWS 耳机、智能穿戴设备、平板电脑等提供小型化谐振器及低相噪抖动振荡器产品。产品封装尺寸最小可达 1.0mm×0.8mm，有效满足便携设备对空间和功耗的严苛要求。公司已服务于多家国内外知名品牌及 ODM 厂商，在主流芯片平台参考设计中实现广泛适配。

C、AIoT 领域

晶振产品在 AIoT 领域发挥着关键作用，为智能家居、智慧城市、智慧商业等场景提供高精度时钟源，以低功耗、高可靠的特性支撑海量节点间的稳定通信与高效协同。

针对 AIoT 多样化需求，公司提供 kHz 音叉晶体及 MHz 晶体，具备宽工作温度范围和长期频率稳定性，并已与多家模组厂商深度合作，广泛应用于低功耗广域网（LPWAN）等无线连接模块，助力万物互联的时钟同步与低功耗唤醒需求。随着端侧 AI 算力下沉，公司持续推出适配 AIoT 边缘计算场景的超小型、低抖动晶振，满足设备对快速启动、高精度及抗干扰的更高要求，进一步巩固在 AIoT 市场的配套优势。

D、工业控制领域

工业控制领域涵盖工厂自动化、过程控制、运动控制及能源管理等场景，设备通常需在宽温、高湿、强电磁干扰等恶劣环境下长期稳定运行，对石英晶体元器件的宽温范围、高可靠性、抗振动、长寿命提出严格要求。

公司已开发适配工业场景的谐振器及振荡器产品，可满足工业伺服驱动、光伏组件、储能系统等应用的时钟同步与控制需求。公司产品亦在光伏逆变器、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）等新能源配套领域实现批量交付，进入工控品牌供应链并服务于行业主流客户，形成较为稳定的业务布局，持续受益于制造业智能化与能源结构转型的长期趋势。

②新兴应用领域

A、汽车电子领域

晶振产品可为高级驾驶辅助系统、车载通信、汽车多媒体等汽车电子功能模块提供高精度时钟同步与频率控制，保障各独立功能模块的稳定运行，满足汽车智能化对宽温、高可靠、抗振动、抗干扰等性能要求。

公司多款车规级产品已通过 AEC-Q200 认证，广泛应用于智能座舱、车载

远程通信终端、车载充电机、域控制器等核心汽车电子单元。公司已实现对多家知名一级汽车零部件供应商的批量供货，产品最终应用于国产主流终端汽车品牌。

B、AI 算力领域

石英晶体频率元器件应用于服务器主控 SoC、GPU 加速卡、内存控制器等 AI 算力核心部件，通过提升基频、减少倍频级数，可降低主频相位噪声及系统抖动，保障高速数据传输稳定性。

随着 AI 算力需求增长，公司推出的高频振荡器及差分振荡器系列产品已通过主要算力基础设施及服务提供商验证，并向客户 K、锐捷、客户 A 等客户批量供货。具体应用情况如下：

其一、在处理器及服务器配套领域：公司为 NPU、GPU、AI 服务器及视觉计算/芯片加速卡等领域提供多尺寸谐振器、振荡器及差分振荡器（包括 100MHz、156.25MHz、312.5MHz 等频率）。

其二、在算力存储领域：随着 AI 模型训练过程中数据处理与存储需求的增长，高性能固态硬盘（SSD）及机械硬盘（HDD）成为市场趋势。公司小型化 1612、2016 尺寸谐振器产品已被客户 L、客户 M、客户 I、希捷（Seagate）等头部客户采用。

其三、在光模块领域：公司已成功开发尺寸为 2.0mm×1.6mm 的高频差分振荡器，陆续进入光模块产业链供应商体系。

C、机器人领域

石英晶体频率元器件广泛应用于机器人主控芯片、通信模块、视觉系统、关节驱动及电池管理等环节，满足复杂运动控制与实时响应需求。随着机器人产业向高精度、高负载及规模化量产发展，对微型化、宽温、抗振动、高可靠性晶振的需求显著增加。

公司开发了抗振动谐振器及振荡器，并具备微型化晶体振荡器（如 1612 封装）的量产能力。相关产品已导入多家机器人产业链客户的供应链，应用于电机与驱动系统、3D 视觉模组、AI 视觉系统、关节驱动等核心功能模块并实现批量交付，为机器人核心部件的国产化配套提供关键频率源支持。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

（1）采购制度与职能部门

公司建立了较为完善的供应商管理体系及采购控制流程，多维度综合评审、动态管控供应商，择优选择以保障采购品质、供应及时及成本合理，支撑生产有序开展。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。公司已建立供应商准入制度，新入供应商需通过相应评审方可入选合格供应商名录。

公司采购工作主要由供应链中心牵头负责，下属采购部、物料部和物流部，部门主要有以下三大职责：①策略制订，开发及日常管理、维护，定期对供应商评价、稽核，编制合格供应商清单；②负责公司采购计划的编制与执行工作，以及对采购合同的签订与存档进行管理工作；③负责公司采购物资的质量与成本控制工作，对采购执行过程进行控制管理，确保采购进度能够满足生产需要。

（2）采购内容

公司原材料采购对象主要分为三类，包括：主要原材料（基座、上盖、晶片、芯片等），生产辅料（导电胶、引线、电极材料等），非生产材料及相关配件（生产机器设备、机器设备配套零部件等）等。

（3）委外加工采购

公司存在少量委外加工，即靶材加工。在石英晶片镀膜工序中，公司需使用少量贵金属靶材。公司采购金银等材料后委托第三方加工为金属靶材，以及对使用消耗后的金属靶材进行二次加工后循环利用。该工序不涉及关键技术，相关工序较容易找到替代厂商。

报告期内，公司委外加工情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
委外加工金额	108.92	75.53	32.77
主营业务成本	39,480.51	32,902.52	29,717.42
占比	**0.28%**	**0.23%**	**0.11%**

2、生产模式

公司根据生产计划采取“以销定产、适度备货”的生产模式进行生产。生产中心根据在手订单、年度销售计划、公司设备产能制定年度生产计划，各制造部门根据年度生产计划和客户订单实际情况组织生产。生产过程中，生产中心对整个生产制造过程进行监督控制。

公司对生产过程进行严格的程序控制，控制程序主要包括《生产计划管理制度》《生产计划管制程序》《制程管制程序》等，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行识别和控制，确保整个生产过程在受控状态下有序进行，不断改善生产过程、提高生产效率、保证产品质量。

公司生产主要由生产中心负责，其主要职能包括：（1）工艺改进：负责督导生产工艺的改进及合理化、持续改善产品品质、降低生产成本，推动生产力提升；（2）制订流程：建立生产流程，负责制订生产作业管理制度规范、监督实施，并对员工进行培训与考核；（3）生产：主要负责执行计划的执行、跟踪、验证，监控产品生产进度，完善产品生产周期制订，提高工作效率，确保产品按期交付。

3、营销及管理模式

本公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。公司直销模式直接面对终端客户，与重要客户维持长期的战略合作关系；经销模式由经销商买断销售。报告期内，公司对外销售产品主要由公司生产。为了满足客户的多元化需求，以及弥补因订单集中造成的阶段性产能不足，公司存在少量外购石英晶体元器件成品进行销售的情形。

4、采用目前经营模式的原因及影响经营模式的关键因素

公司采用目前经营模式主要是结合国家电子元器件产业政策及规划、公司所处石英晶体元器件行业特点及上下游发展情况等因素综合考量后决定的，影响公司经营模式的关键因素包括行业规划、上下游市场供求、客户类型等。报告期内公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一定时间内公司的经营模式不会发生重大变化。

（三）发行人设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

公司自成立以来一直专注于石英晶体元器件的研发、生产和销售，始终围绕“立足中国、面向世界”的使命，不断加强自主创新与产品发展，致力于成为在细分领域领先、具有国际竞争力的企业。公司自设立以来的主要发展阶段如下：



1、奠定基础（1993 年至 2002 年）

公司成立初期主要产品为 DIP 型石英振荡器，主要通过 OEM 模式（贴牌代工）承接欧美客户订单。1997 年，公司增加石英晶体谐振器相关型号产品线，主要客户以美国、巴西、欧洲等海外 OEM 客户为主，逐步拓展自有品牌和国内业务，至 1998 年，公司自有品牌销售（OBM 模式）占比达到 30%左右，产品主要应用于网络通讯市场。1999 年逐步拓展国内网络通讯基站和家电市场。2000 年开始引入 SMD 型石英谐振器生产线，逐步量产 8045/7050/6035 等大尺寸系列的石英晶体谐振器。

2、企业转型（2002 年至 2005 年）

公司大力拓展全球市场，获得多家终端品牌商和知名代工厂的供应商认证，与富士康、客户 J 等知名代工厂建立合作关系，构建了全球产业链合作发展模式。公司“Hosonic”品牌开始崭露头角，完成从 OEM 模式向 OBM 自有品牌经营模式的转型。2004 年将业务拓展至韩国市场，获得客户 B、LG 等韩国品牌客户的认证。公司瞄准产业发展趋势，将产品应用领域拓展至消费电子、储存等产业，公司开始与以客户 I 为代表的存储领域客户开展合作。2006 年前后，公司在直销模式为主的基础上开发经销商模式，并借助联发科手机芯片解决方案的兴起大力拓展国内手机市场，公司 3225 尺寸系列产品的销量快速增长。

3、产品升级，应用场景扩宽（2006 年至 2018 年）

因应市场需求，公司产品逐步向小尺寸、高精度、高频化、高稳定度方向发展。公司于 2006 年量产 2520 尺寸产品，主推消费电子市场；2008 年，公司量产 2016 尺寸产品，主推个人穿戴产品市场；公司于 2012 年量产 1612 尺寸产品，公司产品指标始终处于国内领先水平。同时，公司产品实现多个产业的应用和覆盖。

4、持续扩产，高速发展（2019 年至 2024 年）

公司不断投入新设备、新技术，产能逐年提升，并投建德清生产基地。在智慧医疗、汽车电子、IoT、工控领域，公司不断取得新客户认证，相关领域销售额逐步提升，公司产值逐年提升。期间，公司先后获得“浙江省制造业重点行业亩均效益领跑者称号”、国家级专精特新“小巨人”企业称号。

5、创新突破，智领未来（2025 年至今）

公司坚持以技术创新为核心驱动引擎，全面加速产品迭代升级，构建多系列、微型化、超高频产品矩阵，产品性能位居行业前列，精准匹配高端设备核心频率控制需求。目前，公司已完成 1008 系列微小型晶振产品规模化布局，并进一步完善表晶、TCXO 及 VCXO 产品系列的量产；实现超高频振荡器量产落地，同步攻坚更高频产品研发，持续构筑高壁垒核心竞争力。

同时，公司紧抓人工智能产业发展浪潮，依托杭州、德清双基地产能支撑，深度布局 AI 算力、高速光模块、机器人等前沿赛道，全方位拓展新兴领域市场

份额。

（四）公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况

1、公司主要业务经营情况

报告期内，发行人主要经营数据和财务指标情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务收入（万元）	63,211.96	56,738.44	54,091.17
主营业务毛利（万元）	23,731.44	23,835.92	24,373.75
主营业务毛利率	37.54%	42.01%	45.06%
净利润（万元）	10,832.13	13,303.66	13,290.75
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,831.89	13,303.66	13,290.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	10,586.44	12,635.44	12,413.25

2023 年，受宏观经济和行业周期性因素影响，行业整体处于去库存阶段，终端市场需求承压。随着产业链去库存基本完成，终端需求触底复苏，叠加 AI 及光通信等新技术应用不断落地，电子产业自 2024 年第一季度起经营业绩有所改善，全球消费电子市场呈现显著复苏态势，公司 2024 年度和 2025 年度销售收入持续增长。

因市场竞争加剧，报告期内，公司主营业务毛利率呈现下降趋势。

报告期各期，主营业务毛利率和净利润变动具体原因分析详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（三）毛利、毛利率及变化趋势分析”。

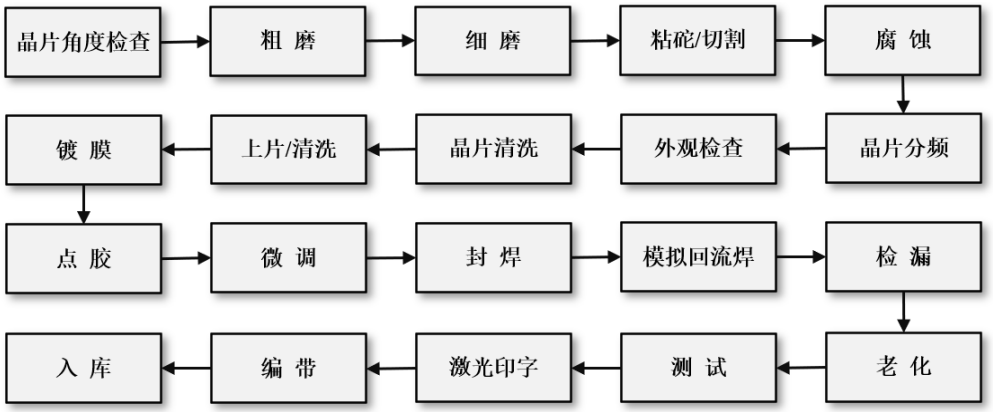
2、公司核心技术产业化情况

发行人在多年发展过程中，积累了石英晶体元器件领域丰富的技术经验和成果，该等技术或成果已大量应用于公司产品中，构建了较为完善的产业化体系。公司在晶片的设计、制造和石英晶振产品的研发、生产及测试等环节实现了上下游垂直的技术资源整合，掌握了一系列核心技术，包括高精度高频产品设计技术、晶振产品精密制造技术、晶振产品测量技术等，能够为客户提供性能优异、质量稳定、可靠性强的产品，赢得了良好的市场口碑，获得下游众多知名客户的认可。公司的核心技术及其在实际生产经营中的应用情况请详见本

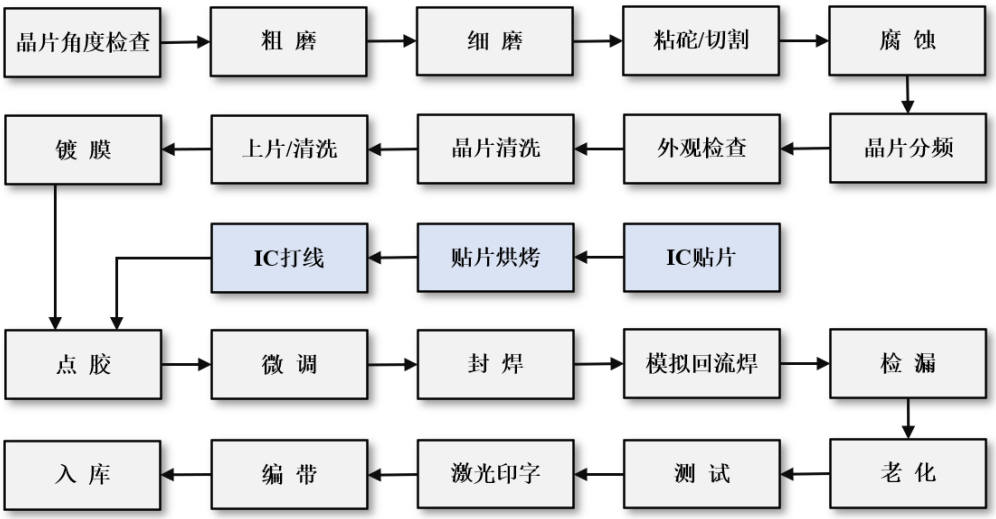
节“五、公司技术与研发情况”之“（一）公司核心技术情况”。

（五）主要产品的生产工艺流程

1、谐振器



2、振荡器



（六）报告期各期具有代表性的业务指标及其变动情况

报告期各期具有代表性的业务指标、变动情况及原因详见本节“一、公司主营业务、主要产品的基本情况”之“（四）公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况”之“1、公司主要业务经营情况”。

（七）公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

近年来，国家出台了一系列产业政策，支持和鼓励包括石英晶振在内的电子元器件行业的发展，大力培育物联网、高速通讯、智能辅助驾驶、AI 算力、机器人等下游行业，有利保障了行业的健康发展，具体情况详见本节“二、公

司所处行业基本情况”之“（二）行业主管部门及管理体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响”之“2、行业主要的法律、法规及政策”。

二、公司所处行业基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司专业从事石英晶体谐振器、振荡器等频率控制元器件的研发、生产和销售，属于电子元器件的细分行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司主营业务属于“C 制造业”门类中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C3989 其他电子元件制造”。根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司主要产品属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

（二）行业主管部门及管理体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门和监管体制

电子元器件行业的主管部门为国家发改委以及国家工业和信息化部，行业自律组织为中国电子元件行业协会。上述主管部门、自律组织的主要职能如下：

主管部门/自律组织	主要职能
国家发改委	负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议；推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划等
国家工业和信息化部	负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；振兴电子信息产品制造业、通信业和软件业，推进国民经济与社会服务信息化；拟定电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规，发布行政规章；负责行政执法和执法监督；组织制订电子信息产品制造业、通信业和软件业的技术政策、技术体制和技术标准等。
中国电子元件行业协会	负责规范行业行为，进行价格协调，维护公平竞争；协调会员关系；制定行业规范；参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督；提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

2、行业主要的法律、法规及政策

近年来，国家相关部委出台了一系列关于支持和鼓励包含石英晶振在内的电子元器件行业发展的政策法规。主要法规和政策性文件如下：

序号	政策名称	发布时间	发布单位	相关内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	2026 年 3 月	全国人民代表大会	推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料。
2	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	2025 年 8 月	工信部、市场监管总局	2025 至 2026 年，主要预期目标是：规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7%左右，加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到 5%以上。到 2026 年，预期实现营收规模和出口比例在 41 个工业大类中保持首位，5 个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过 4,000 亿元，75 英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过 40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进。
3	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	2024 年 1 月	工业和信息化部等七部门	补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。
4	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	2023 年 12 月	国家发改委	将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件）制造列入鼓励类。
5	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	2023 年 1 月	工业和信息化部等六部门	推动基础元器件、基础材料、基础工艺等领域重点突破，锻造产业长板，补齐基础短板，提升产业链供应链抗风险能力。
6	《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》	2022 年 12 月	国务院	实现科技高水平自立自强，聚焦核心基础零部件及元器件、关键基础材料、关键基础软件、先进基础工艺和产业技术基础，引导产业链上下游联合攻关。
7	《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》	2022 年 9 月	国务院	统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度；支持符合条件的基础电子企业上市融资。
8	《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》	2021 年 9 月	中国电子元件行业协会	进一步加快 MEMS、光刻腐蚀等半导体工艺与传统压电晶体器件技术的融合创新，鼓励行业骨干企业扩大片式化、小型化、高频、高可靠的高端压电晶体器件产销规模；着力培育压电晶体行业优秀本土品牌，提高自主品牌产品的销售比例。
9	《基础电子元	2021 年 1 月	工业和信	重点发展微型化、片式化阻容感元

序号	政策名称	发布时间	发布单位	相关内容
	器件产业发展行动计划（2021-2023年）》		息化部	件，高频率、高精度频率元器件，耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块，小型化、高可靠、高灵敏度电子防护器件，高性能、多功能、高密度混合集成电路。

3、行业主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响

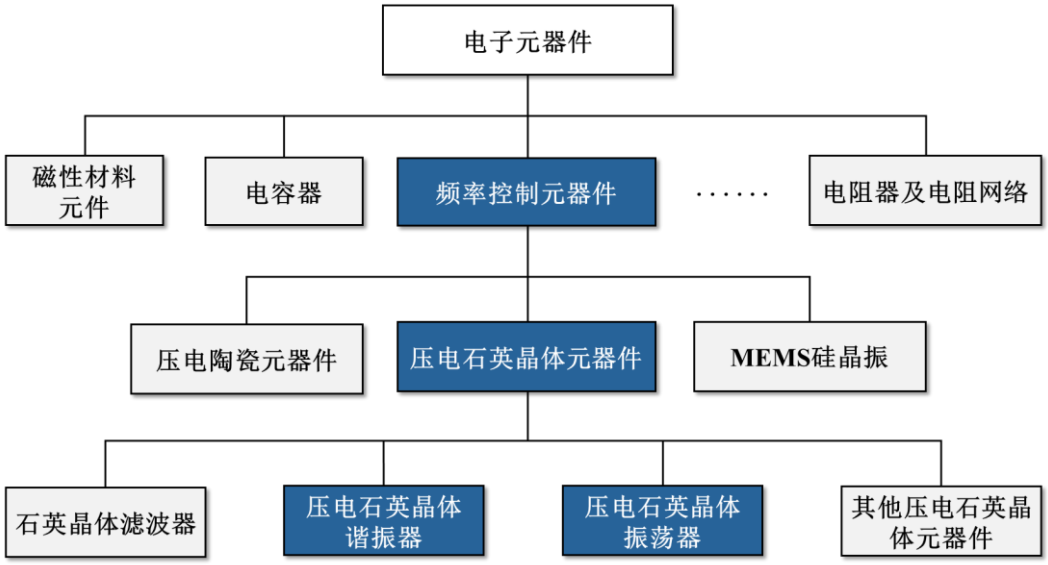
电子元器件作为电子信息产业的重要组成部分，属于国家重点鼓励发展的产业之一，其技术先进程度、供应链稳定性与生产规模均直接影响电子信息技术行业的发展。近年来，中共中央、国务院及各部委先后发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》等多项产业支持政策，持续推动基础电子元器件实现突破，增强关键电子元器件的供应链保障能力，提升产业链、供应链现代化水平，统筹有关政策资源，加大对基础电子产业升级及关键技术突破的支持力度，为公司石英晶体谐振器、石英晶体振荡器等电子元器件业务发展提供了坚实的政策保障和良好的市场环境。

报告期初以来新制定或修订的法律法规不会对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不利影响。

（三）行业发展情况及发展态势

1、电子元器件行业概述

公司隶属于电子元器件行业中的压电石英晶体元器件子行业。行业分类如下图所示：



2、石英晶体元器件行业概述

石英晶体元器件是利用石英晶体的压电效应制成的频率控制元器件，可以产生稳定的脉冲，广泛运用于各类电子产品的振荡电路中，为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号，被誉为“数字电路的心脏”。

石英晶体元器件按属性可划分为石英晶体谐振器和石英晶体振荡器两类，按照封装方式可分为双列直插式（DIP）、表面贴装式（SMD）；按频率可分为 kHz 石英晶振、MHz 石英晶振。

石英晶体元器件产品按功能属性、封装方式、频率分类介绍

分类	类别	概述	功能用途
功能属性	石英晶体谐振器	又称“无源晶振”，是通过在石英晶片两面镀上电极而构成的频率元件。交变信号加载至电极两端时，谐振器依靠压电效应稳定起振于特定频率；谐振频率与晶片厚度、切割工艺密切相关，经由精密加工，可实现指定频率输出。谐振器可进一步分为普通、音叉、热敏等类型	应用范围广，广泛运用于各类频率控制、频率稳定、频率选择和计时系统中
	石英晶体振荡器	又称“有源晶振”，是晶体谐振器和振荡电路（IC）集成在一个封装中，由于晶体单元和振荡电路之间的匹配调整已经完成，因此可输出高稳定度的频率信号。振荡器可进一步分为晶体振荡器（SPXO）、温补（TCXO）、压控（VCXO）、压控温补（VC-TCXO）、恒温（OCXO）、差分等类型	凭借高精度、低漂移、高稳定性的优势，广泛应用于通信设备、系统时钟、传感检测、工业控制等对频率源要求严苛的领域

分类	类别	概述	功能用途
封装方式	双列直插式（DIP）	此封装形式适合穿孔式 PCB，布线较为方便等特点	应用范围逐渐缩小，主要在家用电器、电子玩具、石英钟表等安装空间较大的电子产品中
	表面贴装式（SMD）	此封装形式具有组装密度高、产品体积小、重量轻、可靠性高、抗振能力强和高频特性好等优点	在移动终端、通讯设备的产品升级周期加快、小型化的背景下，呈现稳步增长的态势，已成市场主流形态
频率	kHz 石英晶体元件	是实时时钟（RTC）电路中的核心关键器件；主要为 32.768kHz 频率	为工业控制、移动终端、智能穿戴、智能医疗等传统与新型应用提供时钟信号
	MHz 石英晶体元件	工作频率在兆赫兹（10^6Hz）量级的频率元件，为电子系统提供高精度、高稳定的时钟基准，谐振器频率范围 8MHz~100MHz；振荡器频率范围 1MHz~312.5MHz，是通信、工控、机器人等领域的核心元器件	为 5G 小基站、物联网、移动终端、智能穿戴、AI 服务器、智能医疗等传统与新型应用提供基准频率信号

3、石英晶体元器件行业发展态势

石英晶体元器件行业呈现出“市场稳步扩容、国产替代与产品升级并进、竞争逻辑向价值驱动转变”的多维度发展态势。在市场规模方面，应用领域持续深化与技术迭代形成双重驱动力，共同推动晶振市场稳步增长。在区域化竞争方面，中国大陆作为晶振市场的主要制造基地之一，叠加国产替代从中低端向中高端结构优化，为国内晶振市场创造了良好的发展机遇。在产品价值与竞争逻辑方面，下游应用领域的拓展推动产品性能不断提升，晶振产品正以通用标准品为基础并逐步延伸至面向具体应用场景的解决方案，驱动行业竞争逻辑从成本与规模竞争逐步转向高端化产品的开拓速度及技术迭代能力的竞争。具体市场发展态势如下：

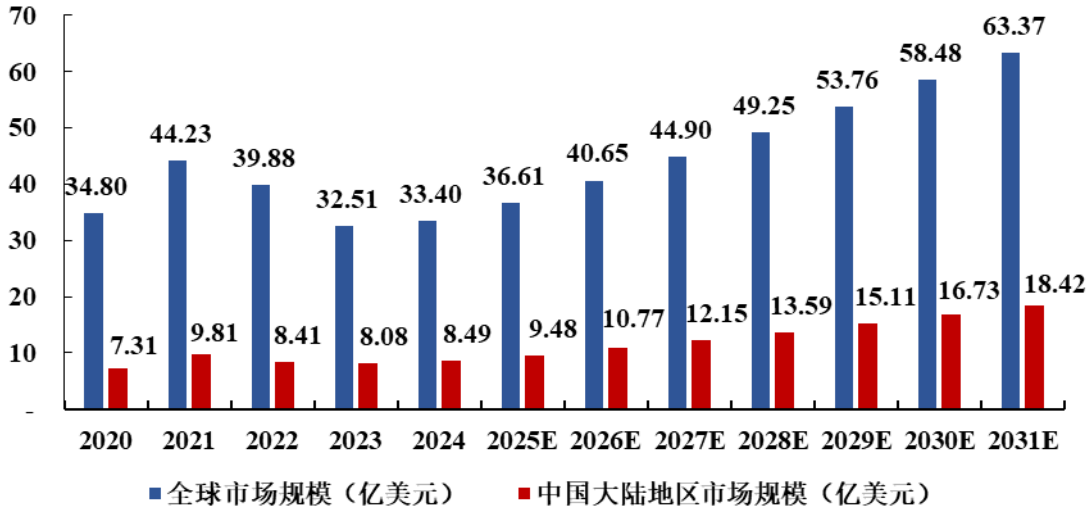
（1）技术迭代与下游应用领域深化，双轮驱动晶振市场规模增长

作为关键的频率控制元器件，石英晶体元器件行业的增长受益于技术迭代与下游应用领域深化双重驱动。在技术端，AI 技术在消费电子、通讯电子、汽车电子等领域的深度渗透，以及光通信技术、智能硬件等关键技术的突破，加速了终端产品的创新迭代，丰富了晶振产品的应用场景，推动产品向微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等方向升级，进而拉动市场用量与价值量提升。在需求端，下游应用领域正向新兴赛道持续拓展：从智能手机、平板电脑

等消费电子终端延伸至车载信息娱乐与自动驾驶系统，从基站、路由器等通信设备延伸至 AI 服务器与高速光模块中的算力集群。同时，端侧 AI 落地、智能驾驶功能持续进阶、数据中心与算力基础设施加速部署以及具身机器人产业化进程启动等新兴业态的不断涌现，持续拓宽晶振行业的应用边界，驱动石英晶振市场需求稳步增长。

根据 QYResearch 数据，2024 年全球石英晶体元器件市场规模为 33.40 亿美元，预计 2031 年将达 63.37 亿美元，复合增长率为 9.58%。2024 年中国大陆地区石英晶体元器件市场规模为 8.49 亿美元，预计 2031 年将达 18.42 亿美元，复合增长率为 11.70%。

2020 年-2031 年全球及中国大陆地区石英晶振元器件市场规模

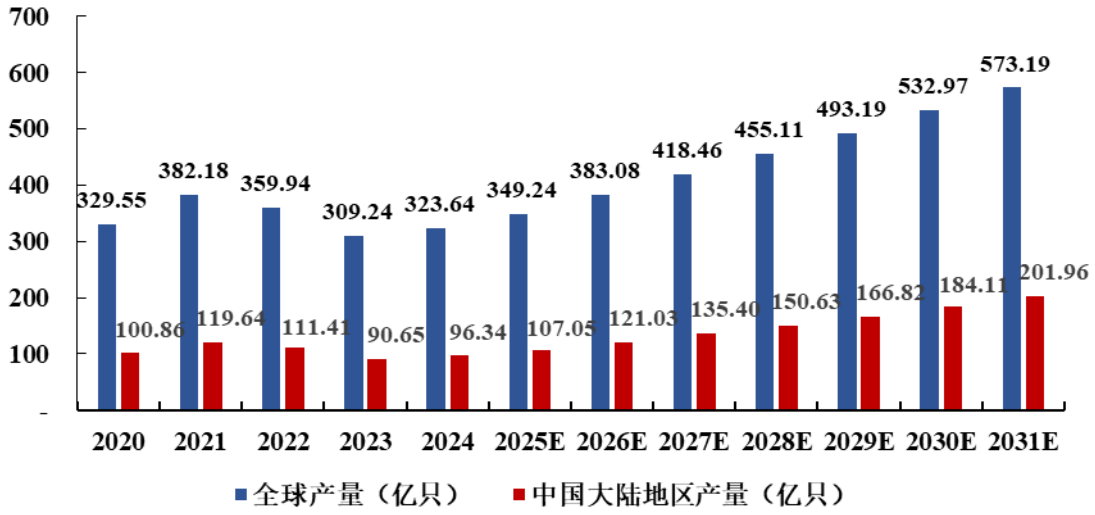


数据来源：QYResearch

（2）主要制造基地地位与国产替代，叠加推动国内晶振市场发展

下游产业的蓬勃发展态势为我国石英晶体元器件行业发展提供了良好的市场基础。中国大陆地区目前已成为全球石英晶体元器件的主要制造基地之一。根据 QYResearch 统计，2024 年全球石英晶体元器件市场产量规模为 323.64 亿只，中国大陆地区产量规模为 96.34 亿只，约占全球的 29.77%。

2020 年-2031 年全球及中国大陆地区石英晶振元器件产量情况



数据来源：QYResearch

受国际形势与全球贸易环境影响，产业链自主可控成为我国电子信息产业发展的关键，石英晶振作为基础频率控制元器件，其供应稳定性备受关注。在此背景下，国内终端厂商日益倾向于与本土供应商建立长期合作，为国产高端晶振产品提供了市场验证与发展机遇。同时，本土行业龙头企业在频率范围、微型化工艺、技术认证及原材料采购等方面不断取得进展，加大研发力度，更加贴近终端市场并及时响应需求变化，积极向微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等附加值提升方向延伸，已具备中高端产品的市场开拓与认证能力。

自主可控需求与本土头部厂商竞争力的提升，加快了中高端产品的国产替代节奏，推动产业持续升级。依托我国作为全球石英晶振主要制造基地的既有地位，以及完善的产业链配套和成熟的制造工艺，国内晶振行业迎来良好的发展机遇。

（3）终端应用拓展推动产品性能升级，重塑晶振行业竞争逻辑

石英晶体元器件作为电子设备的基础频率控制元器件，其市场需求与下游应用领域的发展密切相关。在 AI、5G-A/6G 等新一代通信与智能技术加速迭代的背景下，全球电子信息产业下游应用领域持续拓展，各细分场景对时钟频率基准的要求呈现差异化需求。终端应用的需求延伸驱动石英晶体元器件产品端的性能提升，不断推动晶振产品在尺寸、频率范围、精度、宽温、功耗、可靠性等核心性能维度实现升级。

① 微型化与低功耗

随着智能手机、智能手表、AI 眼镜、无线耳机、物联网模块等终端产品持续向轻薄化、小型化方向演进，石英晶体元器件行业亦由传统较大尺寸规格逐步向 1210、1008 等小尺寸、高性能产品升级。从产品价值看，成熟的大尺寸晶振产品供应充分且价格竞争较为激烈，超小尺寸产品凭借其更高的技术要求与导入门槛，通常具备更高附加值。微型化晶振产品目前已进入量产与应用阶段，应用场景覆盖小型消费电子、智能穿戴设备及医疗健康终端等领域。

此外，在物联网和长续航终端场景下，微型化往往与低功耗需求同步发生。随着智能传感器、穿戴设备和低功耗通信模块数量增长，下游客户不仅要求晶振产品尺寸更小，也要求其在待机和长期运行状态下耗电更低。低功耗已成为石英晶体元器件在物联网和可穿戴领域的重要演进方向，并将持续带动相关产品升级。

② 高频化与高精度

随着 5G-A、千兆光网、Wi-Fi 7/8、数据中心、AI 服务器、光模块及高性能交换设备等新型应用快速发展，终端通信速率与数据处理能力的持续提升正在推动石英晶体元器件由中低频、基础时钟供应逐步向更高频率、更高稳定性、更高同步能力的方向升级。以 Wi-Fi 7 为例，其支持 320MHz 超大带宽和 4096-QAM 更高阶调制方式，对应到基础时钟器件，意味着高速数据传输对信号稳定性的要求明显提升；5G-A 及高等级网络同步场景中，系统已开始对超高稳定度时钟器件提出更高要求，部分高端产品的稳定度控制由传统 ppm 级向更高精度 ppb 方向演进。高频化、高精度晶振产品的应用领域逐步向通信基站、交换机、光模块、AI 服务器、智能网卡等高性能场景拓展，该类产品通常具备较高的技术门槛与附加值，市场需求预计将保持增长态势。

③ 宽温化与高稳定性

随着新能源汽车与智能汽车渗透率持续提高，车载控制、电池管理、智能座舱、车载通信及辅助驾驶等电子系统数量不断增加，汽车电子作为典型牵引领域，持续推动石英晶体元器件，从消费级耐用标准进阶至工业级、车规级的长期稳定应用标准。从技术要求看，汽车电子对石英晶体元器件的运行工作温度范围要求明显高于消费级与工业级晶振产品，元器件需在高温、低温、振动和长期运行环境下具备更强的稳定性。宽温化与高可靠性晶振产品对业内公司

的生产制造和质量控制能力要求更高，使其具备较高的技术门槛和较强的客户黏性。

④ 低抖动

随着 AI 算力需求爆发、高速光模块速率持续提升以及高性能交换设备的规模化部署，高速数据传输对时钟信号稳定性的要求日趋严格。石英晶体元器件正由单端输出、中低频的基础时钟供应向差分输出、超低抖动的方向升级。相位抖动是影响高速数据传输误码率的关键指标，并成为高速互连系统的核心时序元件。普通单端晶振难以满足千兆级以上传输要求，而高性能差分晶振依托差分输出结构，在 12kHz-20MHz 频段可将相位抖动控制在 100fs 至 50fs 之间。当前行业正向飞秒级精度演进，部分高端产品已实现 30fs 乃至 15fs 的抖动水平，其应用领域正逐步向 AI 服务器、高速光模块、高端交换机、车载 ADAS 等高性能场景拓展，有望推动行业产品结构向高附加值方向优化。

由此可见，在终端电子产品愈发轻薄化小型化、通信网络速率与数据处理能力提升、汽车电子智能化升级、AI 算力需求爆发等产业趋势推动下，石英晶体晶振向微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等方向不断演进。石英晶体元器件行业正以通用标准品为基础并逐步延伸至面向具体应用场景的解决方案，这对行业内企业的研发能力、制程工艺及产品质量管控等方面均提出更高要求。

产品性能升级亦驱动石英晶体元器件行业的竞争逻辑发生转变，即从成本与规模竞争，转向高端化产品的开拓速度及技术迭代能力的竞争。具体而言，中低端标准化产品仍将面临充分的市场化竞争，而中高端产品受益于其技术壁垒更高、客户认证体系更为严格将具备较为明显的价值优势与盈利空间，对收入与利润的贡献度有望持续提升。汽车电子、AI 算力、高速光模块、机器人等前沿应用领域需求将成为石英晶振行业长期成长的重要引擎。

4、下游应用领域发展概况

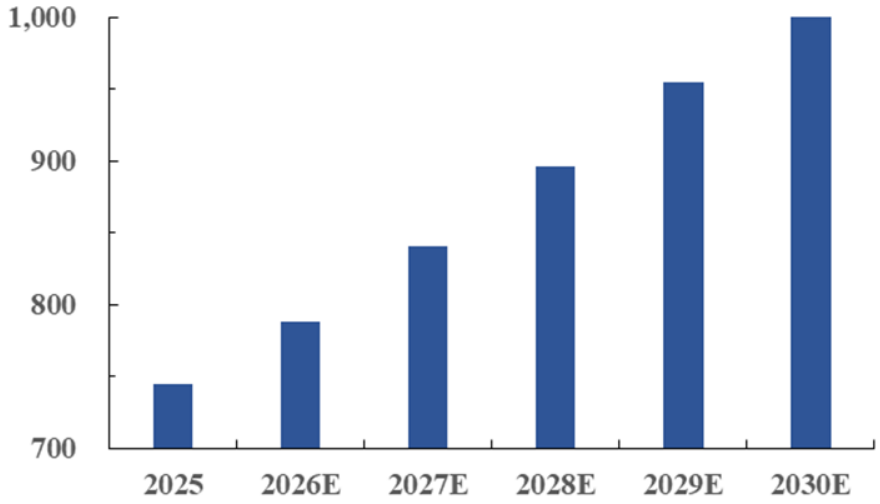
石英晶振行业始终紧密跟随下游应用领域发展趋势，主要下游行业发展概况如下：

（1）通讯电子行业概况

① 发展状况

通信设备是通信业的重要基础，石英晶振作为各通信设备的核心电子元器件，在基站、无线模组、路由器等领域广泛应用。随着新一代通信网络基础设施建设的不断推进，全球通信设备市场迎来新一轮增长。截至 2025 年 12 月末，我国已建成 5G 基站达 483.8 万个，5G-A 网络在 300 余座城市完成部署。同时，全球 6G 技术研发已从概念探索进入关键技术攻关阶段，各国正围绕 2030 年商用目标加速布局。根据 TBRC 数据，全球通信硬件市场规模在 2025 年已达到 7,447.20 亿美元，预计 2030 年将增长至 10,182.30 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 6.6%。

2025-2030 年全球通信硬件市场规模及其预测（十亿美元）



数据来源：TBRC

Wi-Fi 标准的持续升级也为石英晶振带来新机遇，根据 Mordor Intelligence 数据，2025 年全球 Wi-Fi 市场规模为 184.8 亿美元，预计到 2031 年将达 404.4 亿美元，期间年复合增长率为 13.94%。石英晶振在无线路由器 Wi-Fi、智能家居产品等室内终端设备的精准频率控制中发挥着重要作用，能够为 Wi-Fi 7 等先进技术提供稳定的时钟信号支持。随着更高标准的 Wi-Fi 网络设备对低标准设备替代规模的不断扩大，将带动 Wi-Fi 网络设备市场对石英晶振产品的需求。

② 技术发展趋势

随着 5G-A、千兆光网、Wi-Fi 7/8、卫星通信及 6G 前瞻布局加速推进，石英晶体元器件作为通信系统核心时钟基准，其需求正由传统基础时钟供应向高频化、高稳定、高同步、抗复杂环境的性能型需求全面升级。在 5G/5G-A/6G 领域，通信基站、回传链路及边缘计算节点亟需高稳定 TCXO、高可靠谐振器

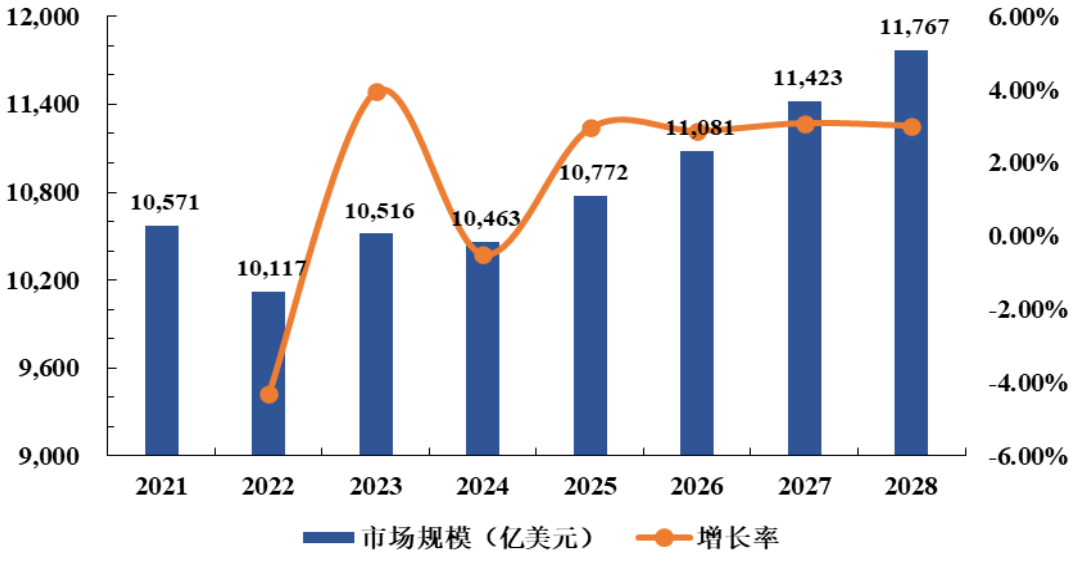
等元器件以保障海量数据传输的时序一致性，同时推动器件向小型化、低功耗与高频化迭代，适配 5G-A 毫米波通信与 6G 超宽带传输的硬件需求。Wi-Fi7/8 作为新一代无线通信标准，凭借 320MHz 超大带宽、4096-QAM 高阶调制及超高并发传输能力，对时钟器件的稳定性与纯净度提出极致要求。Wi-Fi7 设备需时钟信号保持极低抖动与低相位噪声，以保障高速数据传输的信号完整性；Wi-Fi8 前瞻布局超高速无线互联，进一步推动器件向高频化、高稳定度方向升级。在卫星通信与导航定位领域，北斗系统与 5G 融合持续深化，TCXO、TSX 等高精度元器件需求增长。

（2）消费电子行业概况

① 发展状况

消费电子作为石英晶体元器件的主要应用市场之一，广阔的市场规模为石英晶振需求提供了坚实支撑。受益于刺激电子产品消费的政策推动、人工智能与虚拟现实等技术的开发和应用、终端厂商库存的有效去化，消费电子行业自 2024 年以来已呈现复苏迹象。根据中国信息通信研究院数据，2025 年国内手机出货量达 3.07 亿部，其中 5G 手机占比 86.9%，叠加 AI/AR 眼镜、智能穿戴等新型终端快速普及，根据 Statista 预测，全球消费电子市场规模将保持平稳发展态势，预计到 2028 年将达 11,767 亿美元，持续拉动消费电子领域石英晶振市场需求。

2021-2028 年全球消费电子行业市场规模及预测



数据来源：Statista

② 技术发展趋势

石英晶振是确保消费电子设备正常运转的关键部件。在智能手机中，晶振需保障处理器时序、射频通信及影像系统同步；在智能穿戴设备、AI 眼镜、边缘传感器等终端中，则更加注重低功耗待机与高可靠运行。随着终端设备向轻薄化、小型化方向发展，石英晶体元器件的封装尺寸已由 3225、2520 加速朝向 2016、1612 及更小尺寸的 1210 规格演进，微型化产品已进入规模化量产与商用落地阶段。

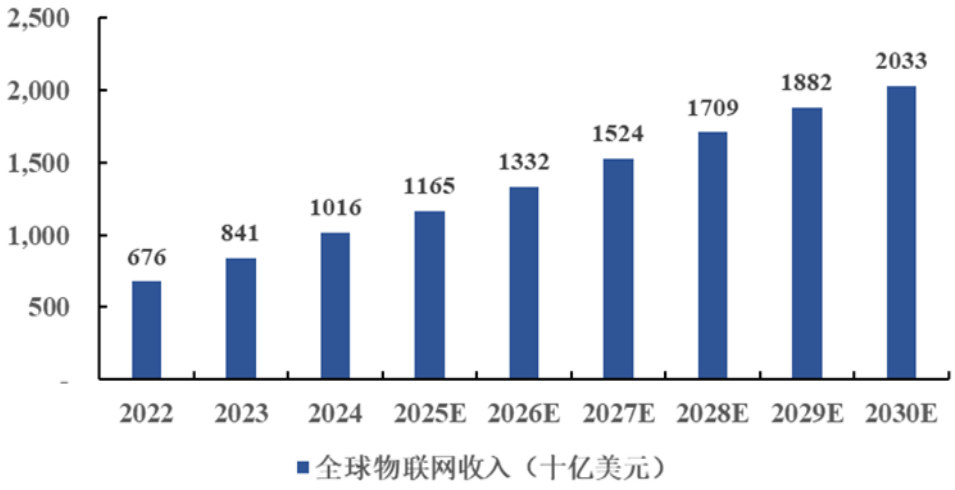
同时，在节能减碳与长续航趋势下，低功耗与微型化呈现协同演进态势。消费电子市场在追求极致尺寸的同时，对频率控制元器件的待机功耗、运行功耗及快速启动特性提出更高标准，使得低功耗成为消费电子领域晶振的主要演进方向之一。

（3）AIoT 行业概况

① 发展状况

物联网作为新一代信息技术的重点方向，正在推进新一轮的产业变革。根据 GSMA Intelligence 统计数据，2024 年全球物联网收入规模超过 1 万亿美元，2030 年达到 2.03 万亿美元规模，2024 年-2030 年期间年复合增长率为 12.25%，在国家政策的支持和 5G、AI、云计算等技术的推动下，物联网将深度渗透各个应用领域，未来市场空间广阔。

2022-2030 年全球物联网收入规模情况

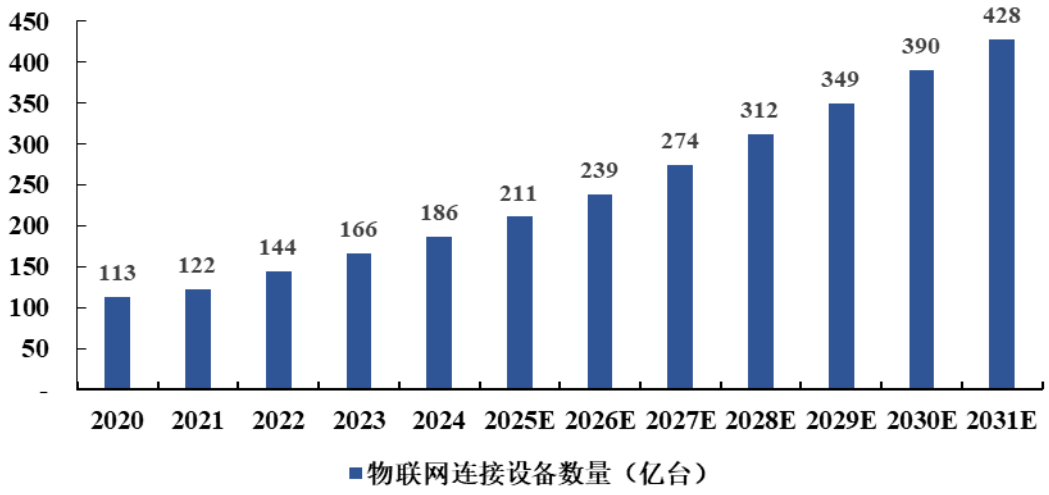


数据来源：GSMA Intelligence

物联网在智慧工业、智慧城市、智慧家居、安防监控等应用领域的不断深

化使物联网连接设备数量大幅增长。根据 IoT Analytics 统计数据，全球物联网连接设备的数量已从 2020 年的 113 亿台增长至 2024 年的 186 亿台，预计 2031 年将达到 428 亿台，2024-2031 年期间年复合增长率为 12.40%。石英晶振广泛应用于无线通信模块、传感器节点、控制单元等核心部件，是保障物联网设备互联互通与精准运行的必备基础元器件。AI 与物联网的深度融合（AIoT）正推动终端设备从简单连接向智能感知、本地决策演进，为石英晶振带来广阔增量空间。

2020-2031 年全球物联网连接设备数量情况



数据来源：IoT Analytics，中国银河证券研究院

② 技术发展趋势

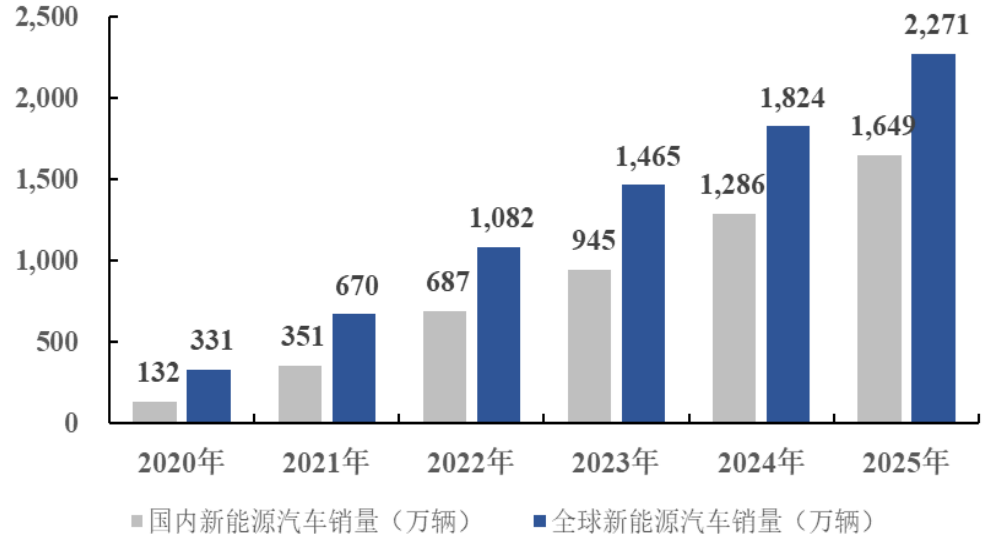
AIoT 的快速发展与端侧 AI 能力下沉，正推动石英晶体元器件实现深层次技术升级。物联网终端设备在连接功能之外，还需承载本地语音识别、图像处理及实时 AI 推理等智能化任务，对晶振提出尺寸更小、功耗更低、稳定性更高等多重严苛要求。与消费电子应用场景类似，微型化与低功耗的行业发展趋势在 AIoT 领域同样持续演进。此外，在高精度方面，随着无线连接、多模感知与定位功能不断增强，AIoT 终端对晶振的频率稳定度逐步向高精密等级演进，部分中高端物联网场景对高频、低抖动器件的需求亦快速提升。Wi-Fi 7、端侧 AI 芯片及高集成度物联网平台的普及亦进一步强化了对低相位噪声、高稳定度时钟基准的依赖。

（4）汽车电子行业概况

① 发展状况

能源消费结构、交通出行模式、汽车产品形态和社会运行方式的变革，为新能源汽车产业提供了重要发展机遇。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量从 2020 年的 132 万辆增长至 2025 年的 1,649 万辆，2020-2025 年期间复合增长率达 65.63%，2015 年以来我国新能源汽车产销量、保有量连续位居世界首位。

2020-2025 年全球及国内新能源汽车销量



数据来源：中国汽车工业协会，EV-Volumes

汽车行业已成为石英晶振的主要应用场景之一。在汽车向电动化、网联化、智能化、共享化的变革趋势下，晶振产品在汽车多媒体、高级驾驶辅助系统、车身控制、胎压监测、信息娱乐等独立功能模块中广泛应用。相较于传统汽车约 30 只的晶振用量，新能源汽车对石英晶振的需求大幅提升，单车用量有望持续增长，长期带动车规级晶振市场规模扩大。

新能源汽车主要应用场景下石英晶振需求量

场景	用途	单车需求量（只）
信息娱乐	车载信息娱乐系统、智能座舱、智能应用等	15-25
通讯	Wi-Fi、蓝牙、超宽带、5G/LTE、V2X、全球导航卫星系统等	8-20
保护	仪表盘、内部控制单元、智能钥匙等	20-30
轮胎监测	轮胎压力测试系统	5

场景	用途	单车需求量（只）
驾驶辅助	摄像头、雷达等	10-16
电动	电动汽车应用、电池管理、车载充电、逆变器等	8-12
安全	动力转向、制动系统等	10-15

数据来源：中泰证券

② 技术发展趋势

随着汽车电子化、智能化及网联化水平持续提升，频率控制元器件在车用领域的应用已逐步延伸至 GNSS 定位、车载通信模块、车联网、信息娱乐系统、电池管理系统（BMS）及各类电子控制单元（ECU）等场景。

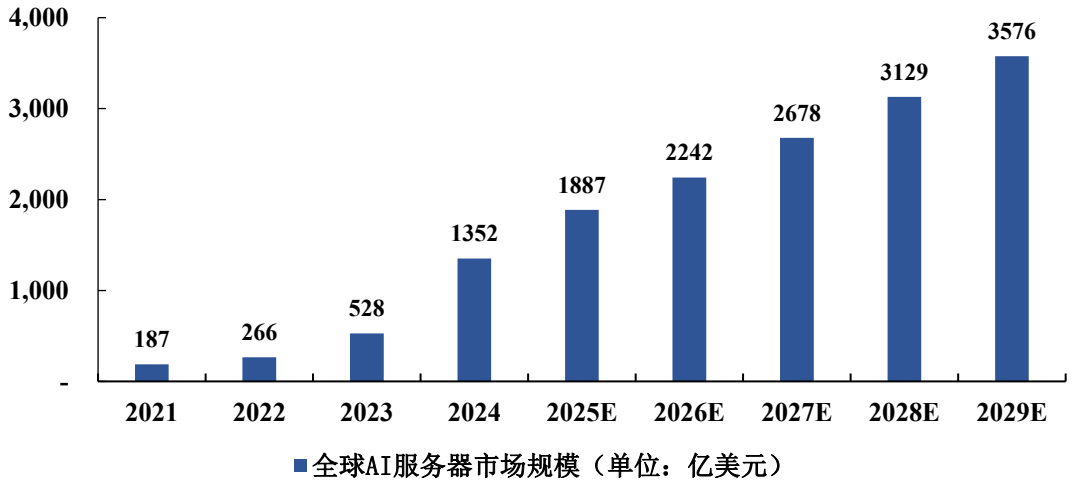
车规级晶振因工作环境特殊，在耐高温、抗机械冲击、可靠性、耐用性等方面较工业级、消费级产品更为严苛。就产品形态而言，汽车电子领域对 TCXO 及 TSX 等产品的需求有所提升。其中，TCXO 主要应用于 GNSS、高精度定位、V2X 及车载通信模块等对频率精度与温度稳定性要求较高的场景；TSX 则适用于车载模块及通信场景。随着智慧汽车、车路协同、北斗高精度定位加快渗透，车规级晶振的频率稳定度要求持续提升，工作温度范围向更宽、更高温等级延伸。整体而言，车用电子领域正持续推动频率控制元器件向高精度、宽温及高可靠方向升级。

（5）AI 算力行业概况

① 发展状况

算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力。光模块作为算力传输的核心器件，根据 Light Counting 预计，2026 年全球光模块市场规模将达 176 亿美元。服务器是算力提供的核心平台，随着各行业数字化转型加快，AI 服务器实现更广泛的部署。根据 IDC 统计，全球 AI 服务器市场规模从 2021 年的 187 亿美元增长到 2024 年的 1,352 亿美元，预计到 2029 年将达到 3,576 亿美元，复合增长率为 44.61%。AI 算力需求的爆发式增长为石英晶体元器件开辟了新的高增长赛道。

2021 年-2029 年全球 AI 服务器市场规模情况



数据来源：IDC，国信证券经济研究所

② 技术发展趋势

随着 5G 与 5G-A 技术的渗透以及光通信模块、AI 服务器、数据中心、交换机等算力基础设施的加速升级，石英晶体频率元器件的需求重心已从单一的频率稳定，转向更高频率、更低抖动、更低相位噪声及更高同步精度。在光通信领域，800G 光模块已对 156.25MHz 高频差分石英晶体器件形成刚性需求，1.6T 及以上光模块推动更高频率差分振荡器量产落地。在高频化方面，石英晶体频率元器件的核心频点已从传统数十 MHz 向 625MHz 等超高频点延伸并持续作为行业演进方向。在低抖动方面，市场对时钟信号抖动的要求从皮秒（ps）级向飞秒（fs）级演进，以满足高速数据传输对信号完整性的极致需求。在低相位噪声方面，AI 算力集群、高速光互连及数据中心交换网络对低相位噪声提出了更高要求，以降低系统误码率。在高同步精度方面，频率稳定度逐步向高精度等级靠拢，长期稳定性成为保障多计算单元协同处理海量数据的关键。

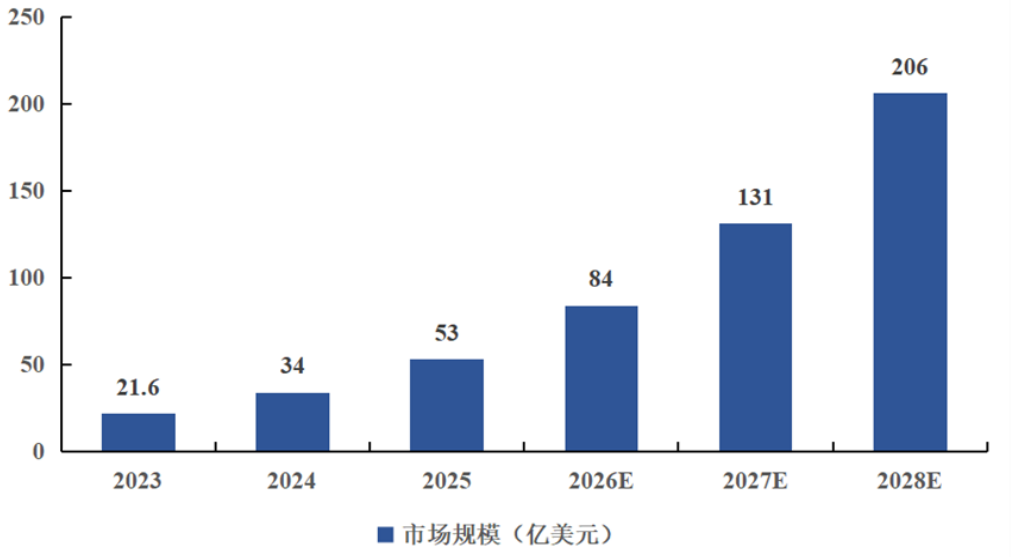
（6）具身机器人行业概况

① 发展状况

机器人是人工智能与高端制造深度融合的代表性领域。近年来，机器人产业正处于从执行重复性任务的“功能装备”向具备感知、决策、自主执行能力的“智能伙伴”加速转型的关键阶段。随着 AI 大模型、多模态感知与控制技术的突破，工业机器人、服务机器人、特种机器人及人形机器人等细分领域均呈现快速增长态势，可广泛覆盖工业制造、物流仓储、公共服务以及巡检安防等

各个领域。根据中商产业研究院数据，2025 年全球人形机器人市场规模为 53 亿美元，预计到 2028 年将达 206 亿美元，复合增长率为 57.20%。根据 IDC 发布的《全球人形机器人市场分析》，2025 年全球人形机器人出货量约为 1.8 万台，同比增长约 508%，其中中国厂商领跑市场。基于我国机器人行业的迅猛态势，摩根士丹利将我国 2026 年人形机器人的销量预测调整至 2.8 万台，并预计到 2035 年将增长至 260 万台。当前全球机器人市场呈现“中美引领、中国厂商强势崛起”的格局，随着工业机器人向高精度、高负载方向发展，服务机器人渗透率持续提升，以及人形机器人从技术突破迈向规模化量产，机器人产业将为宽温、抗机械冲击、高可靠性频率元器件带来崭新的消费场景与广阔的配套机遇。其中，人形机器人因具备高自由度运动控制、多传感器融合与实时通信等复杂功能，对晶振的精度、稳定性及抗机械冲击性能要求远高于常规电子设备，该市场的不断扩张将直接为晶振产业带来显著的增量需求。

2023 年-2028 年全球人形机器人市场规模情况



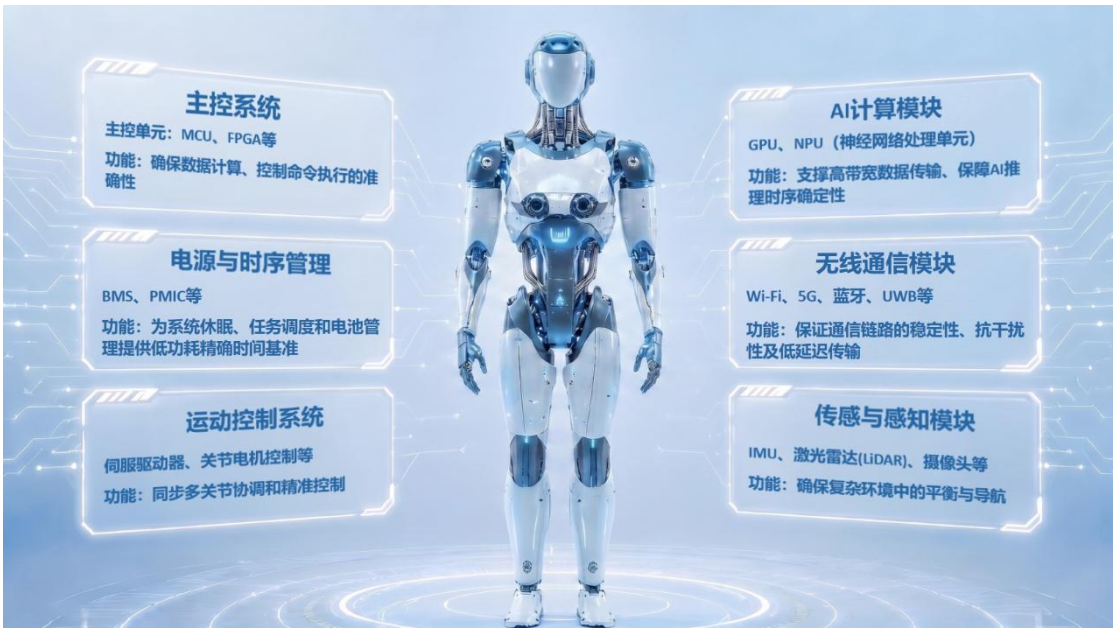
数据来源：中商产业研究院

② 技术发展趋势

机器人的主控系统、通信与网络、电源与时序管理、语音交互、主关节驱动与运动控制以及传感与感知等核心模块中，石英晶振是实现精准控制与稳定运行的关键元件。具体而言，主控芯片需要高精度晶振确保数据计算与控制命令执行的准确性；运动控制系统依赖晶振精度保障步态平衡，防止关节抖动；传感器（IMU、激光雷达等）需要高精度时间同步以实现环境感知与导航；无线通信模块（Wi-Fi、5G、蓝牙）中晶振影响通信稳定性与传输速度；AI 计算

芯片（GPU、NPU）通常采用高频晶振提供高性能计算能力。随着机器人规模化量产加速，对石英晶体元器件在高基频、低功耗、高稳定性、高精度等方面的性能要求不断提高，在系统级配套中更加注重产品的稳定性、一致性、环境适应能力及多模块协同能力。

石英晶振在人形机器人中的应用情况



数据来源：华西证券、中国信息通信研究院、同行业公司公开资料整理

（7）工业控制行业概况

① 发展状况

工业自动化、智能制造、智慧电网、绿色能源设备等领域的快速发展，为石英晶体元器件提供了稳定的增量市场。随着工业设备精密化水平持续提升、能源管理系统复杂度不断升级，工业控制领域对高可靠、宽温、长寿命频率控制元器件的需求日益增长。智慧电网、智慧电表及光伏、储能等绿色能源设备的普及，进一步推动工业控制领域的晶振市场需求扩容。

② 技术发展趋势

在工业自动化与智慧制造场景中，频率控制元器件不再简单满足基础时序控制，而是承担起系统级协同控制、长时间无故障运行的关键职责。工业级晶振的环境适应能力已全面对标工业级标准，宽温范围、抗振动、抗电磁干扰等性能大幅提升。产品精度逐步向更高精度等级升级，在高端同步控制、精密量测等核心场景衍生出超高精度需求。同时，长期漂移控制、温度稳定性及批次一致性愈发关键。

5、行业技术水平及特点

石英晶体元器件频率越低或越高则技术难度越大，而美日等西方国家处在石英晶体元器件行业理论创新的前沿，其中日本技术水平及储备全球领先，频率、尺寸、精度方面走在行业前列，在低频石英晶振、高频石英晶振领域技术优势明显。

我国台湾地区和我国大陆先后承接日本产业化技术，实现了技术水平的快速发展。我国大陆在晶体元器件开发和装备制造水平不断提升的发展背景下，行业技术水平与日本逐步接近，并突破了光刻工艺、技术认证、原材料采购等壁垒，部分龙头企业依托自身技术与工艺积累，不断加大技术研发投入，并与上游装备制造商以及高校和研究院所联合，开发新设备、新材料、新工艺，实现自主创新、协同创新，逐步抢占中高端产品市场。

6、进入行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

石英晶体元器件的生产具有较高的技术含量，对产品品质要求非常苛刻，如频率误差范围、封装质量等。同时，为扩大产能和提高产品质量，厂商需花很长的时间研制新设备、摸索新工艺以求达到快速、高效的生产能力，这往往体现在各公司掌握的关键技术的数量和质量上。另外市场的快速发展也使得从业人员需及时更新专业知识和能力。因此培养合格的研发团队、生产线管理人员和技术工人都需要较长的时间。

（2）客户认证壁垒

石英晶体元器件产品型号、规格较多，如果缺少稳定的客户支持，将很难形成规模生产，进而造成产品成本上升，拥有稳定的客户群是影响企业发展的重要因素。大额订单一般集中于大型跨国企业和国内大型制造公司。要进入这类优质客户的供货商行列，一般都要经过严格的认证过程。在认证过程中，除对公司产品的性能、质量、价格、供应能力有较高要求外，还对公司的设备、环境、内控体系、财务状况甚至社会责任都设有较高的标准。因此要获得下游优质大客户的供应商认证需要一定的时间过程。对于行业后来者而言，存在着大客户采购认证门槛。

（3）资金实力壁垒

石英晶体元器件产品的研发、制造需要高精密的设备和高等级的生产环境，需要较高的研发和生产资金投入。设备和环境上的高投资门槛将对新进入者构成一定的进入障碍。同时，该行业的下游客户一般要求供应商提供一定的信用账期，占用了厂商的部分流动资金。

因此，厂商需要在前期投入较多资金，建设符合产品生产要求的生产场所，同时又需要保证充沛的流动资金以持续获取中高端客户的大额、稳定订单。上述这些行业特点，在一定程度上构成了行业进入的资金实力壁垒。

7、行业面临的机遇与风险

（1）行业机遇

① 产业政策持续支持

近年来，国家出台了一系列产业政策，支持和鼓励包括石英晶振在内的电子元器件行业的发展，大力培育通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制、汽车电子、AI 算力、机器人等下游行业，有利保障了行业的健康发展，具体情况详见本节“二、公司所处行业基本情况”之“（二）行业主管部门及管理体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响”之“2、行业主要的法律、法规及政策”。

② 新兴技术带来重大发展机遇

石英晶体元器件作为频率控制的基础元件，广泛应用于各类智能终端及网络连接设备。当前，5G-A/6G、人工智能、光通信、算力基础设施等新一代信息技术加速迭代，正全面推动万物互联向万物智能演进，催生出一系列高附加值应用场景，包括 AI 算力集群、机器人、智能辅助驾驶、工业互联网、低空经济等。各类智能终端及网络连接设备数量持续攀升，同时单个设备对晶振的用量及性能要求亦不断提高。5G-A/6G、AI、算力基础设施等新兴技术的纵深发展，将为石英晶体元器件行业带来可观的市场增量与结构升级机遇。

（2）面临的风险

① 国内企业起步较晚，整体规模与国际领先企业存在差距

经过多年发展，全球石英晶体元器件制造商已具有较大规模和较强研发能

力，产品种类多样，技术含量高，能够满足不同层次不同领域的客户需求，占据着石英晶体元器件市场的大部分份额。与国外领先企业相比，我国石英晶体元器件企业起步较晚，在产品定位上大多以中低端产品和部分细分产品领域为突破口，整体规模与全球领先企业存在一定的差距。

② 专业技术人才短缺

石英晶体元器件行业涉及晶振设计、晶片设计、晶片制造、晶片镀膜、元器件封装、设备自动化等多个领域的知识，加之下游应用场景技术需求的迭代升级较快，对技术人员有较高的素质要求。虽然优势企业可以通过人才引进满足阶段性发展需要，但从长远来看，专业人才的匮乏是制约国内石英晶体元器件企业做精做强、提升核心竞争力和参与国际竞争的主要障碍。

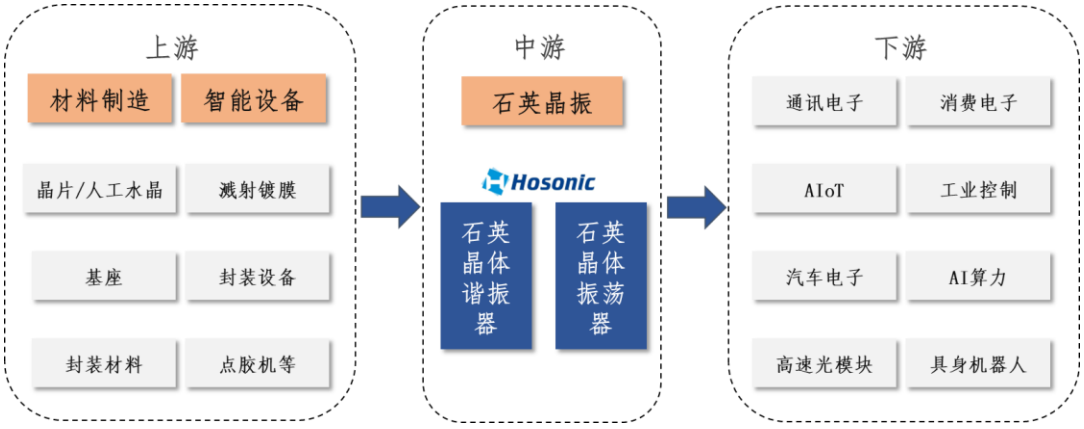
8、行业周期性特征

石英晶体元器件行业的周期性与下游行业的周期性相关，总体上亦与全球宏观经济、居民收入水平、消费者消费偏好等宏观经济形势相关。随着下游应用领域的不断扩大，本行业受宏观经济周期的影响有所降低。

9、发行人所属行业在产业链中的地位和作用、与上下游行业之间的关联性

发行人所处的石英晶体元器件行业位于产业链的中游，行业上游主要系原材料制造商和智能设备研制商，行业的市场容量、发展空间、技术发展方向等与下游应用领域紧密相连。石英晶体元器件行业产业链如下所示：

石英晶体元器件产业链



石英晶体元器件上游领域主要包括晶片、基座、上盖、芯片、封装材料等原材料和元器件制造以及智能设备的研制。发行人所处的石英晶体元器件行业

的上游企业主要如下：

上游产业	产品类型	主要企业名称
上游设备	设备	三生电子（日本）、先锋（日本）、昭和真空（日本）、AVIO（日本）、中国大陆地区厂商
	仪器	S&A（美国）、泰克（美国）、HUMO（日本）、优力（中国台湾地区）、中国大陆地区厂商
上游原材料	晶片/人工水晶	西铁城、成都泰美克、南京菲特晶等国内外厂家
	陶瓷基座	京瓷集团（日本）、NGK 电子（日本）、三环集团（中国大陆地区）
	芯片（IC）	NPC（日本）、Interchip（日本）、上海锐星微
	银胶	日本藤仓、日本三键、上海腾烁
	上盖	日本田中、南平三金、晶赛科技

资料来源：公司自有信息整理。

石英晶振广泛应用于各类对频率稳定性要求较高的电子产品，已深度融入国民经济的多个关键领域。近年来，网络通讯技术不断升级，各类终端设备不断小型化，种类层出不穷，汽车、家居、工控等产品不断向智能化发展。使用石英晶振的终端设备种类不断增加，单个设备对晶振的用量逐渐增多，对微型化、高频、高可靠等晶振产品档次要求日益提升。下游旺盛的市场需求拉动了对石英晶振产品的市场空间。

10、上述情况在报告期内的变化和未来可预见的变化趋势

报告期内，公司通过持续研发投入与技术创新，不断提升市场认可度以及行业地位，公司在行业内已经逐步建立了较强的竞争优势，并拥有较高的市场知名度和稳定的客户基础。

未来，在产业政策、市场竞争、客户需求、产品特点及技术水平等因素不发生重大不利变化的情况下，公司的核心竞争力将随着生产能力、研发投入的提升而不断增强，公司行业竞争地位将进一步得到巩固和提高。公司将继续强化技术开发能力，为下游客户提供更好的产品及技术支持。公司将在加强原有客户服务基础上开拓更多汽车电子、算力基础设施、人工智能和机器人等领域的客户，巩固公司在石英晶体元器件行业的市场地位。

（四）发行人所属行业竞争状况、市场地位及竞争优劣势

1、行业竞争格局

（1）全球市场主要由日本和中国台湾地区厂商占据

根据 QYResearch 数据，2024 年全球市场前五大石英晶体元器件厂商合计市场份额为 48.51%，全球市场前十大石英晶体元器件厂商合计市场份额为 67.92%。

全球石英晶振头部厂商主要集中在日本、中国台湾地区和中国大陆地区。日本和中国台湾地区得益于其领先的电子信息产业，石英晶振行业起步较早，其厂商技术水平和生产自动化程度较高，具备较强的先发、技术、规模及产业链协同等优势。日本精工爱普生（Seiko Epson）、日本电波（NDK）、日本京瓷晶振（KCD）和日本大真空（KDS）等头部企业在高端产品市场、汽车电子等方面竞争优势明显。

近年来以台湾晶技（TXC）为代表中国台湾地区企业凭借不断提升的技术和制造工艺，市场竞争力不断提升，并逐步替代日本厂商在高端领域的市场份额。根据 QYResearch 数据，台湾晶技 2024 年全球市占率第一。

美国厂商主要针对美国国内及部分细分市场，以军工产品为主，产品单价较高。

中国大陆厂商在技术工艺、原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面不断积累经验并发展迅速，但在全球市占率仍然相对较低。

（2）中高端石英晶体元器件产品进口替代空间较大

中国大陆厂商起步相对较晚，发展早期主要从日本、欧洲等国家和地区采购原材料或机器设备。近年来，受益于下游市场需求、境外大型晶振企业在中国大陆地区投资设厂、内资企业加大资本投入等多重有利因素，中国大陆地区石英晶体元器件产业发展迅速，中国大陆地区石英晶振厂商逐步实现了对中低端石英晶振产品的进口替代。

随着中国大陆地区厂商持续技术攻关，逐步突破频率范围及小型化技术工艺、良品率控制、产品认证等壁垒，加之下游国产终端厂商对关键电子元器件进口替代需求，中国大陆石英晶振厂商在中高端石英晶体元器件产品上竞争力

逐步增强，中高端石英晶体元器件产品进口替代空间较大。

2、发行人的市场地位

公司是全球石英晶体元器件的主要品牌商和制造商。根据 QYResearch 数据，鸿星科技 2024 年石英晶体元器件全球市场占有率为 3.19%，排名全球第九位。

2024 年全球石英晶体元器件行业主要企业市场占有率

行业排名	公司名称	所在地	2024 年市场占有率
1	台湾晶技（TXC）	中国台湾地区	11.81%
2	日本电波（NDK）	日本	10.31%
3	精工爱普生（Seiko Epson）	日本	10.05%
4	日本京瓷晶振（KCD）	日本	9.19%
5	日本大真空（KDS）	日本	7.15%
6	赛特时脉（SiTime）	美国	6.07%
7	微芯科技（Microchip）	美国	4.16%
8	泰晶科技（TKD）	中国大陆地区	3.26%
9	鸿星科技（Hosonic）	中国大陆地区	3.19%
10	加高电子股份有限公司（H.ELE.）	中国台湾地区	2.73%

数据来源：QYResearch：《Global Quartz Crystals and Oscillators Market Research Report 2025》

公司为国家级专精特新“小巨人”企业，是中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC）的理事单位。截至 2026 年 4 月 30 日，公司已参与完成 1 项国家标准和 3 项团体标准的制定，正在参与制定 1 项国家标准、1 项行业标准和 3 项团体标准。

公司拥有的“Hosonic”品牌在全球拥有强大的品牌影响力和市场美誉度，曾被富士康、工业富联、锐捷、爱联科技等多家全球知名客户授予“最佳质量奖”“最佳交付奖”“优秀战略合作伙伴”等荣誉称号。

3、行业内相关企业基本情况

行业内主要企业简要情况如下：

（1）境外主要企业

序号	公司名称	公司简介
1	台湾晶技（TXC）	台湾晶技股份有限公司成立于 1983 年，主要从事石英晶体谐振器和振荡器系列产品的研发、设计、生产与销售。其产品包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、声表面波元件、时间模组等。台湾晶技在中国台湾地区、中国大陆地区（宁波、重庆）及印尼建有工厂。
2	精工爱普生（Seiko Epson）	精工爱普生公司（英文全称 Seiko Epson Corporation）前身大和工业创立于 1942 年，1985 年与子公司 EPSON 合并。2005 年将晶体事业部与东洋通信机（TOYO COMMUNICATION）合并，成立了爱普生拓优科梦（EPSON TOYOCOM），并于 2021 将公司名恢复为 SEIKO EPSON。该公司为全球主要石英晶体供应商，产品覆盖石英材料、基座以及精微化、高精度、高品质频率产品。
3	日本电波（NDK）	日本电波工业株式会社（英文全称 Nihon Dempa Kogyo Co.,Ltd.）成立于 1948 年，为石英晶体谐振器行业知名跨国企业。NDK 从 1949 年开始石英晶体谐振器的制造、销售，1958 年成功实现人工水晶培育产业化。NDK 在日本本土、中国、马来西亚、美国均建有工厂和销售网络。
4	日本京瓷晶振（KCD）	即京瓷晶体器件株式会社（英文全称 Kyocera Crystal Device Corp.），是日本京瓷集团的全资子公司。该公司有 7 家下属公司，主要生产制造石英晶体元器件，产品主要用于手机、数字相机及其他数字产品，是全球压电石英晶体行业的主要竞争企业之一。
5	大真空（KDS）	即日本大真空株式会社（英文全称 DASHINKU Corp.）成立于 1951 年，是全球领先的三大石英晶体元器件制造商之一。其制造工厂主要分布在日本本土、中国、泰国、印度尼西亚等地，产品包括石英晶体谐振器、振荡器、滤波器、光学元件等。

注：以上内容摘自公开披露材料。

（2）境内主要企业

序号	公司名称	公司简介
1	泰晶科技（603738）	泰晶科技股份有限公司成立于 2005 年，是一家专业从事频控器件、微声学器件等电子元器件，高速高稳通讯网络器件及组件，汽车电子及模组等智能应用，精密冲压组件及部件，相关智能装备的研发、生产、销售及技术服务的国家级高新技术企业。2016 年在上海证券交易所 A 股上市。
2	惠伦晶体（300460）	广东惠伦晶体科技股份有限公司成立于 2002 年，专业研发、生产和销售新型表面贴装石英晶体谐振器、振荡器、热敏晶体。2015 年在深圳证券交易所 A 股上市。
3	东晶电子（002199）	浙江东晶电子股份有限公司成立于 1999 年，位于浙江金华市，于 2007 年在深圳证券交易所上市。东晶电子主要产品为石英晶体谐振器、石英晶体振荡器，产品主要应用于通讯、网络、汽车电子和家用电器等领域，产品主要销往中国台湾地区、新加坡、日本等国家和地区。2025 年，东晶电子新设子公司开展电池级碳酸锂生产及销售业务，其由石英晶体元器件单一业务模式转变为“电子元器件+锂电新材料”双主业并进的产业格局。
4	晶赛科技（871981）	安徽晶赛科技股份有限公司成立于 2005 年，主要从事石英晶体元器件及封装材料（主要为盖板）的设计、研发、生产及销售，于 2021

序号	公司名称	公司简介
		年在北京证券交易所上市。公司产品主要分为石英晶体元器件和封装材料两类。石英晶体元器件产品包括各类型石英晶体谐振器和石英晶体振荡器。封装材料产品主要包括各类型石英晶体元器件封装外壳、可伐环等，为石英晶体元器件上游材料，另有少量其他电子元件外壳等。

注：以上内容摘自公开披露材料。

4、发行人的竞争优势

（1）研发技术和产品优势

公司积累了大量研发和生产数据，垂直整合了研发与制造能力，实现了研发、制造及客户终端需求的高度匹配，提高了研发和交付效率。产品取得知名下游厂商和主流芯片平台的认证，成为多个领域主流客户的重要供应商。产品顺应行业技术发展方向，实现了多元化以及新兴前沿场景的布局。具体说明如下：

①垂直整合研发与制造能力优势

公司在多年发展过程中，积累了石英晶体元器件领域丰富的技术经验和成果，公司核心技术涵盖了整个产品研发和工艺流程，包含晶片及产品设计、制程工艺、溅射镀膜、高精密点胶、封装测试等，实现了产品设计、技术开发与客户终端产品电路设计及组装需求高度匹配。公司在研发试验和生产实践中，积累了大量的基础数据及可靠的实验报告，有效缩短新产品研发和交付周期。

②取得知名厂商认证，成为多数客户供应链体系的重要供应商

石英晶振行业产品认证是重要的市场准入门槛，下游知名客户通常认证内容更为详细、严格，认证周期更长。公司已赢得了众多下游知名制造服务商和终端品牌商的信赖，成为多个领域主流客户的重要供应商。

③主流芯片平台认证优势

获得主流芯片平台的原厂认证是元器件厂商进入其参考设计、实现规模商用的核心门槛，既代表产品在兼容性、可靠性、性能上通过严苛测试，也是下游客户选型时最直接的信任凭证。公司已取得高通、联发科、客户 N、瑞昱等多个主流芯片平台的认证，覆盖智能手机、可穿戴设备、智能家居家电、物联网、汽车电子、工业控制、服务器等领域。

同时，公司是国内少数同时覆盖消费电子与车规级核心参考设计的石英晶

体频率元器件厂商之一。车规级要求与消费电子的低成本快迭代存在根本性对立，同时满足两类极端标准需跨越晶体切割、封装气密性、自动化产线管控等技术壁垒。公司不仅进入客户 O Wi-Fi 芯片、芯科科技（Silicon Labs）物联网模块及高通手机芯片的参考设计列表，更通过了高通车规级芯片认证参考设计列表的严格筛选，有助于产品在终端应用领域的推广，并为抢占市场份额提供先发优势。

④产品系列和应用领域广泛优势，持续布局新兴领域

在产品系列和应用领域方面，发行人已拥有丰富的产品线，已涵盖 SMD 高频、SMD 小尺寸系列、SMD 热敏系列、SPXO/TCXO/VCXO 系列、车规级产品系列、振荡器差分型系列等，随着 5G-A/6G、Wi-Fi 7/8、光通信、ICT、边缘计算、人工智能等潜力市场需求的增长，公司产品应用领域从通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制等核心领域向汽车电子、AI 算力、高速光模块、机器人等新兴领域不断拓展，保证公司石英晶振产品在新兴应用比例不断增长。

在产品技术指标方面，石英晶体频率元器件的尺寸越小，难度越大。公司的主要产品 SMD 晶体谐振器的最小尺寸为 1008，SPXO 晶体振荡器的最小尺寸为 1612。相较于同行业公司，公司可以生产附加价值更高的微型尺寸、高频率的产品，为公司带来更高的利润水平。公司主要自产产品尺寸范围与境内同行业上市公司对比如下：

产品大类	产品类别	公司	泰晶科技	惠伦晶体	晶赛科技	东晶电子
谐振器	SMD 晶体谐振器	1008-5032	1008-3225	1008-3225	1612-5032	1210-5032
振荡器	SPXO 晶体振荡器	1612-7050	2016-3225	2016-7050	2016-7050	2016-7050

注：可比公司相关产品信息取自其官网网站、年度报告等公开信息。

同时，公司产品持续向微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化方向发展，顺应行业技术发展方向，有利于公司产品在行业竞争中脱颖而出。

（2）生产管理优势

公司深耕石英晶振行业已逾三十年，通过自主掌握关键制程、改造生产装备，导入精益生产管理理念等多项措施，提升产品品质和劳动效率，降本增效，建立了较强的生产管理优势。公司通过持续技术攻关和良好的设备维护保养，根据工艺要求对关键设备进行优化改造，从而使公司各产线的生产效率和产品

质量都大幅提升，设备使用寿命显著提升，进一步增强了公司的竞争力水平。

（3）国际化优势

公司立足于中国，服务全球知名客户，在行业中具有显著的国际化优势，主要体现为：一是在客户结构与销售区域方面，全球知名客户是公司市场开发和服务的重中之重，公司外销占比远高于境内同行业可比公司水平，公司被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”；二是建立了全球化的组织架构和成熟的海外销售体系，公司在中国香港特别行政区设立了 3 家子公司，负责境外采购、境外销售和境外投资，在泰国设立 1 家子公司，拟作为境外生产基地。公司长期参加慕尼黑电子展等境内外行业国际展会，积累了稳定的海外客户合作关系；三是培养和吸引了大量国际化的人才，在研发、销售、管理等岗位上都配备了具有国际视野和工作经验的人才。

（4）自主品牌优势

公司拥有的“Hosonic”品牌在全球拥有强大的品牌影响力和市场美誉度，曾被富士康、工业富联、锐捷、爱联科技等多家全球知名客户授予“最佳质量奖”“最佳交付奖”“优秀战略合作伙伴”等荣誉称号。公司绝大多数产品以自主品牌进行销售，自主品牌产品销售收入占比均保持在 95%以上，相比贴牌生产模式具有更强的产品定价能力和客户粘性。

（5）质量和供应链管理优势

公司已建立并运行了完善的质量管理体系。报告期内公司产品良品率维持较高水平，保证产品极低的失效率，满足下游客户对产品高可靠性的要求。同时，公司已拥有了高效的供应链管理体系，能够高效整合产业链上游资源，快速响应下游客户订单需求。公司通过定期稽核、年度框架合作等方式加强对供应商关系的沟通与维护，基于长期合作和大规模采购有效降低原材料的采购成本。并能够根据下游客户的具体要求，采用多种方式为客户提供仓储物流服务，满足客户的库存管理要求。

5、发行人的竞争劣势

（1）与全球头部企业的市场占有率仍有差距

公司虽为全球前十大石英晶振厂商，但在全球市场份额、业务规模方面相比国际头部厂商仍有差距。根据 QYResearch 数据，2024 年，台湾晶技、日本电波和精工爱普生的全球市场占有率位列全球前三，全球前六大石英晶振厂家的市场占有率均已超过 5%，发行人全球市场占有率为 3.19%。相较于国际头部企业，发行人在石英晶振产能、出货量与市场占有率方面尚存在一定的差距。

（2）生产设备成新率较低，装备和工艺水平需持续提升

公司部分生产设备购置时间较早，生产设备成新率较低，需要投入更多的维保及改造资源以保障工艺品质。而同行业上市公司通过首发及再融资募投扩产等项目，在生产设备的成新率、性能及自动化水平等方面形成了一定优势。

（3）融资渠道较为单一，资本实力相对不足

随着下游应用领域市场需求持续增长，以及新兴领域需求的不断涌现，公司亟需顺应行业发展趋势进行技术升级，并进一步提高装备和工艺水平、优化产品结构、扩大生产能力，而由此将为公司带来较大的资金需求压力。

本行业全球主要厂商多数已上市，拥有强大的资本平台。公司在经营发展过程中，主要依靠经营积累和银行贷款解决业务发展带来的资金需求，融资渠道较为单一，难以满足快速增加的资金需求。

6、发行人与同行业可比公司的比较情况

（1）同行业可比公司的选择依据及基本情况

公司综合考虑产品情况、业务模式、业务规模、主要产地等因素，选取泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子及晶赛科技等四家公司作为可比上市公司，上述公司基本情况详见本节之“二、公司所处行业基本情况”之“（四）发行人所属行业竞争状况、市场地位及竞争优劣势”之“3、行业内相关企业基本情况”之“（2）境内主要企业”。

（2）与同行业可比公司经营情况及市场地位的比较

公司名称	经营情况	市场地位
泰晶科技（603738）	■ 销售模式以直销为主，经销为辅； ■ 2025 年营业收入 9.44 亿元； ■ 2025 年净利润 5,288.38 万元。	国内频率控制器件行业内主要厂商之一，第一批专精特新“小巨人”企业；国内首批实现半导体光刻工艺规模化、产业化应用的企业之一；国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的两家起草单位之一，中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC）的副理事长单位。
惠伦晶体（300460）	■ 销售模式采用经销模式和直销模式； ■ 2025 年营业收入 5.53 亿元； ■ 2025 年净利润-16,646.57 万元。	国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一，较早在国内实现 2520、2016、1612 等片式小微型谐振器的批量生产。积极开发 TSX 热敏晶体、TCXO 振荡器、OSC 振荡器等新产品并已经量产。
东晶电子（002199）	■ 销售模式采用直销方式和中间商销售并重的模式； ■ 2025 年营业收入 3.55 亿元； ■ 2025 年净利润-5,002.11 万元。	国内石英晶体元器件行业的主要厂商，中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC）的副理事长单位。
晶赛科技（871981）	■ 销售模式以直销为主，经销为辅； ■ 2025 年营业收入 5.77 亿元； ■ 2025 年净利润 968.37 万元。	实现晶体频率元器件品种与规格的全覆盖生产销售，企业规模和创新能力均属行业前列。
鸿星科技	■ 销售模式以直销为主，经销为辅； ■ 2025 年营业收入 6.32 亿元； ■ 2025 年净利润 10,832.13 万元。	详见本节“二、公司所处行业基本情况”之“（四）发行人所属行业竞争状况、市场地位及竞争优劣势”之“2、发行人的市场地位”。

（3）与同行业可比公司技术实力的比较

发行人与可比公司的专利数量对比如下：

可比上市公司	总专利数量（个）	发明专利数量（个）
泰晶科技（603738）	162	35
惠伦晶体（300460）	超 100 个	未披露
东晶电子（002199）	86	27
晶赛科技（871981）	64	19
鸿星科技	70	18

注：上述可比公司信息均摘自其公开披露的定期报告或公开信息，发行人总专利数量与发明专利数量系截至 2026 年 4 月 30 日。

公司主要客户为通讯电子、消费电子、AIoT 等应用领域的世界 500 强企业及行业领先企业，其对于晶振等关键电子元器件供应商的选择更加重视产品技

术性能、质量可靠性等因素，专利数量并不能完全体现公司的技术实力。同时，公司的核心技术是在长期生产经营和持续研发过程中积累形成的技术秘密，考虑到申请专利公开后部分技术细节、关键点或具体实施方法等信息可能会被竞争对手所知悉，因此公司习惯采用技术秘密等方式对部分研发成果进行知识产权保护。

三、公司主营业务的具体情况

（一）公司主要产品的销售情况

1、公司主要产品的服务规模

（1）主要产品的产能、产量及产能利用率情况

单位：亿只

产品类型		2025 年度	2024 年度	2023 年度
谐振器	产能	16.84	14.32	13.37
	产量	15.58	13.94	11.35
	产能利用率	92.54%	97.31%	84.86%
振荡器	产能	0.89	0.66	0.63
	产量	0.77	0.50	0.39
	产能利用率	86.44%	75.91%	62.53%
合计	**产能**	**17.72**	**14.98**	**14.00**
	产量	**16.35**	**14.44**	**11.74**
	产能利用率	**92.24%**	**96.37%**	**83.86%**

受益于下游行业市场需求增长，报告期内，公司产能和产量均呈现稳步增长趋势，产能利用率整体保持在较高水平。

（2）主要产品的产量、销量及产销率情况

报告期内，公司自产产品的产量、销量及产销率情况如下：

单位：亿只

产品类型		2025 年度	2024 年度	2023 年度
谐振器	销量	15.43	13.41	11.62
	产量	15.58	13.94	11.35
	产销率	**99.01%**	**96.23%**	**102.41%**

产品类型		2025 年度	2024 年度	2023 年度
振荡器	销量	0.69	0.50	0.40
	产量	0.77	0.50	0.39
	产销率	**89.39%**	**99.02%**	**101.74%**

2、主要产品的销售收入情况及主要客户群体

报告期内，公司主营业务收入按产品分类的构成情况如下：

产品大类	产品名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
谐振器	SMD 晶体谐振器	49,419.29	78.18	45,652.81	80.46	43,126.48	79.73
	音叉型谐振器	3,569.97	5.65	3,027.24	5.34	1,933.79	3.58
	其他	457.91	0.72	515.87	0.91	572.10	1.06
小计		**53,447.17**	**84.55**	**49,195.92**	**86.71**	**45,632.37**	**84.36**
振荡器	SPXO 晶体振荡器	7,172.93	11.35	6,127.45	10.80	6,255.22	11.56
	其他	2,591.85	4.10	1,415.08	2.49	2,203.58	4.07
小计		**9,764.79**	**15.45**	**7,542.53**	**13.29**	**8,458.80**	**15.64**
合计		**63,211.96**	**100.00**	**56,738.44**	**100.00**	**54,091.17**	**100.00**

3、主要产品销售价格的变动情况

报告期内，发行人各主要产品的销售价格变动情况如下：

单位：元/只

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
谐振器	0.31	0.33	0.37
振荡器	1.43	1.52	2.11

4、主营业务收入按销售区域划分

报告期内，发行人主营业务收入按销售区域划分情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
境内	**30,001.85**	**47.46**	**27,297.30**	**48.11**	**24,205.75**	**44.75**
其中：华南	18,592.24	29.41	16,679.37	29.40	14,106.18	26.08

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
华东	8,845.48	13.99	7,285.30	12.84	5,128.55	9.48
西南	1,399.96	2.21	1,978.99	3.49	3,272.60	6.05
华中	679.04	1.07	780.76	1.38	608.64	1.13
华北	457.79	0.72	549.82	0.97	961.40	1.78
西北	27.33	0.04	23.06	0.04	128.37	0.24
境外	**33,210.11**	**52.54**	**29,441.14**	**51.89**	**29,885.42**	**55.25**
其中：越南	8,869.31	14.03	4,666.38	8.22	3,464.78	6.41
中国香港	8,090.62	12.80	8,458.96	14.91	9,029.14	16.69
保税区	5,899.79	9.33	6,606.83	11.64	7,503.24	13.87
中国台湾地区	2,424.01	3.83	1,754.05	3.09	2,317.58	4.28
其他	7,926.39	12.54	7,954.93	14.02	7,570.68	14.00
合计	**63,211.96**	**100.00**	**56,738.44**	**100.00**	**54,091.17**	**100.00**

5、主营业务收入按销售模式划分

报告期内，公司主营业务收入按业务模式划分情况如下：

销售模式	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
直销	48,128.05	76.14	43,224.36	76.18	43,005.92	79.51
经销	15,083.91	23.86	13,514.08	23.82	11,085.25	20.49
合计	**63,211.96**	**100.00**	**56,738.44**	**100.00**	**54,091.17**	**100.00**

6、公司向前五名客户的销售情况

报告期内，公司前五大客户的销售情况如下：

序号	客户名称	销售金额（万元）	占营业收入比例（%）	销售模式	主要销售内容
2025 年度					
1	富士康	6,829.77	10.80	直销	谐振器、振荡器
2	台湾鸿星	4,561.59	7.22	经销	谐振器、振荡器
3	客户 A	4,342.55	6.87	直销	谐振器、振荡器
4	客户 B	4,295.84	6.80	直销	谐振器、振荡器
5	客户 C	2,439.12	3.86	直销	谐振器、振荡器

序号	客户名称	销售金额（万元）	占营业收入比例（%）	销售模式	主要销售内容
合计		**22,468.87**	**35.55**		
2024 年度					
1	富士康	5,925.16	10.44	直销	谐振器、振荡器
2	台湾鸿星	3,604.09	6.35	经销	谐振器、振荡器
3	客户 B	2,996.11	5.28	直销	谐振器、振荡器
4	客户 A	2,701.51	4.76	直销	谐振器、振荡器
5	商络电子	2,246.87	3.96	经销	谐振器、振荡器
合计		**17,473.74**	**30.80**	-	-
2023 年度					
1	富士康	6,087.95	11.24	直销	谐振器、振荡器
2	台湾鸿星	3,528.28	6.52	经销	谐振器、振荡器
3	客户 B	2,948.32	5.44	直销	谐振器、振荡器
4	客户 D	2,918.89	5.39	直销	谐振器、振荡器
5	客户 A	2,169.18	4.01	直销	谐振器、振荡器
合计		**17,652.62**	**32.60**	-	-

注：公司对受同一实际控制人控制的客户合并计算销售金额。

报告期内，公司与主要客户合作稳定，前五大客户变动不大，客户集中度不高。

台湾鸿星为发行人在中国台湾地区的经销商，主要服务中国台湾地区客户，报告期内，台湾鸿星最终销售情况良好。发行人向关联方销售具体情况详见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”。

报告期内，前五大客户除台湾鸿星为发行人的关联方外，公司董事、原监事、高级管理人员及其他核心人员及关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述其他前五大客户无关联关系，也未在上述客户中持有权益。

（二）公司主要产品的原材料和能源及其供应情况

1、主要采购情况

公司晶振产品以基座、上盖、石英晶片和芯片为主要原材料。其中，基座和上盖的主要供应商为三环集团、京瓷集团和时尚科技（日本特殊陶业（NGK）

的代理商）等国内外知名公司及其代理商。公司生产所需的主要原材料均具有成熟的供应市场，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，能够保证公司生产所需材料的稳定供应。

报告期内，公司采购金额及占比情况如下：

物料名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
基座	13,203.47	45.06	11,372.14	44.98	8,827.08	47.68
外购成品石英晶振	4,386.63	14.97	3,567.57	14.11	2,492.21	13.46
石英晶片	2,034.81	6.94	1,952.66	7.72	1,537.11	8.30
芯片	1,939.84	6.62	1,383.43	5.47	859.98	4.64
电费	1,807.67	6.17	1,654.66	6.55	1,491.56	8.06
上盖	850.91	2.90	863.63	3.42	700.93	3.79
其他	5,077.35	17.33	4,486.43	17.75	2,605.19	14.07
合计	**29,300.68**	**100.00**	**25,280.52**	**100.00**	**18,514.07**	**100.00**

报告期内，发行人采购金额呈现稳步增长趋势，与销售规模变动趋势一致。公司存在外购成品石英晶振情形，主要系满足客户的多元化需求，以及弥补因订单集中造成的阶段性产能不足所致。

上述主要物料的单价变动情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	单价（元/千只）	变动率（%）	单价（元/千只）	变动率（%）	单价（元/千只）
基座	77.57	3.95	74.63	1.20	73.74
石英晶片	44.02	-12.12	50.09	18.69	42.20
芯片	234.04	-2.42	239.85	-8.25	261.42
上盖	5.22	-7.60	5.65	-3.36	5.85

2、主要能源供应情况

报告期内，公司生产经营所需的能源主要为电力，其供应情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
用电量（万度）	2,882.83	2,455.35	2,131.65
电费（万元）	1,807.67	1,654.66	1,491.56

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
单价（元/度）	0.63	0.67	0.70

注：上表统计数据为公司主要生产基地鸿星科技、金华鸿瑞、浙江鸿星和湖州鸿皓的用电量及电费

3、报告期内公司向前五名供应商的采购情况

报告期内，公司向前五大供应商（包含原材料、产成品、能源及外协服务供应商）的采购情况如下：

序号	供应商名称	采购金额（万元）	占全年采购额比例（%）	主要采购内容
2025 年度				
1	三环集团	9,363.15	31.96	基座
2	西铁城	2,473.45	8.44	谐振器
3	时尚科技	2,373.46	8.10	基座、上盖
4	国网电力	1,807.67	6.17	电
5	京瓷集团	1,736.55	5.93	基座、上盖
合计		**17,754.27**	**60.59**	
2024 年度				
1	三环集团	8,235.82	32.58	基座
2	时尚科技	2,232.27	8.83	基座、上盖
3	西铁城	2,071.27	8.19	谐振器
4	国网电力	1,654.66	6.55	电
5	京瓷集团	1,238.55	4.90	基座、上盖
合计		**15,432.56**	**61.05**	
2023 年度				
1	三环集团	6,594.28	35.62	基座
2	西铁城	1,588.05	8.58	谐振器
3	时尚科技	1,550.45	8.37	基座、上盖
4	国网电力	1,491.56	8.06	电
5	京瓷集团	923.28	4.99	基座、上盖
合计		**12,147.62**	**65.61**	

报告期内，公司董事、原监事、高级管理人员及其他核心人员及关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述前五大供应商没有关联关系，也未在其中占有权益。发行人向关联方采购具体情况详见本招股说明书“第八节 公司治理与

独立性”之“七、关联方及关联交易” 之“（二）关联交易”。

四、公司主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

1、固定资产概览

截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产账面原值为 97,201.53 万元，账面净值为 34,426.25 万元，总体成新率 35.42%。公司各项固定资产均处于正常使用状态，具体情况如下：

项目	账面原值（万元）	账面价值（万元）	成新率
房屋及建筑物	25,305.84	20,042.59	79.20%
机器设备	69,614.37	13,751.58	19.75%
运输工具	835.69	112.25	13.43%
电子设备及其他	1,445.63	519.83	35.96%
合计	**97,201.53**	**34,426.25**	**35.42%**

公司主要固定资产不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，对公司持续经营不存在重大不利影响。

2、房屋及建筑物

（1）自有房屋及建筑物

截至 2026 年 4 月 30 日，发行人及其子公司拥有房屋及建筑物的具体情况如下：

序号	权证号	权利人	用途	土地位置	面积（㎡）	他项权利
1	浙（2023）杭州市不动产权第 0462577 号	鸿星科技	非住宅	杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号 2 幢	619.85	无
2	浙（2023）杭州市不动产权第 0462577 号	鸿星科技	非住宅	杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号 3 幢	638.46	无
3	浙（2023）杭州市不动产权第 0462577 号	鸿星科技	非住宅	杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号 4 幢	3,091.56	无
4	浙（2023）杭州市不动产权第 0462577 号	鸿星科技	非住宅	杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号 5 幢	2,461.27	无
5	浙（2023）杭州市不动产权第 0462577 号	鸿星科技	非住宅	杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号 6 幢	2,444.67	无
6	浙（2023）杭州市不动产权第 0462577 号	鸿星科技	非住宅	杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号 1 幢	1,422.90	无

序号	权证号	权利人	用途	土地位置	面积（㎡）	他项权利
7	金房权证婺字第00157167号	金华鸿瑞	非住宅	金磐开发区内A6地块	2,040.60	无
8	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	7,770.43	无
9	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	149.24	无
10	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	6,349.08	无
11	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	8,747.63	无
12	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	16,637.14	无
13	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	12,910.14	无
14	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	16,797.06	无
15	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	29.44	无
16	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	143.84	无
17	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	7,104.06	无
18	浙（2023）德清县不动产权第0029849号	浙江鸿星	工业	康乾街道上唐街81号	206.04	无

（2）未取得权属证书的已建成房产及构筑物

截至2026年4月30日，公司存在已建成房屋建筑物未取得房产证的情况，具体如下：

序号	建设单位	房产名称	坐落	建筑面积（平方米）	用途
1	鸿星科技	K楼	浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2880号	2,262.00	办公
2	鸿星科技	冷水塔房、传达室、配电房、电机房等附属用房	浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2880号	1,144.12	配套附属用房
3	金华鸿瑞	门卫、食堂、配电房、机修用房	金华市金磐开发区A6地块	213.10	配套附属用房
合计				**3,619.22**	

截至2026年4月30日，发行人无证房屋建筑物均为办公和配套附属用房，未用于生产，发行人及其子公司无证房产的建筑面积为3,619.22平方米，占发行人全部房屋建筑物总面积的3.88%。发行人根据无证房产的形成原因、具体

用途和对生产经营的影响，对于无证房产采取了如下整改处理方案：

①发行人已委托浙江求是工程检测有限公司对无证房产进行了评估，取得工业建筑使用性《鉴定报告》，确认无证房产主体结构安全可靠，无重大使用功能缺陷，能够满足发行人正常生产经营使用要求，可按现状用途继续正常安全使用。

②发行人已委托浙江中业消防科技有限公司对无证房产进行了消防评估，取得了评估结果为合格的《消防安全评估报告》，评定无产证建筑物消防系统完善，可满足公司日常经营活动的消防需求，不存在重大消防风险。

③发行人已取得杭州市余杭区综合行政执法局出具的《关于鸿星科技（集团）股份有限公司房产有关情况的说明》，允许鸿星科技无证房产继续保留，同意对上述建筑不予强制拆除，不会因为上述事项给予行政处罚。

④发行人的控股股东、实际控制人对发行人无证房产已出具相应承诺，若发行人及其子公司因建设相关建筑物/构筑物未依法办理报批报建手续或涉及其他法律瑕疵而被有关政府部门责令限期拆除、予以行政处罚等，给发行人及其子公司造成经济损失的，其将全额承担由此产生的全部费用，以确保发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。

3、租赁房屋及建筑物

截至 2026 年 4 月 30 日，公司及子公司从第三方租赁房屋及建筑物的情况如下：

序号	出租人	承租人	租赁地址	面积（平方米）	租赁期限	用途	是否办理租赁备案
1	杭州爱家物业服务有限公司	鸿星科技	杭州市余杭区良渚街道蓝郡华庭	87.68	2025.06.06-2026.06.05	员工宿舍	是
2	梅罗滨	鸿星科技	浙江省德清县武康街道东方府	127.97	2025.07.01-2026.06.30	员工宿舍	是
3	林毓馨	东莞佳晟	东莞市长安镇长青街西面长安商业广场	320.00	2026.01.01-2026.12.31	办公	是
4	Zoap Consulting Ltd.	鸿星国际	中国香港特别行政区九龙湾临乐街 19 号南丰商业中心	实用面积约 1,803 平方尺	2026.03.01-2028.02.28	办公	无需办理
5	杭州凡翔	鸿星科技	浙江省杭州市金色海岸住宅区	350.81	2026.01.01-2027.12.31	员工宿舍	是
6	杭州圣瀚	鸿星科技	杭州市大河宸章公寓	220.00	2026.01.01-2027.12.31	员工宿舍	是

序号	出租人	承租人	租赁地址	面积（平方米）	租赁期限	用途	是否办理租赁备案
7			杭州市大河宸章公寓	224.18	2026.01.01-2027.12.31	员工宿舍	是
8			杭州市蓝郡华庭	110.61	2026.01.01-2027.12.31	员工宿舍	是
9			杭州市蓝郡华庭	137.31	2026.01.01-2027.12.31	员工宿舍	是
10			杭州市蓝郡华庭	137.31	2026.01.01-2027.12.31	员工宿舍	是
11	深圳市新美达产业发展有限公司	鸿星科技	深圳市南山区桃源街道丽山路 65 号民企科技园 3 栋 3 楼联合工社	B11（5 人间）区域，5 人间[注]	2025.05.01-2026.04.30	办公	-
12	创宇台湾分公司	鸿星企业	中国台湾地区新北市汐止区新台五路一段 77 号	52.67 坪	2026.01.01-2027.12.31	办公	无需办理
13	浙江海岳酒店管理有限公司（悦栖公寓）	浙江鸿星	德清县长虹东街 919 号莫干山研究院生活楼的悦栖公寓	40 ㎡/间	2026.02.02-2027.03.01	员工宿舍	-
14	钱晶晶	湖州鸿皓	德清县武康镇东宸府小区	105.08	2025.06.05-2026.06.04	员工宿舍	是

注：1、第 11 项租赁房屋租金系根据工位计算，因而未约定租赁面积。

上述第 4 和 11 项租赁房屋，出租方未能提供有效的权属证明文件，出租人是否享有出租该等物业的权利未得到有效确认。但鉴于：（1）上述两处物业面积较小，仅作为办公使用，不属于生产经营性用房，且该等物业若被认定为出租方无权出租而要求发行人搬迁，发行人寻找替代性物业的成本和难度较低；（2）若出现前述无法承租情况，发行人可依据租赁合同向出租方进行索赔；（3）报告期内，发行人未曾出现因租赁房产的出租方未能提供有效的权属证明而被起诉要求提前解除合同或被主管部门处罚的情形。因此，无法继续承租该等物业不会对发行人持续经营构成重大不利影响。

对于上述第 11、13 项房屋租赁，租赁双方未办理租赁备案。根据相关规定，上述发行人未进行租赁备案的物业，其租赁合同效力不会因未进行租赁备案而认定为无效。报告期内，发行人未因上述房产未办理租赁登记备案手续而受到房地产管理部门的行政处罚，上述物业租赁未办理备案登记手续不会对发行人本次发行上市造成实质性法律障碍。

发行人的控股股东、实际控制人已作出承诺，若发行人及其子公司因上述

租赁物业瑕疵而受到相关主管部门的行政处罚，其将承担由此产生的任何滞纳金、罚款或另行租房等可能给发行人及其子公司造成的损失。

综上所述，上述出租方未提供权属证明文件的租赁物业面积占发行人在用房屋总面积的比例较低，发行人后续无法继续租赁情况下寻找替代性物业的成本和难度较低；租赁物业未办理备案不影响租赁合同的效力；发行人控股股东、实际控制人已对上述租赁物业瑕疵做出了兜底承诺，承担因此可能给发行人造成的损失，且报告期内发行人未因租赁物业瑕疵受到主管部门的行政处罚，亦不存在被主管部门立案调查的情形，发行人租赁物业瑕疵情况不会对发行人生产经营造成重大不利影响，亦不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至 2026 年 4 月 30 日，发行人及其子公司拥有的土地使用权的具体情况如下：

序号	权证号	权利人	用途	土地位置	面积（㎡）	他项权利
1	浙（2023）杭州市不动产权第 0462577 号	鸿星科技	工业用地	杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2880 号	15,883.10	无
2	杭余出国用（2007）第 110-401 号	鸿星科技	工业用地	余杭区良渚镇荀山村	1,371.10	无
3	金市国用（2003）字第 6-14876 号	金华鸿瑞	工业用地	金磐开发区内 A6 地块	2,202.80	无
4	浙（2023）德清县不动产权第 0029849 号	浙江鸿星	工业用地	康乾街道上唐街 81 号	34,495.14	无

2、商标

（1）发行人在境内取得的注册商标

截至 2026 年 4 月 30 日，公司拥有的境内注册商标权具体情况如下：

序号	所有权人	商标	申请号	类别	有效日期	权利取得方式
1	鸿星科技	Hosonic	11074042	9	2014.01.28-2034.01.27	原始取得
2	鸿星科技	虹兴晶振	56964914	9	2021.12.21-2031.12.20	原始取得
3	鸿星科技	ETSB	56964891	9	2021.12.21-2031.12.20	原始取得
4	鸿星科技	T1SB	56966132	9	2022.03.07-2032.03.06	原始取得

序号	所有权人	商标	申请号	类别	有效日期	权利取得方式
5	鸿星科技	浙鸿	56973341	9	2022.03.07-2032.03.06	原始取得
6	鸿星科技	鸿翔晶振	56964930	9	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
7	鸿星科技	佳晟晶振	56981524	9	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
8	鸿星科技	红兴晶振	56989817	9	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
9	鸿星科技	鸿瑞晶振	56988312	9	2022.04.07-2032.04.06	原始取得
10	鸿星科技	鸿康晶振	56974767	9	2022.04.07-2032.04.06	原始取得
11	鸿星科技		4149204	9	2016.10.14-2026.10.13	原始取得
12	鸿星科技	HOSONIC	1246945	9	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
13	鸿星科技	鸿晶晶振	56974764	9	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
14	鸿星科技	HOSONIC	74839965	9	2024.04.21-2034.04.20	原始取得

（2）发行人在境外取得的注册商标

截至 2026 年 4 月 30 日，公司拥有的境外注册商标权具体情况如下：

序号	商标	商标权人	马德里注册号	单独注册号	有效期限	注册地/受保护地	取得方式
1	Hosonic	发行人	-	302438406	2012.11.16-2032.11.15	中国香港特别行政区	原始取得
2		发行人	1168273	-	2013.04.16-2033.04.16	澳大利亚、欧盟、日本、菲律宾、韩国、新加坡、美国、俄罗斯、越南	原始取得
3			-	1570812	2013.04.16-2033.04.16	澳大利亚	原始取得
4			-	4460701	2013.04.16-2033.04.16	美国	原始取得
5			-	UK00801168273	2013.04.16-2033.04.16	英国	原始取得
6			-	1909532	2025.10.13-2035.10.13	泰国	原始取得
7	HOSONIC	发行人	1162154	-	2013.04.16-2033.04.16	澳大利亚、欧盟、日本、菲律宾、韩国、新加坡、美国、俄罗斯、越南	原始取得
8			-	1563691	2013.04.16-2033.04.16	澳大利亚	原始取得
9			-	4438164	2013.04.16-2033.04.16	美国	原始取得
10			-	UK00801162154	2013.04.16-2033.04.16	英国	原始取得

序号	商标	商标权人	马德里注册号	单独注册号	有效期限	注册地/受保护地	取得方式
11			-	1909528	2025.10.13-2035.10.13	泰国	原始取得
12	Hosonic	发行人	1168037	-	2013.04.16-2033.04.16	澳大利亚、欧盟、日本、菲律宾、韩国、新加坡、美国、俄罗斯、越南	原始取得
13			-	1570771	2013.04.16-2033.04.16	澳大利亚	原始取得
14			-	4460698	2013.04.16-2033.04.16	美国	原始取得
15			-	UK00801168037	2013.04.16-2033.04.16	英国	原始取得
16	鸿星	发行人	-	00037326	1989.08.01-2029.06.30	中国台湾地区	继受取得
17		发行人	-	00859313	1999.07.16-2029.07.15	中国台湾地区	继受取得
18	Hosoni	发行人	-	01516508	2012.05.01-2032.04.30	中国台湾地区	继受取得
19		发行人	-	02025721	2019.12.01-2029.11.30	中国台湾地区	继受取得

注：上述第 16-19 项商标系自台湾鸿星受让取得。

3、专利

截至 2026 年 4 月 30 日，公司拥有的 70 项专利权，其中 18 项发明专利、52 项实用新型，具体情况如下：

序号	类型	专利名称	专利号	专利权人	专利申请日	取得方式
1	发明专利	石英晶体谐振器点胶过程中点胶头位置控制的测量方法及装置	202111626464X	鸿星科技	2021.12.28	原始取得
2	发明专利	一种智能化 SMD 晶振品控检测专用设备及其工作方法	2021115253633	鸿星科技	2021.12.14	原始取得
3	发明专利	一种适用于无可伐环的陶瓷基座的晶体谐振器的翻转治具	2021113871640	鸿星科技	2021.11.22	原始取得
4	发明专利	一种改进型的 SMD 晶振反分析及品质检测专用治具	202111346488X	鸿星科技	2021.11.15	原始取得
5	发明专利	石英晶体谐振器点胶过程中点胶头的高度控制方法及其装置	2021113366393	鸿星科技	2021.11.12	原始取得
6	发明专利	一种表面贴片式石英晶体振荡器开盖方法	2021112831345	鸿星科技	2021.11.01	原始取得
7	发明专利	一种石英晶体谐振器或振荡器及其设计方法	2021111234987	鸿星科技	2021.09.24	原始取得
8	发明专利	基于四层膜结构的 AT 石英晶体谐振器、振荡器及设计方法	2021111218518	鸿星科技	2021.09.24	原始取得

序号	类型	专利名称	专利号	专利权人	专利申请日	取得方式
9	发明专利	一种标准化的 SMD 石英晶体振荡器检测方法	202111455132X	鸿星科技	2021.12.02	原始取得
10	发明专利	一种石英晶片镀膜治具一体框	201811321451X	鸿星科技	2018.11.07	原始取得
11	发明专利	一种 SMD 石英晶体振荡器上盖印字方法	2023108601886	鸿星科技	2023.07.13	原始取得
12	发明专利	无谐振峰抗振动、抗冲击的石英晶体谐振器	2021116265021	鸿星科技	2021.12.28	原始取得
13	发明专利	梳状金属膜的 AT 切温补晶振	2021113039885	鸿星科技	2021.11.05	原始取得
14	发明专利	一种加热分离 PCB 板和贴片式晶振的方法	2023106832602	鸿星科技	2023.06.09	原始取得
15	发明专利	一种基于压溶液测试的密封检测方法	2025101026793	鸿星科技	2025.01.22	原始取得
16	发明专利	一种有源晶体振荡器及其制造方法	2025102728064	鸿星科技	2025.03.10	原始取得
17	发明专利	一种石英晶片的清洗方法	2025109157497	浙江鸿星	2025.07.03	原始取得
18	发明专利	一种石英晶振基座封焊方法	2025110420873	鸿星科技	2025.07.28	原始取得
19	实用新型	一种石英晶片镀膜治具	2017201718422	鸿星科技	2017.02.24	原始取得
20	实用新型	一种基于小型化晶片安装的石英晶体振荡器	2017201718386	鸿星科技	2017.02.24	原始取得
21	实用新型	一种用于固定石英晶片镀膜夹具的固定框	2017201740939	鸿星科技	2017.02.24	原始取得
22	实用新型	一种温补晶体振荡器	2017201714671	鸿星科技	2017.02.24	原始取得
23	实用新型	一种玻璃封焊的石英晶体谐振器	201720171090X	鸿星科技	2017.02.24	原始取得
24	实用新型	一种石英谐振器的基座结构	2018204029322	鸿星科技	2018.03.23	原始取得
25	实用新型	一种表面贴装石英晶体谐振器	2018204036114	鸿星科技	2018.03.23	原始取得
26	实用新型	一种温补晶体振荡器	2018204036133	鸿星科技	2018.03.23	原始取得
27	实用新型	一种表面贴装石英晶体振荡器	2018204029572	鸿星科技	2018.03.23	原始取得
28	实用新型	一种 SMD 外置热敏电阻的石英谐振器基座结构	2018218285199	鸿星科技	2018.11.07	原始取得
29	实用新型	一种 2016 型石英振荡器的基座结构	2018204029500	鸿星科技	2018.03.23	原始取得
30	实用新型	一种超薄石英晶片镀膜治具框	2018218292864	鸿星科技	2018.11.07	原始取得
31	实用新型	一种石英晶片镀膜治具一体框	2018218285131	鸿星科技	2018.11.07	原始取得
32	实用	一种石英晶体治具的清洗系统	2018220527196	鸿星	2018.12.07	原始

序号	类型	专利名称	专利号	专利权人	专利申请日	取得方式
	新型			科技		取得
33	实用新型	一种石英晶体振荡器测试装置	2018220567780	鸿星科技	2018.12.07	原始取得
34	实用新型	一种双输出石英谐振器的基座	2018218285150	鸿星科技	2018.11.07	原始取得
35	实用新型	一种超薄石英晶片的镀膜治具框	2019221366995	鸿星科技	2019.12.03	原始取得
36	实用新型	一种晶振电性能测试用探针寿命检测装置	2020202874434	鸿星科技	2020.03.10	原始取得
37	实用新型	一种外置热敏电阻的石英谐振器基座	2020202882036	鸿星科技	2020.03.10	原始取得
38	实用新型	一种内置热敏电阻的石英谐振器基座	2020202874237	鸿星科技	2020.03.10	原始取得
39	实用新型	一种压控振荡器基座	202023320297X	鸿星科技	2020.12.31	原始取得
40	实用新型	一种压控振荡器基座	2020233202679	鸿星科技	2020.12.31	原始取得
41	实用新型	一种石英谐振器基座	2020233204462	鸿星科技	2020.12.31	原始取得
42	实用新型	一种石英晶振基座灰尘清理装置	2021233785770	鸿星科技	2021.12.29	原始取得
43	实用新型	一种封焊电极修磨快速夹取装置	2021233786044	鸿星科技	2021.12.29	原始取得
44	实用新型	一种基于小型化晶片安装的基座	2021233881689	鸿星科技	2021.12.29	原始取得
45	实用新型	一种用于晶片生产的供料和收料系统	2021233882658	鸿星科技	2021.12.29	原始取得
46	实用新型	一种耐磨损的气缸装置	2021234450859	鸿星科技	2021.12.29	原始取得
47	实用新型	一种多功能石英晶片清洗装置	2022212498639	金华鸿瑞	2022.05.23	原始取得
48	实用新型	一种具有刹车装置的晶片研磨设备	2022212655324	金华鸿瑞	2022.05.23	原始取得
49	实用新型	一种新型的石英晶片加工用载盘治具	2022220590656	鸿星科技	2022.08.05	原始取得
50	实用新型	一种导电体风冷装置	202320053976X	鸿星科技	2023.01.09	原始取得
51	实用新型	一种吹吸气装置	2023200539454	鸿星科技	2023.01.09	原始取得
52	实用新型	一种吸晶片系统	2023200556144	鸿星科技	2023.01.09	原始取得
53	实用新型	一种镀膜搬送装置	2023231583025	鸿星科技	2023.11.22	原始取得
54	实用新型	一种真空泵拉杆安装定位工具	2023231583010	鸿星科技	2023.11.22	原始取得
55	实用新型	一种便于晶片挤蜡的夹具	2023230670952	金华鸿瑞	2023.11.14	原始取得

序号	类型	专利名称	专利号	专利权人	专利申请日	取得方式
56	实用新型	一种高精度晶片角度测量设备	2023234008932	金华鸿瑞	2023.12.13	原始取得
57	实用新型	一种用于检测产品外观的图像拍摄装置	2023234008928	金华鸿瑞	2023.12.13	原始取得
58	实用新型	一种定点空气除尘装置	202420811986X	浙江鸿星	2024.04.18	原始取得
59	实用新型	一种适应多系列晶片的石英晶体谐振器基座结构	2024207351120	浙江鸿星	2024.04.10	原始取得
60	实用新型	一种芯片倒装石英晶体振荡器基座机构	2024207351116	浙江鸿星	2024.04.10	原始取得
61	实用新型	一种超声波链条清洗装置	2024231328505	鸿星科技	2024.12.18	原始取得
62	实用新型	一种石英晶体谐振器导电胶激光固化装置	2024215454951	鸿星科技	2024.07.02	原始取得
63	实用新型	一种应用于石英振荡器 IC 负性阻抗测试的转接治具	2024231028089	浙江鸿星	2024.12.16	原始取得
64	实用新型	一种多功能石英晶片角度分选机	2024227100587	金华鸿瑞	2024.11.07	原始取得
65	实用新型	一种石英晶片加工用多线切割机	2024227100553	金华鸿瑞	2024.11.07	原始取得
66	实用新型	一种用于晶片加工的正反转研磨机	2024227100500	金华鸿瑞	2024.11.07	原始取得
67	实用新型	一种工装治具	2025207442285	浙江鸿星	2025.04.18	原始取得
68	实用新型	一种实现微调至封焊快速翻料的工装组合治具	2025207442196	浙江鸿星	2025.04.18	原始取得
69	实用新型	一种内置四 PAD 多功能基座结构	2025207442270	浙江鸿星	2025.04.18	原始取得
70	实用新型	一种石英晶振大基座搭载小晶片的结构	2025207216335	浙江鸿星	2025.04.16	原始取得

4、软件著作权

截至 2026 年 4 月 30 日，公司及子公司拥有 3 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	他项权利
1	鸿星科技	晶体谐振器全自动点胶系统 V1.0	2016SR172770	2014.12.30	2014.12.31	原始取得	无
2	鸿星科技	石英晶体微调检测系统 V1.0	2016SR172774	2015.12.30	2015.12.31	原始取得	无
3	鸿星科技	点胶机 Z 轴补偿测量系统	2024SR1086276	2024.07.30	/	原始取得	无

5、域名

截至 2026 年 4 月 30 日，发行人及其子公司已注册并拥有的域名具体情况如下：

序号	网站域名	网站名称	备案/许可证号	主办单位名称	有效期
1	hosonic.com	鸿星科技	浙 ICP 备 2021040184 号-1	鸿星科技	1998.05.27-2030.05.26

（三）特许经营权

截至 2026 年 4 月 30 日，发行人未拥有特许经营权。

（四）生产经营资质与证书

截至 2026 年 4 月 30 日，发行人拥有的生产经营资质与证书情况如下：

序号	名称	证书编号	发证单位	有效期	持有人
1	高新技术企业证书	GR202533001070	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2025.12.19 起三年	鸿星科技
2	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3301939297	中华人民共和国杭州海关	长期	鸿星科技
3	质量管理体系认证证书	02811Q10450R4M	北京中安质环认证中心有限公司	2023.07.06-2026.07.30	鸿星科技
4	环境管理体系认证证书	02811E10219R4M	北京中安质环认证中心有限公司	2023.07.06-2026.07.30	鸿星科技
5	职业健康安全管理体系认证证书	02811S10159R4M	北京中安质环认证中心有限公司	2023.07.06-2026.07.30	鸿星科技
6	IATF16949 汽车质量管理体系	102975/A/0001/SM/ZH	优克斯认证（杭州）有限公司	2024.11.25-2027.11.24	鸿星科技
7	IECQ 符合性证书（有害物质过程管理）	IECQ-HULTW19.0001	德世爱普认证（上海）有限公司	2024.11.06-2028.01.08	鸿星科技
8	电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书	201301103019901247	北京赛西认证有限责任公司	2023.03.07-2028.03.06	鸿星科技
9	电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书	201301103019901245	北京赛西认证有限责任公司	2023.03.07-2028.03.06	鸿星科技
10	排污许可证	91330100609123211C001Q	杭州市生态环境局	2024.09.30-2029.09.29	鸿星科技
11	城镇污水排入排水管网许可证	浙余杭（排水）字第 2025063011569	杭州市余杭区住房和城乡建设局	2025.06.30-2030.06.29	鸿星科技
12	质量管理体系认	03425Q50868R2M	北京航协认证中	2025.08.19-2028.08.27	金华

序号	名称	证书编号	发证单位	有效期	持有人
	证证书		信有限责任公司		鸿瑞
13	固定污染源排污登记回执	91330727749808458Y001W	-	2023.02.10-2028.02.09	金华鸿瑞
14	固定污染源排污登记回执	91330521MA7EFLXR27001Y	-	2025.09.16-2030.09.15	湖州鸿皓
15	城镇污水排入排水管网许可证	浙德城污排字第 2023-19 号	德清县城市管理局	2023.08.23-2028.08.22	浙江鸿星
16	固定污染源排污登记回执	91330521MA2D4DM340001Z	-	2024.01.08-2029.01.07	浙江鸿星
17	质量管理体系认证证书	02824Q10763R0M	北京中安质环认证中心有限公司	2024.03.22-2027.03.21	浙江鸿星
18	环境管理体系认证证书	02824E10513R0M	北京中安质环认证中心有限公司	2024.03.22-2027.03.21	浙江鸿星
19	职业健康安全管理体系认证证书	02824S10483R0M	北京中安质环认证中心有限公司	2024.03.22-2027.03.21	浙江鸿星

五、公司技术与研发情况

（一）公司核心技术情况

1、核心技术及技术来源

公司在长期技术积累与市场实践中已掌握晶片及产品设计、制程工艺、溅射镀膜、高精密点胶、封装测试等相关核心技术。公司核心技术情况详见下表：

技术名称		技术效果简介	技术来源	应用阶段	对应专利情况
高精度高频产品设计技术	多层膜构造电极形成工艺	该技术采用多层膜结构构建晶片电极，通过精确调控各膜层的材料与厚度，最大限度地减小电极材料与石英晶片间的热膨胀系数差异影响，降低热冲击时的频率变动，使晶振产品在宽温度范围内保持频率稳定性。	自主研发	大批量生产	一种石英晶体谐振器或振荡器及其设计方法
	热敏电阻内置技术	该技术通过在基座内部腔体或外部腔体放置高精度热敏电阻，利用其电阻值变化推算基座内部的温度变化。结合晶芯片 5 阶温度系数特性实现了频率输出的精准温度补偿，有效解决了因基座内部芯片温度与外部 PCB 板温度差异导致的频率输出失配问题。	自主研发	大批量生产	一种 SMD 外置热敏电阻的石英谐振器基座结构、一种外置热敏电阻的石英谐振器基座
高精度晶振产品精密制造技术	高精密点胶工艺技术	该技术采用高精密点胶工艺，通过对点胶量、胶点形态与分布位置的精确控制实现陶瓷基座、石英晶片与银胶之间的精准结合，保障晶振产品在长期高频振动环境下具备较好的抗冲击能力。	自主研发	大批量生产	石英晶体谐振器点胶过程中点胶头位置控制的测量方法及装置、石英晶体谐振器点胶过程中点胶

技术名称		技术效果简介	技术来源	应用阶段	对应专利情况
					头的高度控制方法及其装置
		该技术可用于多种规格晶片的测试需求，通过提高测试系统的自动化程度，确保每次测试时探针均能以统一、精确的位置接触晶片，减少传统人工测试带来的定位误差。	自主研发	大批量生产	一种石英晶片的测试装置及方法
	产品电极的设计技术	该技术通过设计一种专用镀膜治具框有效解决了微型高频石英晶片在镀膜过程中易发生电极错位的工艺问题。该治具采用特殊层叠、无缝隙的结构，避免了因组装间隙导致的晶片偏位现象，确保镀膜过程中晶片定位的精准性与稳定性。	自主研发	大批量生产	一种石英晶片镀膜治具一体框、一种超薄石英晶片镀膜治具框
	封焊电极修磨快速夹取装置	该技术采用一种封焊电极修磨快速夹取装置，通过卡块与卡槽实现对轴杆的初次定位后，通过连接螺栓旋入连接螺孔内，实现对轴杆的抵接，从而实现对轴杆的二次定位后，再通过专门的机床进行打磨，较少传统的夹取方式定位过程繁琐，消耗时间过长，反复装卸电极轮对轴杆有较大损耗等不利因素。	自主研发	大批量生产	一种封焊电极修磨快速夹取装置
	高精度小型化封装技术	该技术通过计算封焊时上盖、基座及电极材料产生的发热功率阈值，实现对封焊热场的精准控制，有效提高石英晶振的气密性。	自主研发	大批量生产	一种石英晶振基座封焊方法
	产品组装设计技术	该技术利用胶体的固化收缩力，避免晶片右侧与基座凸台发生接触，保持产品在长期运行中的性能稳定性，可满足通信领域对高性能石英晶体振荡器的需求。	自主研发	大批量生产	一种使晶振晶片悬空的点胶方法、石英晶体振荡器
	自动收放料系统技术	该技术可实现石英晶体从进入回流焊炉到加热再到产品回收的全流程自动化作业，为规模化制造提供高效解决方案，提升生产效率的同时降低人工搬运引发的操作误差。	自主研发	大批量生产	一种用于晶片生产的供料和收料系统
	适用于无可伐环的陶瓷基座的晶体谐振器的翻转治具技术	该技术基于无可伐环陶瓷基座磁性较弱的特点设计了一套翻转移载治具，替代传统人工夹取或吸嘴转移等方式，避免了因人工操作不当造成的产品损伤并提升工序效率。	自主研发	大批量生产	一种适用于无可伐环的陶瓷基座的晶体谐振器的翻转治具
	石英晶体上盖印字清晰技术	该技术通过对激光印字功率与上盖材质进行精确匹配与优化，实现 SMD 石英晶体振荡器上盖印字轮廓分明，并有效抑制周边氧化情况，提升产品的可追溯性与外观质量。	自主研发	大批量生产	一种 SMD 石英晶体振荡器上盖印字方法

技术名称		技术效果简介	技术来源	应用阶段	对应专利情况
	石英晶体产品密封性检测技术	该技术通过一种新型溶液，在一定温度和压力下，实现对密封后的石英产品进行密封性检查，溶液可以穿透细微孔隙，进入产品内部，使产品失效，在规定的时间内可透过电参数检查，筛查出漏气产品。	自主研发	大批量生产	一种基于压溶液测试的密封检测方法
	清洗系统的改造优化	该技术针对传统清洗设备依赖人工作业效率低且易污染晶片的问题，通过对清洗系统的智能化改造，结合专用治具设计与设备定位优化，实现清洗效率提升的同时为高洁净度制造提供保障。	自主研发	大批量生产	一种石英晶片治具的清洗系统
高精度晶振产品测量技术	基座 KV 环面电阻检测技术	该技术适用于各类 KV 基座环面电阻的高精度测量，可实现对封焊电流的精准控制与稳定输出，显著提升封焊工艺的一致性，增强产品的密封性能与长期可靠性。	自主研发	大批量生产	一种标准化的 SMD 石英晶体振荡器检测方法
	晶片表面粗糙度与形貌检测技术	该技术通过获取石英晶体表面的微观平整度与形貌特征，为关键材料的工艺优化提供检测依据，有效指导制程参数的精细化调控，从而提升晶体元件的性能与成品率。	自主研发	大批量生产	一种智能化 SMD 晶振品控检测专用设备及其工作方法
	高精度晶片检测技术	该技术采用基于超声成像的石英晶片快速筛选方法及系统，能够高效识别晶片内部缺陷，并通过逐步缩小缺陷定位范围以最终实现对单个缺陷晶片的精准剔除，大幅提升晶片检测的准确性与效率。	自主研发	大批量生产	一种超声成像的石英晶片快速筛选方法及系统
	kHz 频带石英晶体振荡器/谐振器测试方法	该技术适用于 kHz 频带石英晶体元器件的批量测试需求。通过动态缩窄频率搜索范围，结合感抗与容抗的直接比较及迭代修正，有效抑制模型参数误差对测量结果的影响，实现了负载谐振频率的高精度、高稳定测量并显著缩短测试时间。	自主研发	大批量生产	一种 kHz 频带石英晶体振荡器/谐振器测试方法
	PCB 板分析匹配晶体拆卸安装焊接技术	该技术采用特殊开窗加热技术，只针对晶体进行焊接，减少周围器件的损伤及脱落，可有效实现高效的拆装及和焊接。	自主研发	大批量生产	一种加热分离 PCB 板和贴片式晶振的方法
	无损开盖检测技术	该技术针对传统开盖技术易破坏晶振内部结构的问题，基于物理原理设计无损开盖方法，实现在保持内部结构完整性的前提下完成开盖，为后续获取准确产品测量数据提供保障，进而提升失效分析与质量追溯的可靠性。	自主研发	大批量生产	一种表面贴片式石英晶体振荡器开盖方法
	高可靠性开盖治具工艺技术	该技术设计一种应用于石英晶体的专用开盖治具，通过结构设计与精准定位有效提高石英晶体谐振器、振荡器	自主研发	大批量生产	一种改进型的 SMD 晶振反分析及品质检测专

技术名称		技术效果简介	技术来源	应用阶段	对应专利情况
		开盖操作的成功率与良品率，降低开盖过程中对晶振元件的机械损伤风险。			用治具

2、核心技术在主营业务及产品中的贡献

报告期内，公司主要依靠核心技术开展生产经营，核心技术产品收入占主营业务收入的比例具体如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入（万元）	57,854.22	51,982.48	51,099.26
主营业务收入（万元）	63,211.96	56,738.44	54,091.17
核心技术产品收入占比	91.52%	91.62%	94.47%

3、核心技术保护措施

为保持公司核心竞争力，避免技术流失，公司始终把核心技术的保护作为研发工作中不可缺少的重要环节，采取了严密的技术保护措施，并在实践中取得了良好效果。一方面，公司对主要核心技术申请专利，形成知识产权保护。另一方面，公司制定了《保密制度》等相关制度，明确了各部门的保密风险管理职责，确认了保密风险重要控制部位和控制点。此外，公司与核心技术人员签订了《保密协议》，对于公司核心技术、知识产权、科研成果等保密事项作了严格的规定。

（二）研发费用情况

报告期内，公司研发费用及其占营业收入的比例情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用（万元）	3,799.99	3,597.44	3,540.71
营业收入（万元）	63,212.05	56,739.10	54,153.81
研发费用占营业收入的比例（%）	6.01	6.34	6.54

（三）正在从事的研发项目情况

截至 2026 年 4 月 30 日，公司正在研发的主要项目情况如下：

序号	项目名称	项目目标	进展情况
1	车载智能算力平台用 2520 25.0M 石英晶体振荡器	本项目旨在研发车规级 25.0MHz 晶振，保障平台稳定可靠运行，提供稳定时钟信号，支撑平台算力调度与数据同步，符合车规级性能与可靠性标准。	样品试制阶段
2	低摆幅光模块用高频基本波 156.250M LVDS 差分振荡器	本项目旨在研制低抖动 156.250 MLVDS 差分振荡器，提供低抖动、低功耗时钟信号，满足高速光通信模块稳定工作需求。	样品试制阶段
3	智能机器人灵巧手用超小型化 1008 40M 石英晶体谐振器	本项目旨在研制超小型 1008 封装 40MHz 晶振，提供高精度、高稳定时钟信号，满足机器人控制系统小型化、高可靠性工作需求，满足智能机器人关节驱动高精度高可靠应用。	样品试制阶段
4	汽车 V2X 通信用 2016 38.4M 温补石英晶体振荡器	本项目旨在研发车规级 2016 封装 38.4M 温补晶振，提供高精度、高稳定时钟信号，满足车载通信严苛环境下的高可靠工作要求。	样品试制阶段
5	智能机器人关节用小型化 1612 25M 石英晶体振荡器	本项目旨在研发小型化 1612 封装 25M 晶振，满足机器人关节紧凑空间与高可靠控制需求。	样品试制阶段
6	智能手机精准定位用高频小型化 1612 76.8M 温度补偿石英晶体谐振器	本项目旨在面向智能手机精准定位应用，研发高频小型化 1612 封装 76.8M 温补石英晶体谐振器，提供高精度时钟信号，满足手机定位高灵敏度、高稳定性要求。	样品试制阶段
7	使用光刻技术开发 Wafer 形状的 AT-cut 石英晶片	本项目采用光刻工艺开发 Wafer 级 AT 切石英晶片，形成适合规模化生产的微型化、高频化、高一致性、高可靠性光刻石英晶片制造工艺体系，满足高端晶振元器件在下游应用领域的国产化需求。	样品试制阶段
8	车载激光雷达用 2016 50M 石英晶体谐振器	本项目旨在研发车载激光雷达专用 2016 50M 石英晶体谐振器，完成可靠性认证，实现量产交付与进口替代，提升车载激光雷达核心器件自主可控能力，支撑智能驾驶系统稳定运行。	样品试制阶段
9	车载行驶动态控制用 2016 25.0M 石英晶体谐振器	本项目旨在针对车载行驶动态控制系统，研发 2016 25.0M 石英晶体谐振器，为车载行驶动态控制提供精准时钟基准，保障系统可靠运行，完成进口替代。	样品试制阶段
10	个人医疗平板用 2016 37.4M 石英晶体谐振器	本项目旨在面向个人医疗平板，研发 2016 37.4M 石英晶体谐振器，实现高精度、低功耗、高稳定性，满足医疗设备严苛要求，保障设备精准可靠工作。	样品试制阶段
11	服务器云端与边缘运算 2016 78.125M 石英晶体谐振器	本项目旨在面向服务器云端及边缘运算应用，开发 2016 78.125M 石英晶体谐振器，实现高频低噪、高稳定性能，满足高速运算场景要求，提升设备运行可靠性与数据处理效率。	样品试制阶段
12	服务器 GPU 显卡 2016 24.0M 石英晶体谐振器	本项目旨在针对服务器 GPU 显卡开发 2016 24.0M 石英晶体谐振器，实现低噪声、高稳定与高一致性，保障显卡长时间稳定运算，满足服务器高效可靠运行。	样品试制阶段

（四）合作研发情况

公司积极开展产学研合作，与浙江大学、浙江工业大学建立了合作关系，共同进行研究开发、技术攻关和成果转化，全面提升公司研发实力和技术水平。报告期内，公司的合作研发情况如下：

1、浙江大学

事项	主要内容
主要合作内容	使用 3 英寸 AT 切型石英晶圆，在浙江大学通过实验设计选定所需材料并确立光刻工艺的核心技术，以其结果为基础开发 76.8MHz 频率的石英晶振原型器件，为量产实施提供参考方案。
知识产权分配	（1）合作一方独立完成的成果及相关知识产权归完成方所有。合作各方因履行合同共同开发完成的研究成果及知识产权归合作各方共有。 （2）合作一方独立完成内容所产生的技术秘密归完成方所有。合作各方因履行本合同共同开发完成内容所产生的技术秘密归合作各方共有。
合作期限	2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日
保密措施	（1）保密信息指与本合同项目有关的、与合作各方有关的或与第三方有关的，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式表现的信息，包括但不限于技术开发的内容、技术方案、技术指标、数据、结果、模型等，以及合作各方依据法律规定和有关合同约定要求各方承担保密义务的其他事项。 （2）合作各方仅能为完成本合同项目所定目标而使用保密信息。一方不经其他方的同意，不得直接或间接的将保密信息泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。合作各方应采取适当的保密措施，妥善保管保密信息，以保障保密信息不被泄漏，具体保密措施包括但不限于制定保密制度、与有关人员签订保密合同等。 （3）保密期限为本合同生效之日起至项目验收合格后三年。保密期满后，如合作各方认为有继续保密的必要，可签订新的保密合同。

2、浙江工业大学

事项	主要内容
主要合作内容	（1）开展发行人产品设计理论和设计技术的研究，开展发行人产品检测方法和试验技术的研究，开展发行人生产技术及装备的研究； （2）针对发行人生产和发展需要，协助指定或完善企业有关产品技术标准的编制； （3）结合技术开发申请专利； （4）选择性地参与发行人新产品的开发，共同组织项目的实施，负责项目的理论分析与仿真、试验数据整理、技术资料整理，技术成果的总结等； （5）发挥校企合作的优势，负责组织申报省市和国家科技项目，撰写项目建议书或项目申报书，并负责项目实施的组织工作； （6）发挥校企合作的优势，负责组织申报省市和有关行业组织的科技奖项，撰写、收集和整理申报材料，并负责组织项目介绍与答辩等工作。
知识产权分配	联合研发中心执行合作协议中产生的研发成果的知识产权等权利、权益归双方共同所有，发表或申请各种权利、奖励时，应双方署名； 发行人有权行使、使用、利用，且无需再支付任何报酬、费用；

事项	主要内容
	浙江工业大学有权自己利用，但如欲进行转让、赠与或许可他人以任何形式使用等处分的，应事先取得甲方书面同意；如有特定或例外情况的，须双方另行协商一致后具体确定。
合作期限	2021 年 1 月 18 日至 2024 年 9 月 30 日
保密措施	浙江工业大学以及联合研发中心的参与人员应对在执行本合作协议中接触、获取的甲方任何形式、种类的未公开信息予以严格保密。

（五）科研实力和成果情况

1、公司的科研实力

研发是公司业务发展的重要驱动力。对于产品生产技术的革新与工艺的改进优化，公司给予了高度的重视。经过长时间的技术积累，公司产品质量受到客户的广泛认可，“小型化高频基本波低抖动压控晶体振荡器”等 13 项新产品获评省级工业新产品，“车载高频石英晶体振荡器”等 24 项新产品获得省级科学技术成果鉴定证书。

2、重要荣誉或奖项

公司先后被评为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省加工贸易创新发展示范企业、浙江省分领域分行业亩均效益领跑者、浙江出口名牌。截至 2026 年 4 月 30 日，公司获得的荣誉奖项具体情况如下：

序号	荣誉名称	颁发单位	时间
1	国家专精特新“小巨人”企业	国家工业和信息化部	2025 年
2	浙江出口名牌	浙江省商务厅	2023 年
3	2021 年度浙江省分领域分行业亩均效益领跑者	浙江省深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室	2022 年
4	浙江省加工贸易创新发展示范企业	浙江省商务厅等	2018 年
5	高精度超小型电子元器件省级高新技术企业研究开发中心	浙江省科学技术厅	2018 年

同时，公司在全球拥有较强的市场美誉度和客户认可度，曾被富士康、工业富联、锐捷、爱联科技等多家全球知名客户授予“最佳质量奖”“最佳交付奖”“优秀战略合作伙伴”等荣誉称号。

3、公司参与的行业标准制定

公司作为主要起草单位，完成了 1 项国家标准《半导体晶片近边缘几何形态评价第 1 部分：高度径向二阶导数法（ZDD）》和 3 项团体标准《光刻用 AT 切石英晶片》《汽车用石英晶体元件可靠性试验》《汽车用石英晶体振荡器可靠性试验》的制定。此外，公司正在参与制定 1 项国家标准、1 项行业标准和 3 项团体标准。

（六）研发人员及核心技术人员情况

1、研发人员情况

发行人认定的研发人员均为研发部门中直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员，不包括与研发活动无直接关系的人员。

公司认定的研发人员职能定位明确，均与研发活动直接或密切相关，和其他非研发人员可明确区分。相关人员认定口径符合《监管规则适用指引——发行类第 9 号：研发人员及研发投入》中研发人员认定的范围。

报告期各期末，公司研发人员数量及占比情况如下：

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
研发人员人数（人）	118	102	92
占比	11.75%	11.50%	10.70%

公司研发人员以全时研发人员为主，存在少量非全时研发人员，非全时研发人员当期从事研发活动的工时占比均超过 50%。报告期各期末，公司非全时研发人员数量分别为 8 人、1 人和 1 人。

报告期各期末，发行人研发人员学历分布如下：

学历分布	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	人数（人）	占比（%）	人数（人）	占比（%）	人数（人）	占比（%）
本科及以上	56	47.46	48	47.06	32	34.78
大专	46	38.98	35	34.31	40	43.48
高中及以下	16	13.56	19	18.63	20	21.74
合计	**118**	**100.00**	**102**	**100.00**	**92**	**100.00**

如上表所示，报告期各期末，公司研发人员数量分别为 92 人、102 人和 118 人，其中大专及以上学历人数占比分别为 78.26%、81.37%和 86.44%。发行人研发人员学历整体以大专及以上学历为主，学历分布合理，主要研发人员具有较高学历背景以满足研发活动的需求。

2、核心技术人员情况

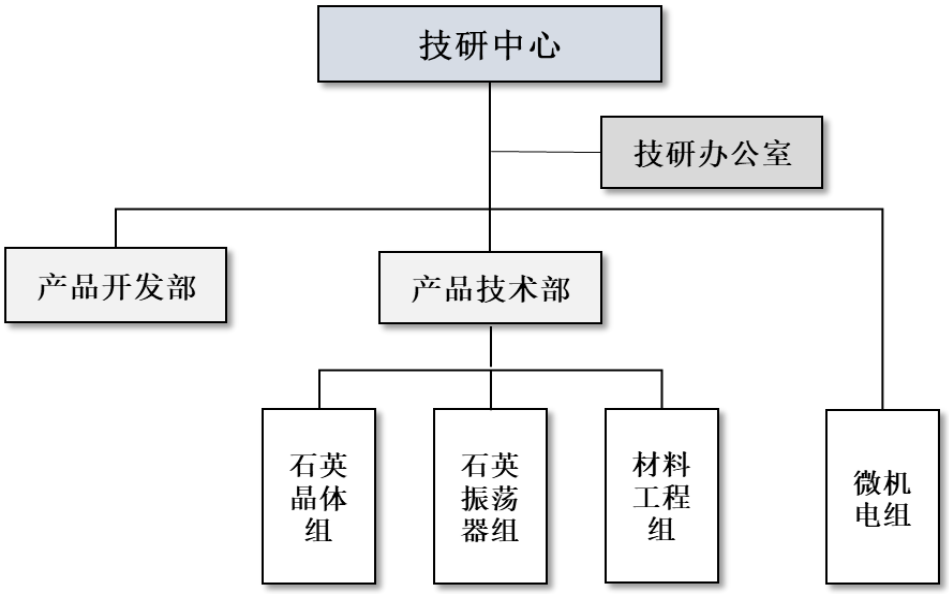
公司核心技术人员为林洪河、辜达元、安田克史。报告期内公司核心技术人员不存在变动情况。核心技术人员简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“4、其他核心人员”。

公司与核心技术人员签订了《保密协议》，对于公司核心技术、知识产权、科研成果等保密事项作了严格的规定，对侵犯公司技术的行为保留索赔、仲裁、诉讼等权利。

（七）公司的技术创新机制

1、公司研发组织架构

公司非常重视生产技术与产品合成路线的研究与开发，经过多年的持续研发投入，公司逐步建立了组织健全、运行高效的研发架构。公司研发组织架构如下：



各部门主要职责如下表所示：

部门	职责
技研办公室	统筹中心内部之任务管理，开发设计与研发项目立项与资源统筹分配，任务执行，进度追踪与绩效考核，并承上启下，传达公司政策与管理制度及要求，并负责跨中心部门的横向联系与沟通交流，与专项任务推进及资源支持等
产品开发部	负责企业产品研发计划的制订与实施，组织新产品研发阶段的设计、测试、验证等管理工作，制定各种技术文件
产品技术部	下辖有三组，分为石英晶体组，石英振荡器组，材料工程组等，负责系列类与衍生类产品开发设计及原材物料评估与验证任务
微机电组	关键材料研究与半导体光刻技术等专项任务与产学研合作项目

2、技术及产品创新安排

公司将充分利用积累经验并结合行业发展趋势，持续对现有产品工艺技术不断升级完善，进行技术储备。同时，通过对市场需求变化的前瞻性分析，公司将积极开展自主研发和外部合作开发等方式进行技术储备。公司一直以来重视紧跟市场和客户需求开发设计新产品，提供满足客户所需的新产品与新技术趋势的策略，具体技术创新安排包括：

（1）加强技术应用服务建设

公司通过不断进行石英晶体元器件产品和客户终端产品的匹配测试，了解与掌握各下游产业终端客户产品的特性、规格，使之与石英晶体特性匹配，从而给予客户关键电子元器件选型与规格匹配建议，在功能运作稳定的前提下持续优化客户终端产品的性能，达到技术原理的合理匹配，实现在满足质量与功能需求达到终端客户满意。

（2）加强关键技术领域的技术储备和自主研发

公司密切紧跟下游行业的主要应用领域与技术发展趋势，紧跟国际一流企业的技术发展方向，通过消化吸收国外先进的新技术和新工艺，提升自主研发能力，在关键技术领域构建核心技术能力，形成自主知识产权体系，提升公司的整体市场竞争力。

（3）持续完善精益生产模式及制程工艺技术改造

公司一贯重视改进和创新现有产品制造技术，加强新工艺技术的革新与改造，逐步解决制程工艺中存在的诸如频率偏移、石英晶振不起振等问题，不断提高生产过程的自动化水平，形成有公司特色的高规格、高效率、高质量、低

成本的制程工艺制造模式，逐渐提升企业技术核心竞争力。

（4）持续建设人才选拔体系，加强研发队伍建设

公司持续建设人才选拔体系，将岗位需求与人才成长作为重点，通过社会招聘、校园招聘、校企合作、内部竞聘与培养等多种渠道与方式，吸引、选拔、聘用科技人才。强化技术开发人员的市场观念和客户意识，通过建立公司技术服务体系，将企业产、销、研有机结合，强化公司市场反应机制并提升响应速度。

六、环境保护与安全生产情况

（一）发行人的环境保护情况

1、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司主要从事石英晶体谐振器和振荡器的研发、生产和销售。根据《环境保护综合名录（2021 年版）》规定，公司的主营业务、主要产品未被列入高污染、高环境风险产品名录，公司所处行业不属于重污染行业。公司生产经营过程中的污染物主要为废气、废水、噪声、固体废物等，主要污染物及对应的处理方式如下：

序号	主体	污染物种类		主要污染物名称	设备名称	处理能力	数量	运行情况
1	发行人	废水		COD	企业现有污水处理站处理	300 吨/天	1	正常运行
				NH_3-N				
		废气		VOCs	活性炭吸附浓缩催化燃烧装置	10000m^3/h	1	同步运转
					活性炭吸附浓缩催化燃烧装置	10000m^3/h	1	同步运转
				HCl、NOx	酸碱中和喷淋排放装置	15000m^3/h	1	同步运转
					酸碱中和喷淋排放装置	15000m^3/h	1	同步运转
		固体废物	一般固废	包装固废、不合格品、导电胶废料	委托处置	达标处置	-	正常运行
			危险固废	废酸、废乙醇、废试剂瓶、废油、废脱胶剂、污水处理站、污泥、废活性炭	委托处置			
		噪声		机械噪声	选用低噪声设备、	达标处置	-	正常

序号	主体	污染物种类		主要污染物名称	设备名称	处理能力	数量	运行情况
					基础减振、厂房隔声、合理布局			运行
2	金华鸿瑞	废水		COD	企业现有污水处理站处理	20t/a	1	正常运行
				NH_3-N				
		废气		氟化氢、氨	收集后通过 15m 排气筒高空排放	5,000m^3/h	1	正常运行
				氨	收集后经喷淋塔处理后通过 15m 以上排气筒高空排放	3,000m^3/h	1	正常运行
		固体废物	一般固废	边角料	委托处置	达标处置	-	正常运行
				生活垃圾	环卫部门统一清运			
			危险固废	污水处理污泥、废液、废包装桶	委托处置			
		噪声		生产设备和辅助设备运行时产生的噪声	合理布局噪声源，对噪声源采取减震措施	达标处置	-	正常运行
3	湖州鸿皓	废水		COD	企业现有污水处理站处理	20 吨/天	1	正常运行
				NH_3-N				
		废气		VOCs、臭气浓度	活性炭吸附装置	1000m^3/h	1	正常运行
				颗粒物	脉冲布袋除尘装置	3000m^3/h	1	正常运行
				氨、氟化物、臭气浓度	喷淋吸收塔	3000m^3/h	1	正常运行
				氨	脱氨塔	3000m^3/h	1	正常运行
		固体废物	一般固废	边角料、废次品、废包装袋、废包装袋、废膜、废机油	委托处置	达标处置	-	正常运行
			危险固废	氨水、废包装材料、含氟废包装物、废机油桶、脱水污泥、废活性炭	委托处置		-	正常运行
		噪声		机械噪声	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局	达标处置	/	正常运行
4	浙江鸿星	废水		COD	企业现有污水处理站处理	600 吨/天	1	正常运行
				NH_3-N				
		废气		氮氧化物	碱液喷淋装置	3000m^3/h	1	正常运行
				非甲烷总烃	三级水喷淋装置	3000m^3/h	1	正常运行
				污水处理站臭气	水喷淋装置	3000m^3/h	1	正常运行

序号	主体	污染物种类		主要污染物名称	设备名称	处理能力	数量	运行情况
		固体废物	一般固废	包装固废、不合格品、导电胶废料	委托处置	达标处置	-	正常运行
			危险固废	废酒精、废包装桶、污水处理污泥、废离子交换树脂、硒鼓墨盒、废矿物油、废脱胶剂、废灯管	委托处置			
		噪声		机械噪声	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局	达标处置	-	正常运行

2、环保投入情况

报告期内，公司的环保投入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
排污费用	96.54	93.59	172.16
环保投资	16.87	118.54	223.17
合计	**113.40**	**212.14**	**395.33**

报告期内，公司排污费用主要包括污水处理费、固废处置费等；环保投资主要包括环保建设工程投入、设备购置费等。

3、环保合规情况

报告期内，发行人及其子公司不存在环保违法法规行为，亦不存在罚款以上的行政处罚。

（二）发行人安全生产情况

公司严格遵守国家安全生产方面的法律、法规，并将安全生产规定落实到生产作业的全过程及各工作岗位，严格抓好安全管理，保证生产安全。同时，公司还根据自身的生产特点制订了各项安全管理制度、各岗位安全操作规程，能够预防并及时、有效地应对生产过程中可能发生的重大安全突发事故。

报告期内，公司未发生过安全生产相关的违法违规行为。

七、公司境外生产经营和境外资产状况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有鸿星企业、鸿星国际、HOSONIC

JAPAN、HOSONIC GLOBAL、HOSONIC THAI 等 5 家境外全资或控股子公司，其中鸿星企业、鸿星国际、HOSONIC GLOBAL 设立于中国香港，HOSONIC JAPAN 设立于日本，HOSONIC THAI 设立于泰国，上述 5 家境外子公司基本情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“七、子公司及参股公司的基本情况”。

截至报告期末，鸿星企业总资产为 12,001.54 万元，主要包括货币资金 9,725.01 万元和应收账款 2,233.83 万元，两项合计占总资产的比例为 99.64%；截至报告期末，鸿星国际总资产为 12,461.32 万元，主要包括货币资金 1,868.99 万元、应收账款 7,604.69 万元和其他非流动资产 2,283.87 万元，三项合计占总资产的比例为 94.35%。报告期内，鸿星企业主要从事基座、上盖等原材料的境外采购业务，鸿星国际主要从事发行人产品的境外销售业务。

HOSONIC JAPAN 成立于 2024 年 5 月、HOSONIC GLOBAL 成立于 2024 年 9 月，HOSONIC THAI 成立于 2025 年 8 月，报告期内尚无经营。

鸿星企业、鸿星国际、HOSONIC JAPAN 和 HOSONIC GLOBAL 均不存在生产性经营资产，不从事产品生产，仅为发行人在境外的采购、销售或投资平台。HOSONIC THAI 计划作为发行人在境外的生产基地。

报告期内，发行人境外子公司的采购模式和销售模式均未发生变化。

第六节 财务会计信息与管理层分析

立信会计师已对公司截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留审计意见的信会师报字[2026]第 ZF 10204 号《审计报告》。

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，均为合并口径。

公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读财务报告、审计报告全文。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动资产：			
货币资金	701,545,399.69	628,197,914.49	503,959,234.75
交易性金融资产	36,781,401.84	63,806,621.00	102,887,447.56
应收票据	6,701,380.84	991,975.73	3,311,274.59
应收账款	163,706,923.39	156,311,637.11	151,798,385.43
应收款项融资	6,887,302.71	8,611,022.76	2,026,275.92
预付款项	1,648,757.39	1,339,530.84	1,209,081.90
其他应收款	3,157,568.98	3,780,471.06	2,110,690.41
存货	132,521,838.44	113,593,156.75	89,755,315.54
其他流动资产	3,159,317.39	10,571,897.58	16,629,555.22
流动资产合计	**1,056,109,890.67**	**987,204,227.32**	**873,687,261.32**
非流动资产：			
固定资产	344,262,480.26	292,910,187.79	288,084,071.55
在建工程	6,074,009.11	53,176,532.73	7,041,620.20
使用权资产	1,647,093.48	2,754,197.19	2,372,093.84
无形资产	30,109,781.02	30,566,954.44	31,137,114.06

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
商誉	1,328,626.64	1,328,626.64	1,328,626.64
长期待摊费用	2,030,404.74	1,346,771.11	2,211,646.05
递延所得税资产	9,136,921.37	10,418,918.72	11,238,233.05
其他非流动资产	27,395,635.41	11,775,261.85	928,455.71
非流动资产合计	**421,984,952.03**	**404,277,450.47**	**344,341,861.10**
资产总计	**1,478,094,842.70**	**1,391,481,677.79**	**1,218,029,122.42**
流动负债：			
短期借款	95,057,270.20	80,057,778.35	15,013,795.83
应付账款	64,257,988.17	86,008,450.84	77,779,102.66
合同负债	551,296.19	87,498.00	45,314.47
应付职工薪酬	49,297,971.90	45,803,277.38	45,000,490.05
应交税费	7,052,046.49	10,658,979.37	5,366,885.63
其他应付款	91,335,441.68	2,525,228.90	2,383,354.25
一年内到期的非流动负债	748,505.50	1,123,001.92	6,936,819.49
其他流动负债	62,265.02	13,214.55	1,133.41
流动负债合计	**308,362,785.15**	**226,277,429.31**	**152,526,895.79**
非流动负债：			
长期借款	-	-	34,159,666.67
租赁负债	912,416.35	1,222,562.69	-
递延收益	10,751,826.47	22,749,224.33	25,380,135.75
递延所得税负债	683,466.57	1,261,505.21	1,606,734.49
非流动负债合计	**12,347,709.39**	**25,233,292.23**	**61,146,536.91**
负债合计	**320,710,494.54**	**251,510,721.54**	**213,673,432.70**
所有者权益：			
股本	147,893,812.00	147,893,812.00	147,893,812.00
资本公积	526,712,674.02	526,712,674.02	526,712,674.02
其他综合收益	4,114,506.44	6,837,865.11	4,905,855.34
专项储备	1,908,531.14	1,512,567.46	865,868.40
盈余公积	43,683,893.25	39,642,842.75	30,067,769.10
未分配利润	432,912,708.60	417,371,194.91	293,909,710.86
归属于母公司所有者权益合计	**1,157,226,125.45**	**1,139,970,956.25**	**1,004,355,689.72**
少数股东权益	158,222.71	-	-

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
所有者权益合计	1,157,384,348.16	1,139,970,956.25	1,004,355,689.72
负债和所有者权益总计	1,478,094,842.70	1,391,481,677.79	1,218,029,122.42

（二）合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	**632,120,520.75**	**567,391,034.45**	**541,538,110.56**
其中：营业收入	632,120,520.75	567,391,034.45	541,538,110.56
二、营业总成本	**523,630,266.79**	**435,593,839.00**	**409,830,152.11**
减：营业成本	394,805,142.70	329,025,197.03	297,631,896.72
税金及附加	4,726,142.32	5,566,753.79	6,193,508.76
销售费用	24,159,372.72	21,794,662.19	20,368,130.69
管理费用	74,568,956.72	66,028,917.08	59,223,796.88
研发费用	37,999,918.37	35,974,437.30	35,407,073.98
财务费用	-12,629,266.04	-22,796,128.39	-8,994,254.92
其中：利息费用	1,756,293.15	2,011,428.51	756,803.42
利息收入	24,972,462.91	19,989,814.78	9,776,616.96
加：其他收益	16,741,558.62	18,755,364.97	15,376,517.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,487,217.46	2,476,386.47	3,117,188.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-333,859.53	-325,326.80	1,191,928.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,046,820.42	-2,654,623.34	-3,919,114.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,826.15	16,608.37	15,601.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**120,358,176.24**	**150,065,605.12**	**147,490,079.23**
加：营业外收入	583,582.29	1,567,550.64	3,157,143.38
减：营业外支出	571,762.94	1,094,241.53	1,474,852.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**120,369,995.59**	**150,538,914.23**	**149,172,370.40**
减：所得税费用	12,048,705.09	17,502,356.53	16,264,864.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**108,321,290.50**	**133,036,557.70**	**132,907,506.30**
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏	108,321,290.50	133,036,557.70	132,907,506.30

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	108,318,851.39	133,036,557.70	132,907,506.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,439.11	-	-
六、其他综合收益的税后净额	**-2,719,610.17**	**1,932,009.77**	**1,215,604.95**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,723,358.67	1,932,009.77	1,215,604.95
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,748.50	-	-
七、综合收益总额	**105,601,680.33**	**134,968,567.47**	**134,123,111.25**
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,595,492.72	134,968,567.47	134,123,111.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,187.61	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.73	0.90	0.90
（二）稀释每股收益	0.73	0.90	0.90

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	657,579,886.20	591,585,459.18	611,261,584.13
收到的税费返还	31,537,543.38	18,522,560.81	6,197,415.83
收到其他与经营活动有关的现金	36,635,525.80	36,554,492.07	43,425,063.73
经营活动现金流入小计	**725,752,955.38**	**646,662,512.06**	**660,884,063.69**
购买商品、接受劳务支付的现金	333,242,731.16	276,940,902.38	251,871,797.80
支付给职工以及为职工支付的现金	162,652,804.26	149,259,181.98	140,560,209.69
支付的各项税费	34,082,159.25	23,062,892.82	35,293,954.54

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付其他与经营活动有关的现金	30,518,886.05	24,503,344.14	24,263,085.77
经营活动现金流出小计	**560,496,580.72**	**473,766,321.32**	**451,989,047.80**
经营活动产生的现金流量净额	**165,256,374.66**	**172,896,190.74**	**208,895,015.89**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	53,512,436.62	66,557,213.03	82,064,252.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,874.23	63,770.80	40,331.97
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,735,085.64	-
投资活动现金流入小计	**53,567,310.85**	**71,356,069.47**	**82,104,584.39**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,948,188.88	116,536,566.81	74,479,467.60
投资支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	101,082,666.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,735,085.64	-
投资活动现金流出小计	**143,948,188.88**	**146,271,652.45**	**175,562,134.27**
投资活动产生的现金流量净额	**-90,380,878.03**	**-74,915,582.98**	**-93,457,549.88**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	155,131.52	-	-
取得借款收到的现金	102,000,000.00	80,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**102,155,131.52**	**80,000,000.00**	**15,000,000.00**
偿还债务支付的现金	87,000,000.00	54,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,983,028.06	1,875,672.63	46,559,301.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,583,579.88	4,837,060.32	5,637,923.70
筹资活动现金流出小计	**90,566,607.94**	**60,712,732.95**	**75,197,225.12**
筹资活动产生的现金流量净额	**11,588,523.58**	**19,287,267.05**	**-60,197,225.12**
四、汇率变动对现金及现	**-13,116,535.01**	**6,970,804.93**	**1,409,535.21**

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	**73,347,485.20**	**124,238,679.74**	**56,649,776.10**
加：期初现金及现金等价物余额	628,175,914.49	503,937,234.75	447,287,458.65
六、期末现金及现金等价物余额	**701,523,399.69**	**628,175,914.49**	**503,937,234.75**

二、财务报表审计意见、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平判断标准

（一）审计意见

立信会计师接受公司的委托，对公司截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第 10204 号标准无保留意见审计报告。审计意见如下：

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿星科技 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（二）关键审计事项

关键审计事项是会计师根据职业判断，认为分别对 2023 年度、2024 年度及 2025 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，会计师不对这些事项单独发表意见。

会计师在审计中识别出的关键审计事项主要为收入确认，具体如下：

1、收入确认事项描述

公司主要产品系谐振器和振荡器。公司 2023 年度营业收入为 541,538,110.56 元，2024 年度营业收入为 567,391,034.45 元，2025 年度营业收入为 632,120,520.75 元。

公司对于销售产品产生的收入，是在商品的控制权已转移至客户时确认的。

由于营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，收入确认的真实性和准确性对公司利润的影响较大。因此，立信会计师将公司收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

会计师针对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）对销售与收款循环内部控制进行了解并执行穿行测试，对重要的控制点执行控制测试；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对报告期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、物流信息、报关单、货运提单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、发货单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（5）对本年记录的收入交易选取样本，执行函证程序；

（6）对于出口销售，亲自获取了中国电子口岸网站导出的发行人海关出口数据，将海关出口数据与境外销售收入进行核对，进一步验证发行人境外销售的真实性及完整性；

（7）对报告期内的收入及毛利率的变动原因进行分析。

（三）与财务会计信息相关的重要性水平判断标准

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收账款	300 万
账龄超过一年的重要预付款项	300 万
重要的在建工程	300 万
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	300 万
重要的承诺事项	公司将质押及抵押资产、保证金质押、开立保函、保证等事项认定为重要

三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表编制的基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营能力评价

公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

（二）合并财务报表范围及变化

子公司名称	报告期各期末是否纳入合并财务报表范围		
	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
金华鸿瑞	是	是	是
东莞佳晟	是	是	是
鸿星企业	是	是	是
鸿星国际	是	是	是
江阴鸿翔	-	-	-
浙江鸿星	是	是	是
湖州鸿皓	是	是	是
HOSONIC JAPAN	是	是	-
HOSONIC GLOBAL	是	是	-
HOSONIC THAI	是	-	-

注 1：公司于 2023 年 1 月 31 日注销子公司江阴鸿翔电子有限公司，故江阴鸿翔自 2023 年 1 月 31 日不再纳入合并范围；

注 2：公司于 2024 年 5 月新设子公司 HOSONIC JAPAN；

注 3：公司于 2024 年 9 月新设子公司 HOSONIC GLOBAL；

注 4：公司于 2025 年 8 月新设子公司 HOSONIC THAI。

四、主要会计政策和会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策

和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，鸿星国际、鸿星企业和 HOSONIC GLOBAL 的记账本位币为港币，HOSONIC JAPAN 的记账本位币为日币，HOSONIC THAI 的记账本位币是泰铢。本财务报表以人民币列示。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

1）一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易年度每月末的汇率平均数折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（九）金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

（1）业务模式是以收取合同现金流量为目标；

（2）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

（1）业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

（2）合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存

金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

提示：对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应

收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况

项目	组合类别	确定依据
	商业承兑汇票	以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
其他应收款	账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

（十）存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品和委托加工物资。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常

生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（十一）固定资产

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	3.00	9.7-4.85
机器设备	年限平均法	5-10	3.00	19.4-9.7
运输工具	年限平均法	5	3.00	19.4
电子设备及其他	年限平均法	5	3.00	19.4

3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十二）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	（1）主体建设工程及配套工程已实质上完工；（2）建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；（3）经消防、国土、规划等外部部门验收；（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备	（1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；（4）设备经过资产管理人员和使用人员验收。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	土地使用证登记年限	年限平均法	无残值	土地证
软件	5	年限平均法	无残值	使用年限
商标权	10	年限平均法	无残值	商标证书

3、研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、材料费、水电气费、办公费用、其他费用等。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列

条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十五）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资

产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十六）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈

余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（十七）收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

公司的产品主要系谐振器、振荡器等，公司在商品的控制权已转移至客户时确认收入。公司销售按地区分为境内销售与境外销售。收入确认的具体方法如下：

境内销售：

（1）非 VMI 模式：公司根据订单或合同约定将产品交付给客户，客户签收后确认收入；

（2）VMI 模式：本公司对部分客户采用了 VMI 的运作管理模式，该模式下本公司在客户从 VMI 仓提货并经双方确认后确认收入；

境外销售：

（1）非 VMI 模式：①按约定产品交付地点为装运港口的，公司按约定将产品报关出口，取得报关单、提单时确认收入；②按约定客户至公司仓库提货的，客户至仓库提货后确认收入；③按约定公司需将货物送到客户指定地点的，由客户签收后确认收入。

（2）VMI 模式：客户从 VMI 仓提货并经双方确认后确认收入。

（十八）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成

长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

（1）政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

（2）根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

（3）若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十九）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

单位：万元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
2023 年起首次执行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	95.49	12.70
	递延所得税负债	89.37	12.63
	盈余公积	0.01	0.01
	未分配利润	6.11	0.06

1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
递延所得税资产	758.14	853.63	-	95.49	95.49
递延所得税负债	147.69	237.07	-	89.37	89.37
盈余公积	1,861.10	1,861.10	-	0.01	0.01
未分配利润	17,239.79	17,245.89	-	6.11	6.11

2）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
递延所得税资产	513.38	526.08	-	12.70	12.70
递延所得税负债	77.90	90.53	-	12.63	12.63
盈余公积	1,634.66	1,634.66	-	0.01	0.01
未分配利润	11,720.72	11,720.79	-	0.06	0.06

（2）执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

1）关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一

年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2）关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3）关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。该解释规定

自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（5）执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会【2025】33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

无。

五、非经常性损益

根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2026]第 ZF10208 号《鸿星科技（集团）股份有限公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的非经常性损益明细表及鉴证报告》，公司报告期内的非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产处置损益	-9.50	-92.18	-60.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	119.76	593.58	754.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权	148.72	247.64	311.72

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
投资取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12.67	41.17	30.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26.96	-	-
小计	**298.60**	**790.21**	**1,035.86**
所得税影响额	-53.15	-122.00	-158.36
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	**245.45**	**668.21**	**877.50**
归属于母公司股东的净利润	10,831.89	13,303.66	13,290.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**10,586.44**	**12,635.44**	**12,413.25**
归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例	**2.27%**	**5.02%**	**6.60%**

报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、理财产品的投资收益等。

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 6.60%、5.02%和 2.27%。上述非经常性损益对公司经营成果不存在重大影响，不会影响公司的持续经营能力。

六、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	2025 年度	2024 年度	2023 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	内销：13%、6%；外销：出口产品零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策；		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%	7%、5%	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%	3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%	2%	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、20%、16.5%、8.25%	15%、25%、20%、16.5%、8.25%	15%、25%、20%、16.5%、8.25%

报告期内，不同纳税主体适用的企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
鸿星科技	15%	15%	15%
金华鸿瑞	20%	20%	20%
东莞佳晟	20%	20%	20%
鸿星企业	16.5%、8.25%	16.5%、8.25%	16.5%、8.25%
鸿星国际	16.5%	16.5%	16.5%
湖州鸿皓	20%	20%	20%
江阴鸿翔	不适用	不适用	不适用
浙江鸿星	25%	25%	25%
HOSONIC JAPAN	15%	15%	不适用
HOSONIC GLOBAL	16.5%	16.5%	不适用
HOSONIC THAI	20%	不适用	不适用

（二）重要的税收优惠政策及依据

1、高新技术企业税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，公司被认定为高新技术企业。报告期内，公司享受 15%企业所得税税率优惠政策。

2、小微企业税收优惠

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。报告期内，公司子公司金华鸿瑞、东莞佳晟和湖州鸿皓满足小微企业条件，享受以上税收优惠。

（三）报告期税收政策的变化及对发行人的影响

报告期内，公司适用的税收政策稳定，未发生重大不利变化，亦不存在面临即将实施的重大税收政策调整的情况。

（四）重要的税收优惠的影响

报告期各期，公司重要的税收优惠金额及占利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
高新技术企业所得税税率优惠金额	246.64	712.02	1,057.31
小型微利企业减免所得税优惠金额	130.50	125.16	55.05
合计	**377.13**	**837.19**	**1,112.35**
当期利润总额	12,037.00	15,053.89	14,917.24
税收优惠占利润总额比例（%）	3.13	5.56	7.46

报告期各期，公司享受的上述税收优惠金额占当期公司利润总额的比例分别为 7.46%、5.56%和 3.13%，占比相对较小，公司的经营业绩对税收优惠不构成重大依赖。

七、分部信息

公司分产品业务收入和分地区业务收入的详细情况详见本节之“九、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”。

八、财务指标

（一）主要财务指标

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	3.42	4.36	5.73
速动比率（倍）	3.00	3.86	5.14
资产负债率（%，合并）	21.70	18.08	17.54
资产负债率（%，母公司）	25.11	20.77	14.73
归属于母公司股东的每股净资产（元）	7.82	7.71	6.79
项目	**2025 年度**	**2024 年度**	**2023 年度**
应收账款周转率（次）	3.75	3.50	3.23
存货周转率（次）	3.01	3.04	2.83
息税折旧摊销前利润（万元）	18,684.35	20,340.96	19,797.79
利息保障倍数（倍）	106.39	101.13	113.97
归属于母公司股东的净利润（万元）	10,831.89	13,303.66	13,290.75

归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	10,586.44	12,635.44	12,413.25
研发投入占营业收入的比例（%）	6.01	6.34	6.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.12	1.17	1.41
每股净现金流量（元）	0.50	0.84	0.38

注：上述财务指标计算如果未特别指出，均为合并财务报表口径，其计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；

4、归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的期末净资产/期末普通股股份数；

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

6、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；

7、息税折旧摊销前利润=净利润+费用化的利息支出+所得税费用+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

8、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息费用（利息费用含资本化利息支出）；

9、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入；

10、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份数；

11、每股净现金流量=现金流量净增加额/期末普通股股份数。

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，公司报告期内净资产收益率和每股收益如下：

1、净资产收益率

项目	加权平均净资产收益率（%）		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.08	12.41	14.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.87	11.78	13.25

2、每股收益

项目	每股收益（元/股）					
	基本每股收益			稀释每股收益		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.90	0.90	0.73	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于	0.72	0.85	0.84	0.72	0.85	0.84

项目	每股收益（元/股）					
	基本每股收益			稀释每股收益		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公司普通股股东的净利润						

九、经营成果分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	63,212.05	56,739.10	54,153.81
营业成本	39,480.51	32,902.52	29,763.19
利润总额	12,037.00	15,053.89	14,917.24
净利润	10,832.13	13,303.66	13,290.75
归属于母公司所有者的净利润	10,831.89	13,303.66	13,290.75

2023 年，受宏观经济和行业周期性因素影响，行业整体处于去库存阶段，终端市场需求承压。

随着产业链去库存基本完成，终端需求触底复苏，叠加 AI 及光通信等新技术应用不断落地，电子产业自 2024 年第一季度起经营业绩有所改善，全球消费电子市场呈现显著复苏态势，公司 2024 年和 2025 年销售收入持续增长；同时，受市场竞争加剧影响，公司 2024 年和 2025 年毛利率小幅下降。

2024 年，公司净利润较 2023 年基本持平。2025 年，公司净利润有所下滑，主要是由于：一方面，受美元贬值影响，公司当期产生较大金额汇兑损失；另一方面，前次 IPO 相关中介费用在当期由其他流动资产转入管理费用。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
主营业务收入	63,211.96	99.99	56,738.44	99.99	54,091.17	99.88

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
其他业务收入	0.09	0.01	0.66	0.01	62.64	0.12
合计	**63,212.05**	**100.00**	**56,739.10**	**100.00**	**54,153.81**	**100.00**

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.88%、99.99%和 99.99%，主要来源于谐振器、振荡器的销售收入，主营业务突出。其他业务收入占比较低，主要为销售材料和提供服务收入。

2、按产品构成划分的主营业务收入分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类型划分情况如下：

产品大类	产品名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
谐振器	SMD 晶体谐振器	49,419.29	78.18	45,652.81	80.46	43,126.48	79.73
	音叉型谐振器	3,569.97	5.65	3,027.24	5.34	1,933.79	3.58
	其他	457.91	0.72	515.87	0.91	572.10	1.06
小计		**53,447.17**	**84.55**	**49,195.92**	**86.71**	**45,632.37**	**84.36**
振荡器	SPXO 晶体振荡器	7,172.93	11.35	6,127.45	10.80	6,255.22	11.56
	其他	2,591.85	4.10	1,415.08	2.49	2,203.58	4.07
小计		**9,764.79**	**15.45**	**7,542.53**	**13.29**	**8,458.80**	**15.64**
合计		**63,211.96**	**100.00**	**56,738.44**	**100.00**	**54,091.17**	**100.00**

报告期各期，公司谐振器销售收入占主营业务收入的比例分别为 84.36%、86.71%和 84.55%，是主营业务收入的主要来源。

报告期内，公司销售产品以自产产品为主。同时，为了满足客户的多元化需求，以及弥补因订单集中造成的阶段性产能不足，公司存在少量外购石英晶振产成品进行销售的情形。报告期各期，公司外购产成品销售收入分别为 2,991.91 万元、4,755.96 万元和 5,357.74 万元，占主营业务收入比例分别为 5.53%、8.38%和 8.48%。

3、主营业务收入按销售模式划分

报告期内，公司主营业务收入按销售模式划分情况如下：

销售模式	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
直销	48,128.05	76.14	43,224.36	76.18	43,005.92	79.51
经销	15,083.91	23.86	13,514.08	23.82	11,085.25	20.49
合计	**63,211.96**	**100.00**	**56,738.44**	**100.00**	**54,091.17**	**100.00**

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。

4、按地区划分的主营业务收入分析

报告期内，发行人主营业务收入按销售区域划分情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
境内	**30,001.85**	**47.46**	**27,297.30**	**48.11**	**24,205.75**	**44.75**
其中：华南	18,592.24	29.41	16,679.37	29.40	14,106.18	26.08
华东	8,845.48	13.99	7,285.30	12.84	5,128.55	9.48
西南	1,399.96	2.21	1,978.99	3.49	3,272.60	6.05
华中	679.04	1.07	780.76	1.38	608.64	1.13
华北	457.79	0.72	549.82	0.97	961.40	1.78
西北	27.33	0.04	23.06	0.04	128.37	0.24
境外	**33,210.11**	**52.54**	**29,441.14**	**51.89**	**29,885.42**	**55.25**
其中：越南	8,869.31	14.03	4,666.38	8.22	3,464.78	6.41
中国香港	8,090.62	12.80	8,458.96	14.91	9,029.14	16.69
保税区	5,899.79	9.33	6,606.83	11.64	7,503.24	13.87
中国台湾地区	2,424.01	3.83	1,754.05	3.09	2,317.58	4.28
其他	7,926.39	12.54	7,954.93	14.02	7,570.68	14.00
合计	**63,211.96**	**100.00**	**56,738.44**	**100.00**	**54,091.17**	**100.00**

报告期内，公司境外销售收入高于境内销售收入。

报告期各期，公司境外销售收入金额分别为 29,885.42 万元、29,441.14 万元和 33,210.11 万元，占主营业务收入比例分别为 55.25%、51.89%和 52.54%，主要以中国香港、保税区、中国台湾地区以及越南的销售为主。

报告期各期，公司境内销售收入金额分别为 24,205.75 万元、27,297.30 万元和 30,001.85 万元，占主营业务收入比例分别为 44.75%、48.11%和 47.46%，

主要以华南及华东地区的销售为主。

5、主营业务收入按季度构成分析

报告期内，公司主营业务收入按季度划分情况如下：

销售季度	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
第一季度	15,019.62	23.76	13,358.31	23.54	12,886.78	23.82
第二季度	16,502.66	26.11	14,594.21	25.72	13,827.56	25.56
第三季度	17,537.32	27.74	14,954.35	26.36	15,006.62	27.74
第四季度	14,152.37	22.39	13,831.56	24.38	12,370.20	22.87
合计	**63,211.96**	**100.00**	**56,738.44**	**100.00**	**54,091.17**	**100.00**

公司产品谐振器和振荡器作为频率控制元器件，应用领域广泛，整体不存在明显的季节性特征。

6、主要产品销售价格、销售数量变动分析

报告期内，公司主要产品销售单价及销售数量如下表所示：

产品类别	产品名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		数量（万只）	单价（元/只）	数量（万只）	单价（元/只）	数量（万只）	单价（元/只）
谐振器	SMD 晶体谐振器	161,161.55	0.31	140,339.79	0.33	118,625.95	0.36
	音叉型谐振器	7,609.25	0.47	5,725.81	0.53	3,111.70	0.62
	其他	1,410.39	0.32	1,529.66	0.34	1,650.60	0.35
振荡器	SPXO 晶体振荡器	5,566.08	1.29	4,338.70	1.41	3,568.42	1.75
	其他	1,284.95	2.02	614.33	2.30	433.97	5.08

随着产业链去库存基本完成，终端需求触底复苏，叠加 AI 及光通信等新技术应用不断落地，电子产业自 2024 年第一季度起经营业绩有所改善，全球消费电子市场呈现显著复苏态势，公司 2024 年和 2025 年各主要产品销量持续增长。同时，受市场竞争加剧影响，公司各主要产品销售单价有所下降。

7、第三方回款情况

报告期内，公司仅 2024 年度存在第三方回款，金额为 0.96 万元，占营业

收入的比例为 0.01%，占比极低，对公司经营影响较小。第三方回款原因为集团内同一控制下其他主体支付，具有商业合理性。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
主营业务成本	39,480.51	100.00	32,902.52	100.00	29,717.42	99.85
其他业务成本	-	-	-	-	45.77	0.15
合计	**39,480.51**	**100.00**	**32,902.52**	**100.00**	**29,763.19**	**100.00**

报告期各期，公司主营业务成本金额分别为 29,717.42 万元、32,902.52 万元和 39,480.51 万元，占营业成本的比例分别为 99.85%、100.00%和 100.00%，与主营业务收入变动趋势及构成情况匹配。

2、主营业务成本构成及变动分析

报告期内，公司主营业务成本按产品类型分类情况如下：

产品大类	产品名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
谐振器	SMD 晶体谐振器	30,551.46	77.38	26,189.81	79.60	24,190.45	81.40
	音叉型谐振器	3,047.17	7.72	2,469.28	7.50	1,578.66	5.31
	其他	304.70	0.77	331.02	1.01	367.14	1.24
小计		**33,903.33**	**85.87**	**28,990.11**	**88.11**	**26,136.25**	**87.95**
振荡器	SPXO 晶体振荡器	3,833.11	9.71	3,084.52	9.37	2,733.17	9.20
	其他	1,744.08	4.42	827.89	2.52	848.00	2.85
小计		**5,577.18**	**14.13**	**3,912.41**	**11.89**	**3,581.17**	**12.05**
合计		**39,480.51**	**100.00**	**32,902.52**	**100.00**	**29,717.42**	**100.00**

报告期各期，谐振器的营业成本占主营业务成本的比例分别为 87.95%、88.11%和 85.87%，与公司收入结构一致。主要产品的营业成本变动分析详见本节之“九、经营成果分析”之“（三）毛利、毛利率及变化趋势分析”之“3、主营

业务按产品分类毛利率变动情况分析”。

3、主营业务成本按性质划分

报告期内，公司主营业务成本按性质划分情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
直接材料	17,848.53	45.21	14,649.45	44.52	13,191.98	44.39
直接人工	7,915.02	20.05	6,840.38	20.79	6,563.21	22.09
制造费用	9,351.62	23.69	7,678.49	23.34	7,667.85	25.80
外购产品成本	4,365.35	11.06	3,734.20	11.35	2,294.38	7.72
合计	**39,480.51**	**100.00**	**32,902.52**	**100.00**	**29,717.42**	**100.00**

报告期各期，公司主营业务成本构成较为稳定，由直接材料、直接人工、制造费用和外购产品成本构成。其中，直接材料成本系主营业务成本的主要构成。报告期各期，公司主营业务成本中直接材料金额分别为 13,191.98 万元、14,649.45 万元和 17,848.53 万元，占比分别为 44.39%、44.52%和 45.21%。另外，公司主营业务成本中包括外购产品成本，系公司为了满足客户的多元化需求，以及弥补因订单集中造成的阶段性产能不足，对外采购产成品进行销售的成本。

（三）毛利、毛利率及变化趋势分析

1、毛利构成及毛利率情况

报告期内，公司营业毛利构成及毛利率情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利（万元）	23,731.44	23,835.92	24,373.75
其他业务毛利（万元）	0.09	0.66	16.87
营业毛利（万元）	**23,731.54**	**23,836.58**	**24,390.62**
主营业务毛利/营业毛利	99.99%	99.99%	99.93%
主营业务毛利率	37.54%	42.01%	45.06%

报告期内，公司主营业务毛利占营业毛利的比例稳定在 99%以上，公司利润主要来自主营业务。

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 45.06%、42.01%和 37.54%，呈现下降趋势。其他业务毛利占营业毛利的比例较小，对公司经营业绩影响较小。

2、主营业务毛利按产品类型划分及变动情况

报告期各期，公司分产品主营业务毛利情况如下：

产品大类	产品名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
谐振器	SMD 晶体谐振器	18,867.83	79.51	19,463.00	81.65	18,936.04	77.69
	音叉型谐振器	522.80	2.20	557.95	2.34	355.13	1.46
	其他	153.21	0.65	184.85	0.78	204.96	0.84
小计		**19,543.84**	**82.35**	**20,205.81**	**84.77**	**19,496.12**	**79.99**
振荡器	SPXO 晶体振荡器	3,339.83	14.07	3,042.93	12.77	3,522.05	14.45
	其他	847.78	3.57	587.19	2.46	1,355.58	5.56
小计		**4,187.61**	**17.65**	**3,630.12**	**15.23**	**4,877.63**	**20.01**
合计		**23,731.44**	**100.00**	**23,835.92**	**100.00**	**24,373.75**	**100.00**

报告期各期，公司主营业务毛利金额分别为 24,373.75 万元、23,835.92 万元和 23,731.44 万元，基本保持稳定。

3、主营业务按产品分类毛利率变动情况分析

报告期内，公司分产品类别的毛利率及毛利率贡献情况如下：

产品大类	产品名称	2025 年度		
		毛利率（%）	收入占比（%）	毛利率贡献（%）
谐振器	SMD 晶体谐振器	38.18	78.18	29.85
	音叉型谐振器	14.64	5.65	0.83
	其他	33.46	0.72	0.24
小计		**36.57**	**84.55**	**30.92**
振荡器	SPXO 晶体振荡器	46.56	11.35	5.28
	其他	32.71	4.10	1.34
小计		**42.88**	**15.45**	**6.62**
合计		**37.54**	**100.00**	**37.54**

（续上表）

产品大类	产品名称	2024 年度		
		毛利率（%）	收入占比（%）	毛利率贡献（%）
谐振器	SMD 晶体谐振器	42.63	80.46	34.30

产品大类	产品名称	2024 年度		
		毛利率（%）	收入占比（%）	毛利率贡献（%）
	音叉型谐振器	18.43	5.34	0.98
	其他	35.83	0.91	0.33
小计		**41.07**	**86.71**	**35.61**
振荡器	SPXO 晶体振荡器	49.66	10.80	5.36
	其他	41.49	2.49	1.03
小计		**48.13**	**13.29**	**6.40**
合计		**42.01**	**100.00**	**42.01**

（续上表）

产品大类	产品名称	2023 年度		
		毛利率（%）	收入占比（%）	毛利率贡献（%）
谐振器	SMD 晶体谐振器	43.91	79.73	35.01
	音叉型谐振器	18.36	3.58	0.66
	其他	35.83	1.06	0.38
小计		**42.72**	**84.36**	**36.04**
振荡器	SPXO 晶体振荡器	56.31	11.56	6.51
	其他	61.52	4.07	2.51
小计		**57.66**	**15.64**	**9.02**
合计		**45.06**	**100.00**	**45.06**

注：毛利率贡献=毛利率*主营业务收入占比

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 45.06%、42.01%和 37.54%，呈现下降趋势。

报告期内，公司 SMD 晶体谐振器和 SPXO 晶体振荡器产品的收入合计分别为 49,381.70 万元、51,780.26 万元和 56,592.23 万元，占主营业务收入的比例合计分别为 91.29%、91.26%和 89.53%，对主营业务毛利率贡献合计分别为 41.52%、39.67%和 35.13%，是主营业务毛利率的主要贡献点，其毛利率的变动决定了主营业务毛利率的变动趋势。

（1）谐振器系列主要产品毛利率变动分析

报告期内，公司谐振器系列主要产品销售收入、成本及毛利率的具体情况如下：

产品	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
SMD 晶体谐振器	销售收入（万元）	49,419.29	45,652.81	43,126.48
	销售成本（万元）	30,551.46	26,189.81	24,190.45
	毛利率（%）	38.18	42.63	43.91
	毛利率变动（%）	-4.45	-1.28	-
	单位售价（元/只）	0.31	0.33	0.36
	单位售价变动影响（%）	-3.49	-6.60	-
	单位成本（元/只）	0.19	0.19	0.20
	单位成本变动影响（%）	-0.96	5.32	-
音叉型谐振器	销售收入（万元）	3,569.97	3,027.24	1,933.79
	销售成本（万元）	3,047.17	2,469.28	1,578.66
	毛利率（%）	14.64	18.43	18.36
	毛利率变动（%）	-3.79	0.07	-
	单位售价（元/只）	0.47	0.53	0.62
	单位售价变动影响（%）	-10.35	-14.32	-
	单位成本（元/只）	0.40	0.43	0.51
	单位成本变动影响（%）	6.56	14.39	-

注：单位售价变动对毛利率的影响=（当期平均单价-基期平均单位成本）/当期平均单价-基期毛利率；单位成本变动对毛利率的影响=当期毛利率-（当期平均单价-基期平均单位成本）/当期平均单价，下同。

①SMD 晶体谐振器毛利率变动分析

报告期各期，公司 SMD 晶体谐振器产品毛利率分别为 43.91%、42.63%和 38.18%，收入占比分别为 79.73%、80.46%和 78.18%，主营业务毛利率贡献分别为 35.01%、34.30%和 29.85%。

报告期各期，受市场竞争加剧影响，公司 SMD 晶体谐振器毛利率整体呈下降趋势。

②音叉型谐振器毛利率变动分析

报告期各期，公司音叉型谐振器产品毛利率分别为 18.36%、18.43%和 14.64%，收入占比分别为 3.58%、5.34%和 5.65%，主营业务毛利率贡献分别为 0.66%、0.98%和 0.83%。

2024 年，音叉型谐振器毛利率较 2023 年基本持平。2025 年，受市场竞争加剧影响，销售单价下降幅度较大，毛利率随之下降。

（2）振荡器系列主要产品毛利率变动分析

报告期内，公司振荡器系列主要产品销售收入、成本及毛利率的具体情况如下：

产品	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
SPXO 晶体振荡器	销售收入（万元）	7,172.93	6,127.45	6,255.22
	销售成本（万元）	3,833.11	3,084.52	2,733.17
	毛利率（%）	46.56	49.66	56.31
	毛利率变动（%）	-3.10	-6.65	-
	单位售价（元/只）	1.29	1.41	1.75
	单位售价变动影响（%）	-4.83	-10.54	-
	单位成本（元/只）	0.69	0.71	0.77
	单位成本变动影响（%）	1.73	3.89	-

报告期各期，公司 SPXO 晶体振荡器产品毛利率分别为 56.31%、49.66%和 46.56%，收入占比分别为 11.56%、10.80%和 11.35%，主营业务毛利率贡献分别为 6.51%、5.36%和 5.28%。

报告期各期，受市场竞争加剧影响，公司 SPXO 晶体谐振器毛利率整体呈下降趋势。

4、主营业务按销售区域毛利率变动情况分析

报告期各期，公司按销售区域毛利及毛利率情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利（万元）	毛利率（%）	毛利（万元）	毛利率（%）	毛利（万元）	毛利率（%）
境外	13,541.37	40.77	13,688.23	46.49	14,455.17	48.37
境内	10,190.07	33.96	10,147.70	37.17	9,918.58	40.98
合计	**23,731.44**	**37.54**	**23,835.92**	**42.01**	**24,373.75**	**45.06**

报告期内，公司主营业务境外及境内销售毛利率变动趋势与公司主营业务毛利率一致。外销毛利率整体高于内销毛利率，主要系境内市场竞争较为激烈所致。

5、主营业务按销售模式毛利率变动情况分析

报告期各期，公司按销售模式毛利及毛利率情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利（万元）	毛利率（%）	毛利（万元）	毛利率（%）	毛利（万元）	毛利率（%）
直销	19,040.42	39.56	19,111.50	44.21	20,177.11	46.92
经销	4,691.03	31.10	4,724.42	34.96	4,196.64	37.86
合计	**23,731.44**	**37.54**	**23,835.92**	**42.01**	**24,373.75**	**45.06**

报告期内，公司主营业务直销模式、经销模式毛利率变动趋势与公司主营业务毛利率一致。直销模式毛利率高于经销模式毛利率，主要是由于直销模式下公司承担义务较多；而经销模式下，公司与经销商签署产品销售合同，经销商直接面对终端客户，存在一定的市场开拓成本。因此，公司对经销商有一部分让利，给予经销商价格较低，符合行业惯例。

6、同行业可比上市公司毛利率比较分析

公司选取泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子及晶赛科技四家公司作为可比公司，上述公司基本情况详见“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业基本情况”之“（四）发行人所属行业竞争状况、市场地位及竞争优劣势”之“3、行业内相关企业基本情况”之“（2）境内主要企业”。

报告期内，公司与同行业可比上市公司相关业务毛利率比较情况如下：

单位：%

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	18.30	23.29	25.64
惠伦晶体	9.37	4.98	-0.53
晶赛科技	9.78	11.61	8.56
东晶电子	4.56	4.98	5.67
算术平均值	**10.50**	**11.22**	**9.84**
公司	**37.54**	**42.01**	**45.06**

注 1：同行业可比公司数据均取自其年报或其他公开数据；

注 2：公司、泰晶科技、惠伦晶体毛利率均为主营业务毛利率；

注 3：报告期内，晶赛科技非石英晶振业务占有一定比例，为便于分析，晶赛科技毛利率为石英晶振业务毛利率；

注 4：2025 年，东晶电子新增电池级碳酸锂业务，为便于分析，东晶电子 2025 年毛利率为石英晶体元器件业务毛利率；2023 年、2024 年为主营业务毛利率。

公司凭借优质的客户结构、先进的技术水平、“优先承接高单价、高毛利率订单”的经营策略、高产能利用率带来的规模效应、高直销占比、高外销占比、

生产设备的高效利用以及高自主品牌占比等优势，共同构筑了优于同行业的毛利率水平。具体分析如下：

（1）优质的客户结构赋予了公司较强的产品定价能力

发行人与同行业公司客户类型比较情况如下：

公司名称	主要客户
泰晶科技	中兴通讯、浪潮、西门子、海康威视、大华、联想、格力、美的、移远、涂鸦、京东方、美格智能、日海、移芯、大疆、国电、华勤、FLEX（伟创力）、Foxconn（富士康）、venture、Jabil 等客户。
惠伦晶体	闻泰科技、移远通信、汇川技术、日海智能、美格智能、共进股份、360、卓翼科技、小米通信、富士康、上海龙旗科技股份有限公司、海信集团有限公司、普联技术有限公司、英特尔（Intel）、三星、韩国 LG 等客户。
晶赛科技	三环、横峰县凯怡实业有限公司、普联技术有限公司、广州视琨电子科技有限公司、深圳市兆驰股份有限公司、深圳市勤正电子有限公司等客户。
东晶电子	索尼、佳能、松下、三星、海康威视、大华、海信、欧智通等客户。
公司	公司主要客户包括客户 A、客户 B、客户 C、客户 D、长虹等国内外知名电子品牌商和通信设备制造商以及富士康、伟创力、客户 H 等知名电子制造服务商，产品最终应用于惠普、戴尔、思科、索尼、金士顿、希捷等众多品牌的终端电子产品。

注：同行业可比公司主要客户信息取自年度报告、招股说明书等公开信息。

如上表所示，公司主要客户与同行业可比上市公司存在一定差异，公司的客户主要为下游各行业的全球头部企业。

公司依托前瞻性国际化布局，叠加客户高标准的供应链准入资质要求，成功搭建起以全球行业龙头为核心的优质客户体系。发行人较早切入全球芯片设计商、电子制造服务商及品牌终端客户的产业链供应矩阵，技术实力获得全球主流客户的广泛认可，积累了大量世界五百强及行业领先企业客户，报告期内前述类型客户占主营业务收入的比重均在 60%以上。深厚的客户认证壁垒，叠加晶振产品作为电子产品“心脏”对性能的极端重要性，使得下游知名客户出于品牌保护与供应链安全考虑，对供应商更换持高度审慎态度。

上述“优质客户结构+高粘性合作关系”的双重护城河，不仅赢得了终端品牌商的高度认可，构筑了公司强大的业务基本盘，更赋予了公司较强的产品定价能力。

（2）发行人技术水平具有先进性

近年来，公司基于自身发展战略布局、顺应行业技术变革和发展趋势，持续突破技术和设备难点，实现微尺寸、高频率、高精度产品持续量产和销售。

石英晶体元器件的尺寸越小，技术难度越大。发行人主要自产产品尺寸范围与同行业可比上市公司主要产品具体对比如下：

产品大类	产品类别	发行人	泰晶科技	惠伦晶体	晶赛科技	东晶电子
谐振器	SMD 晶体谐振器	1008-5032	1008-3225	1008-3225	1612-5032	1210-5032
振荡器	SPXO 晶体振荡器	1612-7050	2016-3225	2016-7050	2016-7050	2016-7050

注：可比公司相关产品信息取自其官网网站、年度报告等公开信息。

如上表所示，发行人的主要产品 SMD 晶体谐振器的最小尺寸为 1008，SPXO 晶体振荡器的最小尺寸为 1612。相较于同行业公司，发行人可以生产附加值更高的更小尺寸、更高频率的产品，为发行人带来更高的毛利率水平。

（3）公司采取“优先承接高单价、高毛利率订单”的经营策略

报告期内，公司产能利用率始终在高饱和下运行。为了高效利用产能，公司一方面将主要产能服务于世界五百强和行业领先企业，优先保障优质客户订单的及时交付。另一方面，针对剩余少量产能，公司采取“优先承接高单价、高毛利率订单”的经营策略。因此，优质客户的业绩基本盘，支撑了公司采取“优先承接高单价、高毛利率订单”的经营策略，使得公司总体毛利率水平向优质客户看齐。

（4）产能高效释放带来规模效应

报告期内，发行人与同行业可比公司产能利用率比较情况如下：

单位：%

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	77.50	69.90	70.79
惠伦晶体	75.60	74.50	49.85
晶赛科技	80.22	79.34	69.63
东晶电子	85.70	75.18	56.33
算术平均值	**79.75**	**74.73**	**61.65**
公司	**92.24**	**96.37**	**83.86**

注：①泰晶科技的产量取自其年度报告披露的相关数据；泰晶科技 2023 年度产能取自其 2022 年 6 月公布的《投资者关系活动记录表》中披露的总产能数据，2024 年度、2025 年度产能数据根据其 2023 年度产能数据加上公开披露的新增数据计算而得；

②惠伦晶体、东晶电子产量取自其年度报告披露的相关数据；产能数据取自其年度报告；

③晶赛科技产能利用率取自其年度报告

报告期内，发行人产能利用率持续处于高位运行状态，显著高于同行业可比公司平均水平。

较高的产能利用率不仅是公司市场响应能力与生产运营效率的直接体现，更是公司实现成本优势的关键驱动因素。这种由高产能利用率所激发的规模效应，一方面通过降低单位固定成本夯实了公司的成本控制能力，另一方面也提升了生产资源的配置效率与周转速率。因此，相较于同行业竞争对手，公司凭借更优的产能利用效率，成功构筑了坚实的成本竞争优势，为更激烈的市场竞争力奠定了基础。

（5）公司外销占比高于同行业

报告期内，公司与可比公司外销收入占比情况如下：

单位：%

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	7.96	8.93	10.16
惠伦晶体	12.36	12.67	20.45
晶赛科技	16.90	12.66	16.73
东晶电子	8.61	11.65	10.60
算术平均值	**11.46**	**11.48**	**14.48**
公司	**52.54**	**51.89**	**55.25**

注：①同行业可比公司数据均取自其年报或其他公开数据；②公司、泰晶科技的外销收入占比=外销收入/主营业务收入；惠伦晶体、晶赛科技、东晶电子的外销收入占比=外销收入/营业收入；

境内市场客户层次不一，价格竞争较为激烈；境外市场以国际电子产业巨头为主导，更为注重品控，质量客诉成本极高，供应商准入标准严苛，一旦进入合格供应商后合作长期稳定。晶振产品境内外不同的竞争环境使得境外市场的毛利率水平通常高于境内市场。

由上表可知，公司具有高于同行业可比公司的外销收入占比，使得公司毛利率水平较高。

（6）公司直销占比高于同行业

报告期内，公司与可比公司直销收入占比情况如下：

单位：%

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	73.68	75.00	74.15
惠伦晶体	62.30	59.65	55.86
晶赛科技	未披露	未披露	未披露
东晶电子	49.13	28.94	24.18
算术平均值	**61.71**	**54.53**	**51.40**
公司	**76.14**	**76.18**	**79.51**

注：①同行业可比公司数据均取自其年报或其他公开数据；②发行人和泰晶科技收入占比均为占主营业务收入的比例，惠伦晶体和东晶电子收入占比为占营业收入的比例。

直销模式下，公司自行进行市场开拓；经销模式下，经销商直接面对终端客户，存在一定的市场开拓成本，公司对经销商有一部分让利，给予经销商价格较低，使得直销模式毛利率通常高于经销模式。

由上表可知，公司直销收入占比高于同行业可比公司，使得公司毛利率水平较高。

（7）生产设备的高效利用为公司带来成本优势

报告期内，公司与可比公司单位收入设备折旧情况如下：

单位：元/百元收入

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	10.25	11.56	12.49
惠伦晶体	14.59	16.21	22.43
晶赛科技	8.99	7.92	9.67
东晶电子	7.55	12.30	13.65
算术平均值	**10.34**	**12.00**	**14.56**
公司	**7.08**	**5.78**	**6.85**

注：①同行业可比公司数据均取自其年报或其他公开数据；②单位收入设备=设备折旧费用/主营业务收入*100。

公司早期生产设备以进口为主，技术精度和设备稳定性较高、故障率较低，公司通过持续技术攻关、对关键工艺的生产设备进行优化改造以及良好的维护保养，整体提升了各生产线的生产效率、产品质量，同时生产设备使用寿命有效提升使得生产设备的整体成新率较低。较低的生产设备成新率，使得公司固定资产折旧分摊计入营业成本的金额较少，一定程度上提高了公司的毛利率水

平。

报告期内，公司持续淘汰生产效能较低、利用程度较差的机器设备，引进自动化程度更高的新设备扩大生产规模，提高自动化水平和生产效率，不存在设备接近或超过使用年限影响产能、产量的情形，有力保障了生产经营的稳定性。

（8）公司自主品牌销售比例在 95%以上，高于境内竞争对手

公司销售以自主品牌（OBM 模式）为主，报告期各期自主品牌产品销售收入占比均保持在 95%以上，相比贴牌生产模式具有更强的产品定价能力。

境内同行业竞争对手较为倚重 OEM、ODM 等贴牌代工，存在一定的贴牌模式收入。泰晶科技 2020 年年度报告披露：“提供 OEM、ODM 方式服务客户吸引知名厂商，提升自主产品品牌影响力，拓展销售模式和渠道，扩大市场占有率”；惠伦晶体 2015 年的招股说明书披露：“2014 年度，公司的 ODM 比例从 31.67%上升到 42.26%”；东晶电子曾为发行人提供贴牌代工服务。相比之下，竞争对手的贴牌业务通常只能获得加工环节利润，定价能力较弱。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占营业收入比例（%）	金额（万元）	占营业收入比例（%）	金额（万元）	占营业收入比例（%）
销售费用	2,415.94	3.82	2,179.47	3.84	2,036.81	3.76
管理费用	7,456.90	11.80	6,602.89	11.64	5,922.38	10.94
研发费用	3,799.99	6.01	3,597.44	6.34	3,540.71	6.54
财务费用	-1,262.93	-2.00	-2,279.61	-4.02	-899.43	-1.66
合计	**12,409.90**	**19.63**	**10,100.19**	**17.80**	**10,600.47**	**19.57**

报告期内，公司期间费用占营业收入的比例（以下简称“期间费用率”）分别为 19.57%、17.80%和 19.63%，存在小幅波动。

1、销售费用构成及分析

（1）销售费用构成及变动情况

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
人员成本	1,761.11	72.90	1,587.50	72.84	1,551.43	76.17
销售服务费	255.48	10.57	192.44	8.83	156.80	7.70
差旅费	128.34	5.31	140.28	6.44	83.98	4.12
业务招待费	70.98	2.94	68.55	3.15	68.46	3.36
办公费	57.72	2.39	57.36	2.63	51.77	2.54
租赁费	44.84	1.86	45.40	2.08	44.61	2.19
修理费	5.52	0.23	7.32	0.34	7.41	0.36
其他费用	91.93	3.81	80.62	3.70	72.36	3.55
合计	**2,415.94**	**100.00**	**2,179.47**	**100.00**	**2,036.81**	**100.00**

报告期各期，公司销售费用金额分别为 2,036.81 万元、2,179.47 万元和 2,415.94 万元，销售费用占营业收入的比例分别为 3.76%、3.84%和 3.82%，销售费用主要为人员成本、销售服务费等，上述费用合计占销售费用的比例分别为 83.87%、81.67%和 83.47%。

报告期各期，公司销售费用中人员成本分别为 1,551.43 万元、1,587.50 万元和 1,761.11 万元，主要为销售人员工资、奖金等，与公司收入变动趋势一致。

报告期各期，公司销售费用中销售服务费分别为 156.80 万元、192.44 万元和 255.48 万元，主要为支付给第三方的市场开拓相关费用。

（2）销售费用率与同行业可比上市公司对比分析

公司销售费用率与同行业可比上市公司比较情况如下：

销售费用率	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	2.48%	2.26%	1.99 %
惠伦晶体	4.01%	4.24%	6.29%
晶赛科技	2.50%	2.43%	3.18 %
东晶电子	0.73%	1.73%	1.75%

销售费用率	2025 年度	2024 年度	2023 年度
算术平均值	2.43%	2.67%	3.30%
发行人	3.82%	3.84%	3.76%

注：①同行业可比公司数据均取自其年报或其他公开数据；②销售费用率=销售费用/营业收入。

报告期内，公司销售费用率略高于同行业可比上市公司平均值，主要是由于：公司直销占比较高，销售人员数量高于同行业可比上市公司，使得公司销售费用中人员成本高于同行业可比公司。

2、管理费用构成及分析

（1）管理费用构成及变动情况

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
人员成本	4,730.61	63.44	4,473.33	67.75	4,384.22	74.03
折旧摊销费	1,082.30	14.51	1,017.13	15.40	486.99	8.22
咨询服务费	730.57	9.80	156.42	2.37	216.56	3.66
办公费	395.84	5.31	467.41	7.08	429.65	7.25
残保金	113.36	1.52	107.06	1.62	97.89	1.65
差旅费	68.37	0.92	50.53	0.77	72.72	1.23
业务招待费	47.68	0.64	81.25	1.23	58.27	0.98
租赁费	34.26	0.46	35.04	0.53	38.35	0.65
修理费	28.11	0.38	32.08	0.49	39.26	0.66
其他费用	225.79	3.03	182.65	2.77	98.45	1.66
合计	**7,456.90**	**100.00**	**6,602.89**	**100.00**	**5,922.38**	**100.00**

报告期各期，公司管理费用金额分别为 5,922.38 万元、6,602.89 万元和 7,456.90 万元，管理费用占营业收入的比例分别为 10.94%、11.64%和 11.80%，管理费用主要为人员成本、咨询服务费、办公费、折旧摊销费等，上述费用合计占管理费用的比例分别为 93.16%、92.60%和 93.06%。

报告期各期，公司管理费用中人员成本分别为 4,384.22 万元、4,473.33 万元和 4,730.61 万元，主要为管理人员工资、奖金等。

报告期各期，公司管理费用中咨询服务费分别为 216.56 万元、156.42 万元和 730.57 万元，主要系上市相关咨询及服务费用。2025 年，咨询服务费增加较多，主要系前次 IPO 相关中介费用在当期由其他流动资产转入管理费用所致。

报告期各期，公司管理费用中办公费分别为 429.65 万元、467.41 万元和 395.84 万元，主要为水电费、低值易耗品及邮递费用等。

报告期各期，公司管理费用中折旧摊销费分别为 486.99 万元、1,017.13 万元和 1,082.30 万元。2024 年、2025 年，折旧摊销费增长较多，主要系浙江鸿星厂区逐步投入使用所致。

（2）管理费用率与同行业可比上市公司对比分析

公司管理费用率与同行业可比上市公司比较情况如下：

管理费用率	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	7.43%	6.69%	7.18%
惠伦晶体	11.43%	11.25%	15.66%
晶赛科技	4.60%	4.82%	5.97%
东晶电子	8.46%	13.11%	16.67%
算术平均值	**7.98%**	**8.97%**	**11.37%**
发行人	**11.80%**	**11.64%**	**10.94%**

注：①同行业可比公司数据均取自其年报或其他公开数据；②管理费用率=管理费用/营业收入。

2023 年，公司管理费用率与同行业可比公司平均值相当。2024 年、2025 年，公司管理费用率高于同行业可比上市公司，主要是由于：一方面，浙江鸿星厂区逐步投入使用，计入管理费用的折旧摊销费增加；另一方面，惠伦晶体热敏晶振及温补晶体振荡器出货量增长较多、东晶电子 2025 年新增非晶振业务，使得上述公司收入规模增幅较大，而管理费用相对稳定，进而导致管理费用率有所下降。

3、研发费用构成及分析

（1）研发费用构成及变动情况

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
人员成本	2,057.50	54.14	1,929.24	53.63	1,722.49	48.65
折旧摊销费	933.58	24.57	932.81	25.93	1,083.07	30.59
材料费	672.77	17.70	658.34	18.30	645.51	18.23
水电费	21.64	0.57	20.16	0.56	19.15	0.54
其他	114.50	3.01	56.89	1.58	70.49	1.99
合计	**3,799.99**	**100.00**	**3,597.44**	**100.00**	**3,540.71**	**100.00**

报告期各期，公司研发费用金额分别为 3,540.71 万元、3,597.44 万元和 3,799.99 万元，研发费用占营业收入的比例分别为 6.54%、6.34%和 6.01%，基本保持稳定。

（2）研发项目投入情况

报告期内，公司主要研发项目投入情况如下：

单位：万元

项目名称	项目预算	研发费用支出金额			实施进度
		2025 年度	2024 年度	2023 年度	
5G 分布式单元加速卡 2016 80M 高频石英晶体谐振器的研发	420.00	390.16	-	-	完结
800G 光通讯 2016 156.25M 小型化高频差分振荡器的研发	410.00	414.25	-	-	完结
无人工业控制 2520 115.2M 小型化高频振荡器的开发	400.00	388.46	-	-	完结
低相噪网通基站 RRU 模块用 2520 96.0096M 晶体振荡器的研发	355.00	337.57	-	-	完结
WIFI 7 模组超小型化 1008 59.97M 石英晶体谐振器的研发	320.00	314.48	-	-	完结
车规级 5G 通讯模块 1612 76.8M 高频温补石英晶体谐振器的研发	480.00	379.08	-	-	完结
车规级 GPS 精准定位 2016 26M 温补石英晶体振荡器的研发	505.00	521.99	-	-	完结
使用光刻技术开发 Wafer 形状的 AT-cut 石英晶片	650.00	31.25	-	-	在研
低轨卫星通讯 3225 40M 石英晶体谐振器的研发	95.00	89.77	-	-	完结
手持终端无线充电 2016 41.03M 石英晶体谐振器的研发	100.00	94.52	-	-	完结
云边缘运算服务器 2520 50M 石英晶体谐振器的研发	95.00	91.20	-	-	完结

项目名称	项目预算	研发费用支出金额			实施进度
		2025年度	2024年度	2023年度	
工业控制充电桩 3225 9.84M 石英晶体谐振器的研发	95.00	92.04	-	-	完结
医疗手套用 3225 13.52M 石英晶体谐振器研发	90.00	87.33	-	-	完结
电力储能微型逆变器 3225 10M 石英晶体谐振器开发	90.00	85.43	-	-	完结
头戴式耳机高保真 1612 49.152M 高频石英晶体谐振器的研发	95.00	94.66	-	-	完结
助听器个人医疗 2016 32M 石英晶体谐振的研发	95.00	95.59	-	-	完结
工业控制电表 2520 30.4M 石英晶体谐振器的研发	90.00	89.93	-	-	完结
农用机器人 3225 8.00M 石英晶体谐振器的研发	85.00	83.57	-	-	完结
可翻转式晶片高效研磨工艺的研发	40.00	24.23	-	-	完结
高精度石英晶片多线切割工艺的研发	40.00	22.54	-	-	完结
高度可调式石英晶片角度分选工艺的研发	40.00	19.62	-	-	完结
可提升石英晶片质量的检测技术研究	40.00	15.34	-	-	完结
多功能晶片磨边工艺的研发	40.00	10.90	-	-	完结
用于石英晶片分选的高效精准上料技术研究	40.00	10.08	-	-	完结
基于多频段协同的石英晶片加工超快速超声波清洗技术研究	40.00	16.01	-	-	完结
车规级 WiFi 6E 用高频基本波 2016 59.97M 石英晶体谐振器	400.00	-	397.24	-	完结
联发科 MTK7922 WiFi 6E 用小型化 1210 40M 石英晶体谐振器	350.00	-	338.06	-	完结
低轨卫星的信号接收器用 3225 125.0M LVDS 差分石英晶体振荡器	360.00	-	308.91	-	完结
运动相机用小型化 2520 100M HCSL 差分石英晶体振荡器	400.00	-	350.29	-	完结
5G 通讯模组用高频小型化 2016 80M 石英晶体振荡器	300.00	-	300.59	-	完结
智能穿戴手表用高精度 2520 26M 温度补偿石英晶体振荡器	450.00	-	425.07	-	完结
低轨卫星接受装置用高精度 2016 26M 温度补偿石英晶体振荡器	400.00	-	385.37	-	完结
WiFi/GNSS 芯片用高精度 2016 38.4M 温度补偿石英晶体振荡器	350.00	-	330.36	-	完结
晶片微纳挤蜡工艺的研究	55.00	-	18.06	-	完结
基于深度学习的产品外观图像拍摄工艺的研究	65.00	-	55.55	-	完结

项目名称	项目预算	研发费用支出金额			实施进度
		2025年度	2024年度	2023年度	
超精密晶片角度测量系统的研发	40.00	-	29.52	-	完结
网络通讯高频用基本波 2016 78.125M 石英晶体谐振器	230.00	-	224.51	-	完结
物联网高温 115℃用小公差 WIFI6/BLE 2016 40M 石英晶体谐振器	130.00	-	122.60	-	完结
便携式心率监测仪用 2520 19.6608M 石英晶体谐振器	130.00	-	119.59	-	完结
车载座舱信息-V2X 通信技术用 48M 高精度石英晶体谐振器研发	95.00	-	92.18	-	完结
智能驾驶、智能座舱、融合感知、智能车控用 25M 高稳定性石英晶体谐振器研发	90.00	-	88.84	-	完结
入耳式助听器应用 1612 48M 石英晶体谐振器	360.00	-	-	346.93	完结
基于 IOT 智能物联技术电视架构的 1210 52.00M 小型化石英晶体谐振器	430.00	-	-	414.03	完结
手环精准定位超低频 32kHz 石英晶体振荡器	390.00	-	-	384.96	完结
基于实时通信的 5G 蜂窝基站模块应用的宽温高稳定度 1612 76.8M 热敏晶体	380.00	-	-	359.23	完结
基于高精度定位技术电子标签应用的高稳定度 2016 55.20M 热敏晶体	430.00	-	-	438.07	完结
车联网系统车载 T-BOX 通信应用车规 2016 26.00M 石英晶体谐振器	400.00	-	-	396.59	完结
高精度 TCXO RTC 时钟用 3225 33.6M 石英晶体谐振器	380.00	-	-	499.80	完结
基于 WiFi 7 通信应用低老化高稳定度 2016 60.00M 石英晶体谐振器	350.00	-	-	330.95	完结
基于 WiFi 7 通信应用低老化高稳定度 2016 80.00M 石英晶体谐振器	300.00	-	-	279.53	完结
高频石英晶片加工工艺的研发	60.00	-	10.76	46.42	完结
晶片稳定研磨工艺的开发	40.00	-	-	44.20	完结
合计		**3,799.99**	**3,597.44**	**3,540.71**	**-**

报告期内，公司严格执行研发管理制度，于年初制定研发项目预算，原材料、人工费用及其他费用均按照项目归集，不存在研发费用和其他成本费用混同的情形。

（3）研发费用率与同行业可比上市公司对比分析

公司研发费用率与同行业可比上市公司比较情况如下：

研发费用率	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	4.65%	5.93%	4.62%
惠伦晶体	5.08%	6.15%	7.39%
晶赛科技	4.43%	4.10%	4.55%
东晶电子	3.36%	4.83%	7.20%
算术平均值	**4.38%**	**5.25%**	**5.94%**
发行人	**6.01%**	**6.34%**	**6.54%**

注：①同行业可比公司数据均取自其年报或其他公开数据；②研发费用率=研发费用/营业收入。

报告期内，公司研发费用率略高于同行业可比上市公司，主要系公司坚持以研发驱动发展，围绕核心客户、核心技术以及行业趋势进行战略布局，持续加大研发投入所致。

4、财务费用的构成及分析

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息费用	175.63	201.14	75.68
其中：租赁负债利息费用	10.27	12.64	19.02
减：利息收入	2,497.25	1,998.98	977.66
汇兑损益	1,036.92	-503.31	-18.55
其他	21.77	21.54	21.10
合计	**-1,262.93**	**-2,279.61**	**-899.43**

报告期内，公司财务费用分别为-899.43 万元、-2,279.61 万元和-1,262.93 万元，占营业收入比例分别为-1.66%、-4.02%和-2.00%，占比较低，主要由利息费用、利息收入及汇兑损益等构成。报告期内，公司利息收入增加较多，主要系美元定期存款有所增加所致。

报告期内，公司外销收入占比较高，外币销售以美元为主，汇率变动对公司汇兑损益影响较大。2024 年，美元兑人民币汇率有所提升，形成 503.31 万元汇兑收益。2025 年，美元兑人民币汇率有所下降，形成 1,036.92 万元汇兑损失。

（五）利润表其他项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	95.38	166.49	263.86
教育费附加	41.72	72.41	113.79
地方教育费附加	27.81	48.28	75.86
房产及土地使用税	258.01	220.70	111.71
印花税	47.54	46.95	52.81
其他	2.15	1.84	1.33
合计	**472.61**	**556.68**	**619.35**

公司税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、房产及土地使用税和印花税等。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	1,589.18	1,667.70	1,510.70
代扣代收和代征手续费返还	42.36	4.41	21.78
进项税加计抵减	15.66	203.43	5.17
直接减免的增值税	26.96	-	-
合计	**1,674.16**	**1,875.54**	**1,537.65**

报告期内，公司其他收益主要系收到的与日常经营相关的政府补助。报告期各期，计入其他收益的政府补助分别为 1,510.70 万元、1,667.70 万元和 1,589.18 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
年产 9.7 亿个片式石英晶体元器件（谐振器）技改项目	-	-	5.66
新增年产 4 亿个片式石英晶体元器件（谐振器）技改项目	22.34	73.28	513.94

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
新增年产 1.5 亿个片式石英晶体元器件（谐振器）技改项目	639.98	484.04	352.13
进口贴息补助	26.86	27.43	25.19
年产高频率片 3.5 亿片项目	10.53	31.16	31.28
德清产业化项目基础设施建设奖励	20.70	20.70	10.80
年产 3 亿个石英晶体元器件（谐振器）技改项目	800.16	557.51	41.77
专精特新“小巨人”企业奖励	-	-	200.00
“双百”企业培育政策补助	-	-	145.67
工业“开门红”攻坚财政奖励	-	-	20.01
发明专利产业化项目补助	-	-	20.00
电力需求响应补助款	0.22	0.83	15.45
收快复工扩投资补助资金	-	-	10.00
入选浙江省有关计划市级补助资金	-	-	5.00
2023 年开门红一次性招用补助	-	-	4.70
知识产权补助	-	-	1.38
云南西畴县企业招聘补助	-	-	0.30
高新技术企业奖励补助资金	-	-	20.00
企业研发投入补助	-	-	47.79
稳岗补贴	33.45	28.13	11.56
企业女职工产假期间社保补贴	1.76	4.98	2.45
引进高端外国专家补助	-	12.20	16.60
产学研合作项目补助	-	18.27	8.25
扩岗补贴	1.65	1.89	-
企业安置补助/残疾人就业补贴	0.50	0.46	0.46
企业用工补贴	-	-	0.30
商标维权补助	-	8.54	-
2023 年度余杭区技术创新类中工业新产品项目	-	5.00	-
2023 年度余杭区企业研发投入补助项目	-	0.38	-
2021 年度余杭区企业培育财政扶持资金/大企业大集团	-	392.90	-
境外展会补助/德国慕尼黑/2023 年	10.00	-	-
支持企业降本增效专项政策奖励/第二季度	2.39	-	-
2022 年-2024 年重点人群补助退税	18.66	-	-
合计	**1,589.18**	**1,667.70**	**1,510.70**

3、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为 311.72 万元、247.64 万元和 148.72 万元，均为理财产品产生的投资收益。

4、信用减值损失/资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失及资产减值损失的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	3.14	-2.73	-1.39
应收账款坏账损失	38.92	23.75	-79.11
其他应收款坏账损失	-8.68	11.51	-38.69
小计	**33.39**	**32.53**	**-119.19**
存货跌价损失	604.68	265.46	391.91
小计	**604.68**	**265.46**	**391.91**
合计	**638.07**	**298.00**	**272.72**

报告期内，公司信用减值损失分别为-119.19 万元、32.53 万元和 33.39 万元，公司资产减值损失分别为 391.91 万元、265.46 万元和 604.68 万元，详见本节之“十、资产质量分析”之“（二）流动资产分析”。

5、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为 1.56 万元、1.66 万元和 1.98 万元，均为非流动资产处置产生。

6、营业外收入

报告期内，公司营业外收入明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	-	100.00	200.00
废品款	13.79	34.84	36.26
诉讼赔偿收入	13.65	-	69.32
其他	30.92	21.91	10.13
合计	**58.36**	**156.76**	**315.71**

报告期内，公司营业外收入金额分别为 315.71 万元、156.76 万元和 58.36 万元，主要由与日常经营活动无关的政府补助、销售废品收入和诉讼赔偿收入构成。

公司营业外收入中政府补助的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产相关/与收益相关
上市补助奖励	-	-	200.00	与收益相关
余杭区经济发展突出贡献企业/高质量发展大会奖项	-	100.00	-	与收益相关
合计	-	**100.00**	**200.00**	-

7、营业外支出

报告期内，公司营业外支出明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	11.62	97.01	62.10
对外捐赠支出	34.12	5.00	81.06
报废损失	3.62	0.08	0.59
其他	7.81	7.33	3.73
合计	**57.18**	**109.42**	**147.49**

报告期内，公司营业外支出分别为 147.49 万元、109.42 万元和 57.18 万元，主要由非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出等构成。

8、所得税费用

报告期内，公司所得税费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税	1,134.47	1,702.83	1,973.07
递延所得税	70.40	47.41	-346.59
所得税费用	**1,204.87**	**1,750.24**	**1,626.49**
利润总额	12,037.00	15,053.89	14,917.24
所得税费用/利润总额	**10.01%**	**11.63%**	**10.90%**

报告期内，公司所得税费用占利润总额的比例分别为 10.90%、11.63%和10.01%，基本保持稳定。

（六）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常损益具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产处置损益	-9.50	-92.18	-60.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	119.76	593.58	754.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	148.72	247.64	311.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12.67	41.17	30.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26.96	-	-
小计	**298.60**	**790.21**	**1,035.86**
所得税影响额	-53.15	-122.00	-158.36
少数股东权益影响额（税后）	-		-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	**245.45**	**668.21**	**877.50**
归属于母公司股东的净利润	10,831.89	13,303.66	13,290.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**10,586.44**	**12,635.44**	**12,413.25**
归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例	**2.27%**	**5.02%**	**6.60%**

报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、理财产品的投资收益等。

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 6.60%、5.02%和 2.27%。上述非经常性损益对公司经营成果不存在重大影响，不会影响公司的持续经营能力。

（七）纳税情况分析

报告期内，公司主要税种的纳税情况如下：

1、增值税缴纳情况

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2025 年度	-466.38	1,589.41	953.31	169.72
2024 年度	-1,297.02	1,296.96	466.32	-466.38
2023 年度	-855.04	-72.81	369.17	-1,297.02

注：期初未交数、期末未交数与应交税费期末数差异在其他流动资产列示。

2、企业所得税缴纳情况

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2025 年度	619.15	1,135.24	1,869.67	-115.27
2024 年度	217.59	1,702.53	1,300.97	619.15
2023 年度	725.42	1,973.07	2,480.90	217.59

注：期初未交数、期末未交数与应交税费期末数差异在其他流动资产列示。

3、所得税费用与利润总额的关系

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利润总额	**12,037.00**	**15,053.89**	**14,917.24**
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,805.55	2,258.08	2,237.59
子公司适用不同税率的影响	155.87	199.23	-67.82
调整以前期间所得税的影响	-0.27	-	6.11
非应税收入的影响	-32.40	-29.36	-19.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9.95	14.13	34.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11.63	3.66	3.98
所得税减免优惠的影响	-98.40	-106.14	-60.07
研发费加计扣除的影响	-647.05	-589.38	-508.88
所得税费用	**1,204.87**	**1,750.24**	**1,626.49**

报告期各期，公司所得税费用分别为 1,626.49 万元、1,750.24 万元和 1,204.87 万元，与公司利润总额规模保持匹配。

十、资产质量分析

（一）资产规模与结构分析

报告期各期末，公司资产的构成情况如下：

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
流动资产	105,610.99	71.45	98,720.42	70.95	87,368.73	71.73
非流动资产	42,198.50	28.55	40,427.75	29.05	34,434.19	28.27
资产总额	**147,809.48**	**100.00**	**139,148.17**	**100.00**	**121,802.91**	**100.00**

1、资产规模分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 121,802.91 万元、139,148.17 万元及 147,809.48 万元，公司资产总额持续增长，主要系货币资金、存货和固定资产等余额增加所致。

2、资产结构分析

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 71.73%、70.95%和 71.45%，非流动资产占总资产的比例分别为 28.27%、29.05%和 28.55%。公司流动资产占总资产比例较高，资产结构较为稳定。

（二）流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下：

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
货币资金	70,154.54	66.43	62,819.79	63.63	50,395.92	57.68
交易性金融资产	3,678.14	3.48	6,380.66	6.46	10,288.74	11.78
应收票据	670.14	0.63	99.20	0.10	331.13	0.38
应收账款	16,370.69	15.50	15,631.16	15.83	15,179.84	17.37
应收款项融资	688.73	0.65	861.10	0.87	202.63	0.23
预付款项	164.88	0.16	133.95	0.14	120.91	0.14
其他应收款	315.76	0.30	378.05	0.38	211.07	0.24
存货	13,252.18	12.55	11,359.32	11.51	8,975.53	10.27

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
其他流动资产	315.93	0.30	1,057.19	1.07	1,662.96	1.90
合计	**105,610.99**	**100.00**	**98,720.42**	**100.00**	**87,368.73**	**100.00**

公司的流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货组成，报告期各期末，上述资产合计占流动资产的比例分别为 97.11%、97.44%及97.96%。

报告期内，公司流动资产主要项目的变动情况分析如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金具体情况如下：

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
库存现金	2.00	0.01	2.00	0.01	2.00	0.01
银行存款	70,133.54	99.97	62,798.79	99.97	50,374.92	99.96
其他货币资金	19.00	0.03	19.00	0.03	19.00	0.04
合计	**70,154.54**	**100.00**	**62,819.79**	**100.00**	**50,395.92**	**100.00**

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 50,395.92 万元、62,819.79 万元和 70,154.54 万元，占流动资产的比例分别为 57.68%、63.63%和 66.43%。公司货币资金余额变动主要受经营活动、投资活动及筹资活动综合影响，具体分析详见本节之“十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（四）现金流量分析”。

公司其他货币资金主要为存放于支付宝账户的资金，金额较小。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 10,288.74 万元、6,380.66 万元和 3,678.14 万元，占流动资产的比例分别为 11.78%、6.46%和 3.48%，均为银行理财产品。

3、应收票据和应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资构成情况如下：

单位：万元

报表科目	明细项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收票据	银行承兑汇票	592.70	81.51	261.56
	商业承兑汇票	81.52	18.62	73.23
	账面余额小计	**674.21**	**100.13**	**334.79**
	减：坏账准备	4.08	0.93	3.66
	账面价值合计	**670.14**	**99.20**	**331.13**
应收款项融资	银行承兑汇票	688.73	861.10	202.63
合计		**1,358.87**	**960.30**	**533.76**

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资账面价值合计分别为 533.76 万元、960.30 万元和 1,358.87 万元，占流动资产的比例分别为 0.61%、0.97%和 1.29%。

4、应收账款

（1）应收账款总体情况

1）报告期各期末，公司应收账款总体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款账面余额	17,232.31	16,453.86	15,978.78
坏账准备	861.62	822.69	798.94
应收账款账面净值	**16,370.69**	**15,631.16**	**15,179.84**
营业收入	63,212.05	56,739.10	54,153.81
应收账款余额占营业收入比例（%）	**27.26**	**29.00**	**29.51**

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 15,978.78 万元、16,453.86 万元及 17,232.31 万元，占当期营业收入的比例分别为 29.51%、29.00%及 27.26%，应收账款余额合理，与当期营业收入金额匹配。

2）报告期各期末，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
1 年以内	17,232.31	16,453.86	15,978.78
合计	**17,232.31**	**16,453.86**	**15,978.78**

报告期各期末，公司的应收账款账龄均为一年以内，应收账款质量优秀。

（2）坏账准备计提情况

1）坏账准备计提总体情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

类别	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-
按组合计提坏账准备	17,232.31	861.62	16,370.69
合计	**17,232.31**	**861.62**	**16,370.69**
类别	**2024 年 12 月 31 日**		
	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-
按组合计提坏账准备	16,453.86	822.69	15,631.16
合计	**16,453.86**	**822.69**	**15,631.16**
类别	**2023 年 12 月 31 日**		
	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-
按组合计提坏账准备	15,978.78	798.94	15,179.84
合计	**15,978.78**	**798.94**	**15,179.84**

报告期各期末，公司应收账款中不存在明显损失需要单项计提的情形。

报告期内，公司按组合计提坏账准备的应收账款具体情况如下：

项目	2025.12.31		
	账面余额（万元）	计提比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	17,232.31	5.00	861.62
合计	**17,232.31**	**5.00**	**861.62**
项目	**2024.12.31**		
	账面余额（万元）	计提比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	16,453.86	5.00	822.69
合计	**16,453.86**	**5.00**	**822.69**
项目	**2023.12.31**		
	账面余额（万元）	计提比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	15,978.78	5.00	798.94

合计	15,978.78	5.00	798.94

2）公司坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比情况

发行人根据《企业会计准则》的规定并结合自身具体情况制定了合理的坏账计提比例，发行人按组合计提坏账准备的计提比例与同行业可比上市公司的比较情况如下：

单位：%

账龄情况	泰晶科技	惠伦晶体	晶赛科技	东晶电子	发行人
1 年以内	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	30.00	10.00	20.00	20.00
2-3 年	15.00	50.00	30.00	40.00	40.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

注：同行业可比上市公司坏账准备计提比例摘自各公司最新一期年度报告。

从上表可以看出，公司总体采用较为谨慎的坏账计提政策，符合所在行业的经营特点，与同行业上市公司相比不存在重大差异，坏账准备计提充分。

（3）应收账款前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

时间	序号	客户	余额（万元）	占比（%）	坏账准备（万元）	账龄	是否为关联方
2025.12.31	1	CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.	1,209.77	7.02	60.49	1 年以内	否
	2	台湾鸿星	1,072.22	6.22	53.61	1 年以内	是
	3	客户 C	815.76	4.73	40.79	1 年以内	否
	4	客户 A1	814.84	4.73	40.74	1 年以内	否
	5	客户 B1	758.55	4.40	37.93	1 年以内	否
	合计		**4,671.15**	**27.10**	**233.56**	-	-
2024.12.31	1	CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.	1,078.80	6.56	53.94	1 年以内	否
	2	客户 A1	914.40	5.56	45.72	1 年以内	否
	3	台湾鸿星	904.47	5.50	45.22	1 年以内	是
	4	客户 C	767.74	4.67	38.39	1 年以内	否
	5	客户 B1	658.46	4.00	32.92	1 年以内	否
	合计		**4,323.87**	**26.29**	**216.19**	-	-

时间	序号	客户	余额（万元）	占比（%）	坏账准备（万元）	账龄	是否为关联方
2023.12.31	1	CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.	1,084.14	6.78	54.21	1 年以内	否
	2	客户 E	798.79	5.00	39.94	1 年以内	否
	3	台湾鸿星	666.92	4.17	33.35	1 年以内	是
	4	客户 B1	604.06	3.78	30.20	1 年以内	否
	5	客户 C	597.87	3.74	29.89	1 年以内	否
	合计		**3,751.78**	**23.47**	**187.59**	-	-

报告期各期末，公司应收账款余额前五大客户资金实力较强信誉良好，与公司建立了长期稳定的合作关系，坏账风险较小。

上述客户中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东，台湾鸿星系公司关联方，除此之外无公司其他关联方。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项金额分别为 120.91 万元、133.95 万元及 164.88 万元，占流动资产的比例分别为 0.14%、0.14%及 0.16%，主要系预付材料款、电费、房租和保险费等。

6、其他应收款

（1）其他应收款构成

报告期各期末，公司其他应收款余额按款项性质分类情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收出口退税	231.69	283.38	107.77
代扣代缴款项	93.90	84.27	86.07
押金及保证金	25.33	49.60	44.49
备用金	0.89	5.52	5.97
其他应收款余额	**351.80**	**422.78**	**244.29**
坏账准备	36.05	44.73	33.22
其他应收款账面价值	**315.76**	**378.05**	**211.07**

报告期各期末，公司其他应收款账面余额分别为 244.29 万元、422.78 万元及 351.80 万元。报告期各期末，公司其他应收款金额较小，主要为应收的出口

退税款、押金保证金和代扣代缴款项等。

（2）其他应收款账龄结构

报告期各期末，公司的其他应收款原值的账龄如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
1 年以内	329.65	385.07	207.68
1-2 年	1.40	2.99	16.40
2-3 年	2.45	16.40	1.08
3 年以上	18.31	18.32	19.12
合计	**351.80**	**422.78**	**244.29**

报告期各期末，公司一年以上账龄的其他应收款原值分别为 36.60 万元、37.70 万元及 22.16 万元，占各年末其他应收款的比例分别为 14.98%、8.92%及 6.30%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司一年以上账龄占比较高的款项主要为押金及保证金，均在合理期限内。

（3）其他应收款坏账准备计提情况

报告期各期末，其他应收款坏账准备计提的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
组合计提坏账准备	351.80	36.05	422.78	44.73	244.29	33.22
合计	**351.80**	**36.05**	**422.78**	**44.73**	**244.29**	**33.22**

报告期各期末，公司其他应收款中不存在明显损失需要单项计提的情形。

报告期内，公司按组合计提坏账准备的其他应收款具体情况如下：

项目	2025.12.31		
	账面余额（万元）	计提比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	329.65	5.00	16.48
1-2 年	1.40	20.00	0.28
2-3 年	2.45	40.00	0.98

3 年以上	18.31	100.00	18.31
合计	**351.80**	**-**	**36.05**
项目	**2024.12.31**		
	账面余额（万元）	**计提比例（%）**	**坏账准备（万元）**
1 年以内	385.07	5.00	19.25
1-2 年	2.99	20.00	0.60
2-3 年	16.40	40.00	6.56
3 年以上	18.32	100.00	18.32
合计	**422.78**	**-**	**44.73**
项目	**2023.12.31**		
	账面余额（万元）	**计提比例（%）**	**坏账准备（万元）**
1 年以内	207.68	5.00	10.38
1-2 年	16.40	20.00	3.28
2-3 年	1.08	40.00	0.43
3 年以上	19.12	100.00	19.12
合计	**244.29**	**-**	**33.22**

（4）其他应收款前五名情况

报告期各期末，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
2025.12.31					
国家税务总局杭州市余杭区税务局	应收出口退税款	231.69	1 年以内	65.86	11.58
ZOAP Consulting LTD.	押金及保证金	10.03	3 年以上	2.85	10.03
客户 G	押金及保证金	5.00	3 年以上	1.42	5.00
深圳市新美达产业发展有限公司	押金及保证金	3.60	1 年以内及 3 年以上	1.02	0.86
浙江启聚实业有限公司	押金及保证金	2.45	2-3 年	0.70	0.98
合计		**252.77**	**-**	**71.85**	**28.46**
2024.12.31					
国家税务总局杭州市余杭区税务局	应收出口退税	283.38	1 年以内	67.03	14.17
浙江新远见实业有限公司	押金及保证金	15.75	2 至 3 年	3.73	6.30

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
客户 F	押金及保证金	10.00	1 年以内	2.37	0.50
客户 G	押金及保证金	5.00	3 年以上	1.18	5.00
张娜	备用金	3.87	1 年以内	0.92	0.19
合计		**318.01**	**-**	**75.22**	**26.16**
2023.12.31					
国家税务总局杭州市余杭区税务局	应收出口退税	107.77	1 年以内	44.11	5.39
浙江新远见实业有限公司	押金及保证金	15.75	1-2 年	6.45	3.15
浙江启聚实业有限公司	押金及保证金	5.05	1 年以内	2.07	0.25
客户 G	押金及保证金	5.00	3 年以上	2.05	5.00
北京易才博普奥管理顾问有限公司	代扣代缴款	2.74	1 年以内	1.12	0.14
合计		**136.30**	**-**	**55.80**	**13.93**

7、存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31			
	账面余额	占比（%）	跌价准备	账面价值
原材料	6,140.00	43.21	517.82	5,622.18
半成品	514.35	3.62	60.99	453.36
委托加工物资	680.51	4.79	-	680.51
在产品	602.54	4.24	-	602.54
库存商品	6,065.62	42.68	380.02	5,685.60
发出商品	207.99	1.46	-	207.99
合计	**14,211.01**	**100.00**	**958.82**	**13,252.18**
项目	**2024.12.31**			
	账面余额	**占比（%）**	**跌价准备**	**账面价值**
原材料	5,422.73	45.20	405.46	5,017.27
半成品	271.61	2.26	11.11	260.51
委托加工物资	361.86	3.02	-	361.86
在产品	662.55	5.52	-	662.55

库存商品	5,094.27	42.46	220.63	4,873.64
发出商品	183.49	1.53	-	183.49
合计	**11,996.51**	**100.00**	**637.20**	**11,359.32**
项目	**2023.12.31**			
	账面余额	**占比（%）**	**跌价准备**	**账面价值**
原材料	4,713.52	48.87	445.79	4,267.74
半成品	247.47	2.57	12.85	234.62
委托加工物资	61.45	0.64	-	61.45
在产品	427.99	4.44	-	427.99
库存商品	4,113.61	42.65	210.37	3,903.24
发出商品	80.49	0.83	-	80.49
合计	**9,644.53**	**100.00**	**669.00**	**8,975.53**

（1）存货构成及变动分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,975.53 万元、11,359.32 万元及 13,252.18 万元，占流动资产的比例分别为 10.27%、11.51%及 12.55%，公司存货规模的增加主要系业务规模扩大，公司根据市场需求适当调整备货规模。

公司存货包括原材料、半成品、委托加工物资、在产品、库存商品和发出商品项目，主要由原材料和库存商品构成，主要原因系公司实行“以销定产+适度备货”的生产模式，根据在手订单及销售预测安排生产计划，需要一定的原材料和库存商品储备。

（2）存货跌价准备计提情况

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货的可变现净值低于其账面价值的，以差额计提存货跌价准备。报告期各期末，公司计提的存货跌价准备余额分别为 669.00 万元、637.20 万元及 958.82 万元。

报告期内，发行人产品销售情况良好，存货不存在大幅跌价的风险，存货跌价准备计提充足。

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产明细如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
预缴税费	314.17	0.76	72.29
待认证进项税额	1.76	0.01	15.01
留抵税额	-	575.29	1,320.94
上市中介费用	-	481.13	254.72
合计	**315.93**	**1,057.19**	**1,662.96**

公司其他流动资产主要为留抵税额、上市中介费用和预缴税费。2025 年度，公司前次申报中介费用由其他流动资产转入管理费用。

（三）非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
固定资产	34,426.25	81.58	29,291.02	72.45	28,808.41	83.66
在建工程	607.40	1.44	5,317.65	13.15	704.16	2.04
使用权资产	164.71	0.39	275.42	0.68	237.21	0.69
无形资产	3,010.98	7.14	3,056.70	7.56	3,113.71	9.04
商誉	132.86	0.31	132.86	0.33	132.86	0.39
长期待摊费用	203.04	0.48	134.68	0.33	221.16	0.64
递延所得税资产	913.69	2.17	1,041.89	2.58	1,123.82	3.26
其他非流动资产	2,739.56	6.49	1,177.53	2.91	92.85	0.27
合计	**42,198.50**	**100.00**	**40,427.75**	**100.00**	**34,434.19**	**100.00**

报告期各期末，公司非流动资产账面价值分别为 34,434.19 万元、40,427.75 万元及 42,198.50 万元。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程及无形资产组成，报告期各期末，上述资产占非流动资产的比例分别为 94.74%、93.17%及 90.16%。

1、固定资产

（1）固定资产的构成

截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产主要为房屋及建筑物和机器设备，

各类固定资产维护和运行状况良好，综合成新率约为 35.42%，具体构成情况如下：

资产类别	折旧年限（年）	账面原值（万元）	账面净值（万元）	成新率
房屋及建筑物	10-20	25,305.84	20,042.59	79.20%
机器设备	5-10	69,614.37	13,751.58	19.75%
运输工具	5	835.69	112.25	13.43%
电子设备及其他	5	1,445.63	519.83	35.96%
合计	-	**97,201.53**	**34,426.25**	**35.42%**

（2）固定资产变动分析

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31			
	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	25,305.84	5,263.25	20,042.59	79.20%
机器设备	69,614.37	55,862.79	13,751.58	19.75%
运输工具	835.69	723.44	112.25	13.43%
电子设备及其他	1,445.63	925.80	519.83	35.96%
合计	**97,201.53**	**62,775.28**	**34,426.25**	**35.42%**
项目	**2024.12.31**			
	账面原值	**累计折旧**	**账面价值**	**成新率**
房屋及建筑物	22,277.17	3,908.73	18,368.44	82.45%
机器设备	61,723.99	51,461.12	10,262.86	16.63%
运输工具	863.84	721.84	141.99	16.44%
电子设备及其他	1,305.98	788.26	517.72	39.64%
合计	**86,170.97**	**56,879.96**	**29,291.02**	**33.99%**
项目	**2023.12.31**			
	账面原值	**累计折旧**	**账面价值**	**成新率**
房屋及建筑物	20,968.82	2,907.77	18,061.04	86.13%
机器设备	58,695.56	48,326.61	10,368.95	17.67%
运输工具	868.28	724.48	143.80	16.56%
电子设备及其他	1,029.94	795.33	234.62	22.78%
合计	**81,562.59**	**52,754.19**	**28,808.41**	**35.32%**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 28,808.41 万元、29,291.02 万元及 34,426.25 万元，占非流动资产的比例分别为 83.66%、72.45%及 81.58%。固定资产增加系公司为扩大生产规模加大厂房、机器设备等资产的投入所致。

（3）公司固定资产折旧年限与同行业可比上市公司对比情况

公司各类固定资产折旧年限与同行业可比上市公司相比不存在显著差异，具体情况如下：

单位：年

资产类别	泰晶科技	惠伦晶体	晶赛科技	东晶电子	发行人
房屋及建筑物	20-25	10-30	20-30	30	10-20
机器设备	5-10	5-10	5-10	10	5-10
运输工具	5-10	5	3-8	10	5
电子设备及其他	3-5	3-10	3-10	5-10	5

注：同行业可比上市公司固定资产折旧年限摘自各公司定期报告。

（4）固定资产减值情况

报告期各期末，公司主要固定资产运行和使用状况良好，各单项资产或资产组未发生因市价大幅度下跌、陈旧、损坏、长期闲置和经济绩效低于预期而导致的可收回金额低于其账面价值的情况，无需计提固定资产减值准备。

（5）固定资产成新率分析

1）固定资产成新率总体情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备及其他的成新率分别为 79.20%、19.75%、13.43%及 35.96%，除房屋及建筑物外，总体成新率较低，主要原因系公司部分固定资产购置时间较为久远，计提折旧时间较长，且运输设备、电子设备等折旧年限相对较短，使得报告期末公司固定资产成新率较低。

2）固定资产成新率低对公司生产经营的影响

报告期内公司运输设备、电子设备及其他等固定资产虽然成新率较低，但仍可正常运行并满足生产经营需要，且市场供应充足，单位价值相对较低，可替代性较强，成新率低不会对公司的生产经营产生不利影响。

报告期内公司的机器设备成新率较低，但从实际使用状况看，一方面公司

会通过日常精心保养维护、定期专业检修来延长主要生产设备的使用寿命，部分设备虽已到折旧年限，但其使用情况良好；另一方面公司持续引进新设备，对核心生产设备进行更新换代，使现有机器设备与公司的生产能力相匹配，保证生产的连续性和稳定性。

综上，报告期内公司固定资产虽成新率较低，但不会对公司的产能产量及产品质量造成影响，不存在因此导致的停工停产及其他对生产经营的不利影响。

2、在建工程

报告期各期末，公司在建工程明细情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
德清石英晶体元器件生产基地建设项目	164.53	1,650.45	586.21
已到厂未验收的设备	32.68	3,023.98	111.35
外购软件	364.14	-	-
其他	46.05	643.22	6.60
合计	**607.40**	**5,317.65**	**704.16**

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 704.16 万元、5,317.65 万元及 607.40 万元，占非流动资产的比例分别为 2.04%、13.15%及 1.44%。2024 年末，公司已到厂未验收的设备金额较大主要系为实施建设项目购置生产设备尚未完成安装验收所致。2025 年末，外购软件金额较大主要系公司为提升管理水平外购的软件产品尚未完成配置和测试工作所致。

报告期各期末，公司主要在建工程均与公司主营业务密切相关，旨在提升产能和盈利能力。公司在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

3、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产的具体情况如下：

单位：万元

项　目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
房屋建筑物	164.71	275.42	237.21
合计	**164.71**	**275.42**	**237.21**

报告期各期末，公司使用权资产金额分别为 237.21 万元、275.42 万元及

164.71 万元，占非流动资产的比例为 0.69%、0.68%及 0.39%，主要由租赁的房屋建筑物构成。

4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		
	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	3,310.22	458.49	2,851.74
软件	762.66	605.28	157.38
商标权	15.54	13.68	1.86
合计	**4,088.42**	**1,077.44**	**3,010.98**
项目	**2024.12.31**		
	账面原值	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	3,310.22	391.10	2,919.12
软件	673.68	536.34	137.34
商标权	13.72	13.49	0.23
合计	**3,997.63**	**940.93**	**3,056.70**
项目	**2023.12.31**		
	账面原值	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	3,310.22	323.71	2,986.51
软件	605.34	479.56	125.78
商标权	13.72	12.30	1.42
合计	**3,929.28**	**815.57**	**3,113.71**

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 3,113.71 万元、3,056.70 万元及 3,010.98 万元，占非流动资产的比例分别为 9.04%、7.56%及 7.14%，主要由土地使用权和软件构成。

报告期各期末，公司无形资产使用状况良好，不存在减值迹象，无需计提减值准备。

5、商誉

（1）商誉总体情况

报告期各期末，公司商誉的总体情况如下：

单位：万元

被投资单位名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
金华鸿瑞	132.86	132.86	132.86
合计	**132.86**	**132.86**	**132.86**

报告期各期末，公司商誉均为 132.86 万元，系 2007 年公司收购金华鸿瑞形成。

（2）商誉形成情况

2007 年度，公司因收购金华鸿瑞形成商誉 132.86 万元，具体计算情况如下：

单位：万元

项目	金额
合并成本合计	750.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	617.14
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	132.86

2007 年 12 月 12 日，华瑞电子与鸿星有限签署《股权转让协议》，华瑞电子将其持有的金华鸿瑞 100%股权以人民币 750.00 万元的价格转让给鸿星有限，2007 年 12 月 24 日财产权转移手续办理完毕。此次收购为非同一控制下企业合并，金华鸿瑞 2007 年 12 月 31 日的账面净资产为 617.14 万元，本次收购合并成本 750.00 万元与取得的可辨认净资产公允价值份额的差额 132.86 万元确认为商誉。

（3）商誉减值情况

报告期各期末，公司对相关资产组进行商誉减值测试，将相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，则相关差额计提商誉减值准备。相关资产组可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流的现值两者之间较高者确认。

经减值测试，公司商誉不存在需要计提减值的情况。

6、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用金额分别为 221.16 万元、134.68 万元及 203.04 万元，占非流动资产的比例分别为 0.64%、0.33%及 0.48%，主要为待摊销的装修费和软件费等。

7、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产组成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	1,075.18	177.25	2,274.92	360.33	2,538.01	402.58
资产减值损失	1,777.13	318.31	1,380.73	253.57	1,422.15	250.76
内部交易未实现利润	1,189.86	215.62	1,350.96	238.22	882.33	135.18
未使用的职工教育经费	955.46	170.70	771.73	136.87	603.83	103.97
租赁负债	166.09	31.07	234.56	43.84	206.18	43.61
可抵扣亏损	4.44	0.73	2.40	0.39	714.05	178.51
其他	-	-	34.66	8.68	36.79	9.20
合计	**5,168.17**	**913.69**	**6,049.96**	**1,041.89**	**6,403.36**	**1,123.82**

报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 1,123.82 万元、1,041.89 万元及 913.69 万元，占非流动资产的比例分别为 3.26%、2.58%及 2.17%，主要系递延收益、资产减值损失、内部交易未实现利润和未使用的职工教育经费等引起的时间性差异产生。

8、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产组成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
预付土地购买款	2,283.87	-	-
预付设备款	455.70	1,177.53	92.85
合计	**2,739.56**	**1,177.53**	**92.85**

报告期各期末，公司其他非流动资产的余额分别为 92.85 万元、1,177.53 万元及 2,739.56 万元，占非流动资产的比例分别为 0.27%、2.91%及 6.49%，主要为公司预付土地购买款和预付供应商的设备购置款。

2024 年末，预付设备款增长较多，主要系为实施建设项目购置生产设备所致。2025 年末，新增预付土地购买款主要系公司新设 HOSONIC THAI 作为境

外生产基地购置土地并支付预付款所致。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转率如下：

单位：次

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率	3.75	3.50	3.23
存货周转率	3.01	3.04	2.83

1、应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司比较情况如下：

单位：次

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	3.49	3.20	3.26
惠伦晶体	2.90	3.04	2.64
晶赛科技	4.96	5.24	4.27
东晶电子	4.34	3.25	2.92
平均值	**3.92**	**3.68**	**3.27**
公司值	**3.75**	**3.50**	**3.23**

注：以上数据来源于可比公司定期报告。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.23 次、3.50 次及 3.75 次，应收账款周转率总体保持稳定，公司对应收账款催收及时，下游客户回款情况较好。

公司应收账款周转率和同行业可比公司相比不存在重大差异，应收账款周转率的波动趋势和同行业可比公司基本保持一致。公司非常重视应收账款的管理，应收账款催收及时，报告期各期末应收账款账龄均在一年以内，且公司下游客户优质，回款情况良好。

2、存货周转率

报告期内，公司存货周转率与同行业可比公司比较情况如下：

单位：次

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
泰晶科技	2.93	2.89	3.08
惠伦晶体	1.64	1.57	1.16

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
晶赛科技	3.24	3.45	2.87
东晶电子	3.18	2.21	1.58
平均值	**2.75**	**2.53**	**2.17**
公司	**3.01**	**3.04**	**2.83**

注：以上数据来源于可比公司定期报告。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.83 次、3.04 次及 3.01 次，整体保持在较高水平，存货周转情况良好。

公司存货周转率高于同行业可比公司平均水平，主要系公司实行“以销定产+适度备货”的生产模式，严格把控存货的库存管理，存货积压情况较少，经营效率较高所致。

十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债状况分析

1、负债规模与结构分析

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
流动负债	30,836.28	96.15	22,627.74	89.97	15,252.69	71.38
非流动负债	1,234.77	3.85	2,523.33	10.03	6,114.65	28.62
负债总额	**32,071.05**	**100.00**	**25,151.07**	**100.00**	**21,367.34**	**100.00**

报告期各期末，公司负债总额分别为 21,367.34 万元、25,151.07 万元及 32,071.05 万元。公司流动负债占负债总额的比例分别为 71.38%、89.97%及 96.15%，是公司负债主要组成部分。2024 年末流动负债金额及占比增加主要系新增短期借款所致；2025 年末流动负债金额及占比增加主要系公司新增应付股利所致。

2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
短期借款	9,505.73	30.83	8,005.78	35.38	1,501.38	9.84
应付账款	6,425.80	20.84	8,600.85	38.01	7,777.91	50.99
合同负债	55.13	0.18	8.75	0.04	4.53	0.03
应付职工薪酬	4,929.80	15.99	4,580.33	20.24	4,500.05	29.50
应交税费	705.20	2.29	1,065.90	4.71	536.69	3.52
其他应付款	9,133.54	29.62	252.52	1.12	238.34	1.56
一年内到期的非流动负债	74.85	0.24	112.30	0.50	693.68	4.55
其他流动负债	6.23	0.02	1.32	0.01	0.11	0.01
合计	**30,836.28**	**100.00**	**22,627.74**	**100.00**	**15,252.69**	**100.00**

公司的流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款构成。报告期各期末，上述负债占流动负债的比重分别为 95.42%、99.46%及 99.56%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
信用借款	9,505.73	8,005.78	1,501.38
合计	**9,505.73**	**8,005.78**	**1,501.38**

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 1,501.38 万元、8,005.78 万元和 9,505.73 万元，占流动负债的比例分别为 9.84%、35.38%和 30.83%。

公司短期借款均系流动资金借款，不存在利息资本化的情况。

（2）应付账款

1）报告期内应付账款余额按款项性质分类情况

报告期各期末，公司应付账款明细情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应付商品采购款	4,801.71	4,552.00	3,805.47

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应付设备工程款	1,398.28	3,699.02	3,548.72
应付其他款项	225.81	349.82	423.72
合计	**6,425.80**	**8,600.85**	**7,777.91**

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 7,777.91 万元、8,600.85 万元及 6,425.80 万元，占流动负债的比例分别为 50.99%、38.01%及 20.84%。

公司应付账款主要包括应付商品采购款和应付设备工程款等。2024 年末，应付商品采购款增加较多，主要系随着下游行业回暖，市场需求增加，公司采购规模有所上升。

2）报告期内应付账款前五大情况

单位：万元

时间	单位名称	期末余额	占比	账龄	是否为关联方
2025.12.31	香港三环电子有限公司	1,360.94	21.18%	一年以内	非关联方
	时尚科技	442.86	6.89%	一年以内	非关联方
	中设建工集团有限公司	429.03	6.68%	一至两年	非关联方
	西铁城	381.64	5.94%	一年以内	非关联方
	合肥晶威特电子有限责任公司	244.63	3.81%	一年以内	非关联方
	合计	**2,859.09**	**44.49%**	-	-
2024.12.31	香港三环电子有限公司	1,507.62	17.53%	一年以内	非关联方
	SHOWA SHINKU CO.,LTD.	835.89	9.72%	一年以内	非关联方
	中设建工集团有限公司	448.53	5.21%	一年以内	非关联方
	浙江尚品机电工程有限公司	417.22	4.85%	一年以内	非关联方
	时尚科技	348.63	4.05%	一年以内	非关联方
	合计	**3,557.90**	**41.37%**	-	-
2023.12.31	中设建工集团有限公司	2,726.36	35.05%	一年以内	非关联方
	香港三环电子有限公司	1,169.45	15.04%	一年以内	非关联方
	西铁城	568.55	7.31%	一年以内	非关联方
	浙江尚品机电工程有限公司	410.01	5.27%	一年以内	非关联方
	时尚科技	409.20	5.26%	一年以内	非关联方
	合计	**5,283.57**	**67.93%**	-	-

（3）合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
合同负债	55.13	8.75	4.53
合计	**55.13**	**8.75**	**4.53**

报告期各期末，公司合同负债金额分别为 4.53 万元、8.75 万元及 55.13 万元，总体金额较小，均为预收的商品销售款。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 4,500.05 万元、4,580.33 万元及 4,929.80 万元，占流动负债的比例分别为 29.50%、20.24%及 15.99%，主要包括工资、奖金、津贴、社会保险费等，总体保持稳定。

（5）应交税费

报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
房产及土地使用税	252.63	234.83	118.49
企业所得税	197.99	619.91	289.89
增值税	172.39	108.92	38.93
城市维护建设税	17.35	23.89	19.78
个人所得税	16.05	18.32	14.16
印花税	11.00	11.30	9.18
教育费附加	7.52	10.28	8.57
地方教育费附加	5.02	6.86	5.71
其他	25.25	31.60	31.99
合计	**705.20**	**1,065.90**	**536.69**

报告期各期末，公司应交税费分别为 536.69 万元、1,065.90 万元及 705.20 万元，占流动负债的比例分别为 3.52%、4.71%及 2.29%。公司应交税费主要由期末已计提尚未缴纳的企业所得税和应交房产及土地使用税等构成。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款明细情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应付股利	8,873.63	-	-
押金保证金	121.17	121.17	137.83
代扣代缴款项	1.15	0.54	0.09
其他	137.60	130.81	100.41
合计	**9,133.54**	**252.52**	**238.34**

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 238.34 万元、252.52 万元及 9,133.54 万元，占流动负债的比例分别为 1.56%、1.12%及 29.62%，主要由应付股利及押金保证金构成。

2025 年末，公司应付股利余额为 8,873.63 万元，主要系公司分配股利所致。关于公司报告期内的分红情况，详见本章节之“十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（三）报告期股利分配的具体实施情况”。

（7）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的明细如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
一年以内到期的长期借款	-	-	487.50
一年内到期的租赁负债	74.85	112.30	206.18
合计	**74.85**	**112.30**	**693.68**

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债金额分别为 693.68 万元、112.30 万元及 74.85 万元，占流动负债的比例分别为 4.55%、0.50%及 0.24%。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债明细如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
待转销项税额	6.23	1.32	0.11

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
合计	6.23	1.32	0.11

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 0.11 万元、1.32 万元及 6.23 万元，金额较小，均为预收货款的待转销项税额。

3、非流动负债分析

报告期各期末，公司的非流动负债由长期借款、租赁负债、递延收益和递延所得税负债构成。公司非流动负债构成情况如下：

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
长期借款	-	-	-	-	3,415.97	55.87
租赁负债	91.24	7.39	122.26	4.85	-	-
递延收益	1,075.18	87.08	2,274.92	90.16	2,538.01	41.51
递延所得税负债	68.35	5.54	126.15	5.00	160.67	2.63
合计	1,234.77	100.00	2,523.33	100.00	6,114.65	100.00

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款明细如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
保证借款	-	-	3,415.97
合计	-	-	3,415.97

2023 年末，公司长期借款系浙江鸿星借款用于德清石英晶体元器件生产基地建设项目，相关借款已于 2024 年归还。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债明细如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
租赁付款额	91.24	122.26	-
合计	91.24	122.26	-

报告期各期末，公司租赁负债期末余额分别为 0.00 万元、122.26 万元及 91.24 万元，占非流动负债的比例分别为 0.00%、4.85%及 7.39%，金额及占比较小。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益的明细如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
政府补助	1,075.18	2,274.92	2,538.01
合计	**1,075.18**	**2,274.92**	**2,538.01**

报告期各期末，公司递延收益的金额分别为 2,538.01 万元、2,274.92 万元及 1,075.18 万元，占非流动负债的比例分别为 41.51%、90.16%及 87.08%，均为与资产相关的政府补助，明细如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
年产 3 亿个石英晶体元器件（谐振器）技改项目	607.59	1,407.74	1,058.23
新增年产 1.5 亿个石英晶体元器件（谐振器）技改项目	295.30	614.46	1,098.50
年产 8 亿个 5G 应用微型片式石英晶体元器件研发及产业化项目	154.77	175.46	196.16
新增年产 4 亿个石英晶体元器件（谐振器）技改项目	0.11	22.45	95.73
进口贴息补助	12.46	39.31	66.75
年产高频率片 3.5 亿片项目	4.96	15.49	22.65
合计	**1,075.18**	**2,274.92**	**2,538.01**

（4）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债金额分别为 160.67 万元、126.15 万元及 68.35 万元，占非流动负债的比例分别为 2.63%、5.00%及 5.54%，主要为固定资产加速折旧及使用权资产产生的暂时性差异。

（二）偿债能力分析

1、未来需偿还的负债及利息与偿债能力分析

截至 2025 年末，公司需要偿还的主要负债为短期借款、应付账款和其他应

付款等。其中，需偿还借款余额为 9,505.73 万元，应付账款余额为 6,425.80 万元，主要包括应付商品采购款、应付设备工程款等；其他应付款余额为 9,133.54 万元，主要为应付的股利和押金保证金。

报告期各期末，公司资产规模逐步扩大，截至 2025 年末，公司货币资金余额为 70,154.54 万元，总资产达 147,809.48 万元。2025 年度，公司营业收入为 63,212.05 万元，净利润为 10,832.13 万元，盈利能力较强。

综上所述，借款规模相较于公司经营规模而言相对较小，公司不存在可预计的未来无法偿还负债的风险。

2、主要偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债指标情况如下：

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	3.42	4.36	5.73
速动比率（倍）	3.00	3.86	5.14
资产负债率（%，合并）	21.70	18.08	17.54
资产负债率（%，母公司）	25.11	20.77	14.73
项目	**2025 年度**	**2024 年度**	**2023 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	18,684.35	20,340.96	19,797.79
利息保障倍数（倍）	106.39	101.13	113.97

（1）资产负债率分析

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 17.54%、18.08%及 21.70%，整体处于较低水平，公司资产负债结构合理，偿债能力较强，资信情况良好，公司拟持续加大对主营业务以及研发的投入，不断改善资本结构，助力公司持续发展。

（2）短期偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 5.73 倍、4.36 倍及 3.42 倍，速动比率分别为 5.14 倍、3.86 倍及 3.00 倍，短期偿债能力良好，偿债风险较低。

（3）利息保障倍数及息税折旧摊销前利润分析

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 19,797.79 万元、20,340.96 万

元及 18,684.35 万元，利息保障倍数分别为 113.97 倍、101.13 倍及 106.39 倍。公司息税折旧摊销前利润的变动趋势与盈利水平的变动情况匹配，利息保障倍数保持在较高的水平，息税折旧摊销前利润远高于利息支出，整体偿债能力较强。

（4）与同行业可比公司偿债能力指标比较分析

报告期各期末，公司短期偿债能力指标与同行业可比上市公司比较情况如下：

单位：倍

公司	项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
泰晶科技	流动比率	3.66	4.24	5.50
	速动比率	2.74	3.38	4.60
惠伦晶体	流动比率	0.95	1.14	1.08
	速动比率	0.62	0.71	0.60
晶赛科技	流动比率	1.22	1.32	1.60
	速动比率	0.71	0.78	1.08
东晶电子	流动比率	0.93	1.27	1.45
	速动比率	0.66	0.87	0.99
算术平均值	**流动比率**	**1.69**	**1.99**	**2.41**
	速动比率	**1.18**	**1.44**	**1.82**
发行人	**流动比率**	**3.42**	**4.36**	**5.73**
	速动比率	**3.00**	**3.86**	**5.14**

注：以上数据来源于可比公司定期报告。

报告期各期末，公司长期偿债能力指标与同行业可比公司比较情况如下：

项目	资产负债率（合并，%）		
	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
泰晶科技	17.82	17.76	13.30
惠伦晶体	67.44	61.91	52.05
晶赛科技	41.99	37.62	34.25
东晶电子	68.45	52.99	41.67
算术平均值	**48.93**	**42.57**	**35.32**
发行人	**21.70**	**18.08**	**17.54**

注：以上数据来源于可比公司定期报告。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率、资产负债率等偿债指标均处于合理水平，流动比率和速动比率均高于可比公司平均水平，资产负债率总体低于可比公司平均水平，公司流动性风险较低，偿债能力较强。

（三）报告期股利分配的具体实施情况

报告期内，公司实际进行了 1 次股利分配，情况如下：

2025 年 12 月，公司召开股东会，审议通过了董事会利润分配的提案，决定公司向全体股东分配现金股利 8,873.63 万元（含税），截至本招股说明书签署日，前述利润分配已实施完毕。

除上述利润分配情况外，报告期内公司未进行其他利润分配，资产负债表日后不存在利润分配以及拟分配利润的情形。

（四）现金流量分析

1、公司报告期现金流量情况

报告期内，公司现金流量构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	16,525.64	17,289.62	20,889.50
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,038.09	-7,491.56	-9,345.75
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,158.85	1,928.73	-6,019.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,311.65	697.08	140.95
五、现金及现金等价物净增加额	7,334.75	12,423.87	5,664.98

2、经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	65,757.99	59,158.55	61,126.16
收到的税费返还	3,153.75	1,852.26	619.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,663.55	3,655.45	4,342.51
经营活动现金流入小计	**72,575.30**	**64,666.25**	**66,088.41**
购买商品、接受劳务支付的现金	33,324.27	27,694.09	25,187.18

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	16,265.28	14,925.92	14,056.02
支付的各项税费	3,408.22	2,306.29	3,529.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,051.89	2,450.33	2,426.31
经营活动现金流出小计	**56,049.66**	**47,376.63**	**45,198.90**
经营活动产生的现金流量净额	**16,525.64**	**17,289.62**	**20,889.50**

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金有所波动，与公司营业收入和营业成本变动趋势匹配。

报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	426.48	1,504.61	2,874.28
暂收款及收回暂付款	639.11	90.70	353.06
存款利息收入	2,497.25	1,998.98	977.66
其他	100.72	61.16	137.50
合计	**3,663.55**	**3,655.45**	**4,342.51**

报告期内，公司支付的各项税费金额分别为 3,529.40 万元、2,306.29 万元及 3,408.22 万元，主要为缴纳的企业所得税款。

报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
费用性支出	2,151.46	2,026.64	1,932.06
暂付款与偿还暂收款	547.88	93.77	94.90
其他支出	352.55	329.93	399.35
合计	**3,051.89**	**2,450.33**	**2,426.31**

报告期内公司实现的净利润与经营活动产生的现金流量净额的调节关系如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	10,832.13	13,303.66	13,290.75
加：信用减值损失	33.39	32.53	-119.19

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
资产减值准备	604.68	265.46	391.91
固定资产折旧	6,030.96	4,563.45	4,316.50
使用权资产折旧	190.34	235.26	235.90
无形资产摊销	136.52	125.36	117.62
长期待摊费用摊销	113.90	161.86	134.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1.98	-1.66	-1.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11.49	93.84	62.10
财务费用（收益以“－”号填列）	1,245.44	-302.17	57.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-148.72	-247.64	-311.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	128.20	81.93	-270.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-57.80	-34.52	-76.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,494.47	-2,651.05	1,350.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	554.61	1,958.51	2,817.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-692.63	-359.86	-1,116.76
其他	39.60	64.67	10.68
经营活动产生的现金流量净额	**16,525.64**	**17,289.62**	**20,889.50**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额整体较高，体现出了公司良好的经营活动创造现金流的能力。公司销售收款情况正常，营业收入转化为现金的能力良好，各期经营活动产生的现金流量净额高于净利润。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 20,889.50 万元、17,289.62 万元及 16,525.64 万元，分别比当期净利润高 7,598.75 万元、3,985.96 万元及 5,693.51 万元，主要系固定资产折旧、经营性应收项目的减少等综合影响所致。

总体而言，剔除折旧和往来款项变动的影响，报告期内公司经营活动现金流量净额与净利润基本匹配。

3、投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	5,351.24	6,655.72	8,206.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.49	6.38	4.03
收到其他与投资活动有关的现金	-	473.51	-
投资活动现金流入小计	**5,356.73**	**7,135.61**	**8,210.46**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,894.82	11,653.66	7,447.95
投资支付的现金	2,500.00	2,500.00	10,108.27
支付其他与投资活动有关的现金	-	473.51	-
投资活动现金流出小计	**14,394.82**	**14,627.17**	**17,556.21**
投资活动产生的现金流量净额	**-9,038.09**	**-7,491.56**	**-9,345.75**

报告期各期，公司投资活动产生的现金流净额变动主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、购买及赎回理财产品净额变动。

报告期内，公司持续加大长期资产的投入力度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 7,447.95 万元、11,653.66 万元及 11,894.82 万元。

报告期各期，公司为提高闲置现金的使用效率，购买结构性存款类等银行理财产品，公司投资支付的现金和收回投资收到的现金主要为购买或赎回此类银行理财产品产生的现金流。

4、筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	15.51	-	-
取得借款收到的现金	10,200.00	8,000.00	1,500.00
筹资活动现金流入小计	**10,215.51**	**8,000.00**	**1,500.00**
偿还债务支付的现金	8,700.00	5,400.00	2,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198.30	187.57	4,655.93
支付其他与筹资活动有关的现金	158.36	483.71	563.79
筹资活动现金流出小计	9,056.66	**6,071.27**	**7,519.72**

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动产生的现金流量净额	1,158.85	1,928.73	-6,019.72

2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净流出金额较大，主要系公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金金额较高所致。

报告期内，公司取得借款收到的现金分别为 1,500.00 万元、8,000.00 万元及 10,200.00 万元，偿还债务支付的现金为 2,300.00 万元、5,400.00 万元及 8,700.00 万元，系公司根据自身流动资金情况取得或偿还的银行借款。

（五）流动性风险分析

报告期各期末，公司负债以流动负债为主，占比分别为 71.38%、89.97%及 96.15%，负债结构较为稳定，其中流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬及其他应付款构成，合计占流动负债的比例分别为 91.90%、94.75%及 97.27%。短期借款、应付账款、应付职工薪酬系公司日常经营性负债，均与生产经营密切相关，其他应付款主要为应付股利，并无重大对外举债的情形。报告期内公司流动比率和速动比率均高于可比公司平均水平，资产负债率总体低于可比公司平均水平，公司资金储备较为充足、偿债能力较强、流动性风险较低。本次募集资金到位后将进一步降低公司的流动性风险，推动公司长期、稳定、可持续发展。

（六）持续经营能力分析

报告期内，公司整体财务状况保持良好，生产经营情况稳定，经营活动现金流量充裕，财务风险较低。从盈利能力来看，报告期内公司业绩规模较大，盈利能力较强，公司未出现影响持续经营能力的重大不利变化。

公司主营业务隶属于国家战略性新兴产业，产品广泛应用于通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制、汽车电子、AI 算力、机器人等领域，未来市场前景较为广阔，积累了以知名电子品牌商、通信设备制造商及电子制造服务商为代表的优质客户资源，广泛的应用领域、广阔的市场前景和优质的客户资源有力保障了公司持续经营能力。

未来，公司将深度结合市场发展前景和客户需求，持续加大产品的研发投入，进一步巩固和提高公司的市场地位和核心竞争力，提升公司盈利能力，随

着募集资金的到位和募投项目的实施，公司技术研发能力、生产经营能力等将得到进一步提升，公司具备良好的持续经营能力。

十二、重大资本性支出与资产业务重组情况

（一）重大资本性支出情况

1、报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 7,447.95 万元、11,653.66 万元及 11,894.82 万元，主要系公司为提高生产经营能力和产品市场竞争力，增加固定资产及在建工程投入而发生的资本性支出。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

在未来两到三年，公司重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资项目，具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（二）资产业务重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项

（一）日后事项

2026 年 1 月 20 日，公司股东冯信和分别与代祖明、桂志义、何东升、江燕、闫翠华、杨耀中、杭州湛洋签订《股权转让协议》，公司前股东刘强与杭州湛洋签订《股权转让协议》。上述股权转让具体情况详见“第四节 发行人基本情况”之“三、报告期内股本、股东变化情况”。

除上述事项外，发行人不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

（三）重大担保事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重大担保事项。

（四）重大诉讼事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼事项。

（五）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他需要披露的重要事项。

十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

本招股说明书已披露的财务报告的审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况详见本招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、本次募集资金运用概况

（一）募集资金总额及使用计划

公司拟公开发行 4,930.6188 万股普通股，发行募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目	鸿星科技	32,240.00	32,240.00
2	新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目	浙江鸿星	15,960.00	14,860.00
3	基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目	鸿星科技	10,000.00	10,000.00
4	数智化制造与运营管理平台升级建设项目	鸿星科技	7,900.00	7,900.00
合计			**66,100.00**	**65,000.00**

若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，发行人将通过银行借款等方式自筹解决。在本次公开发行募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。

（二）募集资金专项存储制度的建立及执行情况

公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理等方面进行了详尽规定。公司募集资金实施专户存储制度，募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行募集资金到位后，公司将及时、完整地将募集资金集中存放于募集资金专户，并在规定时间内与募集资金存管银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，从而确保募集资金专项存储制度能够得到有效执行。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和对业务创新、创造、创意的支持作用。

“新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目”“新增 5 亿只微型

化及高精度石英晶体元器件项目”实施后将有效扩大现有主营业务产品的产能规模，有效解决产能瓶颈问题，丰富公司的产品系列，有助于公司主营业务发展。本次募集资金投资项目紧密围绕发展战略开展，在巩固现有产品生产能力的同时，重点向微型化、高频化、高精度、低抖动及宽温化等方向大幅扩大高技术含量产品的供给，并进一步提高生产效率，实现降本增效，助力公司实现全产业链自主可控，巩固在中高端石英晶振领域的市场地位，为长期战略布局提供支撑，是公司整体提升竞争能力和盈利能力的重要举措。

“基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目”拟通过搭建专业的研发实验室、购置高端设备、引进优秀技术人才，重点开展 MEMS（微机电系统）光刻技术、微型化、高精度、特定应用场景下晶振产品等课题研发。项目实施后有助于公司前瞻布局相关工艺预研，助力丰富产品矩阵，推动现有产品生产工艺升级与综合性能提升的同时，加速超小型化、超高频产品的研发及量产进程，从而巩固在中高端石英晶振市场的竞争优势。

“数智化制造与运营管理平台升级建设项目”拟在现有信息化和数字化基础条件上，升级生产制造、运营决策、市场经营及技术研发等软硬件条件。项目实施后可助力公司推进智能制造转型，达到生产透明化、质量可追溯、研发数字化及决策智能化，显著提升数字化能力与核心竞争力。

（四）募集资金投资项目的确定依据及其实施影响

1、与公司主营业务相适应

公司主营业务为石英晶体元器件的研发、生产和销售。本次募集资金投资项目中，“新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目”和“新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目”主要是对公司现有产能的扩充，有利于增强机器设备、生产线的精度和自动化、智能化水平，大幅扩大高技术含量产品的供给，并进一步提高生产效率，实现降本增效；“基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目”系根据业务发展需求设置研发方向，引进先进技术设备和相关技术人才，开展相关研究，巩固和增强公司技术研发和产品优势，扩展销售产品种类、优化公司产品结构，巩固和提高市场竞争能力，为公司带来可持续的经济效益。“数智化制造与运营管理平台升级建设项目”旨在以数字化手段优化生产与管理流程，一方面提升运营效率与成本控制

水平，强化集团化管控并推动业务全面线上化；另一方面助力打通研发与生产数据闭环，通过统一管理研发数据、回流工艺质量信息、构建企业知识库，为产品创新与迭代升级提供持续支撑。因此，本次募集资金投资项目与现有主营业务紧密相关。

2、与公司生产经营规模相适应

公司当前产能已趋于饱和，随着公司对既有客户需求的深入挖掘，以及新客户的持续拓展，现有产能不足已经成为制约公司发展的重要问题。公司虽能通过外购成品解决部分产能瓶颈问题，但从产品质量及成本的可控性来说，自主生产更具优势，因此公司有必要扩大生产能力。本次募集资金投资项目实施以公司现有核心技术、产品为基础，通过扩建产线和研发中心，进一步扩大产能、增强技术研发水平，拓展业务规模。因此，本次募集资金投资项目与现有生产经营规模相适应。

3、与公司财务状况相适应

公司资产质量良好，经营性现金流稳健，资产负债结构合理，具有持续盈利能力，财务状况良好。随着募投项目的建设投入，公司将面临较大的项目建设资金和流动资金需求，仅仅依靠自身经营积累和银行借款筹集资金存在一定的困难，且财务成本较高，资金流动性水平会显著下降。本次拟使用募集资金对相关项目进行投资，能够有效满足公司经营规模扩张带来的资金需求，并减少负债规模和节省财务费用，保障资产结构安全。因此，本次募集资金投资项目与公司财务状况相适应。

4、与公司技术条件相适应

公司专注于石英晶体元器件领域，坚持定位行业前沿技术进行研发创新，并积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断产出能满足客户需求的新产品，以此保持突出的自主创新能力和竞争地位。公司通过核心技术的不断积累，已在技术创新与储备、技术成果转化等方面形成一系列优势，为本次募投项目的实施提供技术支持。

在技术创新与储备方面，凭借优秀的研发团队和持续增加的研发投入，公司形成了强大的技术研发能力。公司内部研发机构被浙江省科学技术厅评定为

“省级高新技术企业研究开发中心”。公司作为“浙江省高新技术企业”，积极通过专利申请等方式对创新技术成果予以保护，以巩固提升公司在行业内的竞争地位。

技术成果转化方面，公司持续积极研究创新性技术的同时，不断将先进技术转化为技术成果。公司已掌握石英晶体振荡器、谐振器产品的核心技术，核心材料实现自产，为公司石英晶体产品的持续生产提供充分的技术支持。基于核心技术良好的成果转换效果，公司产品广泛获得品牌厂商、芯片设计商、终端客户的认证。

综上所述，公司强大的技术创新与储备以及良好的技术成果转化能力，在提高产品开发效率和生产效率、满足客户对于产品供应效率需求的同时，也确保公司紧随行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发出性能强、质量稳定的石英晶体元器件产品，深度挖掘现有客户需求潜力并吸引潜在客户，为本项目实施提供强大的技术支持，从而能够保障项目的顺利实施。

5、与公司管理能力相适应

公司已形成了稳定的管理团队，主要管理人员均已在公司工作多年，积累了丰富的经营管理经验，为公司技术研发、原材料和设备采购、稳定生产、市场拓展和产品销售、规范运作等奠定了丰富的人力资源基础。因此，本次募集资金投资项目与公司现有管理能力相适应。

6、与公司发展目标相适应

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，是对发行人现有核心业务的强化、拓展与提升，也是发行人落实发展战略的重要举措。通过实施 7 亿只频率控制元器件产品优化及产能扩建项目与 5 亿只微型化高精度石英晶体元器件项目，发行人将进一步巩固并提升市场地位；依托 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目，在现有技术基础上开展产品优化，丰富并延伸产品线，加快布局 5G-A/6G 通信、汽车电子、智能终端、AI 算力等高端应用市场，全面增强综合竞争力；通过数智化制造与运营管理平台升级建设项目，实现智能制造与技术研究的数据联动，提升技术信息支撑能力，助力产品与工艺的持续开发及优化。

公司将秉承“立足中国，面向世界”的企业使命和“以先进技术、优异品

质、完善服务，成为晶体产业最具竞争优势的品牌”的企业愿景，以客户需求为导向、创新研发为基础、市场为导向，加强产能建设、品牌提升与技术创新，持续提升核心竞争力、盈利能力与供应能力，推动石英晶体元器件国产化，与本次募集资金项目协同发力实现长远发展。

7、募集资金投资项目对同业竞争或独立性影响

本次募集资金投资项目的实施主体为公司及其全资子公司，在本次募集资金投资项目实施后，发行人不会与控股股东、共同实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，本次募集资金投资项目的实施不会对发行人的独立性产生不利影响。

二、募集资金运用具体情况

（一）募集资金投资项目概况

公司募集资金投资项目的具体情况详见本招股说明书之“第十二节 附件”之“六、募集资金具体运用情况”。

（二）募集资金运用可行性

公司募集资金运用可行性的具体情况详见本招股说明书之“第十二节 附件”之“六、募集资金具体运用情况”。

（三）与公司主要业务及核心技术之间的关系

报告期内，公司主要产品的产能利用率和产销率较高，公司实施募集资金投资项目能扩大现有经营规模，优化公司产品结构，提升公司的技术水平，进一步提升公司品牌形象，营业收入和净利润也将得到增长，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

本次募集资金运用全部围绕公司现有主营业务和核心技术进行，通过实施募集资金投资项目，公司产能将有所扩大，产品结构进一步优化，研发技术水平得到提升。公司本次募集资金投资项目基于公司主营业务与技术情况提出，与现有生产经营规模、行业技术发展趋势相适应。

本次募集资金投资项目实施以公司现有产品、技术、市场、管理为基础，实施募集资金投资项目将进一步发挥公司在石英晶体元器件行业的核心竞争优

势，是公司围绕现有主营业务进行的扩张和升级，旨在通过集成和实现石英晶体元器件生产系统最新的研究成果，进一步提升公司制造水平和丰富产品序列，巩固公司在石英晶体元器件市场上的竞争优势。

（四）募集资金运用和管理安排

公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理等方面进行了详尽规定。公司募集资金实施专户存储制度，募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行募集资金到位后，公司将及时、完整地将募集资金集中存放于募集资金专户，并在规定时间内与募集资金存管银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，从而确保募集资金专项存储制度能够得到有效执行。

（五）募集资金运用相关程序履行情况

公司本次发行的有关募集资金投资项目获取相关主管部门的审批或备案情况如下：

序号	项目名称	备案文号	环境影响评价批复
1	新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目	2601-330110-07-02-156626	杭环余备（零）2026-4 号
2	新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目	2602-330521-07-02-283903	湖德环建备〔2026〕12 号
3	基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目	2601-330110-07-02-390539	杭环余备（零）2026-5 号
4	数智化制造与运营管理平台升级建设项目	2604-330110-07-02-776325	无需环评

三、发行人未来发展规划及目标

（一）公司未来整体战略规划

公司将秉承“立足中国，面向世界”的企业使命和“以先进技术、优异品质、完善服务，成为晶体产业最具竞争优势的品牌”的企业愿景，坚持以客户需求为导向，不断加强自主创新与发展，持续为客户提供质量稳定、性能优异的石英晶体元器件产品，推动石英晶体元器件国产化进程的发展。公司将以创新研发为发展基础，优化研发平台，持续加强对石英晶体元器件生产工艺的提升和改进，不断加大新产品、新技术的研发力度，持续提升企业的核心竞争力

和持续发展能力；公司将继续坚持市场导向，进一步扩展提升市场开发能力，加强品牌建设，扩大公司市场份额，提升公司的品牌影响力，全面提升公司的盈利能力；公司将根据市场需求和公司发展情况，加强产能建设，提高生产效率，扩大生产规模，提高产品供应能力。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、优化公司治理结构

持续优化公司治理结构，不断加强内部控制建设，充分发挥公司治理对战略目标实现的推进作用。通过优化董事会决策机制、设立独立董事等措施，进一步提升了公司在把握战略方向、做出战略决策的能力与效率，为公司聚焦核心业务、进一步提升研发及生产能力助力。

2、加强研发创新

公司始终重视并坚持研发创新，紧密结合市场需求，紧跟行业前沿发展趋势，加速国产替代，不断完善技术创新机制，激发研发人员的研发热情，持续研发新产品，增强企业研发创新能力。公司通过持续的产品升级换代及产品创新，不断优化产品结构，保持公司产品的领先地位。

3、加大人才培养力度

公司不断加大人才培养的投入力度，形成了人才引进与人才培养的两条路线，充实人才队伍；通过多层次的人才发展计划，打造合理的人才梯队与人才结构，在夯实公司业务发展基础的同时又能够保持灵敏的市场嗅觉，积极响应市场方向，精准把握业务机会。

（三）未来规划采取的措施

1、产能扩充、产品升级和自动化水平提升

公司在杭州、德清等区域布局多个生产基地，持续扩大产品产能，并通过推进智能化、信息化基础设施与软件系统升级，实现数据实时驱动管理提升，增强产品市场竞争力，全面提升整体生产运营效率。随着下游应用领域不断拓展、客户合作持续深化，公司产量、销量及经营业绩有望实现稳步提升。

2、加深与现有客户的合作并积极拓展新客户

凭借多年的品牌积累、优异的产品质量和完善的服务体系，公司目前已经培养并维护了丰富的客户资源，与公司有业务往来的客户数量已达数百家，且不乏世界知名企业。公司的主要客户均与公司建立了长期稳定的合作关系，既保证了公司产品销售的持续稳定，又能在市场上形成良好的带动效应，为公司市场份额的提升提供帮助。

未来，公司将继续强化营销组织建设，优化职能管理；提升营销能力，开拓新兴市场；拓展销售渠道和营销网络；强化品牌建设和形象提升。同时，公司将继续优化产品品质，以品质驱动销售，借助国内产业转型升级和国产替代的契机，不断巩固自身市场地位，扩大业务规模及市场占有率，提高品牌知名度，为新增投资项目的产能消化提供有力支持。

3、充分发挥财务在公司运行中的作用

为推动战略目标的实现，一方面，公司将制定和完善财务制度，为公司资源高效合理利用奠定基础；另一方面，公司将形成长期的融资管理和信用管理机制，不断优化资本结构，保持合理的负债率，在控制融资成本的同时通过合理的杠杆有效支持公司研发以及业务的发展，提升资本回报率，同时公司也将通过上述机制保持良好融资能力，为未来进一步的发展提供财务储备。

4、加大人力资源投入

公司将一如既往重视人才队伍建设，加强与高等院校以及科研院所的合作，一方面引进技术前沿的高端人才，提升产品研发与技术创新上限，另一方面引入优秀应届毕业生，为公司的新生代技术力量培养和人才梯队建设提供人才储备。公司将进一步优化内部人才培养和发展体制，开拓更为全面的人才发展通道，让员工形成推动公司发展的内生力量。此外，公司将继续丰富各类专业人才配置，通过打造专业化的研发、生产、质控、财务、证券、市场人才队伍，更加精准地匹配不断精细化的公司管理需求，提升经营质量。

5、加强技术研发合作

电子元器件对技术的依赖程度远高于传统行业，为此，公司将立足于自主研发创新，不断加强与国内外科研院所的交流合作，充分发挥企业在技术产业

化中的优势，加快新技术的消化吸收，快速形成生产力和产品优势；同时以产促研，通过技术产业化反哺科研力量，不断提高技术创新能力，缩短技术迭代周期，打造产业与技术研发的良性生态循环链。

第八节 公司治理与独立性

一、公司治理概况

公司自股份公司设立以来，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会、监事会/审计委员会、高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制。并结合公司实际情况制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》《董事会秘书工作细则》等制度，为公司规范运行提供了制度保证。

截至本招股说明书签署日，公司各项内控制度均得以有效执行，公司股东会、董事会及管理层相互独立、权责明确、相互监督，形成了科学高效的公司治理体系。

二、公司内部控制情况

（一）公司内控不规范情形及整改情况

报告期内，发行人不存在内控不规范情形及整改情况。

（二）公司管理层对内部控制的自我评估

公司管理层在对公司内部控制制度进行了自查和评估后认为：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及其他法律、法规、规章建立的现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，内部控制于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具了信会师报字[2026]第

ZF10205 号《内部控制审计报告》，其审计意见如下：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、报告期违法违规行为情况

报告期内，公司严格按照国家的有关法律法规开展经营活动，不存在因重大违法违规行为而被国家行政及行业主管部门进行处罚的情况。

四、报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。

五、公司独立持续经营能力

截至本招股说明书签署日，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系及独立面向市场自主经营的能力。

（一）公司独立经营情况

1、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产完整，独立于控股股东和实际控制人。

2、人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3、财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系，设有独立的财务部门，能够独立作出财务决策；公司已制定规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并能够有效执行；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

4、机构独立情况

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司根据《公司法》等法律法规要求，建立了以股东会为最高权力机构、以董事会为决策机构、以审计委员会为监督机构、以经营管理层为执行机构的组织架构体系，保证了公司的独立运营。

5、业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（二）公司持续经营情况

1、主营业务稳定性

报告期内，公司专注于石英晶体谐振器、石英晶体振荡器等频率控制元器件的研发、生产和销售，公司主营业务未发生重大不利变化。

2、控制权稳定性

报告期内，公司实际控制人均为林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士。报告期内，公司实际控制人未发生变更，控制权稳定。

3、管理团队稳定性

报告期内，公司管理团队稳定，董事、高级管理人员均未发生重大不利变化。公司报告期内董事、高级管理人员的具体变动情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内变动情况”。

4、可能影响公司持续经营能力的其他或有事项

公司不存在以下可能对持续经营能力构成重大不利影响的事项：（1）主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷；（2）重大偿债风险；（3）重大担保、诉讼、仲裁等或有事项；（4）经营环境已经或将要发生重大变化；（5）其他对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本招股说明书签署日，除鸿星科技以外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况如下：

序号	企业名称	股权结构	主营业务
1	H-TEC	FORTUNE 持股 64.87%，NICE 持股 11.48%，WISE 持股 9.62%，GOLD HARVEST 持股 7.94%，SHINE 持股 6.09%	公司控股股东，持股平台，无实际经营
2	杭州圣瀚	H-TEC 持股 91.22%，珠海博浩持股 8.78%	无实际经营，仅出租商品房
3	杭州凡翔	H-TEC 持股 91.22%，珠海博浩持股 8.78%	无实际经营，仅出租商品房
4	金图控股	林毓湘持股 28%，林瑞堂持股 28%，林毓馨持股 18%，林洪河持股 16%，林张玉珍持股 10%	持股平台，无实际经营
5	丰诠投资	金图控股持股 100%	持股平台，无实际经营
6	台湾鸿星	丰诠投资持股 56.78%，其他 59 名股东持股 43.22%	发行人在中国台湾地区的经销商
7	美国鸿星	台湾鸿星持股 100%	无实际经营
8	HOLDING	台湾鸿星持股 100%	持股平台，无实际经营
9	GOODMARK	林洪河持股 100%	持股平台，无实际经营
10	珠海博浩	GOODMARK 持股 100%	持股平台，无实际经营
11	BEGONIA	林毓湘持股 100%	持股平台，无实际经营
12	珠海鸿硕	BEGONIA 持股 100%	无实际经营，仅持有不动产
13	鸿升创建	林毓馨持股 100%	无实际经营
14	深圳鸿升	鸿升创建持股 100%	无实际经营
15	创宇股份	林毓馨持股 100%	持股平台，无实际经营
	创宇台湾分公司	创宇股份的分公司	处理行政事务
16	FORTUNE	林洪河持股 30%，林瑞堂持股 22%，林	持股平台，无实际经营

序号	企业名称	股权结构	主营业务
		毓湘持股 20%，林张玉珍持股 15%，林毓馨 13%	
17	POWERCORP	林洪河持股 100%	持股平台，无实际经营
18	PERFECT	林洪河持股 45%，林瑞堂持股 20%，林张玉珍持股 20%，林毓馨持股 15%	持股平台，无实际经营
19	杭州典河	林毓湘持股 100%	持股平台，无实际经营
20	JOINT	林毓湘持股 100%	持股平台，无实际经营
21	LYH	GOLD HARVEST 持股 24.18%，郭佳琛持股 15.87%，林月梅持股 15.87%，刘天裕持股 13.80%，林毓馨持股 8.69%，张千惠持股 5.50%，其他股东持股 16.10%；根据各方约定，LYH 由林毓馨实际控制	持股平台，无实际经营
22	宝海星业	林毓馨持股 100%	无实际经营
23	DYNAMIC	林瑞堂持股 50%；林佳燕持有的 DYNAMIC 50%股权对应的表决权委托给林瑞堂行使，因此 DYNAMIC 由林瑞堂实际控制	持股平台，无实际经营

截至本招股说明书签署日，除台湾鸿星从事石英晶振等产品的经销业务以外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形；台湾鸿星与发行人业务不构成竞争关系，不存在同业竞争，具体详见本节“六、同业竞争”之“（二）公司与台湾鸿星不存在同业竞争”。

（二）公司与台湾鸿星不存在同业竞争

1、台湾鸿星不具备生产和研发能力，仅为公司在中国台湾地区的经销商且销售渠道独立

台湾鸿星目前的业务对发行人不构成“竞争”。在业务发展方面，台湾鸿星自 2000 年起已不再从事石英晶振等产品的研发和生产，仅作为经销商向发行人采购石英晶体谐振器、石英晶体振荡器等产品后，销往中国台湾地区客户；在人员方面，台湾鸿星目前约有 30 名员工，主要为销售和行政管理人员，不从事研发和生产工作；在资产方面，台湾鸿星不拥有晶振相关专利、技术或生产研发设备，不具备石英晶振产品的研发和生产能力；在销售渠道方面，发行人与台湾鸿星在销售渠道方面各自独立，目前及未来台湾鸿星主要面向中国台湾地区客户，而发行人则面向全球市场。综上，台湾鸿星不从事研发和生产业务，在销售方面与发行人渠道独立，不存在实质的竞争关系。

此外，报告期内台湾鸿星石英晶振产品的销售收入及毛利占发行人同类业务收入和毛利的比例较低，不会对发行人的业务发展造成实质影响。

2、协议限制业务范围，避免潜在同业竞争

为避免后续发生同业竞争，2022 年 12 月公司与公司实际控制人及一致行动人、台湾鸿星签订《避免同业竞争协议》，对台湾鸿星的业务范围限制如下：

（1）自 2019 年 1 月 1 日以来，台湾鸿星未从事电子元件产品的研发和生产，仅从事电子元件产品的贸易业务。

（2）除目前从事的电子元件产品的贸易业务外，台湾鸿星不在包括中国台湾地区在内的任何地区从事与甲方主营业务相同或相似的任何业务（包括但不限于投资、新建与甲方主营业务相同或相类似的生产场地、运营主体）；

（3）自《避免同业竞争协议》签订之日起，台湾鸿星仅向中国台湾地区客户销售电子元件产品，不得向除前述以外的其他客户销售电子元件产品；

（4）自《避免同业竞争协议》签订之日起，台湾鸿星不得与发行人或其子公司的客户发生交易；该等客户包括发行人或其子公司现有客户以及未来新获取的客户。就未来新获取的客户，一旦发行人或其子公司获取了新客户，台湾鸿星应避免或者停止与该等客户发生交易；

（5）自《避免同业竞争协议》签订之日起，若台湾鸿星在目前的客户范围以外，存在新增的与发行人业务相关的客户资源或业务机会，台湾鸿星应于发现该客户资源或业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给台湾鸿星的条件优先提供予发行人；

（6）台湾鸿星不得以任何方式限制发行人的业务发展。

根据上述协议，台湾鸿星的业务类型、销售区域、客户范围等均受到限制，防止其损害发行人利益；同时，由于台湾鸿星客户主要集中于中国台湾地区，且台湾鸿星自身不具备独立的生产和研发能力，因此上述协议具有可行性和稳定性。

基于以上，按照实质重于形式的原则，发行人与台湾鸿星的业务不具有替代性、竞争性，因此不构成同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及一致行动人已

分别出具了《避免新增同业竞争的承诺函》，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（十）避免新增同业竞争的承诺”。

（四）与发行人发生重大关联交易或从事相同、相似业务的关联方情况

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中，报告期内与发行人发生重大关联交易或与从事相同、相似业务的关联方为台湾鸿星，具体情况如下：

公司名称	鸿星电子股份有限公司				
成立时间	1979 年 3 月 31 日				
住址	中国台湾地区新北市树林区俊英街 84 巷 23 之 1 号 3 楼				
主营业务	从事石英晶振等产品的经销				
与发行人业务关系	目前为公司在中国台湾地区的经销商				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经审计）	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	11,454.23	9,962.40	5,195.39	-484.17

注：上表中列示财务数据以当期汇率由新台币换算为人民币。

七、关联方及关联交易

截至本招股说明书签署日，根据《公司法》《企业会计准则》等相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

（一）关联方

1、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事及高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为 H-TEC，其董事为林毓湘女士；FORTUNE 通过 H-TEC 间接控制公司，其董事为林洪河先生；公司实际控制人及其一致行动人为林洪河先生、林瑞堂先生、林毓馨女士、林毓湘女士、林张玉珍女士。

上述关联方具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人”。

2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，除 H-TEC 以外，公司控股股东、实际控制人控

制的其他企业情况详见本节“六、同业竞争”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争”。

3、其他持有 5%以上股份的股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除 H-TEC 以外，公司不存在直接持股 5%以上的股东；公司间接持股 5%以上的股东如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	FORTUNE	通过 H-TEC 间接持有公司 51.20%股权
2	NICE	通过 H-TEC 间接持有公司 9.06%股权
3	WISE	通过 H-TEC 间接持有公司 7.59%股权
4	GOLD HARVEST	通过 H-TEC、LYH 间接持有公司 6.69%股权
5	张进兴	GOLD HARVEST 持股 100%股东，通过 GOLD HARVEST 间接持有公司 6.69%股权

4、公司控股子公司

截至本招股说明书签署日，公司拥有的控股子公司情况如下：

序号	关联方名称	股权结构
1	浙江鸿星	公司持股 100%
2	金华鸿瑞	公司持股 100%
3	湖州鸿皓	公司持股 100%
4	东莞佳晟	公司持股 100%
5	鸿星企业	公司持股 100%
6	鸿星国际	公司持股 100%
7	HOSONIC GLOBAL	公司持股 100%
8	HOSONIC JAPAN	鸿星企业持股 100%
9	HOSONIC THAI	鸿星国际持股 99.00%，林毓馨持股 0.50%，林毓湘持股 0.50%

5、公司的董事、高级管理人员

公司现任董事、高级管理人员包括林洪河、辜达元、林毓湘、陈意青、吴哲婉、杨耀中、刘华、郭耀成、李强。

上述人员具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”。

6、上述关联自然人关系密切的家庭成员

上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

7、公司关联自然人直接或间接控制，或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或者其他组织

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人控制的企业以外，公司关联自然人直接或间接控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州子海	公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书陈意青持股 100%，并担任执行董事、总经理的企业
2	杭州纮洋	杭州子海担任执行事务合伙人的企业
3	杭州澜洋	杭州子海担任执行事务合伙人的企业
4	杭州湛洋	杭州子海担任执行事务合伙人的企业
5	杭州湟江	杭州子海担任执行事务合伙人的企业
6	Phoenix Technologies International, LLC	公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书陈意青的姐姐陈怡伶担任经理的企业
7	LINKRICH	公司董事吴哲婉担任董事的企业
8	GOLDRICH	公司董事吴哲婉担任董事的企业
9	SHINE	公司实际控制人之一、董事长林洪河的妹妹的配偶刘天裕家族控制，并由公司实际控制人之一林毓湘担任董事的企业，通过 H-TEC 间接持有发行人 4.81%股权
10	讯端科技股份有限公司	公司实际控制人林毓湘配偶刘嘉顺持股 99.2%，并担任董事长的企业
11	广帛投资股份有限公司	公司实际控制人之一林毓湘的配偶刘嘉顺持股 99.88%，并担任董事长的企业
12	新民加油站股份有限公司	公司一致行动人林张玉珍的妹妹张玉花及其配偶陈思亮合计持股 40%，并由陈思亮担任董事长的企业
13	爱儿堡	林佳燕持股 100%
14	浙江卡麦啦文化创意有限公司	爱儿堡持股 100%
15	杭州智酷玩具有限公司	浙江卡麦啦文化创意有限公司持股 100%
16	杭州原柏文化创意有限公司	爱儿堡持股 100%
17	杭州有静文化创意有限公司	杭州原柏文化创意有限公司持股 100%

序号	关联方名称	关联关系
18	杭州一湾棠草餐饮管理有限公司	杭州有静文化创意有限公司持股 100%
19	杭州酷果文化创意有限公司	爱儿堡持股 100%
20	杭州拾光煮茶餐饮管理有限公司	杭州酷果文化创意有限公司持股 100%
21	杭州拾光煮酒餐饮管理有限公司	杭州酷果文化创意有限公司持股 100%
22	杭州东鲲餐饮管理有限公司	杭州酷果文化创意有限公司持股 100%
23	杭州蒋友青文化品牌管理有限公司	杭州酷果文化创意有限公司持股 51%
24	杭州爱尔堡教育咨询有限公司	公司实际控制人之一林瑞堂的配偶林佳燕控制的 HARVARD TOP-WIT （U.S.A） DEVELOPMENT & INSTRUCTION GROUP LIMITED（该企业已于 2025 年 12 月注销，但目前所持股权尚未变更）持股 96%，并担任董事长兼总经理的企业
25	杭州英盟教育科技有限公司	发行人实际控制人之一林瑞堂的配偶林佳燕控制的杭州爱尔堡教育咨询有限公司持股 90%，并担任执行董事的企业
26	杭州市钱塘区英伦森林幼儿园	发行人实际控制人之一林瑞堂的配偶林佳燕担任负责人的民办非企业单位
27	杭州英伦幼儿园	发行人实际控制人之一林瑞堂的配偶林佳燕担任负责人的民办非企业单位
28	璨巨有限公司	间接持股 5%以上股东张进兴持股 82.61%，并担任董事的企业
29	幸宝有限公司	间接持股 5%以上股东张进兴控制的企业
30	星磐营造有限公司	公司独立董事郭耀成的妹妹郭淑雯及其配偶许志忠共同控制，并由许志忠担任董事长的企业
31	星磐工程有限公司	公司独立董事郭耀成的妹妹郭淑雯及其配偶许志忠共同控制，并由许志忠担任董事长的企业
32	星磐工程行	公司独立董事郭耀成的妹妹郭淑雯及其配偶许志忠共同控制的企业
33	台湾元大证券股份有限公司上海代表处	公司独立董事郭耀成担任首席代表的企业
34	湖北鸿光电子有限公司（已吊销）	公司实际控制人曾经控制的企业，已于 2005 年 4 月因超过经营期限而吊销

8、报告期内曾经主要关联方

截至本招股说明书签署日，报告期前 12 个月至今（即 2022 年至今）曾经为公司关联方的情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	宇柏投资	公司实际控制人之一林毓馨曾经控制的公司，已于 2023 年 10 月注销

序号	关联方名称	关联关系
2	ALLIED	公司实际控制人之一林毓馨曾经通过鸿升创建控制的公司，已于 2023 年 10 月注销
3	珠海鸿康	公司实际控制人之一林洪河通过 GOODMARK 曾经控制的公司，已于 2022 年 5 月注销
4	杭州鸿亿	公司实际控制人之一林洪河通过 POWERCORP 曾经控制的公司，已于 2022 年 1 月注销
5	HTD	台湾鸿星持股 100%，已于 2022 年 3 月注销
6	江阴鸿翔	公司曾经的二级子公司，已于 2023 年 1 月注销
7	杭州博卷图书有限公司	公司实际控制人之一林瑞堂配偶林佳燕曾担任执行董事兼总经理的企业，已于 2022 年 9 月注销
8	VEHICOMN	公司实际控制人曾经控制的公司，已于 2024 年 1 月注销
9	MARS	公司实际控制人曾经控制的公司，已于 2024 年 10 日注销
10	桂志义	报告期内曾担任发行人监事，2025 年 12 月辞任
11	冯信和	曾担任发行人董事，2022 年 9 月辞任
12	杭州幸宝健康管理有限公司	间接持股 5%以上股东张进兴曾经控制并担任执行董事的企业，已于 2024 年 8 月对外转让，目前由杭州市钱塘区河庄街道江东村股份经济合作社 100%持股，张进兴不再担任执行董事
13	利联科技	公司实际控制人曾经控制的企业，已于 2025 年 8 月注销
14	科视电子	公司实际控制人曾经控制的企业，已于 2025 年 11 月注销
15	冠捷科技	公司实际控制人曾经控制的企业，已于 2026 年 3 月注销
16	HARVARD TOP-WIT（U.S.A） DEVELOPMENT & INSTRUCTION GROUP LIMITED	公司实际控制人之一林瑞堂的配偶林佳燕曾经控制的企业，已于 2025 年 12 月注销
17	杭州岛上拼拼餐饮管理有限公司	公司实际控制人之一林瑞堂的配偶林佳燕曾经控制的企业，已于 2025 年 9 月注销

（二）关联交易

报告期内，公司关联交易整体情况如下：

单位：万元

关联交易性质	关联交易重要性	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
重大关联交易	经常性关联交易	商品销售	4,561.59	3,604.09	3,528.28
一般关联交易	-	商品采购	0.78	-	0.24
		采购服务	37.21	32.00	31.93
		关联租赁	详见本节之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、一般性关联交易”		

			之“（3）关联租赁”		
		商标转让及授权	详见本节之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、一般性关联交易”之“（4）商标转让及授权”		
		通过员工账户向 HOSONIC JAPAN 注入资本金	详见本节之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、一般性关联交易”之“（5）通过员工账户向 HOSONIC JAPAN 注入资本金”		
		关联担保	详见本节之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、一般性关联交易”之“（6）关联担保”		
		关键管理人员报酬	951.35	1,003.32	1,007.77
关联方往来	**关联交易重要性**	**关联方往来内容**	**2025.12.31**	**2024.12.31**	**2023.12.31**
关联方往来款	-	关联方应收款项	1,072.22	904.47	666.92
		关联方应付款项	159.42	187.45	95.59

注：参照《创业板上市规则》，公司的重大关联交易主要包括：（1）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；（2）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一年经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。此外，公司单方面获得利益的关联交易（包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等）、公司与控股子公司之间发生的或控股子公司之间发生的担保、关键管理人员薪酬均为一般关联交易。

1、重大经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间的重大经常性关联交易主要系公司向台湾鸿星的关联销售。以上关联交易经过适当审批以及内部决策程序，关联交易价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情形。具体分析如下：

（1）商品销售

1）基本情况

报告期内，在重大经常性关联交易中，公司向关联方销售商品金额占营业收入的比例为 6.52%、6.35%和 7.22%，关联销售占比较低。具体情况如下：

单位：万元

交易内容	关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产成品销售	台湾鸿星-经销	4,561.59	3,604.09	3,528.28
营业收入		**63,212.05**	**56,739.10**	**54,153.81**
占营业收入比例（%）		**7.22**	**6.35**	**6.52**

2）关联交易合理性

公司向台湾鸿星关联销售为经销模式销售，台湾鸿星作为公司在中国台湾地区的经销商，已进入多家中国台湾地区客户的合格供应商名录，在当地具有一定的客户资源积累。公司通过台湾鸿星服务中国台湾地区客户，满足客户本地化采购和服务要求，具有合理性。

3）关联交易公允性

报告期内，公司向台湾鸿星销售的产成品主要为谐振器、振荡器等。台湾鸿星作为公司经销商，销售定价主要考虑采购规模、合作稳定性、市场竞争情况、竞争对手报价以及经销商的运营成本后综合确定，与向非关联第三方经销商销售价格的定价原则一致，关联交易价格公允。

4）公司避免潜在同业竞争的措施

公司与台湾鸿星约定市场划分，台湾鸿星承诺仅向中国台湾地区客户销售产品，详见本节之“六、同业竞争”之“（二）公司与台湾鸿星不存在同业竞争”之“2、协议限制业务范围，避免潜在同业竞争”。

综上所述，台湾鸿星作为发行人在中国台湾地区的经销商，服务中国台湾地区的客户，具备合理性，关联交易经过适当审批且交易价格公允。

2、一般性关联交易

（1）商品采购

单位：万元

交易内容	关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
商品采购	台湾鸿星	0.78	-	0.24
营业成本		**39,480.51**	**32,902.52**	**29,763.19**
占营业成本比例（%）		**0.00**	**-**	**0.00**

（2）采购服务

单位：万元

交易内容	关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
服务费	创宇台湾分公司	9.94	9.47	9.50
网络服务费	创宇台湾分公司	27.28	22.53	22.44
合计		**37.21**	**32.00**	**31.93**

交易内容	关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
管理费用		7,456.90	6,602.89	5,922.38
占管理费用比例（%）		0.50	0.48	0.54

报告期内，公司通过创宇台湾分公司支付部分员工于中国台湾地区的社保、薪酬等费用，公司向创宇台湾分公司支付服务费具有合理性。报告期各期，公司通过创宇台湾分公司支付部分中国台湾籍员工薪酬及少许费用合计分别为 67.75 万美元、65.90 万美元和 69.61 万美元，公司按照上述金额的 2.00%支付服务费，服务费价格经双方协商确认，关联交易价格公允。

另外，公司向创宇台湾分公司租赁了房产并向其采购了网络服务，向创宇台湾分公司关联租赁详见本节之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、一般性关联交易”之“（3）关联租赁”。公司向创宇台湾分公司其支付网络服务费具有合理性，网络服务费价格参考创宇台湾分公司向第三方支付的网络服务费加成 2.00%确定，关联交易价格公允。

（3）关联租赁

单位：万元

出租方	承租方	2025 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出
杭州圣瀚	鸿星科技	-	56.52	80.26	4.99
杭州凡翔	鸿星科技	-	39.60	-	1.70
林毓馨	东莞佳晟	-	21.60	-	2.74
创宇台湾分公司	鸿星企业	11.74	-	-	-
合计	-	**11.74**	**117.72**	**80.26**	**9.43**

（续上表）

出租方	承租方	2024 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出
杭州圣瀚	鸿星科技	-	51.12	121.20	2.20

出租方	承租方	2024 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出
杭州凡翔	鸿星科技	-	39.60	-	1.74
林毓馨	东莞佳晟	-	21.60	75.68	3.37
创宇台湾分公司	鸿星企业	11.62	-	-	-
合计	**-**	**11.62**	**112.32**	**196.88**	**7.31**

（续上表）

出租方	承租方	2023 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出
杭州圣瀚	鸿星科技	-	49.32	-	3.85
杭州凡翔	鸿星科技	-	39.60	74.00	3.45
林毓馨	东莞佳晟	-	23.04	-	2.03
创宇台湾分公司	鸿星企业	11.71	-	-	-
合计	**-**	**11.71**	**111.96**	**74.00**	**9.34**

上述关联租赁价格均系双方根据市场价格协商确定，与周边房屋租赁价格相近，关联租赁价格公允。上述关联交易金额较小，对公司财务状况影响较小。

（4）商标转让及授权

2023 年 5 月，公司与台湾鸿星签署了《商标转让协议》，台湾鸿星将 4 项商标无偿转让给发行人。截至本招股说明书签署日，上述 4 项商标已完成转让变更手续，所有权归发行人所有。同时，为了台湾鸿星便于开展经销业务，发行人将上述 4 项商标无偿授权给台湾鸿星使用。

（5）通过员工账户向 HOSONIC JAPAN 注入资本金

2024 年，公司通过株式会社 HOSONIC JAPAN 的法人代表安田克史个人账户将新设资本金 1 亿日元注入 HOSONIC JAPAN。根据该公司设立地日本相关规定，在注册 HOSONIC JAPAN 之前，需向发起人或法人代表的日本账户存入注册资金。由于发起人鸿星企业没有日本账户，因此，公司将注册资金 1 亿日

元汇入 HOSONIC JAPAN 法人代表安田克史个人日本银行账户，由安田克史将 1 亿日元注册资本金汇入 HOSONIC JAPAN 账户，从而完成 HOSONIC JAPAN 实缴出资。截至 2024 年 6 月末，员工安田克史已将该资本金全额汇入 HOSONIC JAPAN。

（6）关联担保

报告期内，公司发生的关联担保主要情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鸿星科技	浙江鸿星	16,000.00	2022/12/13	2024/10/29	是

（7）关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	951.35	1,003.32	1,007.77
合计	**951.35**	**1,003.32**	**1,007.77**

3、关联方往来

报告期各期末，发行人关联方的应收、应付款项的余额情况如下：

单位：万元

往来性质	具体科目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收款项	应收账款	1,072.22	904.47	666.92
应付款项	一年内到期的非流动负债	68.18	72.04	95.59
	租赁负债	91.24	115.41	-
	小计	**159.42**	**187.45**	**95.59**

上表关联方的应收、应付款项的情况介绍如下：

（1）关联方应收账款

报告期各期末，关联方应收账款余额情况如下：

单位：万元

关联方名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
台湾鸿星	1,072.22	904.47	666.92
合计	**1,072.22**	**904.47**	**666.92**

（2）关联方一年内到期的非流动负债

单位：万元

关联方名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
杭州圣瀚	48.66	53.18	35.73
杭州凡翔	-	-	37.86
林毓馨	19.52	18.86	22.00
合计	**68.18**	**72.04**	**95.59**

以上一年内到期的非流动负债均为关联方租赁产生。

（3）关联方租赁负债

单位：万元

关联方名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
林毓馨	41.07	60.59	-
杭州圣瀚	50.17	54.82	-
合计	**91.24**	**115.41**	**-**

4、关联交易履行的审议程序及独立董事意见

为保护中小股东利益，规范公司关联交易，公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事议事规则》等制度，对关联交易的决策权限、回避和表决程序等做出详尽的规定，确保了关联交易公平、公正、公允。

报告期内，公司各年度关联交易均已经董事会、股东（大）会审议，审议程序符合相关法律法规的要求，相关关联董事、关联股东已回避表决，公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。

综上，公司报告期内的关联交易已按照相关法律法规、《公司章程》的规定履行了审议程序。

5、报告期内关联方变化情况

报告期内，公司关联方变化情况详见本节之“七、关联方及关联交易”之“（一）关联方”之“8、报告期内曾经主要关联方”。

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司股东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，如首次向社会公开发行股票顺利完成，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。

二、发行人报告期内股利分配政策和实际股利分配情况

（一）发行人股利分配政策

根据公司现行《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

（二）报告期内实际股利分配情况

报告期内，公司股利分配情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（三）报告期股利分配的具体实施情况”。

三、本次发行后的股利分配政策

（一）《公司章程（草案）》中利润分配相关规定

根据公司股东会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行后的股利分配政策如下：

1、利润分配原则

（1）公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式；

（4）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。

2、利润分配的具体内容

（1）利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）利润分配的期间间隔

①在公司当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

②公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（3）利润分配的条件

①公司现金分红的具体条件和比例

A.公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）；

B.公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）；

C.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

D.公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展。

E.无公司股东会批准的可以不进行现金分红的其他重大特殊情况。

若满足上述第 A 项至第 E 项条件，公司应进行现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%（按合并报表口径）。

未全部满足上述第 A 项至第 E 项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。

②各期现金分红最低比例

A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第 C 项规定处理。

③发放股票股利的具体条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

3、公司利润分配的决策程序和决策机制

（1）在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配方案。

（2）公司董事会拟订具体的利润分配方案时，应当遵守我国有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的政策。

（3）公司董事会在有关利润分配方案的决策和讨论过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。

（4）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红方案的，公司在召开股东会时除现场会议外，还可向股东提供网络形式的投票平台。

4、利润分配方案的审议程序

（1）公司董事会审议通过利润分配方案后，方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

（2）股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

（3）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、利润分配政策的调整

（1）如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。

（2）公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独

立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意。

（3）对公司章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后提交股东会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因。股东会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6、利润分配方案的实施及披露

（1）如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（2）公司应按照证券监管部门的有关规定，在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并根据证券监管部门的要求对相关事项进行专项说明；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（3）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；

③董事会会议的审议和表决情况；

④独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

（4）公司在将第 4 款第（3）项和第 6 款第（3）项所述利润分配议案提交股东会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股 1%以下、1%-5%、5%以上 3 个区间；对持股比例在 1%以下的股东，还应当按照单一股东持股市值 50 万元以上和以下两类情形，进一步披露相关 A 股股东表决结果。

（5）公司存在第 4 款第（3）项和第 6 款第（3）项所述情形的，公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。

7、审计委员会的监督

公司审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

审计委员会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

（2）未严格履行现金分红相应决策程序；

（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

（二）董事会关于股东回报规划的专项研究论证以及安排理由

为建立公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规要求，公司股东会审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。

董事会对股东分红回报规划进行了专项研究论证，在制定分红安排时坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

在制定上述股东分红回报规划时，主要安排理由如下：1、综合考虑公司所处行业及市场发展情况、公司盈利水平及可持续经营情况、公司战略规划及资金支出安排等因素，采取可执行性高、灵活性强的分红政策；2、充分考虑投资者利益，建立长期、稳定、科学的股东分红回报规划，在兼顾公司阶段性和长期发展需要的前提下，保证公司分红的连续性和持续性；3、重视对股东投资的

合理回报，增强股东回报的可预期性，坚持现金分红为基本原则，实现公司与股东合作共赢、协同发展。

（三）上市后三年内利润分配计划

1、利润分配计划内容

（1）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金方式优先于股票股利方式。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（2）公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，上市后三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（3）在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。

（4）在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事对公司利润分配预案的建议和监督。

2、利润分配计划制定的依据及可行性

公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

3、公司未分配利润的使用安排

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 43,291.27 万元。本次上市前，公司拟将历年滚存的未分配利润用于公司生产经营、业务发展、研发投入等方面，符合公司的实际情况和全体股东利益。

（四）公司长期回报规划

1、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东（特别是公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。

公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东会表决通过后实施。

2、公司利润分配的信息披露

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

3、股东利润分配意见的征求

董事会秘书负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

（一）购销合同

重大销售合同，是指报告期各期公司及其子公司与客户签署的单项或累计金额超过 2,000.00 万元的销售合同或达到上述标准的框架协议。重大采购合同，是指报告期各期公司及其子公司与供应商签署的单项或累计金额超过 1,000.00 万元的采购合同或达到上述标准的框架协议。

1、销售合同

报告期内，公司及其子公司正在履行或已履行完毕的重大销售合同如下：

序号	客户名称	合同标的	合同金额	订立时间	履行情况
1	客户 A1	谐振器、振荡器等	以订单为准	2011 年 7 月	正在履行
2	客户 B	谐振器、振荡器等	以订单为准	2015 年 9 月	正在履行
3	鸿海精密工业股份有限公司	谐振器、振荡器等	以订单为准	2022 年 6 月	履行完毕
4	台湾鸿星	谐振器、振荡器等	以订单为准	2023 年 1 月	履行完毕
5	台湾鸿星	谐振器、振荡器等	以订单为准	2024 年 1 月	履行完毕
6	鸿海精密工业股份有限公司	谐振器、振荡器等	以订单为准	2024 年 5 月	正在履行
7	客户 C	谐振器、振荡器等	以订单为准	2024 年 6 月	正在履行
8	台湾鸿星	谐振器、振荡器等	以订单为准	2025 年 1 月	履行完毕

2、采购合同

报告期内，公司及其子公司正在履行或已履行完毕的重大采购合同如下：

序号	销售方	采购方	采购内容	合同金额	订立时间	履行情况
1	时尚科技	鸿星科技、鸿星企业	基座、上盖	以订单为准	2011 年 11 月	正在履行
2	香港三环电子有限公司	鸿星科技、鸿星企业	基座	以订单为准	2018 年 12 月	正在履行
3	西铁城	鸿星科技	谐振器	以订单为准	2018 年 12 月	正在履行
4	京瓷香港（商贸）有限公司	鸿星科技	基座	以订单为准	2018 年 1 月	正在履行
5	NIPPON AVIONICS	浙江鸿星	设备类	以订单为准	2024 年 10 月	正在履行

序号	销售方	采购方	采购内容	合同金额	订立时间	履行情况
	CO.,LTD.					
6	AKIM CORPORATION	浙江鸿星	设备类	以订单为准	2025 年 2 月	正在履行

（二）借款、授信及担保合同

重大借款、授信及担保合同，是指公司及其子公司与银行签署的金额超过 2,000.00 万元的借款、授信及担保合同。

1、借款合同

报告期内，公司及其子公司正在履行或已履行完毕的重大借款合同情况如下：

序号	合同名称及编号	借款方	贷款方	借款数额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	《固定资产贷款借款合同》公固贷字第 ZH2200000157889 号	浙江鸿星	中国民生银行股份有限公司杭州分行	3,900.00	2022.12.19-2024.9.29	保证、抵押	履行完毕
2	《杭州银行股份有限公司借款合同》编号 200C110202400098	鸿星科技	杭州银行股份有限公司海创园支行	2,100.00	2024.7.25-2025.7.22	无	履行完毕
3	《杭州银行股份有限公司借款合同》编号 200C110202400127	鸿星科技	杭州银行股份有限公司海创园支行	2,000.00	2024.9.27-2025.9.23	无	履行完毕
4	《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》编号 33010120240031157	鸿星科技	中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行	2,700.00	2024.8.26-2025.8.21	无	履行完毕
5	《杭州银行股份有限公司借款合同》编号 200C110202500140	鸿星科技	杭州银行股份有限公司海创园支行	2,200.00	2025.7.25-2026.7.24	无	正在履行
6	《杭州银行股份有限公司借款合同》编号 200C110202500172	鸿星科技	杭州银行股份有限公司海创园支行	2,000.00	2025.9.24-2026.9.23	无	正在履行

2、授信合同

报告期内，公司及其子公司正在履行或已履行完毕的重大授信合同情况如下：

序号	授信方	被授信方	合同名称	合同编号	授信金额（万元）	授信期限	履行情况
1	中国民生银行股份有限公司杭州分行	鸿星科技	综合授信合同	公授信字第ZH2300000033650 号	8,000.00	2023.3.7-2024.3.6	履行完毕
2	中国民生银行股份有限公司杭州分行	鸿星科技	综合授信合同	公授信字第ZH2400000185449 号	5,000.00	2024.8.7-2025.8.6	履行完毕
3	中国民生银行股份有限公司杭州分行	浙江鸿星	综合授信合同	公授信字第ZH2400000231462 号	3,000.00	2024.9.24-2025.9.23	履行完毕

3、担保合同

报告期内，公司及其子公司正在履行或已履行完毕的重大担保合同情况如下：

序号	银行名称	合同编号	担保人	担保金额（万元）	主债权期限	担保方式	履行情况
1	中国民生银行股份有限公司杭州分行	公高抵字第99072021Y51001 号	鸿星科技	3,591.00	2021.4.30-2024.4.29	余房权证良字第08034703、08034704、08034705、08034706、08034707 、 08034708 号的工业厂房及权证号为杭余出国用（2007）第 110-690 号的土地使用权	履行完毕
2	中国民生银行股份有限公司杭州分行	公保字第99072022B51004 号	鸿星科技	16,000.00	2022.12.13-2027.12.12	不可撤销连带责任保证	履行完毕
3	中国民生银行股份有限公司杭州分行	公抵字第99072022Y51001 号	浙江鸿星	2,630.48	2022.12.13-2023.4.14	浙（2021）德清县不动产权第 0004130 号土地使用权	履行完毕

（三）工程施工合同

重大工程施工合同，是指公司及其子公司与供应商签署的金额超过1,000.00 万元的工程施工合同。

报告期内，公司及其子公司正在履行或已履行完毕的重大工程施工合同如下：

序号	销售方	采购方	合同标的	合同金额（万元）	合同订立时间	履行情况
1	中设建工集团有限公司	浙江鸿星	年产 8 亿个 5G 应用微型片式石英晶体元器件研发及产	14,301.01	2021 年 4 月	正在履行

序号	销售方	采购方	合同标的	合同金额（万元）	合同订立时间	履行情况
			业化项目			
2	浙江尚品机电工程有限公司	浙江鸿星	浙江鸿星电子科技有限公司生产楼 B 二层车间装修工程	1,465.00	2022 年 9 月	正在履行
3	浙江尚品机电工程有限公司	浙江鸿星	浙江鸿星电子科技有限公司生产楼 B 三层车间装修工程	1,380.00	2024 年 6 月	正在履行

（四）土地购买协议

报告期内，公司签署的金额超过 1,000.00 万元以上的重大土地购买协议的具体情况如下：

购买方	出让方	土地位置	面积（莱）	土地总价（万泰铢）	合同订立时间
HOSONIC THAI	Amata 集团[注]	泰国春武里府工业园区内	9.6645	11,404.11	2025 年 11 月

注：Amata 集团是泰国领先的工业园区与智慧城市开发商及运营商，总部位于曼谷，成立于 1989 年，在东南亚工业地产领域具有重要地位。

截至 2025 年末，HOSONIC THAI 已根据合同约定向 Amata 集团支付土地购买价款 10,263.70 万泰铢（总价的 90%），剩余土地购买尾款于 2026 年 5 月支付，土地款项全部支付完成后，Amata 集团将配合公司办理土地产权转让事宜。

（五）避免同业竞争协议

2022 年 12 月，发行人（作为甲方）、林洪河、林毓湘、林毓馨、林瑞堂、林张玉珍（即实际控制人及其一致行动人，作为乙方）以及台湾鸿星（作为丙方）等三方签署了《避免同业竞争协议》。根据协议，实际控制人及其一致行动人、台湾鸿星应避免同业竞争，承担包括业务类型限制、市场区域划分、避免客户重叠、潜在客户资源或业务机会让与等义务。具体内容详见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”之“（二）公司与台湾鸿星不存在同业竞争”之“2、协议限制业务范围，避免潜在同业竞争”。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司不存在对外提供担保的情况。

三、诉讼或仲裁事项

（一）公司涉及的未结诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

（二）控股股东或实际控制人、子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

公司间接股东张进兴为林洪河配偶林张玉珍的弟弟，因发行人间接层面的股权纠纷，张进兴对公司实际控制人提起诉讼，具体情况如下：

1、诉讼背景及基本情况

（1）发行人早期间接投资及名义登记安排的历史背景

根据本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九 发行人股本情况”之“（十一）股权代持的形成及解除情况”之“2、间接层面：发行人早期间接投资及名义登记安排”所述，发行人于 1993 年 12 月设立，在设立及早期发展阶段，受当时中国台湾地区有关赴大陆投资政策、投资审批程序、投资额度限制及两岸投资实务环境等因素影响，部分中国台湾地区投资人赴大陆投资时，在登记安排上采用由实际出资人本人、亲友或其他相关人士作为登记名义人的方式。

（2）张氏家族早期间接投资、继承及持股还原情况

发行人成立时，张氏家族（游查某、张进兴、张进沛）分别以自有资金（对台湾鸿星等主体的投资收益等）间接投资发行人。其中，游查某为张进兴母亲，张进沛为张进兴哥哥。2004 年 10 月，张进沛去世，其间接持有的发行人股权由其配偶洪秀珍、女儿张千惠、儿子张家玮继承。2019 年起，发行人开始将张氏家族股权还原至实际股东名下，其中，游查某、张家玮放弃持股，全部赠与张进兴，张进兴所持股权通过 GOLD HARVEST 登记至 H-TEC、LYH。洪秀珍所持股权按实际持股比例通过 NICE 登记至 H-TEC；张千惠所持股权按实际持股比例部分通过 NICE 登记至 H-TEC、部分登记至 LYH。

（3）张进兴此前“刑事告发”及不起诉结果

2023 年 4 月，林洪河收到中国台湾地区检察机构（指中国台湾地区“新北地方检察署”，下同）的“刑事传票”，案由为“背信”。张进兴主张，游查某于 1995 年将有关中国大陆地区投资事业体之权益均赠与给张进兴，林洪河为张进兴处理投资事务。因此张氏家族另两名成员洪秀珍、张千惠的股权亦应归张进兴所有，而林洪河将部份股权还原登记至洪秀珍、张千惠名下之行为，有背信之犯意。

上述案件历经“中国台湾地区检察机构作出不起诉决定-张进兴‘声请再议’后发回续查-续查后再次作出不起诉决定”的过程，2025 年 9 月中国台湾地区地方检察机构下发函文，“不起诉”决定确定，该“刑事诉讼”正式终结。

（4）张进兴本次“民事诉讼”立案情况

2026 年 4 月，根据林洪河、林毓湘收到的“民事起诉状”及中国台湾地区律师意见，张进兴对林洪河、林毓湘在中国台湾地区“新北地方法院”（以下简称“中国台湾地区司法机关”）提起的“民事诉讼”已确认立案。

与此前刑事告发所涉主张相比，张进兴本次民事诉讼所依据的事实基础及请求内容有所调整。张进兴主要援引 1997 年向中国台湾地区投资事务主管部门投资审议委员会（2023 年更名为“投资审议司”，下同）报备的投资人申请名册等资料，主张其自始为相关投资权益之实质权利人，并称其系借游查某、张进沛及王素英三人名义参与相关投资。据此，张进兴推算其在 2021 年持股还原前于 H-TEC 公司应享有的股权比例为 22.74%。

张进兴进一步主张，2021 年持股还原时，林洪河、林毓湘仅向其返还 H-TEC 公司 10.02%股权，导致其应得股权比例减少 12.72%，并据此主张林洪河及林毓湘构成共同侵权及不当得利。基于上述主张，张进兴请求林洪河及林毓湘连带赔偿 1,748.67 万美元，并自起诉状送达次日起至清偿日止按年利率 5%计算利息。截至本招股说明书签署日，该案件尚未开庭审理。

2、发行人早期在中国台湾地区投资事务主管部门，曾存在登记名义人与实际出资安排不完全一致的历史情形

（1）历史不一致情形的形成原因

发行人早期设立发展阶段，受当时中国台湾地区赴大陆投资政策、审批程序、投资额度限制及两岸投资实务环境等因素影响，投资人赴大陆投资时，存在由实际出资人本人、亲友或其他相关人士作为登记名义人的情形。因此，发行人早期在中国台湾地区投资事务主管部门报备或登记的名义人与实际出资及权益安排之间，曾存在不完全一致的情况。该等情形主要系特定历史监管环境及登记实务限制下形成，并非发行人现行股权权属不清或存在重大争议。

（2）历史股权核查及程序瑕疵整改情况

发行人已结合历次出资、利润分配、内部确认文件及相关人员说明等资料，对历史股权沿革进行梳理。为更正前述程序性瑕疵，H-TEC 自 2017 年 5 月开始陆续将股权还原至实际股东名下，中国台湾地区股东亦就还原后的中国台湾股东实际股东情况主动向中国台湾地区投资事务主管部门申请修正，并于 2022 年取得了中国台湾地区投资事务主管部门的投资许可，确保许可事项与实际投资情况一致，相关程序瑕疵均已完成整改。

（3）中国台湾地区投资事务主管部门备案资料仅具行政形式效力，不足以单独作为实际股权归属依据

根据中国台湾律师出具的法律意见，中国台湾地区投资事务主管部门备案资料系主管机关基于“两岸人民关系条例”及外汇管理等规定，对赴大陆投资行为进行行政监督及管理所形成的程序性文件，主要用于确认相关投资行为是否符合当时行政申报及许可要求，并不具有确认私人间实际股权归属或受益权益的终局效力。

涉及名义登记与实际权利归属不一致的民事争议时，股权实质归属仍应结合真实合意、实际出资、股利领取及支配、股东权利行使、内部确认文件及长期履行状态等因素综合判断。张进兴本次主张主要援引历史备案资料推导其个人持股比例，未能充分反映当时两岸投资监管背景、名义登记安排及后续股权还原过程，故不足以单独作为认定其实际持股比例的依据。

截至 2022 年，中国台湾地区投资事务主管部门登记资料与实际股东不一致的情况已经更正，相关程序瑕疵已整改完毕。

3、本次诉讼不会对发行人产生重大不利影响

（1）张进兴诉求仅为现金赔偿，诉讼结果不会引起发行人股权结构变动

张进兴本次民事诉讼请求林洪河及林毓湘连带赔偿其 1,748.67 万美元，并自起诉状送达次日起至清偿日止按年利率 5% 计算利息。该等请求性质上主要为金钱给付请求，并非请求变更发行人股东名册或工商登记事项。因此，该诉讼不会直接导致发行人股权结构发生变动，预计不会对发行人控制权稳定性产生重大不利影响。

（2）张进兴本次民事诉讼相关主张获得支持的可能性较低

结合诉讼时效、现有事实证据及前次“刑事诉讼”处理结果等情况，张进兴本次“民事诉讼”相关主张获得支持的可能性较低，具体如下：

从诉讼时效角度，根据中国台湾律师出具的法律意见，依中国台湾地区有关民事法律规定，侵权行为损害赔偿请求权，自请求权人知悉损害及赔偿义务人时起，二年间不行使而消灭。张进兴早在 2020 年 12 月及 2021 年 5 月间即已多次发函，就相关持股及代持安排提出质疑，并于 2022 年 6 月正式委请律师发函。因此，其至迟于 2022 年 6 月已知悉其所主张之权利受侵害及相应赔偿义务人，相关侵权损害赔偿请求权之二年时效至迟应于 2024 年 6 月届满。

从事实证据角度，张进兴相关主张与长期实际履行情况不符。根据与张进兴的沟通记录、历年分红记录、登记指示书及其他相关资料，2020 年以前，张进兴长期受领相应分红，并未就其实际持股比例及相应分红金额提出异议。

从前次“刑事诉讼”处理结果角度，中国台湾地区检察机关已就相关事项作出不起诉处分。结合中国台湾律师意见及现有证据情况，预计张进兴相关主张获得中国台湾地区法院支持的可能性较低。

综上，基于本次诉讼的请求性质、现有证据情况，本次诉讼事项预计不会对发行人股权结构稳定性、控制权稳定性、持续经营能力及本次发行上市构成重大不利影响。

除上述情况以外，截至本招股说明书签署日，公司控股股东或实际控制人、

子公司，发行人董事、原监事、高级管理人员和其他核心人员不存在可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

第十一节 董事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

林洪河　　辜达元　　林毓湘

陈意青　　吴哲婉　　杨耀中

刘 华　　郭耀成　　李 强

高级管理人员签名：

辜达元　　林毓湘　　陈意青

鸿星科技（集团）股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

发行人全体董事会审计委员会委员声明

公司及全体董事会审计委员会委员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会委员签名：

林洪河　　刘华　　李强

鸿星科技（集团）股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

二、控股股东、实际控制人声明

本公司（或本人）承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：H-TEC HOLDING LIMITED

H-TEC HOLDING LIMITED

董事：

Authorized Signature(s)

林毓湘

实际控制人：

林洪河 林瑞堂

林毓馨 林毓湘

2016 年 5 月 11 日

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

蒋 力

保荐代表人：

俞高平 钱 润

法定代表人：

王苏望

国投证券股份有限公司

2026 年 1 月 11 日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的全部内容，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理签名：

廖笑非

国投证券股份有限公司

2026年 5月 11 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的全部内容，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：

王苏望

国投证券股份有限公司

2020年 5月 11日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

经办律师：

张东晓

经办律师：

张 宽

经办律师：

叶沛瑶

2026 年 5 月 11 日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读鸿星科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供鸿星科技（集团）股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：

魏 琴　　姚丽强　　胡宁宁

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 5 月 11 日

六、承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

正式执业会员 资产评估师 李梁超 32210084

李梁超

正式执业会员 资产评估师 周强 3[illegible]0325

周 强

资产评估机构负责人：

王德清

银信资产评估有限公司

2016 年 5 月 11 日

七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读鸿星科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供鸿星科技（集团）股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：

魏 琴　　姚丽强　　胡宁宁

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 5 月 11 日

八、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读鸿星科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供鸿星科技（集团）股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：

魏 琴 姚丽强 胡宁宁

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 5 月 11 日

第十二节 附件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）募集资金具体运用情况（如募集资金投向和使用管理制度、募集资金投入的时间周期和进度、投资项目可能存在的环保问题及新取得土地或房产等）；

（十四）子公司、参股公司简要情况；

（十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）投资者关系的主要安排

为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构，公

司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定，建立并严格执行完善的投资者权益保护制度，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，积极合理地实施利润分配政策，保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。

1、信息披露制度和流程

公司制定了上市后适用的《信息披露管理制度》，明确公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调执行，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作，公司董事会办公室为信息披露日常事务管理部门。同时《信息披露管理制度》规定了公司信息披露的基本原则和一般规定、内容及披露标准、披露程序、保密措施、披露文件的档案管理与查阅、责任追究机制以及对违规人员的处理措施等，有利于提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。

2、投资者沟通渠道

公司制定了上市后适用的《投资者关系管理制度》，明确了公司投资者关系管理工作的内容和方式、投资者关系管理工作的组织与实施等内容，以加强投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，加强投资者对公司的了解。

3、未来开展投资者关系管理的规划

公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程（草案）》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

（二）本次发行后股利分配政策和决策程序

根据《公司章程（草案）》的相关规定，本次发行后，公司股利分配政策和决策程序的主要条款如下：

1、利润分配原则

（1）公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式；

（4）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。

2、利润分配的具体内容

（1）利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）利润分配的期间间隔

1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

2）公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（3）利润分配的条件

1）公司现金分红的具体条件和比例

①公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）；

②公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）；

③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展。

⑤无公司股东会批准的可以不进行现金分红的其他重大特殊情况。

若满足上述第①项至第⑤项条件，公司应进行现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%（按合并报表口径）。

未全部满足上述第①项至第⑤项条件，但公司认为有必要时，也可进行现

金分红。

2）各期现金分红最低比例

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第③项规定处理。

3）发放股票股利的具体条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

3、利润分配的决策程序和决策机制

（1）在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配方案。

（2）公司董事会拟订具体的利润分配方案时，应当遵守我国有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的政策。

（3）公司董事会在有关利润分配方案的决策和讨论过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、持有公司股份的机构投资者和中小股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。

（4）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后

未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红方案的，公司在召开股东会时除现场会议外，还可向股东提供网络形式的投票平台。

4、利润分配方案的审议程序

（1）公司董事会审议通过利润分配方案后，方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意方为通过。

（2）股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、利润分配政策的调整

（1）如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：如经济环境重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。

（2）公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意方为通过。

（3）对公司章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后提交股东会审议，且公司可提供网络形式的投票平台为股东参加股东会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因。股东会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）股东投票机制建立情况

根据《公司章程（草案）》和《股东会议事规则》的相关规定，公司建立了普通决议表决、特别决议表决、累积投票制选举董事、中小投资者单独计票、网络投票方式召开股东会等股东投票机制，充分保证了股东权利。

三、与投资者保护相关的承诺

（一）发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺

1、公司控股股东 H-TEC 承诺

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项的，发行价应相应调整，下同）。在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

（3）本企业持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

（4）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。

（5）股份锁定期届满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

（6）本企业如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、公司实际控制人林洪河、林毓湘承诺

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该

部分股份。

（2）如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项的，发行价应相应调整，下同）。在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

（3）前述锁定期满后，本人在公司担任董事期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

（4）若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内不得转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

（5）本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

（6）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。

（7）本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

（8）本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。

（9）本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3、公司实际控制人林瑞堂、林毓馨及一致行动人林张玉珍承诺

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项的，发行价应相应调整，下同）。在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

（3）本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

（4）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。

（5）本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

（6）本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

4、公司董事、高级管理人员辜达元及董事杨耀中承诺

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项的，发行价应相应调整，下同）。在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

（3）前述锁定期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

（4）若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过

本人所持公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内不得转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

（5）本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

（6）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。

（7）本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

（8）本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。

（9）本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

5、公司股东杭州湛洋承诺

（1）自取得公司股份的工商变更登记完成之日起三十六个月内及自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。

（3）股份锁定期届满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

（4）本企业如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

6、公司股东 JOINT、PERFECT、DYNAMIC、LYH 承诺

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格不低于发

行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息除权事项的，发行价应相应调整，下同）。在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

（3）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。

（4）股份锁定期届满后，本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

（5）本企业如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

7、公司股东 LINKRICH、KSP、GOLDRICH、杭州纮洋、杭州澜洋、杭州湟江、贡进忠、江燕、桂志义、冯信和、闫翠华、何东升、代祖明、陶霞芳承诺

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。

（3）股份锁定期届满后，本企业/本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，并履行必要的备案、公告程序。

（4）本企业/本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，则违规减持所得全部上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，本企业/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（二）业绩下滑延长锁定期限的承诺

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的其他股东承诺如下：

1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本企业/本人

届时所持股份锁定期限 12 个月；

2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业/本人届时所持股份锁定期限 12 个月；

3、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业/本人届时所持股份锁定期限 12 个月。

上述承诺中，“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准；“届时所持股份”是指本企业/本人上市前取得且上市当年年报披露时仍持有的股份。

（三）发行前股东持股及减持意向承诺

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的其他股东承诺如下：

1、本企业/本人所持发行人股份锁定期届满后，本企业/本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求。

2、减持意向：本企业/本人将严格按照发行人首次公开发行股票招股说明书及本发行人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律法规、规范性文件等监管规定，在锁定期内不减持直接或间接持有的发行人股份。

3、减持方式：减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、减持价格：本企业/本人减持直接或间接持有的发行人股票的价格将根据当时二级市场价格确定（发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权、除息事项的，发行价应相应进行调整，下同）。在锁定期满后两年内，本企业/本人减持所持有的发行人股份的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。

5、减持期限：本企业/本人将根据相关法律法规及证券交易所规则的要求，结合证券市场情况、发行人股价走势及公开信息等情况，审慎制定减持计划。本企业/本人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，其中通过证券交易所集中竞价交易方式首次减持的，应提前十五个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

6、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及深圳

证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

7、若因本企业/本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本发行人无法控制的客观原因导致的除外），转让相关股份所取得的收益归发行人所有，造成投资者和发行人损失的，本企业/本人将依法赔偿损失。

（四）关于稳定股价的措施及承诺

为保护投资者利益，进一步明确发行人上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定，公司制定了公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案，公司、公司控股股东、董事及高级管理人员就稳定股价措施作出承诺如下：

1、稳定股价预案有效期及触发条件

（1）稳定股价预案自公司股票上市之日起 3 年内有效；

（2）稳定股价预案有效期内，一旦公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案；

（3）稳定股价预案授权公司董事会负责监督、执行。

公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日内发布提示公告，并在 5 个交易日内召开董事会会议讨论通过具体的稳定股价方案并公告。如未按上述期限公告稳定股价措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。

公司制定稳定股价方案时，应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购的相关规定；不可导致公司股权分布不符合上市条件。

2、稳定股价预案的具体措施

稳定股价预案的具体措施为：公司回购公司股票，公司控股股东增持公司股票，董事（不包括独立董事，下同）和高级管理人员增持公司股票。

公司制定稳定股价预案具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响，并在符合相关法律法规的规定的情况下，各

方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体，并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。

公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标。当次稳定股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。如果在公司稳定股价方案实施前公司股价已经不满足预案触发条件的，可不再继续实施该方案。

公司及控股股东、董事及高级管理人员在履行其回购或增持义务时，应按照深圳证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。

3、稳定股价措施的实施

（1）公司回购股票

①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

②在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在收到通知后 2 个工作日内启动决策程序，经股东会决议通过后，依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取深圳证券交易所集中竞价交易方式、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

③公司回购股份议案需经董事会、股东会决议通过，其中股东会须经出席会议的股东所持表决的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东承诺就该等回购事宜在股东会中投赞成票。

④公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

⑤公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金。

除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下各项：

公司单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，超过上述标准的，有

关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

如果公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

（2）公司控股股东增持

①控股股东为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。

②在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东应在收到通知后 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

③控股股东在实施稳定股价议案时，应符合下列各项：

公司控股股东合计单次用于增持的资金不超过其上一年度公司现金分红的 10%，年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额；公司控股股东合计单次增持不超过公司总股本 2%；

公司控股股东增持价格不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

（3）公司董事及高级管理人员增持

①公司董事及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

②在公司出现应启动预案情形时，公司董事及高级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内开始启动增持方案。增持方案实

施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

③公司董事及高级管理人员增持价格应不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

④公司董事及高级管理人员实施稳定股价议案时，单次用于增持股份的货币资金不超过董事和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的 10%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的税后薪酬的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

（5）公司董事及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。公司上市后 3 年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

4、相关约束措施

（1）公司违反本预案的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（2）公司控股股东违反承诺的约束措施

公司控股股东在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述预案的规定采取相应

的稳定股价措施并实施完毕时为止。

（3）公司董事及高级管理人员违反承诺的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事及高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬或股东分红（如有），同时持有的公司股份（如有）不得转让，直至按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

5、稳定股价措施的继续实施和终止

（1）在公司稳定股价措施实施期间，公司、控股股东、董事、高级管理人员可在履行相应程序和信息披露义务后，追加实施回购或增持措施。

（2）在公司稳定股价措施实施期限（自触发日起 120 天）届满时，若稳定股价方案终止的条件未能实现，公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体应即刻提出并追加实施回购或增持措施（追加措施的比例和期限可届时视情形确定），直至稳定股价方案终止条件实现。

（3）在公司稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

（五）股份回购和股份买回的措施和承诺

1、公司承诺

《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，将依法回购首次公开发行的全部新股。

本公司将在中国证监会或其他有权部门认定有关违法事实之日起 30 日内公

告回购新股的方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，回购方案应经本公司股东会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起六个月内完成回购，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股票的加权平均价。公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权、除息事项的，发行价应相应进行调整。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业/本人将督促发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

（六）关于欺诈发行上市的股份购回的承诺

1、发行人承诺

保证本公司本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

2、公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺

保证公司本次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

（七）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、填补被摊薄即期回报的措施

（1）加快募投项目进度，加强募集资金管理，提高资金使用效率

本次募投资金项目市场前景良好。募集资金到位后，公司将加快募投项目

建设，尽快产生经济效益。同时，公司董事会将严格按照《募集资金管理办法》要求，将本次募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中并严格管理，确保专款专用，防范募集资金使用风险。

（2）完善公司治理，强化内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东会、董事会及其各专门委员会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理架构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制。公司内部控制制度完整、合理且有效。公司将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（3）不断推进改进工艺流程，持续提升安全生产和环保处理能力

公司将持续投入研发生产，不断改进全环节的工艺流程。在前端生产环节上：通过优化生产流程不断向自动化靠拢，一方面有利于保障生产过程的精准高效，另一方面不断减少人力的直接参与，将进一步减少安全生产事故的发生概率以及发生安全生产事故后造成人身安全事故的风险。在后端三废处理环节上：通过持续的环保投入和研发探索，不断改进三废处理的方式方法，使得公司环保方面持续满足监管部门现在以及未来的各项监管要求，从而避免出现因环保不过关而影响正常生产的情形出现。

（4）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，公司在《公司章程（草案）》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制；公司已制定《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。

公司将严格实施相关利润分配制度，切实保护中小投资者的利益，努力提高所有股东的即期回报。

2、填补被摊薄即期回报的承诺

（1）公司控股股东承诺

1）承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用

其他方式损害公司利益；

2）承诺对职务消费行为进行约束；

3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6）在中国证监会或证券交易所另行发布摊薄即期回报的填补措施及承诺的相关意见或实施细则后，如果公司的相关规定及本企业承诺不能满足该等规定的，本企业承诺将立即按该等规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；

7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺，本企业愿意：①在公司股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②无条件接受中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本企业作出的处罚或采取的相关监管措施；③给公司或者投资者造成损失的，依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

（2）公司实际控制人及其一致行动人承诺

1）承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2）承诺对职务消费行为进行约束；

3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6）在中国证监会或证券交易所另行发布摊薄即期回报的填补措施及承诺的相关意见或实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺不能满足该等规定的，本人承诺将立即按该等规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；

7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺，本人愿意：①在公司股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②无条件接受中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；③给公司或者投资者造成损失的，依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

（3）董事、高级管理人员的承诺

1）承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2）承诺对职务消费行为进行约束；

3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6）在中国证监会或证券交易所另行发布摊薄即期回报的填补措施及承诺的相关意见或实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺不能满足该等规定的，本人承诺将立即按该等规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；

7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺，本人愿意：①在公司股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②无条件接受中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；③给公司或者投资者造成损失的，依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

（八）关于利润分配政策的承诺

1、公司承诺

本公司将严格按照经股东会审议通过的《公司章程（草案）》《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。

如本公司违反承诺给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担责任。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

本企业/本人将督促公司严格按照经股东会审议通过的《公司章程（草案）》《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》规定的利润分配政策向股东分配利润，履行利润分配方案的审议程序。

如本企业/本人违反承诺给投资者造成损失的，本企业/本人将向投资者依法承担责任。

（九）依法承担赔偿责任的承诺

1、公司承诺

（1）《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（2）本公司将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行上述承诺，本公司将在本公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

2、公司控股股东承诺

（1）《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法

赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本企业将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（2）本企业将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本企业未履行上述承诺，本企业将在发行人股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本企业直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本企业按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本企业将严格依法执行该等裁判、决定。

3、公司实际控制人及一致行动人承诺

（1）《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（2）本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而

被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

4、公司董事、高级管理人员承诺

（1）《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（2）本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

5、与本次发行有关的中介机构承诺

本次发行的保荐机构国投证券股份有限公司承诺：本公司已对发行人招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。

本次发行的审计机构、验资机构、验资复核机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如本所为发行人申请首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

本次发行的律师事务所上海市锦天城律师事务所承诺：如因本所为发行人

首次公开发行股票并上市出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，投资者有权按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(法释[2022]2 号)等相关法律法规和司法解释的规定获得合法赔偿。如相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的法律法规和司法解释执行。

本次发行的评估机构银信资产评估有限公司承诺：为鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本机构制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（十）避免新增同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

1、发行人主要从事石英晶振产品的研发、生产和销售。台湾鸿星主要向中国台湾地区客户销售石英晶振产品；台湾鸿星不从事任何研发和生产业务，仅为发行人在中国台湾地区的经销商，不会对发行人构成重大不利影响。

2、截至本承诺函签署日，除第 1 条所述情形外，本企业及本企业控制的其他企业/本人及本人近亲属在中国境内外不存在直接或间接（包括但不限于自营、与他人共同经营或为他人经营）从事与发行人形成竞争或潜在竞争关系业务（以下简称“竞争业务”）。

竞争业务具体是指：（1）石英晶振产品的研发、生产和销售；或（2）与石英晶振产品存在替代、竞争和利益冲突的业务。

3、除第 1 条所述情形外，本企业及本企业控制的其他企业/本人及本人近亲属未来也不在中国境内外直接或间接从事竞争业务。台湾鸿星未来仅向中国台湾地区客户销售石英晶振产品，不得从事研发或生产业务，且不得与发行人的客户发生交易。

4、为确保第 3 条相关措施的有效实施，本企业/本人承诺：（1）每季度汇总本企业及本企业控制的其他企业/本人及本人近亲属控制的全部企业经营业务情况，向发行人出具《关于避免同业竞争承诺的执行情况报告》；（2）台湾鸿星应于每月前 10 个工作日内向甲方报送上月销售明细表，包括但不限于客户名称、客户所在区域、销售产品、销售数量等要素。

5、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业控制的其他企业/本人及本人近亲属将不直接或间接生产、开发与发行人拓展后的产品存在竞争的产品，从事或参与与发行人拓展后的业务存在竞争的业务；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本企业及本企业控制的其他企业/本人及本人近亲属直接或间接控制的除发行人外的其他企业将以停止生产或经营存在竞争的产品或业务的方式、或将存在竞争的业务纳入到发行人体内的方式、或将存在竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

6、如有任何违反上述承诺的事项发生，本企业/本人将在公司股东会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有，并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。

（十一）规范和减少关联交易的承诺

1、公司控股股东承诺

（1）严格遵守《中华人民共和国公司法》《鸿星科技（集团）股份有限公司章程》《鸿星科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》《鸿星科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》《鸿星科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本企业在发行人中的地位，为本企业、本企业控制的除发行人及其子公司以外的企业，在与发行人或其子公司的关联交易中谋取不正当利益；

（2）如果本企业、本企业控制的除发行人及其子公司以外企业与发行人或其子公司不可避免地出现关联交易，本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议；

（3）发行人或其子公司与本企业、本企业控制的除发行人及其子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其子公司的合法权益；

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有，并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。

2、公司实际控制人及一致行动人承诺

（1）严格遵守《中华人民共和国公司法》《鸿星科技（集团）股份有限公司章程》《鸿星科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》《鸿星科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》《鸿星科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位，为本人、本人控制的除发行人及其子公司以外的企业，在与发行人或其子公司的关联交易中谋取不正当利益；

（2）如果本人、本人控制的除发行人及其子公司以外企业与发行人或其子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议；

（3）发行人或其子公司与本人、本人控制的除发行人及其子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其子公司的合法权益；

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有，并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。

3、公司董事、高级管理人员承诺

（1）严格遵守《中华人民共和国公司法》《鸿星科技（集团）股份有限公司章程》《鸿星科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》《鸿星科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》《鸿星科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位，为本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其子公司以外的企业，在与发行人或其子公司的关联交易中谋取不正当利益；

（2）如果本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其子公司以外的企业与发行人或其子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行相关义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东会、董事会作出侵犯发行人及其他股东合法权益

的决议；

（3）发行人或其子公司与本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其子公司的合法权益；

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有，并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的全部损失。

（十二）股东信息披露的承诺

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》等相关文件的要求，公司作出如下承诺：

1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

2、不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份的情形；

3、不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

（十三）在审期间不进行现金分红的承诺

针对在审期间现金分红事项，公司作出如下承诺：

1、自本公司向深圳证券交易所提出首次公开发行股票申请之日至公司股票在深圳证券交易所创业板上市前，本公司不进行现金分红；

2、上述承诺为本公司的真实意思表示，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

（十四）未能履行承诺的约束措施的承诺

1、公司承诺

为保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就本公司在《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：

（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规调整、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：

①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体

原因；

②向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益；

③将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东会审议；

④调减对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事和高级管理人员的薪酬、津贴；停止制定或实施增发股份、发行公司债券、重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺；

⑤若因本公司违反或未能履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的公开承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法承担相应的法律责任。

（2）如因相关法律法规调整、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。

2、公司控股股东承诺

本企业作为公司控股股东，为保护公司及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本企业在《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中作出承诺的履行事宜，郑重承诺如下：

除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：

（1）如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

③暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；

④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

⑤本企业未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（2）如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

3、公司实际控制人及一致行动人承诺

本人作为公司实际控制人或实际控制人之一致行动人，为保护公司及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中作出的承诺的履行事宜，郑重承诺：

除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：

（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

⑤本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司

投资者利益。

4、公司董事、高级管理人员承诺

本人作为公司董事/高级管理人员，为保护公司及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在《鸿星科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中作出的承诺的履行事宜，郑重承诺：

除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：

（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

④可以职务变更但不得主动要求离职；

⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；

⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

⑦本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

四、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

报告期内，公司股东会、董事会等依照相关法律法规及《公司章程》的规定独立运作，相关人员能够切实履行各自的权利、义务与职责，未出现违法违

规情形。

（一）股东会制度建立健全及运行情况

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东会的权力和决策程序，对股东会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。《股东会议事规则》分别从股东会的召集、提案与通知、召开、监管措施等方面详细规定了股东行使权力的方式以及股东会作为公司最高权力机构的基本职能。

股份公司成立以来，公司历次股东会的召集人和出席会议人员资格均合法、有效，历次股东会的表决程序及表决结果均合法有效，股东依法履行了《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务，不存在违反《公司法》及其他相关规定行使职权的情形。

（二）董事会制度建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会。

《董事会议事规则》对董事会的召集及通知、会议的议事和表决程序、会议记录、决议及公告等作出了明确规定。目前，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任。董事长由董事会选举产生。

股份公司成立以来，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关规定规范运作，历次董事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。董事会、董事依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。

（三）监事会制度建立健全及运行情况

股份公司成立至 2025 年 12 月，公司由 3 名监事组成监事会，制定并有效执行《监事会议事规则》。监事会存续期间，公司历次监事会会议的召集、出

席、议事、表决均符合相关规定，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。历次监事会对监事会主席的选举、财务预算与决算、公司利润分配等事项进行审议并做出有效决议，对公司财务工作、董事及高级管理人员的工作、重大生产经营等重大事宜实施了有效监督。历次监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》及相关规定，规范运作，不存在监事会违反《公司法》及其他相关规定行使职权的情形。

2025 年 12 月，公司根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，取消监事会。监事会取消后，由审计委员会行使原监事会职权。

（四）独立董事制度建立健全及运行情况

依据《公司法》和《证券法》等相关法律法规要求，公司制定了《公司章程》和《独立董事议事规则》等规范。公司董事会成员中包括 3 名独立董事（其中 1 名为会计专业人士），不少于董事会成员总人数的三分之一，符合相关规定要求。独立董事的提名与任职符合相关法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等的规定。

自公司设立独立董事以来，独立董事出席了全部股东会会议、董事会会议，能够依据《公司法》《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行相关权利和义务，及时了解公司业务、财务等经营管理情况，认真审议各项会议议案，在完善公司治理结构、公司战略发展选择等方面发挥了积极作用，保护了全体股东的利益。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等规范。公司设立董事会秘书 1 名，负责协调和组织公司的信息披露事务。

公司董事会秘书按照《公司章程》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东会，为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，按照有关规定完成历次会议记录，较好地履行了相关职责。

五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况

（一）董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，确保了董事会对管理层的有效监督，协助董事会履行职责，进一步完善了本公司的公司治理结构。

（二）专业委员会的运行情况

公司各专业委员会自设立以来运行情况良好，各专业委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及各委员会工作细则等规定，规范运作。各位委员谨慎、认真、勤勉地履行了相应权利和义务。各专门委员会的建立和运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

六、募集资金具体运用情况

（一）募集资金项目总体情况

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目	鸿星科技	32,240.00	32,240.00
2	新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目	浙江鸿星	15,960.00	14,860.00
3	基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目	鸿星科技	10,000.00	10,000.00
4	数智化制造与运营管理平台升级建设项目	鸿星科技	7,900.00	7,900.00
合计			**66,100.00**	**65,000.00**

（二）募集资金项目具体情况

1、新增 7 亿只频率控制元件产品优化及产能扩建项目

（1）项目概况

本项目是由发行人在杭州基地的现有厂区内实施，建成达产后，新增年产石英晶振 7 亿只的生产能力。本项目拟对现有杭州基地进行技术改造，购置生

产设备。项目投资具体情况如下表所示：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比重（%）
1	设备投资	25,000.00	77.54
2	软件投资	2,000.00	6.20
3	预备费	1,350.00	4.19
4	铺底流动资金	3,890.00	12.07
项目总投资		**32,240.00**	**100.00**

（2）项目选址情况

本项目在发行人位于浙江省杭州市余杭区良渚街道的现有厂区内实施。本项目区域内工业辅助设施、物流运输、环境保护和管理服务等的资源整合和基础设施建设、消防、供水、供电、通讯、排污管网污水处理厂等公用设施齐全。

（3）项目的环保情况

本项目已取得杭州市生态环境局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》（杭环余备（零）2026-4 号）。

（4）项目实施进度

本项目建设期 3 年，第 1 年开始生产，第 5 年达产。本项目建设期分如下四个阶段工作实施：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
设备订货及采购												
设备安装及调试												
人员招聘及培训												
试运营及投产												

2、新增 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件项目

（1）项目概况

本项目是由公司子公司浙江鸿星在浙江省湖州市德清县的厂区内实施，建成达产后，预计新增年产 5 亿只微型化及高精度石英晶体元器件产能。本项目拟对现有德清基地进行技术改造，购置生产设备。项目投资具体情况如下表所示：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比重（%）
1	建设投资	3,900.00	24.44
2	设备投资	7,900.00	49.50
3	软件投资	1,700.00	10.65
4	预备费	630.00	3.95
5	铺底流动资金	1,830.00	11.47
项目总投资		**15,960.00**	**100.00**

（2）项目选址情况

本项目在发行人子公司浙江鸿星位于浙江省德清县康乾街道上唐街 81 号的现有厂区内实施。本项目区域内工业辅助设施、物流运输、环境保护和管理服务等的资源整合和基础设施建设、消防、供水、供电、通讯、排污管网污水处理厂等公用设施齐全。

（3）项目的环保情况

本项目已取得湖州市生态环境局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》（湖德环建备〔2026〕12 号）。

（4）项目实施进度

本项目建设期 3 年，第 1 年开始生产，第 5 年达产。本项目建设期分如下五个阶段工作实施：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设												
设备订货及采购												
设备安装及调试												
人员招聘及培训												
试运营及投产												

3、基于 MEMS（微机电系统）光刻新技术新产品平台研发项目

（1）项目概况

本项目是由发行人在杭州基地的现有厂区内实施，通过建设黄光室，引进半导体封装试验设备、频率测量机等研发设备，对现有研发平台进行改造升级，旨在建成基于 MEMS（微机电系统）光刻工艺技术平台，同时研究微型化、高

精度、特定应用场景下晶振产品的设计、生产工艺、装备改造、测试等技术。项目投资具体情况如下表所示：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比重（%）
1	建设投资	500.00	5.00
2	设备投资	4,000.00	40.00
3	预备费	225.00	2.25
4	项目实施费用	5,275.00	52.75
项目总投资		**10,000.00**	**100.00**

（2）项目选址情况

本项目在发行人位于浙江省杭州市余杭区良渚街道的现有厂区内实施，不涉及新增募投项目用地。

（3）项目的环保情况

本项目已取得杭州市生态环境局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》（杭环余备（零）2026-5 号）。

（4）项目实施进度

本项目建设期 3 年，本项目建设期分如下三个阶段工作实施：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
场地装修												
设备订货及采购												
人员招聘及课题开展												

4、数智化制造与运营管理平台升级建设项目

（1）项目概况

本项目在公司现有的信息化和数字化基础条件上，升级生产制造、运营决策、市场经营及技术研发等信息化系统条件，提升鸿星科技数字管理能力，推动业务全面智能化，支撑集团化管控体系，提升经营管理效率。项目投资具体情况如下表所示：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比重（%）
1	硬件投资	2,000.00	25.32
2	软件投资	4,200.00	53.16

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比重（%）
3	预备费	310.00	3.92
4	项目实施费用	1,390.00	17.59
项目总投资		**7,900.00**	**100.00**

（2）项目选址情况

本项目在发行人位于浙江省杭州市余杭区良渚街道的现有厂区内实施，不涉及新增募投项目用地。

（3）项目的环保情况

本项目为数智化制造与运营管理平台升级建设项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目无需开展环境影响评价备案、审批。

（4）项目实施进度

本项目建设期 3 年，本项目建设期分如下四个阶段工作实施：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
软件系统设计												
硬件设施												
软件系统实施												
人员培训												

（三）募集资金运用可行性

1、良好的品牌形象和完善的产品系列，为本项目实施提供产能消化保障

公司自成立以来，凭借优质的产品及服务，打造的“鸿星（Hosonic）”品牌已经得到广泛认可，成为国内外石英晶体元器件市场的主流品牌之一，产品具有较高的客户认知度和忠诚度，鸿星科技石英晶体元器件全球市场占有率持续位于全球前列。经过多年发展，公司已形成从大尺寸到小尺寸、涵盖高中低频石英晶体振荡器、谐振器的产品系列，并广泛应用于通讯电子、消费电子、AIoT、工业控制、汽车电子、AI 算力、机器人等领域，积累了丰富的多行业下游应用经验。

因此，基于公司现有完善的产品系列，以及下游应用领域的成功应用，公司产品将在满足现有行业客户需求的基础上，深入挖掘现有行业客户的潜在需

求和其他潜在行业客户的各类需求，进一步完善产品系列，为本项目实施提供产能消化保障。

2、高效的营销网络和优质的客户资源，为本项目实施提供销售基础

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，在国内外建立较为高效的营销网络。公司总部设立于浙江杭州，在深圳、东莞、中国香港等地设有营销网点，可覆盖华东区域、华北区域、华南区域、亚太地区，形成了广泛且稳定的销售服务网络。此外，经销商遍布国内外多座城市，可对直销渠道未覆盖区域形成有效补充，有利于公司业务进一步扩大。高效的营销网络体系也为公司聚集优质的客户资源提供了必要的支持作用。

公司深耕石英晶体元器件市场多年，坚持以客户需求为导向，通过质量良好的品牌形象、完善的产品系列、高效的营销体系，获得了国内外下游客户的高度认可，构建了优质的客户资源体系，优质稳定的客户群体对公司的发展和壮大起到了重要的推动作用，同时也为本项目的开展奠定了稳定的市场基础。

综上，凭借良好的品牌形象、完善的产品系列和高效的营销体系，公司在国内外石英晶体元器件领域具有较强的市场影响力。众多优质的国内外客户资源保证了为本项目扩产的产品产能消化提供了必要的销售基础。

3、严格的质量控制和健全的生产体系，为本项目实施提供必要保证

公司不断健全科学高效的生产管理体系，为本项目的实施提供了必要保证。

在质量控制方面，公司始终把产品质量视为公司经营发展的重要保障，根据行业及公司特性制定了《生产计划管理制度》《存货管理制度》等质量管理规章制度，推行全面质量管理，建立科学、严密、高效的质量管理体系。公司设立有品保中心，配备满足生产需要的质量检验人员和设备、设施、测量工具等，从原材料进厂到产成品出厂实行全流程管控，有效保证了产品质量和项目实施符合市场及客户需求。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 质量管理体系、IECQ 质量评定体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

在生产管理方面，公司生产计划主要采取以销定产+适度备货模式。生产过程中，生产中心对整个生产制造过程进行监督控制，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行识别和控制，确保整个生产过程在受控状态下有序进行，不

断改善生产过程、提高生产效率、保证产品质量。

在成本控制方面，公司产品具有较强的成本优势。从内部管理看，公司积累了大量的实践数据和丰富的生产管理经验，能够从晶片加工至包装标识等各生产工艺环节进行严格的质量管控，提升各制造环节的合格率，并在关键质量控制点进行节点控制，避免后续投入物料的浪费。严格的工艺流程管理和控制，有效降低了公司的生产成本。从设备自动化程度看，公司生产的自动化程度较高，一方面有利于生产工艺流程管理，保证产品质量及合格率；另一方面，所需的产线工人较少，有利于在人力成本持续上涨的情况下控制生产成本。

综上，公司实现了健康、优质、高效的生产运作，在质量控制、生产管理、成本控制等方面具备完善的管理机制和丰富的经验积累，能够为本次募投项目提供充分的管理流程和经验支持，从而确保本项目的顺利实施。

4、强大的技术实力和完善的研发体系，为本项目实施提供技术支持

公司积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，不断产出能满足客户需求的新产品，持续强化公司在石英晶振领域的竞争地位。通过核心技术的不断积累，公司已在技术创新与储备、研发团队、研发体系等方面形成一系列优势，为项目的实施提供了技术支持。

在技术创新与储备方面，凭借优秀的研发团队和持续增加的研发投入，公司形成了强大的技术研发能力。公司内部研发机构被浙江省科学技术厅评定为“省级高新技术企业研究开发中心”。公司积极通过专利申请等方式对创新技术成果予以保护，以巩固提升公司在行业内的竞争地位。公司拥有丰富的设备管理与改造经验，掌握了高精度高频产品设计技术、高精度晶振产品精密制造技术、高精度晶振产品测量技术等相关核心技术，进一步提高了公司产品的自动化生产水平；公司基于 MEMS 光刻技术已有技术储备，进一步突破超小尺寸、超高频率晶体制造的技术壁垒，实现微小尺寸、超高基频晶振稳定量产，提升我国石英晶振核心元件的自主化水平。

在研发团队方面，公司建立一支行业经验丰富、创新能力强、技术水平先进的研发团队，主要由无线电技术、电子与通信工程、自动化、机械设计制造及其自动化等专业人员组成，专业结构丰富、年龄层次合理。同时，公司不断完善与加强人才激励制度，鼓励人才的创新研究、成果转化，并通过合作研发

合作等方式，加强与外部科研院所的交流，加速核心研发人才培育与梯队建设，为公司发展创造源源不断的动力。

在研发体系方面，公司积极完善企业技术创新、技术储备机制，建立了较为完整的技术创新体制，研发部门结合企业发展战略、市场及技术现状，制定研发项目开发计划，实施了从研发立项、产品设计与开发到样品验证等各个环节的全流程规范管理，并随着公司规模的不断扩大和研发水平的不断提升而持续完善。同时为规范技术创新工作，公司制定了创新管理标准，对核心技术人员管理、研发成果转化与保护进行了详细规定。此外，公司制定了《研究与开发管理制度》等制度，为技术创新提供制度保障。

综上所述，公司强大的技术创新与储备、经验丰富的研发团队、完善的研发体系，在满足客户对于产品供应效率需求的同时，可确保公司紧随行业发展趋势和客户实际需求，为客户提供性能强、质量稳定的石英晶振产品，深度挖掘现有客户需求潜力并吸引潜在客户，为本项目实施提供强大的技术支持。

七、子公司及参股公司的基本情况

（一）浙江鸿星

公司名称	浙江鸿星电子科技有限公司				
成立时间	2020 年 7 月 21 日				
注册资本	13,242.30 万元				
实收资本	13,242.30 万元				
注册地和主要生产经营地	浙江省湖州市德清县康乾街道上唐街 81 号				
主营业务	从事石英晶振的生产与销售				
子公司定位	发行人石英晶振等产品的生产基地之一				
股权结构	鸿星科技持股 100%				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经立信审计）	**日期**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	33,815.42	15,116.18	22,844.76	997.76

（二）金华鸿瑞

公司名称	金华鸿瑞电子有限公司
成立时间	2003 年 4 月 30 日

注册资本	860 万元				
实收资本	860 万元				
注册地和主要生产经营地	浙江省金华市金磐开发区大盘街 1 号				
主营业务	从事晶片的生产				
子公司定位	发行人原材料晶片的生产基地之一				
股权结构	鸿星科技持股 100%				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经立信审计）	**日期**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	1,963.41	1,579.15	1,389.62	199.07

（三）湖州鸿皓

公司名称	湖州鸿皓电子新材料有限公司				
成立时间	2021 年 12 月 14 日				
注册资本	2,500 万元				
实收资本	2,500 万元				
注册地和主要生产经营地	浙江省湖州市德清县康乾街道上唐街 81 号生产楼 A 一层				
主营业务	从事晶片的生产				
子公司定位	发行人原材料晶片的生产基地之一				
股权结构	鸿星科技持股 100%				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经立信审计）	**日期**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	3,666.04	3,274.71	1,819.84	258.03

（四）东莞佳晟

公司名称	东莞市佳晟电子有限公司				
成立时间	2007 年 7 月 19 日				
注册资本	380 万元				
实收资本	380 万元				
注册地和主要生产经营地	东莞市长安镇长青街西面长安商业广场四区 1207 单元				
主营业务	从事石英晶振等产品的销售				
子公司定位	发行人华南地区的销售平台				
股权结构	鸿星科技持股 100%				
最近一年主要财务	**日期**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**

数据（单位：万元，经立信审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2,957.14	1,344.99	5,331.54	178.91

（五）鸿星企业

企业名称（中文）	鸿星国际企业有限公司				
企业名称（英文）	HOSONIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED				
成立时间	2014 年 10 月 27 日				
注册资本	10 万股				
实收资本	10 万港元				
注册地和主要生产经营地	Room 1405, 14/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Hong Kong（中国香港特别行政区九龙湾临乐街 19 号南丰商业中心 14 层 1405 室）				
主营业务	从事基座、上盖等原材料的境外采购				
子公司定位	发行人境外采购平台				
股权结构	鸿星科技持股 100%				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经立信审计）	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	12,001.54	9,325.82	16,573.60	2,938.82

（六）鸿星国际

企业名称（中文）	鸿星国际电子有限公司				
企业名称（英文）	HOSONIC INTERNATIONAL LIMITED				
成立时间	2000 年 6 月 14 日				
注册资本	1,680 万股				
实收资本	1,680 万港元				
注册地和主要生产经营地	Flat 1405-06, 14/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong（中国香港特别行政区九龙湾临乐街 19 号南丰商业中心 14 层 1405-1406 室）				
主营业务	从事石英晶振等产品的境外销售				
子公司定位	发行人境外销售平台				
股权结构	鸿星科技持股 100%				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经立信审计）	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	12,461.32	4,289.99	18,429.08	780.60

（七）HOSONIC GLOBAL

企业名称（中文）	鸿星全球投资有限公司

企业名称（英文）	HOSONIC GLOBAL INVESTMENT LIMITED				
成立时间	2024 年 9 月 10 日				
注册资本	1,000 万股				
实收资本	-				
注册地和主要生产经营地	Room 1405, 14/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Hong Kong（中国香港特别行政区九龙湾临乐街 19 号南丰商业中心 14 层 1405 室）				
主营业务	投资管理				
子公司定位	拟作为境外投资、采购平台				
股权结构	鸿星科技持股 100%				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经立信审计）	**日期**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	85.39	11.49	-	13.23

（八）HOSONIC JAPAN

公司名称	株式会社 HOSONIC JAPAN				
成立时间	2024 年 5 月 20 日				
注册资本	10,000 株				
实收资本	1 亿日元				
注册地和主要生产经营地	东京都港区赤坂二丁目 8 番 14-407 号				
主营业务	投资管理				
子公司定位	拟作为投资平台				
股权结构	鸿星企业持股 100%				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经立信审计）	**日期**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	434.69	433.88	-	-14.33

（九）HOSONIC THAI

公司名称	Hosonic Timetec Thai Co., Ltd.
成立时间	2025 年 8 月 18 日
注册资本	7,000 万泰铢
实收资本	7,000 万泰铢
注册地和主要生产经营地	No. 89/133, Village # 13, Lam Luk Ka Subdistrict, Lam Luk Ka District,Pathum Thani Province, Thailand
主营业务	目前尚未营业，拟从事石英晶振等产品的制造、研发与销售
子公司定位	拟开展石英晶振等产品的制造、研发与销售

股权结构	鸿星国际持股 99.00%，林毓馨持股 0.50%，林毓湘持股 0.50%				
最近一年主要财务数据（单位：万元，经立信审计）	**日期**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2,670.75	1,582.23	-	24.39

（十）江阴鸿翔（已注销）

公司名称	江阴鸿翔电子有限公司
成立时间	2006 年 6 月 21 日
注销时间	2023 年 1 月 31 日
注册资本	299.598 万元
实收资本	299.598 万元
注册地和主要生产经营地	江阴市华士镇工业园共臻路南侧
主营业务	原从事晶片的生产
子公司定位	原为发行人原材料晶片的生产基地之一，注销清算过程中主要设备迁至湖州鸿皓
股权结构	湖州鸿皓持股 100%